

科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



长鑫科技集团股份有限公司

CXMT Corporation

（安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（注册稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）



北京市朝阳区建国门外大街 1 号
国贸大厦 2 座 27 层及 28 层



北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

声明

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

（一）增强公司研发创新能力，加快技术迭代和产品布局的完善

自设立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。DRAM 行业技术迭代快，目前 DDR5 和 LPDDR5/5X 等产品正加速渗透下游市场，技术和产品先发优势、持续的研发投入以及高效的技术迭代能力对于公司构建市场竞争力至关重要。同时，集成电路又是典型的人才密集型行业，吸引、留住高端人才是行业和公司持续发展的先决条件。本次发行上市一方面能够通过募集资金有效增强公司持续研发投入的能力，另一方面能够提升自身品牌影响力，吸引全球顶尖人才加入公司，增强公司研发团队技术创新能力。

（二）加快公司产能建设和升级，增强公司市场竞争力和盈利能力

公司产能规模已位居中国第一、全球第四，但距离 DRAM 行业前三家国际头部厂商仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求。随着本次上市募集资金建设项目的稳步推进，公司将加速工艺升级，从而实现更低的单位成本，更强的市场竞争力及盈利能力，更有效地满足未来全球下游市场旺盛的需求，助力公司在全球 DRAM 市场中占据更有利的地位。

（三）把握广阔的市场成长空间，加快市场拓展并推动产业发展

集成电路是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。DRAM 作为集成电路产业发展的战略基础性产品，是数字经济时代的核心芯片之一，也是国家信息基础设施战略安全的重要基石。我国是全球主要 DRAM 消费市场，但本土品牌 DRAM 产品自给率仍较低，未来发展空间广阔。

经过多年发展，公司突破了 DRAM 关键核心技术并顺利实现产品自主研发、设计和商业化量产，填补了中国大陆 DRAM 产品在全球市场上的长期空白。本次发行上市能够有效加速公司产能规模的建设、工艺技术的升级、产品布局的完善和产品性能的优化，增强公司对庞大市场需求的供给保障能力，助力我国信息基础设施建设和新质生产

力发展，为保障国家信息及产业安全和构建国家现代化产业体系贡献力量。

作为我国 DRAM 产业龙头，本次发行上市不仅能够促进公司自身高质量发展，也能够有效带动“存储芯片设计企业、EDA 厂商、半导体材料厂商、半导体设备及零部件厂商、模组厂商及下游终端应用厂商”等产业链核心环节的相关企业协同发展，进一步提升我国集成电路产业链综合实力，推动我国集成电路产业朝着更高水平迈进。

（四）完善公司治理并持续提升核心竞争力，持续为股东创造长期价值

报告期内，公司凭借不断优化的产品结构、持续迭代的工艺水平、日臻成熟的运营能力以及广泛的市场认可，营业收入持续增长，净亏损幅度快速收窄并于 2025 年实现盈利。本次发行上市完成后，公司将借助上市平台和更完善的治理结构，进一步发挥公司技术、产品、市场和组织管理优势，持续提升核心竞争力，为公司股东创造长期价值回报。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

自成立以来，公司始终致力于建立健全现代企业制度。自整体变更为股份公司以来，公司已建立了由股东会、董事会（包括独立董事）、各专门委员会和经营管理层组成的治理结构，并分别制定了相关议事规则，规定了独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了满足《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件要求的现代企业制度。同时，公司立足长期可持续发展，制定了明确的利润分配计划和股东回报规划，切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

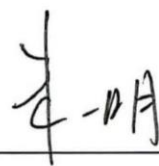
本次发行的募集资金使用将围绕公司主营业务展开，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究及开发项目，系基于业务发展阶段特点和技术研发创新要求对公司现有业务进行的扩充和延伸，是公司进一步提高技术与研发实力的必然要求，也是公司持续深化工艺技术开发与积累、不断开拓前沿技术、提升核心竞争力的重要举措。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司自设立以来一直致力于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，现已发展成为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。公司已具备一定的规模效应并持续进行技术迭代和产能建设，同时通过不断创新的自主研发保持技术持续领先。公司业务发展前景良好，财务健康，具有较强的持续经营能力。

公司将秉持“以存储科技赋能信息社会，改善人类生活”的使命，坚持高水平技术研发，持续积累并开拓工艺和产品技术，夯实核心技术根基，加速产能布局建设，拓展多元化产品组合，不断强化人才梯队与运营管理体系，并最终实现“成为技术领先与商业成功的半导体存储公司”的发展愿景。

董事长签字：


朱一明



本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前），占公司发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行不存在公司股东公开发售股票的情形。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票的数量不超过本次发行股票数量的 15%
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 7,081,505.7468 万股（行使超额配售选择权之前）
保荐机构（主承销商）	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

声明	1
致投资者的声明	2
一、发行人上市的目的	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况	3
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划	3
四、发行人持续经营能力及未来发展规划	4
本次发行概况	5
目 录	6
第一节 释义	10
一、一般释义	10
二、专业释义	14
第二节 概览	17
一、重大事项提示	17
二、发行人及中介机构情况	22
三、本次发行概况	23
四、发行人主营业务情况	25
五、发行人符合科创板定位	27
六、发行人主要财务数据及财务指标	28
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况	28
八、发行人选择的具体上市标准	31
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项	31
十、募集资金运用与未来发展规划	31
十一、其他对发行人有重大影响的事项	31
第三节 风险因素	32
一、与发行人相关的风险	32
二、与行业相关的风险	35
三、其他风险	36
第四节 发行人基本情况	37

一、发行人基本情况.....	37
二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.....	37
三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）	59
四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.....	59
五、发行人的股权结构.....	59
六、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况.....	59
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	78
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.....	82
九、发行人协议控制架构的情况.....	82
十、发行人股本情况.....	82
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.....	93
十二、发行人的股权激励和其他制度安排和执行情况.....	107
十三、发行人员工及其社会保障情况.....	115
第五节 业务与技术	117
一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.....	117
二、发行人所处行业基本情况和竞争情况.....	127
三、发行人的行业地位及竞争优势.....	146
四、发行人销售情况和主要客户.....	152
五、发行人采购情况和主要供应商.....	154
六、发行人主要固定资产和无形资产.....	156
七、发行人特许经营及取得的相关资质.....	161
八、发行人的核心技术与研发情况.....	162
九、发行人安全生产及环境保护情况.....	170
十、发行人境外经营情况.....	171
第六节 财务会计信息与管理层分析	172
一、财务报表.....	172
二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项.....	177
三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.....	179
四、财务报表编制基础和财务报表合并范围.....	180
五、重要会计政策和会计估计.....	181

六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.....	206
七、主要税种、税率和税收优惠.....	207
八、发行人的主要财务指标.....	212
九、经营成果分析.....	213
十、资产质量分析.....	236
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	254
十二、重大资本性支出、重大资产业务重组等事项.....	268
十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.....	268
十四、盈利预测报告.....	268
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.....	268
第七节 募集资金运用与未来发展规划	272
一、募集资金运用概况.....	272
二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性.....	273
三、发行人未来发展规划.....	276
第八节 公司治理与独立性	279
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....	279
二、内部控制情况.....	279
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.....	280
四、发行人主要股东及其控制的其他企业占用发行人资金及发行人人为其提供担保情况.....	280
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.....	280
六、同业竞争情况.....	282
七、关联方和关联关系.....	282
八、关联交易.....	286
第九节 投资者保护	295
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....	295
二、发行人股利分配政策.....	295
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或累计未弥补亏损	

的情况及投资者保护措施.....	299
第十节 其他重要事项	300
一、重大合同.....	300
二、对外担保.....	302
三、重大诉讼或仲裁.....	302
第十一节 声明	303
一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....	303
二、发行人第一大股东声明.....	305
三、保荐人（主承销商）声明.....	306
三、保荐人（主承销商）声明.....	309
四、发行人律师声明.....	311
五、会计师事务所声明.....	312
六、验资会计师事务所声明.....	313
七、评估机构声明.....	314
第十二节 附件	315
一、备查文件.....	315
二、备查地点及备查时间.....	315
三、申报前十二个月新增股东的基本情况.....	316
四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....	318
五、与投资者保护相关的承诺.....	321
六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.....	343
七、股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	346
八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....	347
九、公司无形资产情况.....	349
十、员工持股平台.....	363
十一、募集资金运用具体情况.....	369

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

一、一般释义

长鑫科技、公司、发行人	指	长鑫科技集团股份有限公司
睿力集成	指	睿力集成电路有限公司，发行人前身
合肥智聚	指	合肥智聚集成电路有限公司，发行人前身
集团公司	指	公司及其合并报表范围内的控股子公司及分支机构
长鑫存储	指	长鑫存储技术有限公司
长鑫新桥	指	长鑫新桥存储技术有限公司
长鑫集电	指	长鑫集电（北京）存储技术有限公司
长鑫香港	指	长鑫存储技术（香港）有限公司
长鑫科服	指	合肥长鑫科技服务有限公司
久芯科技	指	北京久芯科技有限公司
长鑫日本	指	ChangXin Memory Technologies ジャパン株式会社
长鑫西安	指	长鑫存储技术（西安）有限公司
长鑫芯聚	指	长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司
启航鑫睿	指	安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司
长鑫芯元	指	长鑫芯元股权投资（安徽）有限公司
长鑫科技合肥	指	长鑫存储科技（合肥）有限公司
长鑫产品合肥	指	长鑫存储产品（合肥）有限公司
长鑫集电科技	指	长鑫集电科技（北京）有限公司
长鑫集电半导体	指	长鑫集电半导体（北京）有限公司
长鑫闵科	指	长鑫闵科存储技术（上海）有限公司
安徽新一代	指	安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）
启航创芯	指	合肥启航创芯基金合伙企业（有限合伙）
长鑫芯达	指	长鑫芯达企业管理（合肥）有限公司
长鑫芯安	指	长鑫芯安（合肥）企业管理合伙企业（有限合伙）
长鑫深芯	指	长鑫深芯科技（深圳）有限公司
长鑫芯瑞	指	长鑫芯瑞存储技术（北京）有限公司
长鑫汇芯	指	长鑫汇芯贸易（合肥）有限公司
长鑫汇芯北京	指	长鑫汇芯贸易（北京）有限公司
合肥才聚	指	合肥才聚科技有限公司

长鑫集成	指	合肥长鑫集成电路有限责任公司
芯睿投资	指	合肥芯睿投资有限责任公司
清辉集电、石溪集电	指	合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）及其前身合肥石溪集电企业管理合伙企业（有限合伙）
清辉长鑫	指	合肥清辉长鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
合肥集鑫	指	合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
三重一创	指	安徽省三重一创产业发展基金有限公司
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司
建银国际	指	建银国际（深圳）投资有限公司
农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
国寿投资	指	国寿投资保险资产管理有限公司，原名为国寿投资控股有限公司
招银云亭	指	深圳市招银云亭成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
招证投资	指	招商证券投资有限公司
中安招商基金	指	池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽交控	指	安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）
海通徽银	指	合肥市海通徽银股权投资合伙企业（有限合伙）
天津海河	指	天津海河融泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中金共赢	指	中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖北小米	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
北京君联	指	北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽省投	指	安徽省投资集团控股有限公司
芜湖星原	指	芜湖星原基石股权投资合伙企业（有限合伙）
国调基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
碧桂园创投	指	海口市碧桂园创投科技有限公司
宁波燕创	指	宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
安徽担保集团	指	安徽省信用融资担保集团有限公司
安华创新	指	安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）
安元星亿达	指	安徽安元星亿达投资基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴恒旭	指	嘉兴恒旭隼睿股权投资合伙企业（有限合伙）
美的投资	指	美的投资有限公司
青岛朗格	指	青岛朗格数科产业投资基金合伙企业（有限合伙）
东方资管	指	中国东方资产管理股份有限公司
人保科创	指	人保科创股权投资基金（上海）中心（有限合伙）

建信领航	指	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）
中邮人寿	指	中邮人寿保险股份有限公司
华芯科泰	指	合肥华芯科泰集成电路投资合伙企业（有限合伙）
阳光人寿	指	阳光人寿保险股份有限公司
云锋卓越	指	海南云锋卓越私募股权投资基金中心（有限合伙）
前海方舟	指	焦作前海方舟半导体投资基金合伙企业（有限合伙）
星棋道和	指	宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）
人保资本	指	人保资本保险资产管理有限公司
宁波君和	指	宁波君和同诚股权投资合伙企业（有限合伙）
北京峰益	指	北京峰益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
和谐健康	指	和谐健康保险股份有限公司
阿里网络	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
鑫芯家园	指	广东鑫芯家园股权投资合伙企业（有限合伙）
鑫芯励润	指	合肥鑫芯励润科技合伙企业（有限合伙）
Gamcier	指	Gamcier Pte Ltd
Glades View	指	Glades View Investment Pte. Ltd
深圳投控	指	深圳投控芯辰私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
芯鑫集电	指	合肥芯鑫集电股权投资合伙企业（有限合伙）
建银皖江	指	安徽省江皖企业管理服务有限公司，曾用名：建银皖江产业基金管理（安徽）有限公司
安徽担保资管	指	安徽担保资产管理有限公司
汇碧五号	指	佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙）
产投壹号	指	合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
广州科集	指	广州科集企业管理合伙企业（有限合伙）
工融金投	指	工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中银资产	指	中银金融资产投资有限公司
交银金融	指	交银金融资产投资有限公司
建信投资	指	建信金融资产投资有限公司
和壮高新	指	安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）
中建材新材料基金	指	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
产投高成长	指	合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥建长	指	合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）
君挚璞创投	指	上海君挚璞创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙））
广州信德	指	广州信德鑫成科技投资合伙企业（有限合伙）

阿里云计算	指	浙江阿里巴巴云计算有限公司
合肥产投	指	合肥市产业投资控股（集团）有限公司
启航恒鑫	指	合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）
鑫益合升	指	合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）
亦庄科技	指	北京亦庄科技有限公司
屹唐科技	指	北京屹唐科技有限公司
亦庄国投	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
合肥沛顿	指	合肥沛顿存储科技有限公司
合肥鑫丰	指	合肥鑫丰科技有限公司
兆易创新集团	指	兆易创新科技集团股份有限公司、合肥格易集成电路有限公司、珠海横琴芯存半导体有限公司、上海格易电子有限公司、Gigadevice Semiconductor Singapore PTE. LTD.、Gigadevice Semiconductor（HK） LTD.、北京青耘科技有限公司
海恒控股	指	合肥海恒控股集团有限公司
华卓精科	指	北京华卓精科科技股份有限公司
长虹美菱	指	长虹美菱股份有限公司
泽丰半导体	指	上海泽丰半导体科技有限公司
上扬软件	指	上扬软件（上海）有限公司
中电科	指	中电科数字技术股份有限公司
安徽合力叉车	指	安徽合力叉车销售有限公司
三星电子	指	Samsung Electronics Co., Ltd.
SK 海力士	指	Sk Hynix Inc.
美光科技	指	Micron Technology, Inc.
南亚科技	指	南亚科技股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
华邦电子	指	华邦电子股份有限公司
力积电	指	力晶积成电子制造股份有限公司
保荐人、保荐机构、联席保荐人、联席保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
锦天城、发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
德勤、发行人会计师	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股

本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期、报告期各期	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年度
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日
招股说明书	指	发行人为本次发行上市制作的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》
上市保荐书	指	保荐机构出具的《关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《长鑫科技集团股份有限公司章程（草案）》，于 2025 年 9 月 25 日经发行人 2025 年第三次临时股东大会会议审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市挂牌交易之日起生效
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》
《证券投资基金法》	指	《中华人民共和国证券投资基金法（2015 年修正）》
《私募基金管理办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
合肥市场监管局	指	合肥市市场监督管理局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国法律、行政法规、地方性法规、部门规章以及规范性文件
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，上下文另有说明的除外

二、专业释义

存储芯片	指	存储芯片是半导体存储器，用于在电子设备中保存和读取数据，分为易失型存储和非易失型存储
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器，是一种半导体存储器，需要周期性刷新以维持其存储的数据
DDR	指	Double Data Rate，即双倍速率同步动态随机存储器，指数据传输速度为系统时钟频率的两倍。DDR、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5 分别代表不同代际的 DDR 技术
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate，即低功耗双倍速率同步动态随机存储器，以低功耗和小体积著称，主要用于移动式电子产品；LPDDR4/4X、LPDDR5/5X、LPDDR6 分别代表不同代际的 LPDDR 技术

GDDR	指	Graphics Double Data Rate, 图形双倍速率同步动态随机存储器, 主要用于图像处理领域
bit	指	Binary Digit, 即比特, 是现代计算机系统中表示信息的最小单位
Byte	指	字节, 是计算机技术中一种数据计量单位, 1Byte=8bit, 常用于表示内存容量
Gb、GB、ZB	指	为计算机存储容量单位, Gb 指 Gigabit, GB 指 Giga Byte, ZB 指 Zetta Byte, 1GB=8Gb, ZB=1024 ⁴ GB
MGB	指	MGB 指 Million GB, 1MGB=10 ⁶ GB
Mbps	指	衡量数据交换能力的单位, 1Mbps 代表每秒传输 1 兆位 (即 1,000,000 比特)
Die	指	由晶圆厂流片生产出来、具有复杂电路功能的单体芯片, 经过封测后进一步形成芯片产品。在生产过程中常被称为“裸片”
ECC	指	错误检查和纠正 (Error Checking and Correction) 或错误校正编码 (Error Correction Coding), 是一种用于检测和修正数据传输或存储过程中产生的错误的算法
DIMM	指	Dual-Inline-Memory-Module, 即双列直插内存模组, DRAM 内存模组的主流规格之一, 俗称“内存条”
RDIMM	指	Registered DIMM, 即寄存式双列直插内存模组, 采用了特定芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组, 主要应用于服务器
UDIMM	指	Unbuffered DIMM, 即无缓冲双列直插内存模组, 指地址和控制信号不经缓冲器, 无需做任何时序调整的内存模组, 主要应用于台式机
SODIMM	指	Small Outline DIMM, 即小型双列直插内存模组, 主要应用于笔记本电脑
MRDIMM	指	Multiplexed Rank DIMM, 即多路复用双列直插内存模组, 是一种更高带宽的服务器内存模组
LPCAMM	指	Low Power Compression Attached Memory Module, 是一种新型的内存模组标准, 结合了 LPDDR 内存的低功耗特性与 CAMM 模组 (一种新型内存模组标准, 采用 LPDDR5X 内存颗粒, 通过优化模组布局和使用更紧凑的连接器的实现更轻薄尺寸、更高容量、更低功耗和更优散热性能) 的紧凑设计, 旨在为轻薄笔记本、移动工作站等设备提供高性能、低功耗且可升级的内存解决方案
CXL	指	Compute Express Link, 是一种开放性的互联协议标准, 该标准于 2019 年推出, 旨在提供 CPU 和专用加速器、高性能存储系统之间的高效、高速、低延时接口, 以满足资源共享、内存池化和高效运算调度的需求
JEDEC	指	Joint Electron Device Engineering Council, 即 JEDEC 固态技术协会, 成立于 1958 年, 是全球微电子产业的权威标准化机构, 负责制定 DRAM 产品的全球行业标准和规范
IDM	指	Integrated Device Manufacturer, 指垂直整合制造工厂, 是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商, 属于半导体行业的一种业务模式
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计企业, 只从事芯片的设计和制造, 将晶圆制造、封装和测试等步骤分别委托给专业厂商完成
Bank Group	指	存储库组, 即芯片中用于组织和管理存储单元的基本结构单元, 常用于 DRAM 芯片中以提高存储器的效率和访问速度

Row Hammer	指	一种安全漏洞，依赖于相邻内存单元之间的电荷泄漏，使威胁行为者能够翻转 1 和 0 并更改内存中的内容，这种现象被称为比特翻转（Bit Flips），可被利用获取更高的权限
RDL	指	Redistribution Layer，即重布线技术，通过晶圆级金属布线制程和凸块制程改变其 I/O 接点位置，达到线路重新分布的目的，广泛用于半导体先进封装
DVFS	指	动态电压频率调整（Dynamic Voltage and Frequency Scaling），是根据芯片所运行的应用程序对计算能力的不同需要，动态调节芯片的运行频率和电压（对于同一芯片，频率越高，需要的电压也越高），从而达到节能的目的
DFT	指	Design For Test，即芯片进行可测性设计，是指在芯片设计过程中保证功能的前提下，加入特殊的测试结构，芯片制造完成后进行测试，在制造或者封装过程中若有瑕疵，芯片不能正常工作

本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本招股说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果在尾数上略有不同。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）特别风险提示

公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容。

1、存在累计未弥补亏损的风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计亏损为-3,665,042.11 万元，最近一年末存在累计未弥补亏损的主要原因系：（1）DRAM 行业具有规模导向属性。为增强产品的市场占有率和竞争力，公司需要持续提升产能规模，而厂房及产线建设等需要高额的固定资产投资，对应固定资产折旧金额较大。报告期内，公司处于产能快速爬坡阶段，产线持续建设并不断升级，相关资产转固后产生的折旧等固定成本较高且金额持续增加。虽然公司于 2024 年息税折旧摊销前利润转正，但新增产能带来的规模效应尚未完全显现；（2）DRAM 行业具有极高的技术门槛，公司持续进行产品和工艺技术的研发迭代，以尽快实现对国际先进水平的追赶、提升产品竞争力并满足市场需求，报告期内研发投入持续增加。

公司未来几年内持续扩产及投入研发带来的折旧及摊销、研发支出等在短期内仍将给公司利润带来压力，如果未来公司出现产品研发及市场化不及预期、规模效应释放不及预期等情况，将可能导致公司持续处于存在未弥补亏损的状态，对公司的盈利能力带来一定不利影响，并导致短期内无法向股东进行现金分红。

2、人工智能发展是驱动本轮 DRAM 行情的重要因素之一，未来其带来的 DRAM 市场需求存在不确定性

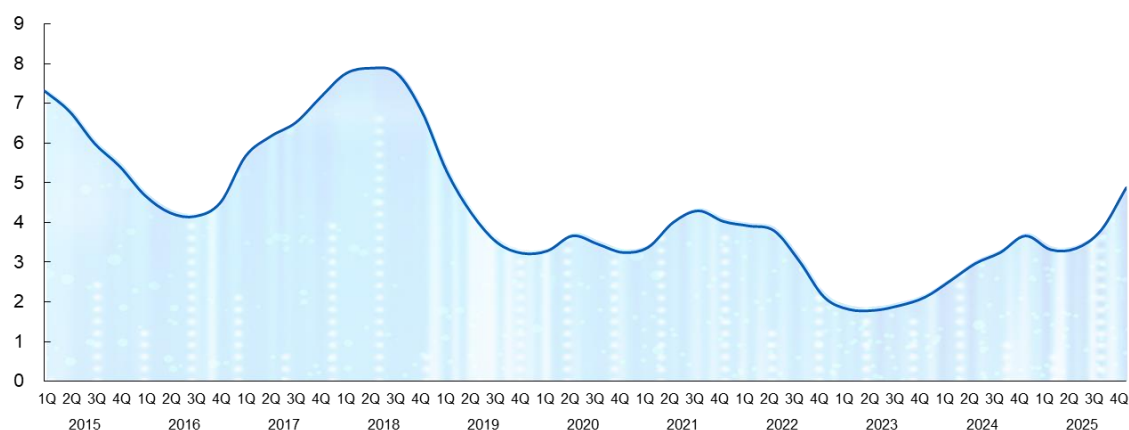
DRAM 是人工智能算力系统的核心枢纽，随着人工智能快速发展，相关基础设施投资高速增长。2025 年下半年以来，受人工智能发展带来的 DRAM 需求增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，带动 DRAM 产品价格上涨，是 2025 年下半年以来公司业绩增长的主要原因之一。

当前人工智能产业正处于基础设施集中投资建设期,但其商业化应用仍处于持续拓展过程中,公司报告期内相关领域内的收入占比相对较低。倘若未来人工智能规模化应用落地不及预期或头部云厂商资本开支节奏放缓,可能会对 DRAM 市场未来需求增长带来不利影响;同时,伴随人工智能模型算法持续优化,存算一体、片上缓存等新型硬件架构与技术方案也在持续探索中。前述技术路线若实现大规模产业化应用,可能改变现有以云端 GPU/AI 加速卡集群搭配 DRAM 的主流算力部署方式,削弱人工智能对 DRAM 市场的驱动作用。当前全球主要 DRAM 厂商均在积极进行技术升级和扩充产能,后续若人工智能对 DRAM 需求不及预期,叠加新产能的释放,或将导致供过于求,进而致使公司业绩下行。

3、宏观经济波动和行业周期性导致公司产品销售价格及经营业绩波动的风险

DRAM 行业受市场供需波动的影响较大,具有周期性特征,同时,宏观经济波动、高行业集中度下主要厂商的产能调控策略等因素进一步加剧了行业周期性波动。2015 年-2025 年间,DRAM 产品价格最高达到 7.89 美元/GB,2023 年上半年的最低点为 1.78 美元/GB,DRAM 市场价格呈现大幅波动。

2015-2025 年 DRAM 市场价格 (美元/GB)



数据来源: Omdia

报告期各期,公司归属于母公司股东的净利润分别为-1,633,977.72 万元、-714,488.72 万元和 187,485.94 万元,经营业绩的波动一方面得益于规模效应逐步释放及精益生产管理,另一方面受行业周期影响较大。2022 年至 2023 年上半年,受上游 DRAM 产品库存水平较高、下游市场需求低迷的影响,DRAM 行业处于深度下行周期,DRAM 产品

的销售价格大幅下滑，价格低点较 2022 年上半年高点下降 50%左右，该轮行业周期内，行业内企业出现普遍性亏损情况。下行周期会对公司产品价格和经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司主要的 DRAM 产品销售单价在行业周期的影响下波动较大，2024 年和 2025 年，公司主要 DRAM 产品销售单价的同比变动幅度分别为 55.08%和 33.69%。2025 年下半年，受人工智能发展带来的 DRAM 需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，成为公司产品单价和毛利率提升以及业绩增长的重要原因之一，但未来人工智能发展对 DRAM 市场需求存在不确定性。未来，如果宏观经济发生不利变化、人工智能下游需求不及预期、市场供需关系发生较大变化，可能导致 DRAM 行业再次进入下行周期，可能导致公司产品价格出现大幅下跌，业绩出现大幅下滑乃至亏损，2026 年上半年的业绩大幅增长的情况存在不可持续的风险。

4、固定资产投资及折旧金额较大的风险

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 8,445,207.29 万元、15,313,201.60 万元和 18,302,398.79 万元，占期末资产总额的比例分别为 43.81%、56.38%和 54.34%，占比较高且金额持续增加。报告期内各期计提固定资产折旧额分别为 1,055,525.26 万元、1,487,543.58 万元、2,468,025.21 万元，呈现上升趋势。公司还在进行持续产能建设，固定资产账面价值预计将进一步增加，其产生的大额折旧将在折旧期限内对公司业绩带来一定影响。同时，公司固定资产可能由于发生毁损、技术升级迭代或路线变化等原因，出现固定资产减值的风险，并对公司的经营业绩产生不利影响。

5、存货跌价风险

报告期内，随着销售规模的稳步增长，公司各期末原材料、在产品及产成品的存货余额亦呈增长趋势，各期末存货余额分别为 1,418,047.50 万元、2,121,450.87 万元和 2,938,989.52 万元，各期末计提的存货跌价准备分别为 344,429.77 万元、266,497.91 万元和 82,220.84 万元。集成电路行业存在周期特征，宏观经济、行业景气度以及产能周期等因素均会对行业产生重要影响，报告期各期，公司存货跌价损失分别为-1,150,021.06 万元、-182,688.41 万元和-47,314.97 万元，受 DRAM 行业周期的影响较大，尤其是 2023 年，DRAM 行业周期下行带来存货跌价损失计提大幅增加。未来，如果行业周期、市场需求或公司产品的市场价格发生变化，使得部分存货的售价不能覆盖成本，公司将面临存货跌价增加的风险，进而对公司资产价值及盈利能力产生不利影响。

6、国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险

经过多年发展，半导体产业链已形成高度专业化和高效协同的全球分工体系，但当前地缘政治冲突正加速产业链重构。尽管公司自成立以来始终坚持市场化运营，自觉遵守国际间有关进出口相关规则 and 规定，但如短期内相关国家进一步加强限制政策，可能导致公司面临产业链不稳定的风险，进而对公司的生产和经营活动造成一定不利影响。

7、产品及技术研发不达预期的风险

DRAM 行业属技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，产品终端应用场景丰富，产品升级和迭代速度较快。DRAM 行业的技术含量较高，需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践，研发周期较长。多年来，公司坚持自主研发的道路，通过研发与创新形成了现有核心技术平台。若公司研发方向与市场需求出现偏差、新产品技术性能落后于竞争对手或技术研发和产品升级不及预期，导致公司未来不能紧跟行业前沿和市场需求，则可能对公司未来的经营带来不利影响。

8、无控股股东和实际控制人的风险

根据公司股权结构，直接持有公司 5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，分别持有长鑫科技 21.67%、11.71%、8.73%、8.37% 及 7.91%的股权，不存在单一持股比例超过 50%的股东，公司的股权结构较为分散。其中，公司第一大股东清辉集电系无实际控制人结构。根据公司董事会构成，公司董事会由 11 名成员构成，其中独立董事 4 名。7 名非独立董事中，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

由于公司无控股股东和实际控制人，可能会出现股东或董事意见不一致导致决策效率较低从而错失发展机遇的风险。同时，公司的股权结构相对分散，存在上市后控制权发生变动的可能性，从而给公司经营和发展稳定带来潜在的风险。

9、募投项目新增费用及折旧摊销影响公司经营业绩的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建设期间，公司新增相关费用投入；本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产的投入将导致相应的折旧、摊销费用增加，对发行人各年度经营业绩有直接影响。由于募投项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种不确定性，若未来发行人所处市场环境等因素发生

重大不利变化，导致募集资金投资项目无法实现预计效益，则前述新增的折旧摊销、期间费用等可能影响公司利润，从而导致未来经营业绩存在下降的风险。

10、对重要子公司长鑫新桥和长鑫集电持股比例较低的风险

截至本招股说明书签署日，长鑫新桥、长鑫集电为发行人重要子公司。发行人及子企业直接持有长鑫新桥 30.68%的股权，并通过与鑫益合升、合肥产投一致行动协议控制长鑫新桥 42.33%的表决权，合计控制长鑫新桥 73.01%的表决权，可以控制长鑫新桥。发行人直接持有长鑫集电 31.72%的股权，并通过与屹唐科技、亦庄科技、亦庄国投一致行动协议控制长鑫集电 43.60%的表决权，合计控制长鑫集电 75.32%的表决权，可以控制长鑫集电。上述长鑫新桥、长鑫集电少数股东与发行人及子企业签署的一致行动协议长期有效。若一致行动协议的有效履行情况在未来发生不利变化，导致发行人实际控制长鑫新桥、长鑫集电的表决权比例下降，发行人对长鑫新桥、长鑫集电控制的稳定性可能存在一定风险，会对公司业务开展及经营管理造成不利影响。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司提示投资者认真阅读公司、相关股东、董事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施。

发行人第一大股东清辉集电已作出关于业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。前述“届时所持股份”分别指本企业在发行人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。

具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”和“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（三）本次发行前滚存利润的分配安排、发行后股利分配政策

经公司上市相关股东会决议通过：公司本次发行上市前可根据股东会决议进行利润分配，留存的滚存未分配利润（累计未弥补亏损）全部由公司本次发行上市后的新老股

东按上市后的持股比例共同享有（承担）。

公司提示投资者关注公司本次发行上市后的股利分配政策、上市后三年分红回报规划，具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”。

（四）公司董事长关于未来员工激励事项的安排

朱一明通过持有合肥集鑫上层合伙人合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）的份额，获授予 1,535,841,835 股长鑫科技的激励股份。作为公司创始人和董事长，朱一明秉持长期主义原则，为进一步激发公司员工的科技创新和创业热情，推动长鑫科技高质量发展，自愿将其持有的合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额中的 50%（对应公司当前股本的 767,920,918 股长鑫科技股份，以下简称“目标激励股份”）未来分配给长鑫科技及其并表子企业员工用于激励（激励对象不包含朱一明本人），并计划自公司首次公开发行并上市满 36 个月后的 5 个自然年度内完成 50% 目标激励股份的授予或减持收益分配，自公司首次公开发行并上市满 36 个月后的 10 个自然年度内完成剩余目标激励股份的授予或减持收益分配。

该目标激励股份未来分配安排的实施过程不会新增发行公司股份及稀释上市后新老股东权益。未来激励对象（即员工）所支付行权价款在扣除认购目标激励股份的出资成本、税务成本及资金成本后将全部无偿交付给公司；目标激励股份未来减持收益在扣除出资成本、税务成本及资金成本后将专项用于公司员工激励。

未来，公司将根据目标激励股份授予或减持收益分配时股票公允价值、员工授予价格及约定服务期限等确认相关期间股份支付费用，可能会对公司未来期间经营业绩产生影响。

二、发行人及中介机构情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	长鑫科技集团股份有限公司	成立日期	2016 年 6 月 13 日
注册资本	6,019,279.7469 万元人民币	法定代表人	赵纶
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号	主要生产经营地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号
控股股东	无	实际控制人	无
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司		
主承销商	中国国际金融股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司	发行人律师	上海市锦天城律师事务所
审计机构	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	资产评估机构	中水致远资产评估有限公司
保荐人律师	上海市通力律师事务所、 北京市通商律师事务所	保荐人会计师	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、 证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经 办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其 他利益关系		1、截至2025年12月31日，保荐人中金公司的全资子公司中金资本运营有限公司是中金共赢的执行事务合伙人，而中金共赢直接持有发行人19,041.98万股股份，占发行人股份总数的0.32%；中金资本运营有限公司是中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）是北京君联的有限合伙人，持有其1.99%的合伙份额，而北京君联直接持有发行人11,774.27万股股份，占发行人股份总数的0.20%；中金公司及其下属企业间接持有发行人股东华芯科泰合伙企业份额，逐层穿透后通过华芯科泰间接持有的发行人股份比例合计为0.0007%。综上，中金公司及中金共赢、中金启融的合计持股比例为0.32%。	
		2、截至2025年12月31日，保荐人中信建投的全资子公司中信建投投资有限公司是合肥水木鑫欣向荣股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有其26.57%的合伙份额，合肥水木鑫欣向荣股权投资基金（有限合伙）是鑫芯励润的有限合伙人，持有其52.34%的合伙份额，而鑫芯励润直接持有发行人63,977.53万股股份，占发行人股份总数的1.06%，逐层穿透后间接持有的发行人股份比例合计为0.15%。除前述情况外，发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接股权关系或其他权益关系。	
(三) 本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

(一) 本次发行基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	本次公开发行不超过1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	本次公开发行不超过	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超

	1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前）		额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 7,081,505.7468 万股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份总数计算）	发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前已发行股份总数计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后已发行股份总数计算）	发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后已发行股份总数计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	根据询价后确定的价格乘以发行股数确定		
募集资金净额	由募集资金总额扣除发行费用后确定		
募集资金投资项目	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目		
	DRAM 存储器技术升级项目		
	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中： （1）承销费及保荐费【】万元 （2）审计、验资费【】万元 （3）律师费【】万元 （4）评估费【】万元 （5）其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行的新股，发行人将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行上市战略配售，具体按照交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行上市战略配售的具体方案，并按规定向交易所提交相关文件		

拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
(二) 本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务情况

(一) 主要业务、主要产品或服务

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 的产品覆盖和迭代，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。

公司积极把握行业发展趋势，持续进行产品迭代，现已形成 DDR 系列、LPDDR 系列等多元化产品布局，并可提供 DRAM 晶圆、DRAM 芯片、DRAM 模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。公司在合肥、北京两地共拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂，根据 Omdia 的数据，按照产能、出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。公司高度重视自主研发和创新，在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了全面、完善的核心技术体系，主要核心技术已达到国际先进水平，并形成了丰富的自主知识产权。目前，公司已积累了广泛的优质客户资源，并与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发展的产业生态。

(二) 主要原材料与重要供应商

报告期内，公司生产经营使用的主要原材料包括化学品、光阻剂、硅片、气体、靶材、备件及其他等。重要供应商详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人采购情况和主要供应商”。

（三）主要生产模式

在晶圆制造环节，公司根据客户订单、市场预测和自身的产能工艺情况制定生产计划，生产过程中实行严格的制程控制与良率管理，通过前后道工序、工艺的协同配合，实现 DRAM 产品的稳定量产与快速交付。产品生产过程可分为制定生产计划、编制作业计划、作业准备确认及生产执行、过程监控与控制、晶圆产出入库等环节。

在芯片封装及成品测试环节，公司在技术自主研发的基础上，采用委外生产模式，即将封装环节委托给封测厂商外协生产。对于测试业务，公司在技术自主研发的基础上，采用自主测试为主，委外测试为辅的生产模式，一部分测试业务由全资子公司长鑫产品合肥完成，一部分测试委托封测厂商外协生产。

在模组加工及测试环节，在技术自主研发的基础上，采用自主加工测试和委外加工测试相结合的生产模式，模组加工及测试业务一部分由全资子公司长鑫产品合肥完成，一部分委托模组厂商外协完成。

详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及服务情况”之“（二）发行人的主要经营模式”。

（四）主要销售方式及重要客户

报告期内，公司采取经销和直销相结合的销售模式，公司经销模式为买断式销售，经销模式是公司主要的销售模式之一。经销商可以帮助公司快速地建立销售渠道、扩大市场份额，实现产品和资金的较快周转，提升公司的运作效率和响应速度。报告期内，公司的前五大客户主要为行业知名经销商及下游应用领域的头部大型厂商等，且较为稳定，不存在向单个客户销售比例超过营业收入 50%或严重依赖少数客户的情况。详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人销售情况和主要客户”。

（五）行业竞争情况及发行人的竞争地位

DRAM 行业具有极高的技术与资金门槛，已形成一定规模的领先企业可通过规模效应降低成本，巩固已有优势。受此行业特性的影响，DRAM 行业自 20 世纪 80 年代发展初期的数十家企业，发展到目前全球主要生产厂商包括三星电子、SK 海力士、美光科技及长鑫科技等。

根据 Omdia 的数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在

全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96%、34.48%和 23.41%，上述三家企业合计占全球 DRAM 市场 90%以上的市场份额。

近年来，国产 DRAM 厂商里长鑫科技正逐步进入主要厂商阵营。基于 Omdia 数据测算，按 2025 年第四季度 DRAM 销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至 7.67%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。

除前述厂商外，其他占有一定市场份额的厂商主要集中在中国台湾，包括南亚科技、华邦电子、力积电等。中国大陆亦有其他半导体企业布局 DRAM 业务，但多专注于芯片设计。

五、发行人符合科创板定位

（一）发行人符合科技创新行业领域要求

发 行 人 所 属 行 业 领 域	☒ 新一代信息技术	公司主要从事 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，是中国领先的 DRAM 研发设计制造一体化企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为“制造业”（C）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（39）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024 年 4 月修订），公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

（二）发行人符合科创属性相关指标要求

科创属性评价指标	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	☒ 是 ☐ 否	2023 年至 2025 年，公司研发投入分别为 467,047.07 万元、634,129.13 万元、959,325.46 万元，合计研发投入金额 2,060,501.67 万元，超过 8,000 万元；发行人最近 3 年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 21.67%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员为 6,259 人，员工总数为 19,298 人，公司研发人员占比达到 32.43%，研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有境内专利 3,929 件（其中发明专利 3,165 件）、境外专利 3,043 件，并广泛应用于公司主营业务，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	☒ 是 ☐ 否	2023 年至 2025 年，公司营业收入复合增长率为 160.78%，超过 25%；公司 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，超过 3 亿元

六、发行人主要财务数据及财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
资产总额（万元）	33,678,492.22	27,159,883.10	19,275,633.28
归属于母公司所有者权益（万元）	5,675,370.42	4,141,966.16	3,559,534.99
资产负债率（合并）	54.24%	61.61%	66.22%
资产负债率（母公司）	21.82%	10.26%	8.69%
营业收入（万元）	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
净利润（万元）	714,423.71	-905,100.04	-1,922,488.63
归属于母公司所有者的净利润（万元）	187,485.94	-714,488.72	-1,633,977.72
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	531,588.62	-787,003.23	-1,675,200.38
基本每股收益（元）	0.03	-0.13	-0.30
稀释每股收益（元）	0.03	-0.13	-0.30
加权平均净资产收益率	3.83%	-17.54%	-38.28%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入比例	15.52%	26.23%	51.40%

七、财务报告审计截止日后的主要经营状况

（一）审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况持续向好，经营模式未发生重大变化；公司与主要客户、供应商合作情况良好，未出现重大不利变化；董事、高级管理人员与核心技术人员未发生重大变化；公司所处行业及市场发展情况良好，未出现重大不利变化；在研产品的研发工作有序进行，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2026 年 1-3 月财务数据审阅情况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。德勤对发行人 2026 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2026 年 1-3 月的合并及母公司利润表，2026 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了无保留意见的《审阅报告》（德师报（阅）字（26）第 R00024 号）。

公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。

公司 2026 年 1-3 月经审阅的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	38,816,614.87	33,678,492.22	15.26%
负债总额	19,656,122.68	18,268,498.28	7.60%
所有者权益	19,160,492.19	15,409,993.94	24.34%
归属于母公司所有者权益	8,172,440.89	5,675,370.42	44.00%
项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月	同比变动幅度
营业收入	5,080,014.55	620,169.05	719.13%
营业利润	3,543,298.24	-283,061.42	1,351.78%
利润总额	3,543,428.53	-282,466.50	1,354.46%
净利润	3,301,152.51	-282,524.37	1,268.45%
息税折旧摊销前利润	4,373,337.84	398,650.45	997.04%
归属于母公司所有者的净利润	2,476,203.15	-155,902.79	1,688.30%
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	2,634,078.41	-139,118.16	1,993.41%
经营活动产生的现金流量净额	4,256,599.29	19,951.16	21,235.10%

注 1：2026 年 1-3 月财务数据已经发行人会计师审阅。

注 2：对于利润类指标为负时的变动幅度，以正值表示亏损金额收窄或利润转正。

1、财务状况分析

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额较 2025 年末增长 15.26%，主要由于随着 DRAM 行业价格的持续快速上升，公司经营活动产生的现金流量净额快速增加，货币资金和交易性金融资产规模大幅增长。公司负债总额存在小幅上升，所有者权益随着资产总额的增长而较 2025 年末增长 24.34%。

2、经营成果分析

2026 年 1-3 月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，价格自 2025 年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势，同时，随着公司产销规模的持续增长、产品结构的持续优化，公司营业收入迅速增长，较 2025 年 1-3 月同比大幅增长 719.13%。得益于 2026 年一季度 DRAM 产品价格的快速上涨，

公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。

3、现金流分析

2026 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额较 2025 年 1-3 月同比增长 21,235.10%，主要由于受 2026 年一季度 DRAM 产品价格的快速上涨影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金随着公司收入快速增长而大幅增加。

4、非经常性损益分析

公司 2026 年 1-3 月非经常性损益明细表如下：

单位：万元

非经常性损益明细	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,305.16	42.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-176,459.17	-21,196.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524.91	595.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,546.60	4,459.53
减：所得税影响额	4,321.42	-
少数股东权益影响额	4,471.34	686.16
合计	-157,875.26	-16,784.63

公司 2026 年 1-3 月非经常性损益绝对值较上年同期有所上升，主要来源于应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项的公允价值变动损益等。

（三）2026 年 1-6 月业绩预计情况

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计 2026 年 1-6 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动幅度
营业收入	11,000,000 至 12,000,000	1,543,792.46	612.53%至 677.31%
净利润	6,600,000 至 7,500,000	-408,751.86	1,714.67%至 1,934.85%
归属于母公司所有者的净利润	5,000,000 至 5,700,000	-233,205.82	2,244.03%至 2,544.19%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,200,000 至 5,800,000	-238,653.84	2,278.89%至 2,530.30%

注 1：2026 年 1-6 月的业绩预计情况未经发行人会计师审计或审阅，2025 年 1-6 月经营业绩为经发行人会计师审计数据。

注 2：对于利润类指标为负时的变动幅度，以正值表示亏损金额收窄或利润转正。

2026 年 1-6 月，随着 DRAM 行业产品价格的持续快速上涨，以及公司产销规模的持续增长、产品结构的不断优化，公司预计营业收入、净利润、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期均实现大幅增加。

上述 2026 年 1-6 月业绩预计仅为公司管理层对经营业绩的合理估计，未经发行人会计师审计或审阅，不构成对公司的盈利预测或业绩承诺。

八、发行人选择的具体上市标准

公司选择的具体上市标准为《上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准，即“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

发行人 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司的估值情况，发行人预计将满足《上市规则》第 2.1.2 条的第四套标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目	75.00	75.00	发行人子公司
2	DRAM存储器技术升级项目	180.00	130.00	发行人子公司
3	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目	90.00	90.00	发行人
合计		345.00	295.00	-

本次募集资金运用详细情况及公司未来发展规划详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价判断公司股票价值时，除仔细阅读本招股说明书提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险

（一）存在累计未弥补亏损的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（二）产品及技术研发不达预期的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（三）人才短缺或流失的风险

公司所处 DRAM 行业属于人才密集型行业。从 DRAM 研发到生产、销售及运营管理的各个环节，都需要相关人员具备扎实的专业基础以及长期的经验积累。优秀的行业人才是公司生存和发展的基础，也是公司获得持续竞争优势的重要保障。

公司组建了具备丰富半导体行业经验的技术研发及运营管理团队，在 DRAM 产品设计、工艺开发、生产制造、质量管控、运营管理等方面具备深厚的技术积累和丰富的经验。公司高度重视对人才的管理，制定了完善的人才及薪酬管理体系，采取股权激励等多样化的方式，有效绑定并吸引优秀人才。近年来在国家政策的支持下，集成电路企业数量高速增长，半导体行业人才需求与日俱增，优秀行业人才供不应求。未来，如果公司无法持续吸引和绑定优秀人才，可能导致公司核心人才流失，进而影响公司重要研发与创新活动的开展，对公司未来业务发展产生不利影响。

（四）技术泄密及知识产权保护、纠纷风险

经过多年来持续的技术积累，公司掌握了多项与 DRAM 相关的核心技术，涵盖 DRAM 产品设计、制造、封测及模组设计与应用等多个环节，并形成了大量生产工艺方面的技术诀窍（Know-How）、专利、集成电路布图设计等知识产权。一直以来，公司重视对核心技术的保护，制定了完善的信息保密制度，并与相关技术人员在劳动合同、

保密协议中约定了相应职务发明和作品权属、保密及竞业条款等。但受技术保密手段的固有局限性、核心人才流动风险及其他外部不可控因素影响，未来公司仍可能因核心技术人员流失、信息保管不善、外界窃取等原因导致公司核心技术泄露，以及不排除在未来业务开展过程中与竞争对手产生技术及知识产权相关的纠纷、争议或诉讼的可能，从而对公司市场竞争力和生产经营带来不利影响。

（五）客户集中度较高的风险

报告期各期，发行人主营业务中向前五大客户合计销售额占当期主营业务收入的比例分别为 74.12%、67.30%和 68.08%，直接客户主要为半导体行业知名经销商，终端客户主要为服务器、移动设备、个人电脑等下游应用领域的大型厂商，包括阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等。公司客户集中度相对偏高，主要由于公司下游服务器、移动设备、个人电脑等市场需求相对较大且市场相对集中，同时公司主要通过经销模式由少量经销商对接终端客户所致。如果未来主要客户的市场需求受外部负面因素影响出现大幅下滑，将可能对公司持续经营能力及未来业绩的成长性构成一定不利影响。

（六）主营业务毛利率存在波动的风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为-2.19%、5.00%和 41.02%。报告期内，一方面，受公司持续进行大额固定资产及研发投入带来的折旧及摊销金额较高、规模效应尚未完全显现等因素影响，公司产品生产成本较高，另一方面，公司工艺技术水平等与三星电子、SK 海力士及美光科技相比仍有一定差距，产品结构处于持续优化状态，公司毛利率水平与国际前三家厂商相比仍较低。此外，叠加 DRAM 行业周期导致产品价格变动，报告期内公司毛利率存在一定波动。

若未来存储芯片市场价格出现下滑且公司规模效应长期无法显现，公司毛利率可能面临下滑的风险，从而对公司未来持续经营能力产生不利影响。

（七）固定资产投资及折旧金额较大的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（八）研发投入较大、无形资产摊销金额较大及减值的风险

公司高度重视核心技术的自主研发，报告期内累计研发投入为 2,060,501.67 万元，占累计营业收入的 21.67%，研发投入强度较高。报告期内各期计提无形资产摊销额分别为 134,301.92 万元、143,190.66 万元、167,542.57 万元，呈现上升趋势。报告期内，公司研发支出资本化的金额分别为 15,000.00 万元、173,400.78 万元和 0 万元，研发支出资本化比例分别为 3.21%、27.34%和 0，研发支出资本化及形成的自研无形资产金额和摊销金额均较大。如果公司受研发进展不及预期、相关技术发生颠覆性变革或者市场需求发生重大变化等不利因素影响，可能导致公司相关无形资产面临较大的减值风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（九）存货跌价风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（十）经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-727,162.07 万元、689,745.85 万元和 3,651,981.33 万元；公司各期末现金及现金等价物余额分别为 3,111,261.16 万元、4,250,821.86 万元和 3,779,781.08 万元。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，2024 年实现转正并于 2025 年大幅增长，未来如果公司经营情况或外部行业及市场出现波动且不能得到持续改善，公司的营运资金周转将存在一定的流动性风险，公司业务发展可能会受到制约。

（十一）对重要子公司长鑫新桥和长鑫集电持股比例较低的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（十二）无控股股东和实际控制人的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（十三）环境保护的风险

公司在生产经营中会产生废水、废气和固体废物，需遵守环境保护方面的相关法律

法规。公司根据相关规定，积极履行环保职责，完善环保措施，制定了严格的环保制度，但未来如果公司由于环保设施运行故障等原因发生环境污染事件，可能受到相关部门的行政处罚，并对公司的生产经营产生不利影响。同时，如果国家或各地出台更为严格的环保要求，公司或需投入相应资金对现有环保设施进行升级改造。

（十四）安全生产的风险

公司生产涉及部分机械设备操作且所需的部分原材料存在一定危险性，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。公司高度重视安全生产，制定了完备的安全生产管理规范，对操作人员进行了严格的培训，建立了科学的安全生产管理体系。但未来如果公司在安全生产管理制度上出现漏洞、管理不规范或生产人员在生产过程中未严格按照安全生产制度进行生产作业等，则公司存在发生安全生产事故，导致员工伤亡、财产损失、产线停工及受到相关部门行政处罚的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）人工智能发展是驱动本轮 DRAM 行情的重要因素之一，未来其带来的 DRAM 市场需求存在不确定性

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（二）宏观经济波动和行业周期性导致公司产品销售价格及经营业绩波动的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（三）国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（四）市场竞争风险

从行业发展历史来看，DRAM 行业自 20 世纪 80 年代发展初期的数十家企业，发展到三星电子、SK 海力士及美光科技三家国际 DRAM 厂商长期占全球 90%以上的市场份额，当前市场呈现高度集中格局。与国际头部厂商相比，公司在整体规模、技术积累、客户资源等方面仍然存在一定差距。

DRAM 市场具备大宗商品属性及强周期性特点，在激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握产业迭代和技术发展趋势，及时跟进市场需求进行技术升级、产能调控、提高产品性能与服务质量，则难以在高度集中的市场中维持可持续的竞争力，进而对公司未来的业务前景和市场地位造成不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目实施不及预期的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前中国境内外市场环境、行业发展趋势和技术水平等因素作出的。但上述项目需要一定的建设周期，一旦市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大变化，项目在实施过程中可能受到市场环境、产业政策以及项目管理、产品及服务市场销售状况等变化因素的不利影响，将影响项目的实施进度，致使项目的实际效益情况与公司预测存在差异，面临募集资金投资项目实施效果不及预期的风险。

（二）募投项目新增费用及折旧摊销影响公司经营业绩的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”。

（三）发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对行业及公司价值判断等多种内外部因素的影响。公司股票发行价格确定后，若发行人网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定中止发行。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需向上交所备案，方可重新启动发行。若公司未在中国证监会予以注册决定的有效期内完成发行，公司将面临发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	长鑫科技集团股份有限公司
英文名称	CXMT Corporation
注册资本	6,019,279.7469 万元
法定代表人	赵纶
成立日期	2016 年 6 月 13 日
整体变更为股份公司日期	2023 年 6 月 27 日
公司住所	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
邮政编码	230088
电话号码	0551-67189988
传真号码	0551-67189889
互联网网址	https://www.cxmt.com/
电子邮箱	ir@cxmt.com
信息披露和投资者关系负责部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人	袁园（董事会秘书）
信息披露和投资者关系负责人电话	0551-67189988

二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况

（一）发行人的设立情况

1、有限公司的设立情况

发行人的前身合肥智聚系由合肥才聚于 2016 年 6 月 13 日出资设立。作为发行人成立时的唯一股东，合肥才聚于 2016 年 6 月 13 日就成立合肥智聚等相关事项作出股东决定，合肥智聚成立时的注册资本为 1,000 万元。

2016 年 6 月 13 日，合肥才聚签署了《合肥智聚集成电路有限公司章程》。

2016 年 6 月 13 日，合肥市工商行政管理局颁发了统一社会信用代码为“91340100MA2MWUT60Q”的《营业执照》。

合肥智聚成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	合肥才聚	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

2017年4月17日，合肥才聚作出决定，同意公司名称变更为“睿力集成电路有限公司”。

2、股份公司的设立情况

2023年5月13日，德勤出具了“德师报（审）字（23）第S00406号”《审计报告》，截至2023年3月31日，睿力集成（单体）经审计的净资产值为6,706,260.57万元。

2023年5月13日，中水致远资产评估有限公司出具了“中水致远评报字[2023]第020324号”《资产评估报告书》，于评估基准日2023年3月31日，公司经评估的净资产值为7,499,144.25万元。

2023年6月6日，睿力集成召开股东会，审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》，公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司，以德勤审计的截至2023年3月31日的净资产67,062,605,743.61元为基础，折为股份公司的股本计5,363,300.00万元，每股面值为1元，净资产超过股本的部分计入资本公积。

2023年6月26日，公司全体股东签署《关于共同发起设立长鑫科技集团股份有限公司之发起人协议》，约定作为发起人共同设立股份有限公司，并就股本与股份比例，各发起人的权利义务以及筹建发行人的相关事宜、违约责任等进行了约定。同日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，决定公司名称变更为“长鑫科技集团股份有限公司”，股份公司的注册资本变更为5,363,300.00万元，睿力集成以经德勤审计确认的截至整体变更基准日2023年3月31日的净资产67,062,605,743.61元，按1:0.7997（四舍五入保留前四位小数）的比例折为股份公司的股本计5,363,300.00万元，净资产超过股本的部分计入股份公司的资本公积。股份公司的股本分为等额股份，总股份数为5,363,300万股股份，每股面值为人民币1元，均为人民币普通股。

2023年6月27日，公司领取了合肥市场监管局颁发的统一社会信用代码为“91340100MA2MWUT60Q”的股份公司营业执照。

2023年6月28日，德勤出具了“德师报（验）字（23）第00178号”《长鑫科技集团股份有限公司（筹）验资报告》，确认截至2023年6月26日止，公司已收到全体

发起人以其拥有的睿力集成的净资产折合的股本 5,363,300.00 万元整。

整体变更设立完成后，公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	石溪集电	1,304,375.49	24.32
2	长鑫集成	666,469.23	12.43
3	大基金二期	525,607.38	9.80
4	合肥集鑫	503,736.38	9.39
5	安徽省投	476,049.45	8.88
6	招银云亭	95,209.89	1.78
7	北京峰益	90,131.42	1.68
8	汇碧五号	90,131.42	1.68
9	和谐健康	90,131.42	1.68
10	国调基金	67,598.56	1.26
11	阿里网络	67,598.56	1.26
12	鑫芯励润	63,977.53	1.19
13	宁波燕创	59,486.74	1.11
14	芜湖星原	54,078.85	1.01
15	兆易创新	51,095.82	0.95
16	国寿投资	47,604.95	0.89
17	宁波君和	46,868.34	0.87
18	中安招商基金	46,798.79	0.87
19	人保资本	46,703.85	0.87
20	鑫芯家园	45,291.04	0.84
21	嘉兴恒旭	45,065.71	0.84
22	美的投资	45,065.71	0.84
23	安徽担保资管	45,065.71	0.84
24	安元星亿达	45,065.71	0.84
25	安华创新	45,065.71	0.84
26	君挚璞创投	45,065.71	0.84
27	青岛朗格	45,065.71	0.84
28	星棋道和	45,065.71	0.84
29	Gamcier	43,105.35	0.80
30	Glades View	43,105.35	0.80

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
31	农银投资	42,082.68	0.78
32	建银国际	41,181.37	0.77
33	华芯科泰	39,883.15	0.74
34	深圳投控	35,601.91	0.66
35	招证投资	32,371.36	0.60
36	前海方舟	30,194.03	0.56
37	云锋卓越	29,292.71	0.55
38	安徽交控	29,108.79	0.54
39	海通徽银	28,562.97	0.53
40	东方资管	22,532.85	0.42
41	阳光人寿	22,532.85	0.42
42	中邮人寿	22,532.85	0.42
43	建信领航	22,532.85	0.42
44	天津海河	19,041.98	0.36
45	中金共赢	19,041.98	0.36
46	湖北小米	12,675.59	0.24
47	北京君联	11,774.27	0.22
48	人保科创	9,013.14	0.17
49	芯鑫集电	7,661.17	0.14
合计		5,363,300.00	100.00

3、整体变更时存在的未弥补亏损情况

（1）股改基准日未分配利润为负的形成原因

2023年5月13日，德勤对睿力集成截至2023年3月31日的财务报表进行了审计，并出具了“德师报（审）字（23）第S00406号”《审计报告》，经审计，睿力集成母公司截至2023年3月31日的净资产值为6,706,260.57万元，未分配利润为-259,181.33万元。

公司存在未分配利润为负的情形，主要系报告期内公司处于产能爬坡阶段，生产线前期折旧摊销金额较大且不断上升，同时公司产品受存储芯片市场环境及行业周期等因素的影响价格出现下滑，资产减值损失计提增加。内外部因素叠加影响，导致公司整体变更时存在未分配利润为负的情况。

（2）未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配情况，对未来盈利能力的影响

通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补亏损-259,181.33万元。截至2025年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为-3,665,042.11万元，公司未分配利润为负的情形尚未消除。

整体变更完成后，公司持续进行业务拓展，现有产能逐步释放且新建产能逐步完成，产品竞争力及行业影响力不断增强。同时，公司加大人才吸引力度，加强团队稳定性建设，持续提高研发投入，积极布局推出DDR5等更先进代际产品。未分配利润为负的情形对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定、研发投入、战略投入、生产经营可持续性等方面不存在负面影响，未对公司未来持续经营能力以及盈利能力构成重大不利影响。

（3）整体变更具体方案及相应的会计处理

公司以经德勤出具的“德师报（审）字（23）第S00406号”《审计报告》确认的截至整体变更基准日2023年3月31日的净资产6,706,260.57万元，按1:0.7997（四舍五入保留前四位小数）的比例折为股份公司的股本计5,363,300万元，净资产超过股本的部分计入股份公司的资本公积。通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补亏损-259,181.33万元。

公司整体变更时母公司的会计处理如下：

项目	金额（元）
借：实收资本	53,632,566,506.46
资本公积-资本溢价	16,021,852,497.49
未分配利润	-2,591,813,260.34
贷：股本	53,633,000,000.00
资本公积-资本溢价	13,429,605,743.61

（4）公司整体变更相关事项及程序合法合规

公司以有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的过程中已履行了有权机构决策、审计、评估、召开创立大会、验资及工商登记等程序。

公司整体变更中，发起人符合法定人数、全体发起人认购的股本总额与注册资本一

致并足额缴纳、折合的实收股本总额未高于公司净资产额、发起人对股份有限公司设立筹备事项予以同意并授权、公司设立时的《公司章程》载明了必要事项并依法建立了股东会、董事会、监事会在内的组织机构。

（二）报告期内发行人的股本和股东变化情况

公司报告期内的股本和股东变化简要情况如下：

序号	时间	变化情况	变化前注册资本 (万元)	变化后注册资本 (万元)
1	2023 年 3 月	公司注册资本由 4,857,571.36 万元增加至 5,363,256.65 万元，新增注册资本由睿力集成的资本公积金中的 505,685.29 万元转增形成。其中，大基金二期获得转增注册资本 49,557.53 万元，合肥集鑫获得转增注册资本 456,127.75 万元	4,857,571.36	5,363,256.65
2	2023 年 3 月	安徽担保集团将其持有的公司 0.8403% 股权，转让至其关联方安徽担保资管；建银国际将其持有的公司 0.1428% 股权，转让至其关联方芯鑫集电；碧桂园创投将其持有的公司 1.6805% 股权，转让至其关联方汇碧五号，转让价格为 2.22 元/股	5,363,256.65	5,363,256.65
3	2023 年 6 月	公司整体变更为股份有限公司	5,363,256.65	5,363,300.00
4	2024 年 6 月	公司注册资本由 5,363,300.00 万元增至 5,777,094.22 万元，新增注册资本由产投壹号等 12 名投资者以货币方式认购，认购价格为 2.61 元/股	5,363,300.00	5,777,094.22
5	2024 年 12 月	汇碧五号将其持有的公司 1.56% 的股份以 200,000.00 万元的价格转让给合肥建长，转让价格为 2.22 元/股	5,777,094.22	5,777,094.22
6	2025 年 6 月	Glades View 按 26,750.00 万元的价格向广州信德转让所持的长鑫科技 10,301.67 万元注册资本，转让价格为 2.60 元/股	5,777,094.22	5,777,094.22
7	2025 年 6 月	公司注册资本由 5,777,094.22 万元增至 6,019,279.75 万元，新增注册资本由阿里云计算等 3 名投资者以货币方式认购，认购价格为 2.63 元/股	5,777,094.22	6,019,279.75

1、报告期初睿力集成的股权结构

报告期初，睿力集成的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	石溪集电	1,304,364.95	货币、实物、土地使用权	26.85
2	长鑫集成	666,463.84	货币、实物、土	13.72

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
			地使用权	
3	大基金二期	476,045.60	货币	9.80
4	安徽省投	476,045.60	货币	9.80
5	招银云亨	95,209.12	货币	1.96
6	北京峰益	90,130.69	货币	1.86
7	碧桂园创投	90,130.69	货币	1.86
8	和谐健康	90,130.69	货币	1.86
9	国调基金	67,598.02	货币	1.39
10	阿里网络	67,598.02	货币	1.39
11	鑫芯励润	63,977.02	货币	1.32
12	宁波燕创	59,486.26	货币	1.22
13	芜湖星原	54,078.41	货币	1.11
14	兆易创新	51,095.41	货币	1.05
15	建银国际	48,842.14	货币	1.01
16	合肥集鑫	47,604.56	货币	0.98
17	国寿投资	47,604.56	货币	0.98
18	宁波君和	46,867.96	货币	0.96
19	中安招商基金	46,798.42	货币	0.96
20	人保资本	46,703.47	货币	0.96
21	鑫芯家园	45,290.67	货币	0.93
22	嘉兴恒旭	45,065.34	货币	0.93
23	美的投资	45,065.34	货币	0.93
24	安徽担保集团	45,065.34	货币	0.93
25	安元星亿达	45,065.34	货币	0.93
26	安华创新	45,065.34	货币	0.93
27	君挚璞创投	45,065.34	货币	0.93
28	青岛朗格	45,065.34	货币	0.93
29	星棋道和	45,065.34	货币	0.93
30	Gamcier	43,105.00	货币	0.89
31	Glades View	43,105.00	货币	0.89
32	农银投资	42,082.34	货币	0.87
33	华芯科泰	39,882.83	货币	0.82
34	深圳投控	35,601.62	货币	0.73

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
35	招证投资	32,371.10	货币	0.67
36	前海方舟	30,193.78	货币	0.62
37	云锋卓越	29,292.47	货币	0.60
38	安徽交控	29,108.55	货币	0.60
39	海通徽银	28,562.74	货币	0.59
40	东方资管	22,532.67	货币	0.46
41	阳光人寿	22,532.67	货币	0.46
42	中邮人寿	22,532.67	货币	0.46
43	建信领航	22,532.67	货币	0.46
44	天津海河	19,041.82	货币	0.39
45	中金共赢	19,041.82	货币	0.39
46	湖北小米	12,675.49	货币	0.26
47	北京君联	11,774.18	货币	0.24
48	人保科创	9,013.07	货币	0.19
合计		4,857,571.36	——	100.00

2、发行人报告期内的股本变化情况

（1）2023 年 3 月，第七次增资

2023 年 3 月 2 日，睿力集成全体股东以书面决议方式作出股东会决议，同意公司注册资本由 4,857,571.36 万元增加至 5,363,256.65 万元，新增注册资本由睿力集成的资本公积金中的 505,685.29 万元转增形成。其中，大基金二期获得转增注册资本 49,557.53 万元，合肥集鑫获得转增注册资本 456,127.75 万元。

2023 年 3 月 13 日，合肥市场监管局颁发了统一社会信用代码为“91340100MA2MWUT60Q”的《营业执照》。

本次增资后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	石溪集电	1,304,364.95	货币、实物、土地使用权	24.32
2	长鑫集成	666,463.84	货币、实物、土地使用权	12.43
3	大基金二期	525,603.14	货币	9.80
4	合肥集鑫	503,732.31	货币	9.39

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
5	安徽省投	476,045.60	货币	8.88
6	招银云亭	95,209.12	货币	1.78
7	北京峰益	90,130.69	货币	1.68
8	碧桂园创投	90,130.69	货币	1.68
9	和谐健康	90,130.69	货币	1.68
10	国调基金	67,598.02	货币	1.26
11	阿里网络	67,598.02	货币	1.26
12	鑫芯励润	63,977.02	货币	1.19
13	宁波燕创	59,486.26	货币	1.11
14	芜湖星原	54,078.41	货币	1.01
15	兆易创新	51,095.41	货币	0.95
16	建银国际	48,842.14	货币	0.91
17	国寿投资	47,604.56	货币	0.89
18	宁波君和	46,867.96	货币	0.87
19	中安招商基金	46,798.42	货币	0.87
20	人保资本	46,703.47	货币	0.87
21	鑫芯家园	45,290.67	货币	0.84
22	嘉兴恒旭	45,065.34	货币	0.84
23	美的投资	45,065.34	货币	0.84
24	安徽担保集团	45,065.34	货币	0.84
25	安元星亿达	45,065.34	货币	0.84
26	安华创新	45,065.34	货币	0.84
27	君挚璞创投	45,065.34	货币	0.84
28	青岛朗格	45,065.34	货币	0.84
29	星棋道和	45,065.34	货币	0.84
30	Gamcier	43,105.00	货币	0.80
31	Glades View	43,105.00	货币	0.80
32	农银投资	42,082.34	货币	0.78
33	华芯科泰	39,882.83	货币	0.74
34	深圳投控	35,601.62	货币	0.66
35	招证投资	32,371.10	货币	0.60
36	前海方舟	30,193.78	货币	0.56
37	云锋卓越	29,292.47	货币	0.55

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
38	安徽交控	29,108.55	货币	0.54
39	海通徽银	28,562.74	货币	0.53
40	东方资管	22,532.67	货币	0.42
41	阳光人寿	22,532.67	货币	0.42
42	中邮人寿	22,532.67	货币	0.42
43	建信领航	22,532.67	货币	0.42
44	天津海河	19,041.82	货币	0.36
45	中金共赢	19,041.82	货币	0.36
46	湖北小米	12,675.49	货币	0.24
47	北京君联	11,774.18	货币	0.22
48	人保科创	9,013.07	货币	0.17
合计		5,363,256.65	——	100.00

（2）2023年3月，第六次股权转让

2023年3月25日，睿力集成召开股东会并作出决议，决定安徽担保集团将其持有的公司0.8403%股权，转让至其全资子公司安徽担保资管；建银国际将其持有的公司0.1428%股权，转让至其关联方芯鑫集电；碧桂园创投将其持有的公司1.6805%股权，转让至其关联方汇碧五号。具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让的注册资本（万元）	股权转让对价（万元）	每注册资本单价（元/注册资本）
1	建银国际	芯鑫集电	7,661.11	17,000.00	2.22
2	碧桂园创投	汇碧五号	90,130.69	200,000.00	2.22
3	安徽担保集团	安徽担保资管	45,065.34	100,000.00	2.22

2023年3月30日，合肥市场监管局颁发了统一社会信用代码为“91340100MA2MWUT60Q”的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	石溪集电	1,304,364.95	货币、实物、土地使用权	24.32
2	长鑫集成	666,463.84	货币、实物、土地使用权	12.43
3	大基金二期	525,603.14	货币	9.80

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
4	合肥集鑫	503,732.31	货币	9.39
5	安徽省投	476,045.60	货币	8.88
6	招银云亭	95,209.12	货币	1.78
7	北京峰益	90,130.69	货币	1.68
8	汇碧五号	90,130.69	货币	1.68
9	和谐健康	90,130.69	货币	1.68
10	国调基金	67,598.02	货币	1.26
11	阿里网络	67,598.02	货币	1.26
12	鑫芯励润	63,977.02	货币	1.19
13	宁波燕创	59,486.26	货币	1.11
14	芜湖星原	54,078.41	货币	1.01
15	兆易创新	51,095.41	货币	0.95
16	国寿投资	47,604.56	货币	0.89
17	宁波君和	46,867.96	货币	0.87
18	中安招商基金	46,798.42	货币	0.87
19	人保资本	46,703.47	货币	0.87
20	鑫芯家园	45,290.67	货币	0.84
21	嘉兴恒旭	45,065.34	货币	0.84
22	美的投资	45,065.34	货币	0.84
23	安徽担保资管	45,065.34	货币	0.84
24	安元星亿达	45,065.34	货币	0.84
25	安华创新	45,065.34	货币	0.84
26	君挚璞创投	45,065.34	货币	0.84
27	青岛朗格	45,065.34	货币	0.84
28	星棋道和	45,065.34	货币	0.84
29	Gamcier	43,105.00	货币	0.80
30	Glades View	43,105.00	货币	0.80
31	农银投资	42,082.34	货币	0.78
32	建银国际	41,181.03	货币	0.77
33	华芯科泰	39,882.83	货币	0.74
34	深圳投控	35,601.62	货币	0.66
35	招证投资	32,371.10	货币	0.60
36	前海方舟	30,193.78	货币	0.56

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
37	云锋卓越	29,292.47	货币	0.55
38	安徽交控	29,108.55	货币	0.54
39	海通徽银	28,562.74	货币	0.53
40	东方资管	22,532.67	货币	0.42
41	阳光人寿	22,532.67	货币	0.42
42	中邮人寿	22,532.67	货币	0.42
43	建信领航	22,532.67	货币	0.42
44	天津海河	19,041.82	货币	0.36
45	中金共赢	19,041.82	货币	0.36
46	湖北小米	12,675.49	货币	0.24
47	北京君联	11,774.18	货币	0.22
48	人保科创	9,013.07	货币	0.17
49	芯鑫集电	7,661.11	货币	0.14
合计		5,363,256.65	——	100.00

（3）2023 年 6 月，整体变更为股份有限公司

发行人于 2023 年 6 月整体变更为股份有限公司的具体情况详见本节之“二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况”之“（一）发行人的设立情况”之“2、股份公司的设立情况”。

（4）2024 年 6 月，第八次增资

2024 年 2 月 22 日，长鑫科技召开 2024 年第一次临时股东大会并作出决议，公司进行融资且此次融资分阶段交割。2024 年 3 月 31 日，长鑫科技召开 2024 年第二次临时股东大会并作出决议，确定第一阶段融资金额为 555,000.00 万元，第二阶段融资金额为 525,000.00 万元。本次融资两个阶段交割完成后，公司注册资本由 5,363,300.00 万元增至 5,777,094.22 万元，增加注册资本 413,794.22 万元，且全部由投资者以货币认缴，增资价款超过认缴注册资本的部分计入公司资本公积。

本次增资投资者的增资情况如下：

序号	交割阶段	投资人名称	增资价款（万元）	认缴新增注册资本（万元）
1	第一阶段	产投壹号	235,000.00	90,038.56
2		广州科集	100,000.00	38,314.28

序号	交割阶段	投资人名称	增资价款（万元）	认缴新增注册资本（万元）
3		工融金投	100,000.00	38,314.28
4		中银资产	60,000.00	22,988.57
5		交银金融	60,000.00	22,988.57
6	第二阶段	产投壹号	55,000.00	21,072.85
7		建信投资	130,000.00	49,808.56
8		兆易创新	150,000.00	57,471.42
9		长鑫集成	100,000.00	38,314.28
10		农银投资	40,000.00	15,325.71
11		和壮高新	20,000.00	7,662.86
12		中建材新材料基金	20,000.00	7,662.86
13		产投高成长	10,000.00	3,831.43
合计			1,080,000.00	413,794.22

2024年6月11日，公司本次增资完成了工商变更登记，本次增资完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	清辉集电	1,304,375.49	22.58
2	长鑫集成	704,783.51	12.20
3	大基金二期	525,607.38	9.10
4	合肥集鑫	503,736.38	8.72
5	安徽省投	476,049.45	8.24
6	产投壹号	111,111.41	1.92
7	兆易创新	108,567.24	1.88
8	招银云亭	95,209.89	1.65
9	北京峰益	90,131.42	1.56
10	汇碧五号	90,131.42	1.56
11	和谐健康	90,131.42	1.56
12	国调基金	67,598.56	1.17
13	阿里网络	67,598.56	1.17
14	鑫芯励润	63,977.53	1.11
15	宁波燕创	59,486.74	1.03
16	农银投资	57,408.39	0.99

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
17	芜湖星原	54,078.85	0.94
18	建信投资	49,808.56	0.86
19	国寿投资	47,604.95	0.82
20	宁波君和	46,868.34	0.81
21	中安招商基金	46,798.79	0.81
22	人保资本	46,703.85	0.81
23	鑫芯家园	45,291.04	0.78
24	嘉兴恒旭	45,065.71	0.78
25	美的投资	45,065.71	0.78
26	安徽担保资管	45,065.71	0.78
27	安元星亿达	45,065.71	0.78
28	安华创新	45,065.71	0.78
29	君挚璞创投	45,065.71	0.78
30	青岛朗格	45,065.71	0.78
31	星棋道和	45,065.71	0.78
32	Gancier	43,105.35	0.75
33	Glades View	43,105.35	0.75
34	建银国际	41,181.37	0.71
35	华芯科泰	39,883.15	0.69
36	广州科集	38,314.28	0.66
37	工融金投	38,314.28	0.66
38	深圳投控	35,601.91	0.62
39	招证投资	32,371.36	0.56
40	前海方舟	30,194.03	0.52
41	云锋卓越	29,292.71	0.51
42	安徽交控	29,108.79	0.50
43	海通徽银	28,562.97	0.49
44	中银资产	22,988.57	0.40
45	交银金融	22,988.57	0.40
46	东方资管	22,532.85	0.39
47	阳光人寿	22,532.85	0.39
48	中邮人寿	22,532.85	0.39

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
49	建信领航	22,532.85	0.39
50	天津海河	19,041.98	0.33
51	中金共赢	19,041.98	0.33
52	湖北小米	12,675.59	0.22
53	北京君联	11,774.27	0.20
54	人保科创	9,013.14	0.16
55	和壮高新	7,662.86	0.13
56	中建材新材料基金	7,662.86	0.13
57	芯鑫集电	7,661.17	0.13
58	产投高成长	3,831.43	0.07
合计		5,777,094.22	100.00

2024 年 6 月 11 日，合肥市场监管局颁发了统一社会信用代码为“91340100MA2MWUT60Q”的股份公司《营业执照》。

(5) 2024 年 12 月，第七次股份转让

2024 年 12 月 27 日，汇碧五号与合肥建长签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之股份转让协议》，汇碧五号将其持有的长鑫科技 1.56%的股份以 200,000.00 万元的价格转让给合肥建长。

本次股份转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
1	清辉集电	1,304,375.49	22.58
2	长鑫集成	704,783.51	12.20
3	大基金二期	525,607.38	9.10
4	合肥集鑫	503,736.38	8.72
5	安徽省投	476,049.45	8.24
6	产投壹号	111,111.41	1.92
7	兆易创新	108,567.24	1.88
8	招银云亭	95,209.89	1.65
9	北京峰益	90,131.42	1.56
10	合肥建长	90,131.42	1.56
11	和谐健康	90,131.42	1.56

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
12	国调基金	67,598.56	1.17
13	阿里网络	67,598.56	1.17
14	鑫芯励润	63,977.53	1.11
15	宁波燕创	59,486.74	1.03
16	农银投资	57,408.39	0.99
17	芜湖星原	54,078.85	0.94
18	建信投资	49,808.56	0.86
19	国寿投资	47,604.95	0.82
20	宁波君和	46,868.34	0.81
21	中安招商基金	46,798.79	0.81
22	人保资本	46,703.85	0.81
23	鑫芯家园	45,291.04	0.78
24	嘉兴恒旭	45,065.71	0.78
25	美的投资	45,065.71	0.78
26	安徽担保资管	45,065.71	0.78
27	安元星亿达	45,065.71	0.78
28	安华创新	45,065.71	0.78
29	君挚璞创投	45,065.71	0.78
30	青岛朗格	45,065.71	0.78
31	星棋道和	45,065.71	0.78
32	Gancier	43,105.35	0.75
33	Glades View	43,105.35	0.75
34	建银国际	41,181.37	0.71
35	华芯科泰	39,883.15	0.69
36	广州科集	38,314.28	0.66
37	工融金投	38,314.28	0.66
38	深圳投控	35,601.91	0.62
39	招证投资	32,371.36	0.56
40	前海方舟	30,194.03	0.52
41	云锋卓越	29,292.71	0.51
42	安徽交控	29,108.79	0.50
43	海通徽银	28,562.97	0.49

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
44	中银资产	22,988.57	0.40
45	交银金融	22,988.57	0.40
46	东方资管	22,532.85	0.39
47	阳光人寿	22,532.85	0.39
48	中邮人寿	22,532.85	0.39
49	建信领航	22,532.85	0.39
50	天津海河	19,041.98	0.33
51	中金共赢	19,041.98	0.33
52	湖北小米	12,675.59	0.22
53	北京君联	11,774.27	0.20
54	人保科创	9,013.14	0.16
55	和壮高新	7,662.86	0.13
56	中建材新材料基金	7,662.86	0.13
57	芯鑫集电	7,661.17	0.13
58	产投高成长	3,831.43	0.07
合计		5,777,094.22	100.00

(6) 2025 年 6 月，长鑫科技第八次股份转让

2025 年 5 月 8 日，Glades View 与广州信德签署了《关于长鑫科技集团股份有限公司之股份转让协议》，约定 Glades View 按 26,750.00 万元的价格向广州信德转让所持的长鑫科技 10,301.67 万元注册资本（对应 0.1783% 的股份），相关股份转让款扣减受让方应缴税费后的余额为应付股份转让价款。2025 年 6 月 6 日，广州信德向 Glades View 支付了前述股份转让价款。

本次股份转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
1	清辉集电	1,304,375.49	22.58
2	长鑫集成	704,783.51	12.20
3	大基金二期	525,607.38	9.10
4	合肥集鑫	503,736.38	8.72
5	安徽省投	476,049.45	8.24
6	产投壹号	111,111.41	1.92

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
7	兆易创新	108,567.24	1.88
8	招银云亭	95,209.89	1.65
9	北京峰益	90,131.42	1.56
10	合肥建长	90,131.42	1.56
11	和谐健康	90,131.42	1.56
12	国调基金	67,598.56	1.17
13	阿里网络	67,598.56	1.17
14	鑫芯励润	63,977.53	1.11
15	宁波燕创	59,486.74	1.03
16	农银投资	57,408.39	0.99
17	芜湖星原	54,078.85	0.94
18	建信投资	49,808.56	0.86
19	国寿投资	47,604.95	0.82
20	宁波君和	46,868.34	0.81
21	中安招商基金	46,798.79	0.81
22	人保资本	46,703.85	0.81
23	鑫芯家园	45,291.04	0.78
24	嘉兴恒旭	45,065.71	0.78
25	美的投资	45,065.71	0.78
26	安徽担保资管	45,065.71	0.78
27	安元星亿达	45,065.71	0.78
28	安华创新	45,065.71	0.78
29	君挚璞创投	45,065.71	0.78
30	青岛朗格	45,065.71	0.78
31	星棋道和	45,065.71	0.78
32	Gamcier	43,105.35	0.75
33	建银国际	41,181.37	0.71
34	华芯科泰	39,883.15	0.69
35	广州科集	38,314.28	0.66
36	工融金投	38,314.28	0.66
37	深圳投控	35,601.91	0.62
38	Glades View	32,803.68	0.57

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
39	招证投资	32,371.36	0.56
40	前海方舟	30,194.03	0.52
41	云锋卓越	29,292.71	0.51
42	安徽交控	29,108.79	0.50
43	海通徽银	28,562.97	0.49
44	中银资产	22,988.57	0.40
45	交银金融	22,988.57	0.40
46	东方资管	22,532.85	0.39
47	阳光人寿	22,532.85	0.39
48	中邮人寿	22,532.85	0.39
49	建信领航	22,532.85	0.39
50	天津海河	19,041.98	0.33
51	中金共赢	19,041.98	0.33
52	湖北小米	12,675.59	0.22
53	北京君联	11,774.27	0.20
54	广州信德	10,301.67	0.18
55	人保科创	9,013.14	0.16
56	和壮高新	7,662.86	0.13
57	中建材新材料基金	7,662.86	0.13
58	芯鑫集电	7,661.17	0.13
59	产投高成长	3,831.43	0.07
合计		5,777,094.22	100.00

(7) 2025 年 6 月，长鑫科技第九次增资

2025 年 6 月 24 日，长鑫科技召开 2025 年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 5,777,094.22 万元增至 6,019,279.75 万元。

本次增资投资者的增资情况如下：

序号	投资人名称	增资价款 (万元)	认缴新增注册资本 (万元)
1	阿里云计算	610,000.00	231,920.20
2	星棋道和	10,000.00	3,801.97
3	广州信德	17,000.00	6,463.35

序号	投资人名称	增资价款 (万元)	认缴新增注册资本 (万元)
合计		637,000.00	242,185.53

2025年6月27日，公司本次增资完成了工商变更登记，本次增资完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
1	清辉集电	1,304,375.49	21.67
2	长鑫集成	704,783.51	11.71
3	大基金二期	525,607.38	8.73
4	合肥集鑫	503,736.38	8.37
5	安徽省投	476,049.45	7.91
6	阿里云计算	231,920.20	3.85
7	产投壹号	111,111.41	1.85
8	兆易创新	108,567.24	1.80
9	招银云亭	95,209.89	1.58
10	北京峰益	90,131.42	1.50
11	合肥建长	90,131.42	1.50
12	和谐健康	90,131.42	1.50
13	国调基金	67,598.56	1.12
14	阿里网络	67,598.56	1.12
15	鑫芯励润	63,977.53	1.06
16	宁波燕创	59,486.74	0.99
17	农银投资	57,408.39	0.95
18	芜湖星原	54,078.85	0.90
19	建信投资	49,808.56	0.83
20	星棋道和	48,867.68	0.81
21	国寿投资	47,604.95	0.79
22	宁波君和	46,868.34	0.78
23	中安招商基金	46,798.79	0.78
24	人保资本	46,703.85	0.78
25	鑫芯家园	45,291.04	0.75
26	嘉兴恒旭	45,065.71	0.75
27	美的投资	45,065.71	0.75

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
28	安徽担保资管	45,065.71	0.75
29	安元星亿达	45,065.71	0.75
30	安华创新	45,065.71	0.75
31	君挚璞创投	45,065.71	0.75
32	青岛朗格	45,065.71	0.75
33	Gamcier	43,105.35	0.72
34	建银国际	41,181.37	0.68
35	华芯科泰	39,883.15	0.66
36	广州科集	38,314.28	0.64
37	工融金投	38,314.28	0.64
38	深圳投控	35,601.91	0.59
39	Glades View	32,803.68	0.54
40	招证投资	32,371.36	0.54
41	前海方舟	30,194.03	0.50
42	云锋卓越	29,292.71	0.49
43	安徽交控	29,108.79	0.48
44	海通徽银	28,562.97	0.47
45	中银资产	22,988.57	0.38
46	交银金融	22,988.57	0.38
47	东方资管	22,532.85	0.37
48	阳光人寿	22,532.85	0.37
49	中邮人寿	22,532.85	0.37
50	建信领航	22,532.85	0.37
51	天津海河	19,041.98	0.32
52	中金共赢	19,041.98	0.32
53	广州信德	16,765.02	0.28
54	湖北小米	12,675.59	0.21
55	北京君联	11,774.27	0.20
56	人保科创	9,013.14	0.15
57	和壮高新	7,662.86	0.13
58	中建材新材料基金	7,662.86	0.13
59	芯鑫集电	7,661.17	0.13

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例(%)
60	产投高成长	3,831.43	0.06
合计		6,019,279.75	100.00

2025 年 6 月 27 日，合肥市场监管局颁发了统一社会信用代码为“91340100MA2MWUT60Q”的股份公司《营业执照》。

（三）发行人历史沿革中的股份代持情况

公司历史沿革过程中曾经存在股份代持情形。截至本招股说明书签署日，股份代持情形均已解除。股份代持的形成、演变及解除情形具体如下：

2021 年 7 月，建银皖江与建银国际签署《委托投资合作协议》，由于建银国际与建银皖江为关联公司，并考虑到建银皖江所管理的基金尚未募集成立，建银皖江委托建银国际代建银皖江拟设立的基金向睿力集成投资，即在基金募集设立完成之前先通过建银国际代为向睿力集成支付投资款项。后根据建银皖江设立基金的实际情形，前述委托投资款项确定为 17,000.00 万元。

2022 年 7 月，建银国际与芯鑫集电（芯鑫集电的执行事务合伙人为建银皖江）签署了《股权转让协议》，约定建银国际将其持有的睿力集成 0.1428%股权转让至芯鑫集电，股权转让对价为 17,000.00 万元。本次建银国际股权转让系将建银皖江委托投资部分的长鑫科技股权还原给芯鑫集电，已履行了适当的内部审批程序；转让完成后，建银国际与建银皖江之间不存在因上述《委托投资合作协议》而形成的代持关系。建银国际、芯鑫集电、建银皖江之间不存在因代持形成及代持解除所产生的任何纠纷和潜在争议。

除上述发行人直接股东层面曾存在的股份代持情况外，发行人直接股东鑫芯励润上层有限合伙人合肥水木鑫欣向荣股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥水木”）之有限合伙人中泰旋益（厦门）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泰旋益”）存在出资人陈秋琳女士所持财产份额（出资额 120 万元）在工商登记层面被其他合伙人代持的情形。

2025 年 12 月，中泰旋益与吕大龙先生签署《关于合肥水木鑫欣向荣股权投资基金（有限合伙）之财产份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”），中泰旋益将其持有的合肥水木的全部财产份额（财产份额比例为 3.322%，对应 2,500 万元出资额）转让给吕大龙。根据《转让协议》约定，自本次份额转让完成工商变更登记之日起，吕大龙即取

得本次份额转让所涉全部财产份额的权属并成为合肥水木的合伙人。2025 年 12 月 17 日，主管登记机关办理完成了本次合伙人变更的工商登记手续。

截至提交本次首发上市申请前，发行人历史上存在的股份代持情形已经依法解除，相关股权转让各方之间不存在关于股权归属方面的纠纷或潜在纠纷。发行人股份权属清晰，不存在股份代持情形。

三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）

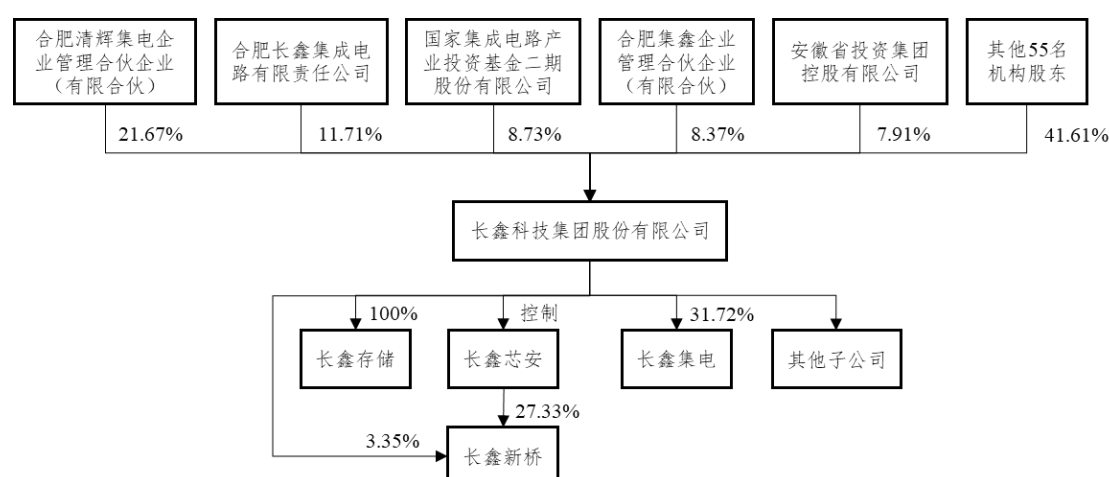
发行人报告期内不存在重大资产重组等重大事件。

四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况

发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌情况。

五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



六、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况

（一）重要子公司具体情况

截至本招股说明书签署日，长鑫存储、长鑫新桥、长鑫集电系公司业务重要的经营主体，形成一定的生产销售规模或承担核心技术研发，于 2025 年 12 月末总资产规模占公司合并财务报表总资产规模比例合计超过 88%，属于重要子公司。

公司上述重要子公司的具体情况如下：

1、长鑫存储

企业名称	长鑫存储技术有限公司		
统一社会信用代码	91340111MA2R95NL69		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区启德路 799 号		
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区启德路 799 号		
法定代表人	吴丽影		
注册资本	2,388,760.16 万元		
实收资本	2,388,760.16 万元		
成立日期	2017 年 11 月 16 日		
营业期限	2017 年 11 月 16 日至无固定期限		
经营范围	许可项目：职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主营业务	动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售		
股东构成	发行人持股 100%		
主要财务数据 (单位：万元)	年度	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	总资产	7,804,556.92	7,895,706.25
	净资产	3,444,477.20	2,563,047.26
	营业收入	2,902,514.86	1,977,569.29
	净利润	755,558.14	-63,936.42

注：上述财务数据经德勤会计师审计。

2、长鑫新桥

企业名称	长鑫新桥存储技术有限公司		
统一社会信用代码	91340111MA2WKMFR5C		
类型	其他有限责任公司		
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区新淮大道 2788 号		
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区新淮大道 2788 号		
法定代表人	赵纶		

注册资本	5,395,371.51 万元		
实收资本	5,356,179.11 万元		
成立日期	2021 年 01 月 05 日		
营业期限	2021 年 01 月 05 日至无固定期限		
经营范围	存储技术服务；集成电路设计、制造、加工、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；电子产品销售并提供售后服务及技术服务；半导体集成电路芯片研发、设计、委托加工、销售；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；设备、房屋租赁；产业并购；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。		
主营业务	动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售		
股东构成	序号	股东名称	持股比例
	1	长鑫芯安	27.33%
	2	合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）	27.09%
	3	大基金二期	26.99%
	4	合肥产投	15.24%
	5	长鑫科技	3.35%
	合计		100.00%
主要财务数据 （单位：万元）	年度	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
	总资产	10,726,013.63	9,508,151.93
	净资产	5,719,244.94	4,594,643.66
	营业收入	1,793,093.55	322,466.28
	净利润	332,798.64	-133,635.49

注：上述财务数据经德勤会计师审计。

为巩固发行人在长鑫新桥中的控制地位，保持发行人对长鑫新桥有效控制的稳定性和可持续性，发行人子企业长鑫芯安（甲方）和发行人子公司长鑫新桥已分别与鑫益合升（乙方）、合肥产投（乙方）签署了一致行动协议及补充协议。上述协议主要内容如下：

事项	条款
签署目的	保证甲方取得公司的股权表决权并进一步实现对公司的控制，优化公司治理水平，同时也为了提高对公司重大事项进行决策的效率。
一致行动事项的具体范围	双方同意，本协议所称之“一致行动”、“一致行动关系”，具体应指如下含义：（1）双方应在公司股东会的召集、提案及表决，以及任何由股东实施，或在股东层面决策的事项中，按第二条的规定保持一致行动；（2）在同时存在甲方董事（指甲方提名/委派并最终经公司股东批准而当选的董事）及乙方董事（指乙方提名/委派并最终经公司股东批准而当选的董事）的情况下，甲方董事和乙方董事在公司董事会的召集、提案及表决、

事项	条款
	以及任何由董事实施，或在董事会层面决策的事项中，按第二条的规定保持一致行动； (3) 在任何一方人员担任公司高级管理人员或在公司兼任其他职务的情况下，在其职权范围内做出的决策或者实施的行为应与公司股东会、董事会做出的决策保持一致；(4) 双方应在公司的经营、管理、治理、控制、重大事项等方面采取一致意见。 双方有权按照公司章程的规定向公司提出提案，在提案内容不违反国有资产监督管理法律法规的前提下，乙方将支持甲方的提案。双方应根据如下规则保持一致行动：双方在公司股东会会议表决时保持的“一致行动”指，双方在公司股东会中表决公司如下事项时保持一致；在行使股东会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以甲方的意见为准。(1) 决定公司的经营方针和投资计划；(2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3) 审议批准董事会的报告；(4) 审议批准监事会的报告；(5) 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；(6) 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；(7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8) 对发行公司债券作出决议；(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(10) 决定聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(11) 修改本章程；(12) 审议公司股权激励计划；(13) 审议批准变更募集资金用途事项；(14) 审议法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。双方所推荐或委派的董事人选（如有）在公司的董事会行使表决权时，均应采取相同的意思表示保持一致，出现意见不一致时，以甲方推荐或委派的董事意见为准。 双方一致认可，《一致行动协议》中的“一致行动事项”包括股东会/董事会的提案、表决，董事/监事提名、任免，以及其他影响公司财务与经营决策相关事项。
意见分歧解决机制	在甲方履行《一致行动协议》及补充协议不违反法律法规的情况下，对于《一致行动协议》中约定的“一致行动事项”均以甲方单方面意思表示为准。
违约责任	如果任何一方(“违约方”)未按照本协议的约定履行本协议的约定，或者其在本协议中所作之任何陈述或保证是虚假的或错误的，或该陈述或保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本协议，并应赔偿守约方的相应损失。 双方进一步同意，在乙方违约的情况下，如乙方未能根据本协议第 4.1 款的约定在甲方限定时间内采取适当补救措施，则除了按照第 7.1 款承担违约赔偿责任以外，甲方有权视具体情况进一步决定采取以下措施而乙方应无条件配合：(1)由乙方继续履行本协议；或(2)甲方或其指定的第三方按照国有资产管理规定收购乙方持有的全部或部分公司股权。
解除条款	甲方履行《一致行动协议》及补充协议期间，在未触发《一致行动协议》及补充协议终止条件、且合法合规的情况下，乙方不得单方面解除《一致行动协议》及补充协议。
转让限制条款	未经甲方同意，乙方不得以委托、信托或其他任何方式将所持公司全部或部分股权委托给甲方以外的第三方管理或行使权利，亦不得将包括表决权在内的股东权益委托甲方以外的第三方行使，或以包括但不限于放弃股东权利等方式规避与甲方保持一致行动。 乙方转让所持公司股权应严格根据双方签署的公司章程、股东协议等法律文件项下的规定执行。乙方应积极支持任何受让其所持公司股权而成为公司股东的主体承接其在本协议项下的所有义务，并继续与甲方保持一致行动关系，否则乙方转让公司股权的行为无效。在甲方根据本协议第 7.2 款指定第三方收购乙方所持股权时，甲方自行与第三方协商一致行动安排。 乙方同意，于乙方持有公司股权且《一致行动协议》有效期间，非经甲方同意，乙方不得质押所持公司的股权等处置或设定其他权利限制。乙方转让所持公司的股权时，须确保受让方同意承继乙方在《一致行动协议》及补充协议项下的义务，否则未经甲方同意，乙方不得进行转让。
协议有效期	《一致行动协议》及补充协议长期有效，直至甲方收购公司股权并拥有公司控制权。

针对该等一致行动协议及补充协议，合肥产投、鑫益合升均确认，协议的内容、签

署过程、签署方各自履行的决策程序具有合法合规性，对签署方具有法律约束力。

综上，一致行动协议未违反《公司法》等法律、行政法规的强制性规定，不存在《民法典》规定的合同无效、可撤销或效力待定情形，协议内容具有合法合规性。

截至本招股说明书签署日，发行人子企业长鑫芯安系长鑫新桥第一大股东，且与发行人合计直接持有长鑫新桥超过 30%的股权。同时，基于上述协议的有效约定，发行人及其子企业长鑫芯安合计持有长鑫新桥超过三分之二的表决权，巩固并保持着对长鑫新桥长期稳定的控制权。

3、长鑫集电

企业名称	长鑫集电（北京）存储技术有限公司		
统一社会信用代码	91110302MA007QPT25		
类型	其他有限责任公司		
注册地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 51 号院 1 号楼 1-5 层		
主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区经海三路 51 号院 1 号楼 1-5 层		
法定代表人	赵纶		
注册资本	5,084,948.03 万元		
实收资本	5,084,948.03 万元		
成立日期	2016 年 08 月 23 日		
营业期限	2016 年 08 月 23 日至 2066 年 08 月 22 日		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；机械设备租赁。		
主营业务	动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售		
股东构成	序号	股东名称	持股比例
	1	长鑫科技	31.72%
	2	北京亦庄国际投资发展有限公司	31.72%
	3	大基金二期	24.67%
	4	北京亦庄科技有限公司	6.79%
	5	北京屹唐科技有限公司	5.09%
	合计		100.00%
主要财务数据 (单位：万元)	年度	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度

	总资产	11,177,733.50	9,467,550.62
	净资产	5,997,803.40	4,145,905.70
	营业收入	1,770,233.03	813,012.22
	净利润	426,728.36	-127,929.65

注：上述财务数据经德勤会计师审计。

截至本招股说明书签署日，发行人系长鑫集电第一大股东，根据长鑫集电的《公司章程》，长鑫科技享有其董事会多数董事席位的提名权，且《公司章程》中约定的董事会席位条款和《公司章程》的修订需要经全体股东一致同意，即长鑫科技能够有效且稳定控制长鑫集电董事会。为巩固发行人在长鑫集电中的控制地位，保持发行人对长鑫集电有效控制的稳定性和可持续性，发行人（甲方）和发行人子公司长鑫集电已分别与亦庄科技（乙方）、屹唐科技（乙方）以及亦庄国投（乙方）签署了一致行动协议及补充协议。上述协议主要内容如下：

事项	条款
签署目的	保证甲方取得公司的股权表决权并进一步实现对公司的控制，优化公司治理水平，同时也为了提高对公司重大事项进行决策的效率。
一致行动事项的具体范围	双方同意，本协议所称之“一致行动”、“一致行动关系”，具体应指如下含义：（1）双方应在公司股东会就一致行动事项的表决，按第二条的规定保持一致行动；（2）本协议中的“一致行动事项”是指根据适用的《公司章程》或公司全体股东之间的协议，该等事项需要在公司股东会层面决策，但本协议第 1.4 条所约定的事项除外。 为免疑义，“一致行动事项”不包括公司的如下事项、其他根据《公司法》需代表三分之二以上表决权的股东同意的事项及如本协议签署后《公司章程》和/或公司全体股东之间的协议规定的需代表三分之二以上表决权的股东同意（如有，包括但不限于需要全体股东一致同意的事项）的事项（相关调整以不影响长鑫科技对公司合并财务报表为限）：（a）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（b）对公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式或者股东之间约定的清算事件和视同清算事件作出决议；（c）修改公司章程；（d）改变公司的主营业务、进入主营业务之外的业务领域、终止任何现有主营业务；（e）审议批准公司员工激励计划和执行方案以及员工激励成本方案。 双方一致认可，甲方实际控制公司董事会。在不违反《公司章程》关于董事会约定的情况下，《一致行动协议》中的“一致行动事项”包括股东会的提案、表决，非由职工代表担任的董事/监事的提名、任免，以及该等一致行动事项下所涉及的其他影响公司财务与经营决策的股东会相关事项等（需全体股东一致同意的事项除外）。
意见分歧解决机制	在不违反《一致行动协议》及补充协议不违反法律法规的情况下，对于《一致行动协议》中约定的“一致行动事项”均以甲方单方面意思表示为准。
违约责任条款	如果任何一方（“违约方”）未按照本协议的约定履行本协议的约定，或者其在本协议中所作之任何陈述或保证是虚假的或错误的，或该陈述或保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本协议，并应赔偿守约方的相应损失。 双方进一步同意，在乙方违约的情况下，如乙方未能根据本协议第 4.1 款的约定在甲方限定时间内采取适当补救措施，则除了按照第 7.1 款承担违约赔偿责任以外，甲方有权视具体情况进一步要求由乙方继续履行本协议。

事项	条款
解除条款	乙方不得单方面解除《一致行动协议》及补充协议或撤回授权，但在甲方违反《一致行动协议》和/或触发《一致行动协议》及补充协议终止条件和/或《一致行动协议》及补充协议违反法律法规的情况下除外。
转让限制条款	未经甲方同意，乙方不得以委托、信托或其他任何方式将所持公司全部或部分股权委托给甲方以外的第三方管理或行使权利，亦不得将包括表决权在内的股东权益委托甲方以外的第三方行使，或以包括但不限于放弃股东权利等方式规避与甲方保持一致行动（但乙方因关联交易或与所表决事项具有法定应予以回避的情形而需要回避表决的情形除外）。 甲方或乙方转让所持公司股权应严格根据双方签署的《公司章程》、《增资扩股合同》等法律文件项下的规定执行。乙方对第三方转让所持公司股权时应根据《增资扩股合同》相关约定提前通知并取得甲方同意，如受让方未同意承接乙方在本协议项下的所有义务，则甲方有权拒绝乙方转让股权的要求。 乙方同意，于乙方持有公司股权且《一致行动协议》有效期间，非经甲方同意，乙方不得质押所持公司的股权等处置或设定其他权利限制。乙方转让所持公司的股权时，须确保受让方同意承继乙方在《一致行动协议》及补充协议项下的义务，否则未经甲方同意，乙方不得进行转让。
协议有效期	《一致行动协议》及补充协议长期有效，直至甲方通过一致行动安排以外的其他方式（包括收购公司股权并拥有公司控制权）实现对公司合并财务报表或乙方不再持有公司股权（以较早发生者为准）。在达成前述情形及《一致行动协议》第 6.1 条终止条件情况下（以较早发生者为准），《一致行动协议》及补充协议自动终止。 《一致行动协议》终止条件包括：若在本协议有效期内，(i)甲方通过本协议约定的一致行动安排以外的其他方式实现对公司合并财务报表，或者(ii)乙方不再持有公司股权，则本协议应在该等事件发生之日（以较早发生者为准）自动终止。

针对该等一致行动协议及补充协议，亦庄科技、屹唐科技、亦庄国投均确认，协议的内容、签署过程、签署方各自履行的决策程序具有合法合规性，对签署方具有法律约束力。

综上，一致行动协议未违反《公司法》等法律、行政法规的强制性规定，不存在《民法典》规定的合同无效、可撤销或效力待定情形，协议内容具有合法合规性。

截至本招股说明书签署日，发行人系长鑫集电第一大股东，直接持有长鑫集电超过30%的股权，且控制长鑫集电董事会。同时，基于上述协议的约定，发行人合计持有长鑫集电超过三分之二的表决权，巩固并保持着对长鑫集电长期稳定的控制权。

（二）其他子公司具体情况

截至本招股说明书签署日，发行人其他子公司基本情况如下：

1、长鑫香港

企业名称	长鑫存储技术（香港）有限公司 ChangXin Memory Technology (Hong Kong) Limited
商业登记号码	69757731

注册地址	Room 06, 13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
已发行股份数	500.00 万港元
成立日期	2018 年 8 月 14 日
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股份

2、长鑫科服

企业名称	合肥长鑫科技服务有限公司
统一社会信用代码	91340111MA2UYQ645U
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号 CB 栋 101 室
法定代表人	李啸宇
注册资本	5,000.00 万元
成立日期	2020 年 7 月 3 日
经营期限	2020 年 7 月 3 日至无固定期限
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；餐饮管理；规划设计管理；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商业综合体管理服务；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；企业管理咨询；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

3、久芯科技

企业名称	北京久芯科技有限公司
统一社会信用代码	91110302MA01TEQA1L
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区经海三路 51 号院 1 号楼 2 层
法定代表人	赵纶
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2020 年 7 月 8 日
经营期限	2020 年 7 月 8 日至无固定期限
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；集成电路设计；

	产品设计；委托加工半导体集成电路芯片；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通信设备、电子产品；设备租赁；出租办公用房；出租商业用房；代理进出口、技术进出口、货物进出口。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

4、长鑫日本

企业名称	ChangXin Memory Technologies ジャパン株式会社
公司编号	0106-01-058398
注册地址	日本神奈川县横滨市港北区新横滨 2 丁目 8 番 12 号
认缴注册资本	900.00 万日元
成立日期	2020 年 11 月 30 日
经营范围	1.存储器片的开发、设计、关于软件开发及测试的服务及技术转移服务； 2.半导体制品的销售及售后服务； 3.有关半导体制品及电脑的软件及硬件的开发； 4.半导体关联公司（生产商、商社或技术开发公司）的收购及收购相关支持服务； 5.半导体设备的设计、软件开发、量产方面的技术开发、测试程序的开发及销售等的咨询业务； 6.以上各项附带的所有业务。
出资人及持有权益情况	长鑫香港持有 100%股份

5、长鑫西安

企业名称	长鑫存储技术（西安）有限公司
统一社会信用代码	91610131MAB10DL15U
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	陕西省西安市高新区科技六路西段 88 号新加坡腾飞科汇城东楼 23 层 2301 室
法定代表人	赵纶
注册资本	1,000.00 万元
成立日期	2021 年 9 月 10 日
经营期限	2021 年 9 月 10 日至无固定期限
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

6、长鑫芯聚

企业名称	长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司
统一社会信用代码	91340111MA8NRTL0Y
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
法定代表人	赵纶
注册资本	563,364.70 万元
成立日期	2022 年 3 月 16 日
经营期限	2022 年 3 月 16 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

7、启航鑫睿

企业名称	安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91340111MA8NWX334M
类型	其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区锦绣大道 5708 号清华路科技园 30 号楼
法定代表人	孙坚
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2022 年 3 月 30 日
经营期限	2022 年 3 月 30 日至无固定期限
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	长鑫芯聚持有 100%股权

8、长鑫芯元

企业名称	长鑫芯元股权投资（安徽）有限公司
统一社会信用代码	91340111MA8P4JLL3U
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
法定代表人	赵纶
注册资本	10,000.00 万元

成立日期	2022 年 6 月 9 日
经营期限	2022 年 6 月 9 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	长鑫芯聚持有 100%股权

9、长鑫科技合肥

企业名称	长鑫存储科技（合肥）有限公司
统一社会信用代码	91340111MA8PDEPY0N
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号
法定代表人	赵纶
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2022 年 8 月 26 日
经营期限	2022 年 8 月 26 日至无固定期限
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

10、长鑫产品合肥

企业名称	长鑫存储产品（合肥）有限公司
统一社会信用代码	91340123MA8PN0YKXR
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区紫蓬山路 8 号
法定代表人	赵纶
注册资本	666,100.00 万元
成立日期	2022 年 11 月 4 日
经营期限	2022 年 11 月 4 日至无固定期限
经营范围	许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；通用设备修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；电子元器件批

	发；电子产品销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

11、长鑫集电科技

企业名称	长鑫集电科技（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110400MAC6U2BL52
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼6层601-1（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人	赵纶
注册资本	500,000.00 万元
成立日期	2022 年 12 月 26 日
营业期限	2022 年 12 月 26 日至 2072 年 12 月 25 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资人及持有权益情况	长鑫集电持股 100%

12、长鑫集电半导体

企业名称	长鑫集电半导体（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110400MAC6A6EB40
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼6层601-1（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人	赵纶
注册资本	500,000.00 万元
成立日期	2022 年 12 月 26 日
营业期限	2022 年 12 月 26 日至 2072 年 12 月 25 日
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

企业名称	长鑫集电半导体（北京）有限公司
出资人及持有权益情况	长鑫集电持股 100%

13、长鑫闵科

企业名称	长鑫闵科存储技术（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310112MAC5C6PF7P
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	上海市闵行区漕宝路 1355 号 26 幢
法定代表人	赵纶
注册资本	1,000.00 万元
成立日期	2023 年 1 月 6 日
经营期限	2023 年 1 月 6 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；电子元器件批发；软件开发；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

14、安徽新一代

企业名称	安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）	
统一社会信用代码	91340111MA8Q9R8X9F	
类型	有限合伙企业	
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创业园 9 号楼 808 室	
执行事务合伙人	启航鑫睿	
出资额	1,250,000.00 万元	
成立日期	2023 年 4 月 6 日	
经营期限	2023 年 4 月 6 日至 2035 年 4 月 6 日	
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
出资人及持有权益情况	出资人	持有权益比例
	安徽省财金投资有限公司	40.00%
	长鑫芯聚	39.92%
	合肥市创业投资引导基金有限公司	10.02%

	合肥市创业投资引导基金二期有限公司	9.98%
	启航鑫睿	0.08%
	合计	100.00%

15、启航创芯

企业名称	合肥启航创芯基金合伙企业（有限合伙）	
统一社会信用代码	91340111MA8QP5YCXL	
类型	有限合伙企业	
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创业园 9 号楼 808 室	
执行事务合伙人	启航鑫睿	
出资额	550,001.00 万元	
成立日期	2023 年 7 月 13 日	
经营期限	2023 年 7 月 13 日至 2030 年 7 月 12 日	
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
出资人及持有权益情况	出资人	持有权益比例
	安徽新一代	90.9089%
	长三角协同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	9.0909%
	启航鑫睿	0.0002%
	合计	100.0000%

16、长鑫芯达

企业名称	长鑫芯达企业管理（合肥）有限公司
统一社会信用代码	91340111MA8QY4MT91
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区硕放路 1 号新桥集成电路科技园研发楼 106 室
法定代表人	赵纶
注册资本	100.00 万元
成立日期	2023 年 9 月 1 日
经营期限	2023 年 9 月 1 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；财务咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	长鑫芯聚持有 100%股权

17、长鑫芯安

企业名称	长鑫芯安（合肥）企业管理合伙企业（有限合伙）	
统一社会信用代码	91340111MA8QYLWD8U	
类型	有限合伙企业	
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区硕放路 1 号新桥集成电路科技园研发楼 106 室	
执行事务合伙人	长鑫芯达	
出资额	1,519,137.00 万元	
成立日期	2023 年 9 月 6 日	
经营期限	2023 年 9 月 6 日至无固定期限	
经营范围	一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
出资人及持有权益情况	出资人	持有权益比例
	启航创芯	36.2048%
	合肥产投	33.0080%
	发行人	30.7807%
	长鑫芯达	0.0066%
	合计	100.0000%

18、长鑫深芯

企业名称	长鑫深芯科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MAD34PE377
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B3504
法定代表人	赵纶
注册资本	50.00 万元
成立日期	2023 年 11 月 15 日
经营期限	2023 年 11 月 15 日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；销售代理；信息技术咨询服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

19、长鑫芯瑞

企业名称	长鑫芯瑞存储技术（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110400MADFRPLT0H
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢5层501-10
法定代表人	赵纶
注册资本	20,000.00 万元
成立日期	2024 年 3 月 27 日
经营期限	2024 年 3 月 27 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；电子元器件批发；软件开发；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

20、长鑫汇芯

企业名称	长鑫汇芯贸易（合肥）有限公司
统一社会信用代码	91340111MAEA7KHX23
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道空港工业园兴业大道 388 号
法定代表人	赵纶
注册资本	500.00 万元
成立日期	2025 年 2 月 17 日
经营期限	2025 年 2 月 17 日至无固定期限
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

21、长鑫汇芯北京

企业名称	长鑫汇芯贸易（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110400MAECBJLJ4K

类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层606-3室
法定代表人	赵纶
注册资本	500.00 万元
成立日期	2025 年 3 月 11 日
经营期限	2025 年 3 月 11 日至无固定期限
经营范围	一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；进出口代理；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资人及持有权益情况	发行人持有 100%股权

（三）其他参股公司具体情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外投资的其他参股公司基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围	股权结构	控制方	发行人 认缴比例 （%）	发行人 实缴出资 （万元）	发行人 入股时间
1	上海芯展科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务	长鑫芯聚认缴 10%，上海孚腾私募基金管理有限公司认缴 35%，上海临港科创投资管理有限公司认缴 20%，芯原微电子（上海）股份有限公司认缴 10%，上海华虹投资发展有限公司认缴 10%，上海兆芯集成电路股份有限公司认缴 10%，西藏远识创业投资管理有限公司认缴 5%	无实际控制人	10.00%	100.00	2024 年 10 月

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股子公司对外投资并参股的股权投资企业基本情况如下：

序号	公司名称	发行人实缴出资 （万元）	认缴主体及比例	执行事务合伙人	发行人 入股时间
1	长三角协同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	50,000.00	长鑫芯聚认缴 7.04%	上海国方私募基金管理有限公司	2023 年 3 月
2	北京京芯集力科技合伙企业（有限合伙）	5,000.00	长鑫芯聚认缴 16.61%	北京驰砺科技有限公司	2024 年 7 月
3	安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000.00	安徽新一代认缴 27.27%	深圳创维投资管理企业（有限合伙）	2023 年 11 月
4	安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,644.83	安徽新一代认缴 13.33%	兴富投资管理有限公司	2023 年 12 月
5	芜湖德联星宸投资基金中心（有限合伙）	10,000.00	安徽新一代认缴 20.00%	芜湖德联运通投资管理合伙企业(有限合伙)	2024 年 1 月

序号	公司名称	发行人实缴出资 (万元)	认缴主体及比例	执行事务合伙人	发行人 入股时间
6	安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）	9,000.00	安徽新一代认缴 30%	山证投资有限责任公司、合肥瑞丞私募基金管理有限公司	2024 年 4 月
7	厚雪启明星河股权投资基金（合肥）合伙企业（有限合伙）	3,000.00	安徽新一代认缴 30%	上海厚雪私募基金管理有限公司	2024 年 8 月
8	安徽嘉岸启信创业投资合伙企业（有限合伙）	26,631.26	安徽新一代认缴 30%	宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）	2024 年 8 月
9	合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）	10,500.00	安徽新一代认缴 30%	上海高信私募基金管理有限公司	2024 年 10 月
10	安徽美科启信创业投资合伙企业（有限合伙）	3,173.09	安徽新一代认缴 30%	宁波美科美慧企业管理合伙企业（有限合伙）	2024 年 10 月
11	安徽徽海启明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000.00	安徽新一代认缴 30%	青岛海立方舟股权投资管理有限公司	2024 年 10 月
12	滁州启金翌鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	3,600.00	安徽新一代认缴 30%	安徽省听瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)	2024 年 12 月
13	安徽华业启成股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000.00	安徽新一代认缴 17.02%	珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）	2025 年 1 月
14	合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）	18,330.00	安徽新一代认缴 21.95%，启航鑫睿认缴 1.17%	安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司	2024 年 1 月
15	安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）	2,400.00	安徽新一代认缴 30%	国元股权投资有限公司	2025 年 7 月
16	上海中移数字转型产业私募基金合伙企业（有限合伙）	25,000.00	安徽新一代认缴 7.34%	浦和创（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	2025 年 9 月
17	合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32,567.33	安徽新一代认缴 29.99%	合肥经开创业投资管理有限公司	2025 年 12 月

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）持有发行人 5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日，直接持有发行人 5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	清辉集电	1,304,375.49	21.67
2	长鑫集成	704,783.51	11.71
3	大基金二期	525,607.38	8.73
4	合肥集鑫	503,736.38	8.37
5	安徽省投	476,049.45	7.91

1、清辉集电

企业名称	合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368 号格易集成电路合肥基地项目办公室楼辅楼 205 室
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368 号格易集成电路合肥基地项目办公室楼辅楼 205 室
执行事务合伙人	合肥清辉长鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	1,370,100.00 万元
实缴出资额	1,370,100.00 万元
成立日期	2020 年 9 月 30 日
主营业务	从事投资业务（仅投资发行人）
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关
实际控制人	无实际控制人

截至本招股说明书签署日，清辉集电合伙份额结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	芯睿投资	700,000.00	51.09
2	长鑫集成	670,000.00	48.90
3	合肥清辉长鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	0.01
合计		1,370,100.00	100.00

2、长鑫集成

企业名称	合肥长鑫集成电路有限责任公司
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦525室
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦525室
注册资本	271,505.05 万元
实收资本	271,505.05 万元
成立日期	2016 年 6 月 13 日
主营业务	从事工程服务及投资业务
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关
实际控制人	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

截至本招股说明书签署日，长鑫集成股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	271,505.05	100.00
合计		271,505.05	100.00

3、大基金二期

企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
注册资本	20,415,000.00 万元
实收资本	20,039,270.10 万元
成立日期	2019 年 10 月 22 日
主营业务	从事集成电路产业相关投资业务
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关
实际控制人	无实际控制人

截至本招股说明书签署日，大基金二期股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例 (%)
1	中华人民共和国财政部	2,250,000.00	11.02
2	国开金融有限责任公司	2,200,000.00	10.78
3	中国烟草总公司	1,500,000.00	7.35
4	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000.00	7.35
5	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000.00	7.35

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
6	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000.00	7.35
7	成都天府国集投资有限公司	1,500,000.00	7.35
8	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,400,000.00	6.86
9	江苏甌泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000.00	4.90
10	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000.00	4.90
11	北京国谊医院有限公司	1,000,000.00	4.90
12	中移资本控股有限责任公司	1,000,000.00	4.90
13	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	750,000.00	3.67
14	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)	750,000.00	3.67
15	广州产业投资基金管理有限公司	300,000.00	1.47
16	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000.00	1.47
17	深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	300,000.00	1.47
18	黄埔投资控股(广州)有限公司	200,000.00	0.98
19	中国电信集团有限公司	150,000.00	0.73
20	联通资本投资控股有限公司	100,000.00	0.49
21	广西投资引导基金有限责任公司	100,000.00	0.49
22	中电金投控股有限公司	50,000.00	0.24
23	华芯投资管理有限责任公司	15,000.00	0.07
24	北京建广私募基金管理有限公司	10,000.00	0.05
25	上海矽启企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000.00	0.05
26	协鑫资本管理有限公司	10,000.00	0.05
27	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000.00	0.05
28	福建三安集团有限公司	10,000.00	0.05
合计		20,415,000.00	100.00

4、合肥集鑫

企业名称	合肥集鑫企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区合肥空港经济示范区玉兰路东侧合肥空港动植物检验检疫进境指定口岸办公楼 110 室
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区合肥空港经济示范区玉兰路东侧合肥空港动植物检验检疫进境指定口岸办公楼 110 室
执行事务合伙人	合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司
出资额	528,919.43 万元
成立日期	2020 年 7 月 14 日

主营业务	员工持股平台
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关
实际控制人	无实际控制人

截至本招股说明书签署日，合肥集鑫合伙份额结构如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥集鑫肆拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	478,934.14	90.5495
2	合肥集鑫零号企业管理合伙企业（有限合伙）	39,434.88	7.4557
3	香港集鑫有限公司	10,549.91	1.9946
4	合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司	0.50	0.0001
合计		528,919.43	100.0000

5、安徽省投

企业名称	安徽省投资集团控股有限公司
注册地址	安徽省合肥市宿松路 3658 号
主要生产经营地	安徽省合肥市宿松路 3658 号
注册资本	6,000,000.00 万元
实收资本	6,000,000.00 万元
成立日期	1998 年 7 月 31 日
主营业务	从事投资业务及企业管理
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关
实际控制人	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

截至本招股说明书签署日，安徽省投股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	6,000,000.00	100.00
合计		6,000,000.00	100.00

（二）控股股东、实际控制人情况

公司为无控股股东、无实际控制人结构，最近两年实际控制人未发生变更。

根据公司股权结构，直接持有公司 5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，截至本招股说明书签署日，分别持有长鑫科技 21.67%、11.71%、8.73%、8.37%及 7.91%的股权，不存在单一持股比例超过 50%的股东，公司的股权结构较为分散。

根据公司董事会构成，公司董事会由 11 名成员构成，其中独立董事 4 名。7 名非独立董事中，清辉集电提名 2 名，大基金二期提名 2 名，合肥集鑫提名 1 名，安徽省投提名 1 名，职工董事 1 名。根据长鑫科技的公司章程以及清辉集电的合伙协议，最近两年，清辉集电向长鑫科技提名的公司董事人数均为 2 人，分别由执行事务合伙人清辉长鑫及有限合伙人长鑫集成提名推荐。长鑫科技董事会 7 名非独立董事实际提名方为：清辉长鑫 1 席，长鑫集成 1 席，大基金二期 2 席，合肥集鑫 1 席，安徽省投 1 席，职工董事 1 席，因此，无任何一名股东通过实际支配表决权能够决定长鑫科技董事会半数以上成员的选任。

综上，根据公司股权架构及董事会成员构成，报告期内，公司为无控股股东、无实际控制人结构。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东、无实际控制人，因此，不存在控股股东、实际控制人控制的其他企业。

（四）股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

九、发行人协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构。

十、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

本次发行前，公司总股本为 6,019,279.75 万股，本次拟公开发行股份不超过 1,062,225.9999 万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。若本次公司公开发行 668,808.8608 万股，发行前后公司的股本结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
清辉集电	1,304,375.49	21.67	1,304,375.49	19.50
长鑫集成	704,783.51	11.71	704,783.51	10.54
大基金二期	525,607.38	8.73	525,607.38	7.86
合肥集鑫	503,736.38	8.37	503,736.38	7.53
安徽省投	476,049.45	7.91	476,049.45	7.12
阿里云计算	231,920.20	3.85	231,920.20	3.47
产投壹号	111,111.41	1.85	111,111.41	1.66
兆易创新	108,567.24	1.80	108,567.24	1.62
招银云亭	95,209.89	1.58	95,209.89	1.42
北京峰益	90,131.42	1.50	90,131.42	1.35
合肥建长	90,131.42	1.50	90,131.42	1.35
和谐健康	90,131.42	1.50	90,131.42	1.35
国调基金	67,598.56	1.12	67,598.56	1.01
阿里网络	67,598.56	1.12	67,598.56	1.01
鑫芯励润	63,977.53	1.06	63,977.53	0.96
宁波燕创	59,486.74	0.99	59,486.74	0.89
农银投资	57,408.39	0.95	57,408.39	0.86
芜湖星原	54,078.85	0.90	54,078.85	0.81
建信投资	49,808.56	0.83	49,808.56	0.74
星棋道和	48,867.68	0.81	48,867.68	0.73
国寿投资	47,604.95	0.79	47,604.95	0.71
宁波君和	46,868.34	0.78	46,868.34	0.70
中安招商基金	46,798.79	0.78	46,798.79	0.70
人保资本	46,703.85	0.78	46,703.85	0.70
鑫芯家园	45,291.04	0.75	45,291.04	0.68
嘉兴恒旭	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67
美的投资	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67
安徽担保资管	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67
安元星亿达	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67
安华创新	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67
君挚璞创投	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67
青岛朗格	45,065.71	0.75	45,065.71	0.67

股东名称	发行前		发行后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
Gamcier	43,105.35	0.72	43,105.35	0.64
建银国际	41,181.37	0.68	41,181.37	0.62
华芯科泰	39,883.15	0.66	39,883.15	0.60
广州科集	38,314.28	0.64	38,314.28	0.57
工融金投	38,314.28	0.64	38,314.28	0.57
深圳投控	35,601.91	0.59	35,601.91	0.53
Glades View	32,803.68	0.54	32,803.68	0.49
招证投资	32,371.36	0.54	32,371.36	0.48
前海方舟	30,194.03	0.50	30,194.03	0.45
云锋卓越	29,292.71	0.49	29,292.71	0.44
安徽交控	29,108.79	0.48	29,108.79	0.44
海通徽银	28,562.97	0.47	28,562.97	0.43
中银资产	22,988.57	0.38	22,988.57	0.34
交银金融	22,988.57	0.38	22,988.57	0.34
东方资管	22,532.85	0.37	22,532.85	0.34
阳光人寿	22,532.85	0.37	22,532.85	0.34
中邮人寿	22,532.85	0.37	22,532.85	0.34
建信领航	22,532.85	0.37	22,532.85	0.34
天津海河	19,041.98	0.32	19,041.98	0.28
中金共赢	19,041.98	0.32	19,041.98	0.28
广州信德	16,765.02	0.28	16,765.02	0.25
湖北小米	12,675.59	0.21	12,675.59	0.19
北京君联	11,774.27	0.20	11,774.27	0.18
人保科创	9,013.14	0.15	9,013.14	0.13
和壮高新	7,662.86	0.13	7,662.86	0.11
中建材新材料基金	7,662.86	0.13	7,662.86	0.11
芯鑫集电	7,661.17	0.13	7,661.17	0.11
产投高成长	3,831.43	0.06	3,831.43	0.06
本次拟发行	-	-	668,808.86	10.00
合计	6,019,279.75	100.00	6,688,088.61	100.00

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前的前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	清辉集电	1,304,375.49	21.67
2	长鑫集成	704,783.51	11.71
3	大基金二期	525,607.38	8.73
4	合肥集鑫	503,736.38	8.37
5	安徽省投	476,049.45	7.91
6	阿里云计算	231,920.20	3.85
7	产投壹号	111,111.41	1.85
8	兆易创新	108,567.24	1.80
9	招银云亭	95,209.89	1.58
10	北京峰益	90,131.42	1.50
10	合肥建长	90,131.42	1.50
10	和谐健康	90,131.42	1.50
合计		4,331,755.21	71.97

（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司股东均为机构股东，无自然人股东。

（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况

1、国有股份情况

截至本招股说明书签署日，公司股东中共有 15 名国有股东符合《上市公司国有股权监督管理办法》第三条规定的情形。根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会于 2025 年 8 月 14 日出具的《关于长鑫科技集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》，发行人下列股东标注“SS”标识：

序号	股东名称	股东标识（SS/CS）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	长鑫集成	SS	704,783.51	11.71
2	大基金二期	SS	525,607.38	8.73
3	安徽省投	SS	476,049.45	7.91
4	国调基金	SS	67,598.56	1.12
5	农银投资	SS	57,408.39	0.95

序号	股东名称	股东标识 (SS/CS)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
6	建信投资	SS	49,808.56	0.83
7	国寿投资	SS	47,604.95	0.79
8	人保资本	SS	46,703.85	0.78
9	安徽担保资管	SS	45,065.71	0.75
10	建银国际	SS	41,181.37	0.68
11	招证投资	SS	32,371.36	0.54
12	中银资产	SS	22,988.57	0.38
13	交银金融	SS	22,988.57	0.38
14	东方资管	SS	22,532.85	0.37
15	中邮人寿	SS	22,532.85	0.37
合计			2,185,225.93	36.29

注：SS 系 State-owned Shareholder 缩写，表示国有股东；CS 系 Controlling State-owned Shareholder 的缩写，表示不符合国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业。

2、外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司外资股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	Gamcier	43,105.35	0.72
2	Glades View	32,803.68	0.54
合计		75,909.03	1.26

(五) 股东私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 60 名机构股东。其中 29 名机构股东不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续，具体情况如下：

单位：名

股东名称	机构股东数量	不需备案原因
(1) Gamcier (2) Glades View	2	境外机构股东
(1) 合肥集鑫	1	发行人员工持股平台
(1) 长鑫集成 (2) 安徽省投 (3) 阿里云计算	17	依据中国法律法规依法设立并有效存续的公司，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形、不存在资产由基金

股东名称	机构股东数量	不需备案原因
(4) 兆易创新 (5) 和谐健康 (6) 阿里网络 (7) 农银投资 (8) 建信投资 (9) 美的投资 (10) 安徽担保资管 (11) 建银国际 (12) 招证投资 (13) 中银资产 (14) 交银金融 (15) 东方资管 (16) 中邮人寿 (17) 阳光人寿		管理人管理的情形、亦未担任任何私募投资基金的管理人
(1) 国寿投资 (2) 人保资本	2	代表其设立的股权投资计划持有公司股份，前述股权投资计划依法设立并已纳入国家金融监管部门有效监管，登记编号分别为 202020120003、202021120009，其投资发行人的行为已按照规定履行审批、备案或报告程序，国寿投资和人保资本作为管理人也已依法注册登记
(1) 清辉集电 (2) 北京峰益 (3) 华芯科泰 (4) 鑫芯励润 (5) 产投壹号 (6) 广州科集 (7) 广州信德	7	不存在以公开或非公开方式募集资金设立的情形，未专门委托基金管理人进行投资管理，亦不存在收取管理费或业绩报酬的情形
合计	29	-

截至本招股说明书签署日，公司共有 31 名机构股东属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金管理办法》规定的私募投资基金，均已在基金业协会进行私募基金备案，具体情况如下：

序号	股东名称	备案编号/产品编码	备案时间	基金管理人名称	登记编号	登记时间
1	大基金二期	SJU890	2020.03.12	华芯投资管理有限责任公司	P1009674	2015.03.25
2	招银云亭	SNR510	2021.01.12	招银国际资本管理（深圳）有限公司	P1009831	2015.04.02
3	天津海河	SLR987	2020.08.24	珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1001260	2014.04.23
4	湖北小米	SEE206	2018.07.20	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司	P1067842	2018.04.02
5	北京君联	SEF172	2018.08.13	君联资本管理股份有限公司	P1000489	2014.03.17

序号	股东名称	备案编号/产品编码	备案时间	基金管理人名称	登记编号	登记时间
6	芜湖星原	SQT787	2021.07.27	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	P1000502	2014.04.22
7	国调基金	SN3042	2016.11.25	诚通基金管理有限公司	P1033560	2016.09.08
8	宁波燕创	SQV819	2021.07.05	上海燕创德恒私募基金管理有限公司	P1033742	2016.09.19
9	安元星亿达	SQS390	2021.06.07	安徽安元投资基金管理有限公司	P1023390	2015.09.18
10	嘉兴恒旭	SQF491	2021.04.06	上海恒旭创领私募基金管理有限公司	P1070270	2019.10.28
11	青岛朗格	SQX717	2021.07.02	深圳市招商金台资本管理有限责任公司	P1060508	2016.12.16
12	君挚璞创投	SQY725	2021.07.09	苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）	P1067353	2018.02.11
13	人保科创	SND880	2020.10.29	人保资本股权投资有限公司	P1069084	2018.09.29
14	建信领航	SLA615	2020.09.22	建信股权投资管理有限责任公司	P1004749	2014.10.13
15	前海方舟	STL197	2021.12.15	前海方舟资产管理有限公司	P1030546	2016.01.21
16	星棋道和	SNG601	2020.12.11	伟星资产管理（上海）有限公司	P1060370	2016.12.09
17	宁波君和	SSZ320	2021.12.17	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）	P1061301	2017.01.25
18	鑫芯家园	STM711	2021.12.21	粤港澳大湾区共同家园发展基金管理有限公司	P1070125	2019.08.28
19	深圳投控	STB595	2022.01.04	深圳市投控资本有限公司	P1064093	2017.08.07
20	芯鑫集电	SVT868	2022.07.05	天津建银国际金禾股权投资管理有限公司	P1015284	2015.06.05
21	合肥建长	SAQR23	2024.11.19	合肥建投资本管理有限公司	P1033786	2016.09.19
22	云锋卓越	SSL206	2021.10.14	上海云锋新创投资管理有限公司	P1008847	2015.03.04
23	安徽交控	SCA820	2017.12.29	安徽徽道招商私募基金管理有限公司	GC2600030392	2017.12.20
24	海通徽银	SNH852	2020.12.04	海通开元投资有限公司	PT2600012857	2015.05.08
25	中金共赢	SJN595	2020.02.17	中金资本运营有限公司	PT2600030375	2017.12.13
26	安华创新	SQF680	2021.04.08	华安嘉业投资管理有限公司	GC1900031600	2015.07.16
27	工融金投	SXL680	2022.09.30	工银资本管理有限公司	P1069650	2019.03.26

序号	股东名称	备案编号/产品编码	备案时间	基金管理人名称	登记编号	登记时间
28	中建材新材料基金	SSG288	2021.10.11	中建材私募基金管理（北京）有限公司	P1072218	2021.07.23
29	产投高成长	STR199	2022.03.07	合肥产投资本创业投资管理有限公司	P1071755	2021.01.19
30	和壮高新	SJJ005	2020.01.15	方正和生投资有限责任公司	PT2600011619	2015.12.17
31	中安招商基金	S32115	2015.12.18	招商致远资本投资有限公司	PT2600030376	2017.12.13

（六）发行人特殊股东情况

截至本招股说明书签署日，公司直接股东中存在国寿投资、人保资本所发行的股权投资计划，其分别持有公司 0.79%、0.78%的股权。国寿投资、人保资本所发行的股权投资计划具体情况如下：

1、国寿投资-睿力集成股权投资计划

股权投资计划名称	国寿投资-睿力集成股权投资计划
登记编号	202020120003
登记时间	2020.12.09
管理人名称	国寿投资保险资产管理有限公司
认购人	中国人寿财产保险股份有限公司

2、人保资本-睿力集成股权投资计划

股权投资计划名称	人保资本-睿力集成股权投资计划
登记编号	202021120009
登记时间	2021.12.14
管理人名称	人保资本保险资产管理有限公司
认购人	光大永明人寿保险有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司

截至本招股说明书签署日，国寿投资和人保资本不是长鑫科技控股股东、实际控制人或第一大股东，持股比例均低于 1%；国寿投资和人保资本及所发行的股权投资计划依法设立并有效存续，已纳入国家金融监管部门有效监管，并已按照规定履行审批、备案或报告程序，国寿投资和人保资本作为管理人也已依法注册登记；国寿投资和人保资本及所发行的股权投资计划已按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》等相关要求履行股东信息披露义务并对锁定期和减持等事项作出合理安排；公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属，本次发行的中介机构及其经办人员未直接

或间接在上述股权投资计划中持有权益；国寿投资和人保资本的股权投资计划穿透后的认购人均为具有长期投资意愿的大型保险公司，符合发行人股权清晰的发行上市条件。

（七）申报前十二个月发行人新增股东情况

1、申报前十二个月新增股东的持股数量及变化等情况

截至本招股说明书签署日，公司申报前十二个月新增股东情况如下：

序号	股东名称	取得股份方式	取得股份时间	取得股份数量 (万股)	取得价格 (元/股)	定价依据	入股原因
1	广州信德	股份受让	2025.6.6	10,301.67	2.5967	协商定价	看好公司发展
		增资	2025.6.27	6,463.35	2.6302	协商定价	看好公司发展
2	星棋道和	增资	2025.6.27	3,801.97	2.6302	协商定价	看好公司发展
3	阿里云计算	增资	2025.6.27	231,920.20	2.6302	协商定价	看好公司发展

注：2025年6月增资的投资者星棋道和自2022年起已成为公司股东，不属于申报前12个月新增股东，因此星棋道和所持公司股权仅2025年6月增资部分适用《证券期货法律适用意见第17号》中相关锁定要求：发行人申报前6个月增资扩股的，新增股份持有人自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起锁定36个月。

广州信德、阿里云计算已承诺所持申报前12个月内新增股份自取得之日起36个月内不得转让。星棋道和已承诺所持申报前6个月内取得的新增股份自取得之日起36个月不得转让。

公司不存在申报前6个月内从控股股东、实际控制人受让股份的新增股东。

2、申报前十二个月新增股东的基本情况

公司IPO申报前十二个月新增股东的基本信息参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、申报前十二个月新增股东的基本情况”。

3、关联关系情况

公司申报前十二个月新增股东中阿里云计算与公司股东阿里网络同受阿里巴巴集团控股有限公司控制。除上述情况外，公司申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。公司申报前十二个月新增股东不存在股份代持的情形。

(八) 本次发行前各股东间的关联关系情况

股东名称	持股比例 (%)	关联关系
清辉集电	21.67	(1)长鑫集成系持有清辉集电 48.90%合伙份额的有限合伙人； (2) 长鑫集成持有产投壹号 18.97%的财产份额； (3) 长鑫集成持有产投高成长 60.00%的财产份额，产投高成长的执行事务合伙人合肥产投资本创业投资管理有限公司与长鑫集成同受合肥产投控制。
长鑫集成	11.71	
产投壹号	1.85	
产投高成长	0.06	
建信领航	0.37	建信领航直接持有人保科创 30.00%的财产份额。
人保科创	0.15	
人保资本	0.78	人保资本的全资子公司人保资本股权投资有限公司为人保科创执行事务合伙人并持有人保科创 0.30%的财产份额。
人保科创	0.15	
建信领航	0.37	中邮人寿直接持有建信领航 10.27%的财产份额。
中邮人寿	0.37	
建银国际	0.68	(1) 芯鑫集电的管理人天津建银国际金禾股权投资管理有限公司与建银国际同为建银国际（控股）有限公司控制； (2) 建信领航的执行事务合伙人建信股权投资管理有限公司、建银国际、建信投资同受中国建设银行股份有限公司控制。
芯鑫集电	0.13	
建信领航	0.37	
建信投资	0.83	
北京君联	0.20	君挚璞创投的执行事务合伙人君联资本管理股份有限公司系北京君联的执行事务合伙人拉萨君祺企业管理有限公司的母公司。
君挚璞创投	0.75	
鑫芯励润	1.06	和壮高新持有鑫芯励润 21.09%的财产份额。
和壮高新	0.13	
招证投资	0.54	(1) 招证投资为招商证券股份有限公司的全资子公司； (2) 安徽交控的执行事务合伙人安徽徽道招商私募基金管理有限公司的控股股东招商致远资本投资有限公司系招商证券股份有限公司的全资子公司； (3) 中安招商基金的执行事务合伙人招商致远资本投资有限公司系招商证券股份有限公司全资子公司。
安徽交控	0.48	
中安招商基金	0.78	
Gamcier	0.72	Gamcier 和 Glades View 受同一主体控制。
Glades View	0.54	
阿里网络	1.12	阿里网络与阿里云计算同受阿里巴巴集团控股有限公司控制。
阿里云计算	3.85	

注：上述关联关系系指（1）股东之间构成《上市规则》第 15.1 条第（十五）款规定的关联人情形；（2）股东存在直接持有另一股东 5%以上股份或财产份额的情形；（3）如股东为合伙企业，则其普通合伙人或执行事务合伙人相同或存在前述第（1）项情形；（4）如股东为私募基金，则其私募基金管理人相同或存在前述第（1）项情形。

除上述情况外，本次发行前公司各股东之间不存在其他关联关系。

（九）公司与股东之间的特殊权利安排

2025年6月24日，长鑫科技与公司股东签署了《关于长鑫科技集团股份有限公司之股东协议》（取代此前签署的股东协议，以下简称“《股东协议》”），对股东特殊权利进行了约定，具体包括“股权转让限制”“优先购买权”“共同出售权”“优先认购权”“反稀释”“最优惠待遇”“知情权和检查权”“二期基金的特殊权利¹”等条款（以下简称“特殊权利条款”）。

公司与全体股东在《股东协议》中对股东特殊权利条款的终止进行了明确约定，主要约定如下：

（1）“二期基金的特殊权利”在公司向相关证券监督管理机构或证券交易所递交首次公开发行股票之申请日自动终止。

（2）“股权转让限制”“优先购买权”“共同出售权”“优先认购权”“反稀释”“最优惠待遇”“知情权和检查权”等其他特殊权利条款在公司向相关证券监督管理机构或证券交易所递交首次公开发行股票之申请日自动终止。同时，各方同意并确认，上述条款如果根据约定自动终止，若发生如下任何一种情形，则相关条款立即自动恢复执行，如同从未被终止过，但前提为相关安排的实施符合届时所适用法律法规的规定：（i）公司主动撤回上市申请；（ii）公司的上市申请未被受理、经审核不通过，或公司上市申请经审核通过或核准但最终未在相关证券交易所成功上市交易的。在特殊权利条款自动终止之后且恢复执行之前，各方之间的权利义务根据公司章程确定；在特殊权利条款自动终止之前或者恢复执行之后，公司章程与关键条款不一致的，应优先适用特殊权利条款。

在《股东协议》所约定的特殊权利条款中，不涉及发行人承担的回购义务，相关特殊权利条款不涉及导致公司控制权变化，相关条款未与市值挂钩，特殊权利条款不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不存在违反《监管规则适用指引——发行类第4号》规定的情形。

2025年12月5日，公司全体股东已签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之特殊权利终止协议》。根据各方签署的终止协议，上述《股东协议》中约定的特殊权利条款

¹ 根据《股东协议》第18.14条的约定：各方一致同意，在公司实现上市之前，以下事项应经股东会的审议且必须经国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（“二期基金”）的同意方可通过：（a）对二期基金签署的交易文件（指本协议及公司章程）项下任何有关二期基金的权利、优先权、特权、权力或有利于二期基金的规定作任何形式的修改、变更、终止、删减或重新签署；（b）选举和更换二期基金提名的董事，在公司下一轮融资前变更董事会人数数量；（c）公司合并、分立、清算、解散、终止、停业或形式、性质变更，或对可能导致公司解散、歇业、破产、清算的事件做出决议。

在公司正式向证券交易所提交首次公开发行 A 股股票并上市申请并获受理之日自始无效、不可恢复地终止，不存在对发行人构成重大不利影响或严重影响投资者权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的相关要求。

（十）发行人股东公开发售股份的情况

本次公开发行不涉及持股满 36 个月的原有股东向投资者公开发售股份的情况。

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员基本情况

1、董事会成员

公司董事会由 11 名成员组成，其中包括 4 名独立董事。公司董事由股东会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任；独立董事任期三年，任期届满可连选连任，连任时间不得超过六年。

截至本招股说明书签署日，公司董事会成员情况如下表所示：

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	朱一明	董事长	2023.06.26-2026.06.25	清辉集电
2	曹堪宇	董事	2023.06.26-2026.06.25	合肥集鑫
3	郑锐	董事	2025.05.09-2026.06.25	安徽省投
4	方炜	董事	2023.06.26-2026.06.25	清辉集电
5	韦俊	董事	2023.06.26-2026.06.25	大基金二期
6	侯华伟	董事	2025.08.29-2026.06.25	大基金二期
7	谢树民	董事	2025.08.07-2026.06.25	职工代表大会
8	陈武朝	独立董事	2023.06.26-2026.06.25	董事会
9	李华	独立董事	2023.06.26-2026.06.25	董事会
10	蔡一茂	独立董事	2023.06.26-2026.06.25	董事会
11	郭薇	独立董事	2025.06.24-2026.06.25	董事会

各董事简历情况如下：

（1）朱一明

朱一明先生，1972 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士研究生。朱一明先生曾先后任 ipolicy Networks Inc. 资深工程师、Monolithic System Technologies Inc.

项目主管；2005 年创办兆易创新，2005 年 4 月至 2018 年 7 月，任兆易创新总经理；2005 年 4 月至今，任兆易创新董事长。2018 年 7 月至 2023 年 4 月，先后任长鑫存储董事、董事长、首席执行官；2020 年 5 月至 2023 年 4 月，任发行人首席执行官；2021 年 2 月至今，任发行人董事长。

（2）曹堪宇

曹堪宇先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2002 年 5 月至 2005 年 6 月，曹堪宇先生先后曾任职于美国飞利浦半导体股份有限公司、美国 Hyperband comm.公司；2005 年 7 月至 2013 年 8 月先后创立了北京昆天科微电子有限公司、北京凡达讯科技有限公司；2013 年 11 月至 2017 年 10 月，任 NoVoMem,Inc. NAND 闪存事业部总经理。2017 年 11 月加入发行人后，先后任睿力集成执行副总裁、长鑫存储产品研发执行副总裁、技术研发执行副总裁、长鑫集电总经理等职务；2021 年 6 月至今，任发行人董事；2023 年 4 月至今，先后任发行人首席执行官、总裁。

（3）郑锐

郑锐先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2010 年 7 月至 2017 年 7 月，先后担任安徽省投综合发展部高级主管、金融投资部项目经理、风险管控部部门经理、安徽中安资本管理有限公司总经理助理等职务；2017 年 7 月至 2021 年 12 月，任安徽皖投资产管理有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2024 年 10 月，任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、副总经理；2024 年 10 月至今，任安徽皖投资产管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。2025 年 5 月至今，任发行人董事。

（4）方炜

方炜先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1991 年 8 月至 2022 年 1 月，先后任职于原合肥化肥厂、合肥四方化工集团有限公司、合肥市工业投资控股有限公司等公司；2015 年 3 月至 2022 年 1 月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司计划财务部总经理；2022 年 2 月至今，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司总经济师。2022 年 8 月至今，任发行人董事。

（5）韦俊

韦俊先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1990 年 7 月至 2008 年 3 月，先后任职于机械电子工业部电子行业发展司、电子工业部综合规划

司、信息产业部综合规划司；2008年3月至2015年7月，任工信部规划司副司长；2015年7月至今，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；2019年10月至今，任大基金二期副总裁；2025年5月至今，任国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司副总裁。2023年6月至今，任发行人董事。

（6）侯华伟

侯华伟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001年7月至2006年5月，任职于中国船舶工业集团公司船舶工业经济研究中心，担任船舶市场分析师；2006年5月至2011年10月，任职于国家开发银行，先后担任副科级行员、副处长等职务；2011年10月至2013年8月，任北京市西城区金融街街道办事处副主任；2013年8月至2023年4月，任职于国家开发银行，先后担任评审二局副局长、处长、行业二部处长等职务；2023年4月至今，任华芯投资管理有限责任公司董事、副总裁。2025年8月至今，任发行人董事。

（7）谢树民

谢树民先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至2021年4月，先后任职于安徽中皖物矿有限责任公司、安徽科力信息产业有限责任公司、合肥经济技术开发区管委会、华夏幸福基业股份有限公司合肥事业部。2021年4月至2022年10月，任长鑫存储综合管理部总监；2022年10月至今，任发行人总监、党群中心工会负责人；2023年6月至2025年6月，任发行人职工代表监事、监事会主席；2025年8月至今，任发行人职工董事。

（8）陈武朝

陈武朝先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1995年8月至1998年10月，任中华会计师事务所项目经理；1998年10月至今，先后担任清华大学讲师、副教授；2023年6月至今，任中国石油集团资本股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任中信信托有限责任公司独立董事；2021年9月至今，任发行人独立董事。

（9）李华

李华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1997年7月至2007年1月，先后任职于中国石化国际事业有限公司、北京市乾坤律师事务所、

天府清源控股有限公司等公司；2007年1月至2009年6月，任北京市天银律师事务所合伙人律师；2009年7月至2011年6月，任北京京仪集团有限责任公司总经理助理；2011年7月至2019年6月，任北京市盈科律师事务所高级合伙人律师、资本市场部主任；2019年6月至今，先后任北京德恒律师事务所一级合伙人、全球合伙人；2020年7月至2025年11月，任绿盟科技集团股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任太极计算机股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任北京宇信科技集团股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任发行人独立董事。

（10）蔡一茂

蔡一茂先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2006年8月至2009年8月，于韩国三星电子担任高级研究员；2009年8月至2021年6月，于北京大学微纳电子学系先后担任副教授、教授、系主任职位；2021年7月至今，于北京大学集成电路学院担任教授、院长职位；2023年4月至今，任方正科技集团股份有限公司独立董事；2025年4月至今，任北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任发行人独立董事。

（11）郭薇

郭薇女士，1982年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士研究生。2012年8月至2020年5月，任职于香港理工大学，担任助理教授职务；2020年6月至今，任职于中欧国际工商学院，担任副教授职务。2023年4月至今，任环旭电子股份有限公司独立董事。2025年6月至今，任发行人独立董事。

2、审计委员会

根据《公司章程》的规定，发行人董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，发行人不设监事会或者监事。发行人审计委员会成员为3名，为陈武朝、李华、郑锐，由陈武朝担任召集人。前述审计委员会成员的简历参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”。

3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等公司董

事会认定的人员。总经理每届任期三年，连聘可以连任。

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员情况如下表所示：

序号	姓名	职务
1	曹堪宇	总裁
2	赵纶	总经理
3	张羽	联席总裁
4	朱文菊	执行副总裁
5	黄丹阳	高级副总裁、财务负责人
6	冯鹏熙	高级副总裁、战略投资负责人
7	袁园	副总裁、董事会秘书
8	李红文	高级副总裁

各高级管理人员简历情况如下：

（1）曹堪宇

曹堪宇先生，简历详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”。

（2）赵纶

赵纶先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。赵纶先生1982年2月至2002年4月，曾先后任职于原邮电部半导体研究所、原电信科学技术研究院集成电路设计中心、大唐电信科技股份有限公司微电子分公司等；2002年4月至2012年2月，先后任大唐微电子技术有限公司总经理、副董事长，期间曾任大唐电信科技股份有限公司董事、副总经理。2012年2月至2015年7月，任中航（重庆）微电子有限公司副总经理；2015年7月至2017年11月，任北京创安微芯科技有限责任公司董事长。2017年11月至2022年10月，任长鑫存储总经理、执行董事；2023年6月至2025年8月，任发行人董事。2022年10月至今，任发行人总经理。

（3）张羽

张羽先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年7月至2002年9月，先后担任航空部第606研究所工程师、北京安可尔通讯技术有限公司副总经理。2004年3月至2024年9月，任职于京东方科技集团股份有限公司，先后

担任总监、高级副总裁、执行副总裁等职务。2024 年 9 月加入发行人，现担任发行人联席总裁。

(4) 朱文菊

朱文菊女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1993 年 7 月至 2011 年 6 月，先后任职于英特尔（中国）有限公司、NMX Philippines 等公司；2011 年 7 月至 2021 年 12 月，于美光半导体西安/新加坡/马来西亚担任总经理及副总裁职务。2021 年 12 月加入发行人，历任高级副总裁、执行副总裁等职务；2025 年 4 月至今，任发行人执行副总裁。

(5) 黄丹阳

黄丹阳女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，拥有特许公认会计师（ACCA），高级会计师职称。1991 年 7 月至 2007 年 7 月，先后任职于南京天悦（集团）公司、联合饼干（中国）有限公司南京分公司、南京百事可乐饮料有限公司、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司。2007 年 7 月至 2018 年 10 月，先后于江森自控（中国）投资有限公司、麦格纳汽车技术（上海）有限公司、上海辑智信息科技有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司担任财务总监。2018 年 10 月至 2022 年 9 月，历任长鑫存储高级总监、副总裁、高级副总裁等职务；2022 年 9 月至今，任发行人高级副总裁及财务负责人。

(6) 冯鹏熙

冯鹏熙先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，具有高级会计师、高级经济师职称，曾获得特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。1996 年 10 月至 2003 年 8 月期间，先后任工商银行武汉分行洪山支行储蓄、信贷专员、华工科技股份有限公司投资部长、武汉长江通信产业股份有限公司项目投资部部长。2006 年 3 月至 2010 年 2 月，先后任中国银行总行司库、财务管理部高级经理（统计分析、外币定价、资本管理高级分析师）。2010 年至 2020 年期间，任武汉金融控股集团有限公司副总经理及总经济师、湖北集成电路产业投资基金股份有限公司董事长（期间曾任武汉市江汉区副区长）等职务。2020 年至 2024 年 8 月，先后任小米集团产业投资部总经理、基金管理合伙人，珠海太和私募股权投资公司管理合伙人等职务。2024 年 8 月加入发行人，现任发行人高级副总裁。

(7) 袁园

袁园女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 11 月，任美的集团股份有限公司研发工程师、项目经理；2008 年 11 月至 2018 年 8 月，历任京东方科技集团股份有限公司科长、部长等职务。2018 年 9 月加入发行人后，历任发行人总监、高级总监、副总裁等职务；2023 年 6 月至今，任发行人副总裁、董事会秘书。

(8) 李红文

李红文先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2003 年 3 月，先后任职于中国航空计算技术研究所第十研究室、北京高鸿信通技术有限公司、北京畅迅信通技术有限公司；2003 年 3 月至 2017 年 2 月，任美光半导体（上海）有限责任公司设计部经理。2017 年 3 月加入发行人，先后任发行人设计总监、长鑫存储副总裁等职务；2023 年 2 月至今，先后任发行人副总裁、高级副总裁。

4、核心技术人员

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员 5 名，为曹堪宇、李红文、TAN TECK HONG（陈德鸿）、王丹、唐衍哲，各核心技术人员简历情况如下：

(1) 曹堪宇

曹堪宇先生，简历详见本招股说明书之“第四节发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”。

(2) 李红文

李红文先生，简历详见本招股说明书之“第四节发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“3、高级管理人员”。

(3) TAN TECK HONG（陈德鸿）

TAN TECK HONG（陈德鸿）先生，1980 年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，硕士研究生。2005 年 7 月至 2022 年 4 月，TAN TECK HONG（陈德鸿）先生任职于新加坡美光科技。2022 年 6 月加入发行人，目前担任发行人工厂运营副总裁职务。

（4）王丹

王丹女士，1983 年出生，中国国籍，拥有韩国永久居留权，博士研究生。2010 年 9 月至 2018 年 3 月，王丹女士于韩国三星电子担任高级工程师职务。2019 年 1 月加入发行人，目前担任发行人研发总监职务。

（5）唐衍哲

唐衍哲女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2004 年 5 月至 2018 年 11 月，唐衍哲女士先后任职于冠捷半导体（上海）有限公司、GLOBALFOUNDRIES、Institute of Microelectronics/A*STAR、NXP Semiconductors 等公司；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任职于绿芯存储技术有限公司，担任总监职务。2020 年 11 月加入发行人，目前担任发行人总监职务。

（二）董事、高级管理人员和核心技术人员与公司签订的协议及履行情况

截至本招股说明书签署日，除独立董事、股东委派董事之外，在公司专职并领薪的董事、高级管理人员及核心技术人员均已签订了《劳动合同》、保密和竞业禁止协议，对上述人员的忠诚义务和勤勉义务作了相关约定，明确了双方之间的权利和义务。自前述协议签订以来，公司董事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责，遵守相关承诺。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况

1、董事变动情况

最近两年，公司董事的具体变动情况如下：

期间	董事会成员	变动原因
2024 年 1 月至 2025 年 5 月	朱一明、曹堪宇、赵纶、王楠、方炜、彭红兵、韦俊、陈武朝、李华、蔡一茂、朱煜	-
2025 年 5 月至 2025 年 6 月	朱一明、曹堪宇、赵纶、郑锐、方炜、彭红兵、韦俊、陈武朝、李华、蔡一茂、朱煜	安徽省投变更提名董事，由王楠变更为郑锐
2025 年 6 月至 2025 年 8 月	朱一明、曹堪宇、赵纶、郑锐、方炜、彭红兵、韦俊、陈武朝、李华、蔡一茂、郭薇	朱煜辞任独立董事职务，公司新聘任郭薇为独立董事
2025 年 8 月至今	朱一明、曹堪宇、郑锐、方炜、侯华伟、韦俊、谢树民、陈武朝、李华、蔡一茂、郭薇	赵纶辞任董事职务，公司职工代表大会选举谢树民作为职工董事；大基金二期变更提名董事，由彭红兵变更为侯华伟

2、监事变动情况

最近两年，公司监事的具体变动情况如下：

期间	监事会成员	变动原因
2024 年 1 月至 2025 年 6 月	许允金、李珺、谢树民	-
2025 年 6 月至今	无	根据《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司不再设置监事会或监事

3、高级管理人员变动情况

最近两年，公司高级管理人员变动具体情况如下：

期间	人员	变动原因
2024 年 1 月至 2024 年 10 月	曹堪宇、赵纶、黄丹阳、袁园、李红文、李啸宇、刘方	-
2024 年 10 月至 2025 年 2 月	曹堪宇、赵纶、黄丹阳、袁园、李红文、刘方、张羽、冯鹏熙	张羽、冯鹏熙被聘任为高级管理人员，李啸宇不再认定为高级管理人员
2025 年 2 月至 2025 年 4 月	曹堪宇、赵纶、黄丹阳、袁园、李红文、张羽、冯鹏熙	刘方离职，辞任公司高级管理人员
2025 年 4 月至今	曹堪宇、赵纶、黄丹阳、袁园、李红文、张羽、冯鹏熙、朱文菊	朱文菊被聘任为高级管理人员

4、核心技术人员变动情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共 5 名，分别为曹堪宇、李红文、TAN TECK HONG（陈德鸿）、王丹、唐衍哲。最近两年内，公司核心技术人员未发生重大不利变化。

5、近两年人员变动的结论性意见

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 2 年内无重大不利变化，变动的原因主要系股东单位提名委派调整、公司进一步完善治理结构需要以及根据法规的规定取消监事会等原因所致。发行人的核心管理团队、核心技术人员稳定，负责公司的战略、研发、生产、销售、财务等经营管理活动，并参与公司的经营决策。最近 2 年离任董事、高管不会对公司生产经营造成重大不利影响。

公司董事、监事、高级管理人员的变动均依法履行了《公司法》《公司章程》规定的程序，且该等变动未对公司的法人治理结构、经营政策的延续性产生重大不利影响。

(四) 董事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况

公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接持有发行人股份的情形，上述人员间接持有发行人股份的情况如下表所示：

姓名	职务/亲属关系	间接持股情况	合计持股数量 (股)	合计持股比例
朱一明	董事长	通过清辉集电间接持有发行人 858,879 股；通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 1,535,841,835 股；通过兆易创新间接持有发行人 55,730,232 股	1,592,430,946	2.6456%
赵纶	总经理	通过合肥集鑫壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 2,387,269 股，通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 10,000,081 股	12,387,350	0.0206%
曹堪宇	董事、总裁、核心技术人员	通过清辉集电间接持有发行人 93,315 股；通过合肥集鑫壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 2,278,849 股，通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 209,813,756 股	212,185,920	0.3525%
谢树民	董事	通过合肥集鑫拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 598,005 股，通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 3,210,026 股	3,808,031	0.0063%
张羽	联席总裁	通过合肥集鑫叁拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 598,146 股，通过合肥集鑫玖拾伍号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 50,000,000 股	50,598,146	0.0841%
朱文菊	执行副总裁	通过合肥集鑫壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 2,538,021 股，通过合肥集鑫陆拾贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 50,800,411 股	53,338,432	0.0886%
黄丹阳	高级副总裁、财务负责人	通过合肥集鑫壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 4,092,896 股，通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 32,190,736 股	36,283,632	0.0603%
冯鹏熙	高级副总裁、战略投资负责人	通过合肥集鑫叁拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 507,913 股，通过合肥集鑫玖拾伍号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 4,914,000 股	5,421,913	0.0090%
袁园	副总裁、董事会秘书	通过合肥集鑫拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 1,355,411 股，通过合肥集鑫叁拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 190,142 股，通过合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 14,210,115 股，通过合肥集鑫玖拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 4,503,831 股	20,259,499	0.0337%
李红文	高级副总裁、核心	通过合肥集鑫拾陆号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 2,586,014 股，通过合肥集	27,870,218	0.0463%

姓名	职务/亲属关系	间接持股情况	合计持股数量(股)	合计持股比例
	技术人员	鑫肆拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有发行人 25,284,204 股		
TAN TECK HONG (陈德鸿)	核心技术人员	通过合肥集鑫捌拾号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 9,000,073 股, 通过合肥集鑫叁拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 891,007 股	9,891,080	0.0164%
王丹	核心技术人员	通过合肥集鑫贰号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 322,923 股, 通过合肥集鑫叁拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 69,925 股, 通过合肥集鑫伍拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 2,400,019 股, 通过合肥集鑫玖拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 1,688,937 股	4,481,804	0.0074%
杨益	核心技术人员王丹的配偶	通过合肥集鑫肆拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 1,050,008 股, 通过合肥集鑫贰拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 200,002 股, 通过合肥集鑫壹佰壹拾号企业管理合伙企业(有限合伙)持有 993,707 股	2,243,717	0.0037%
唐衍哲	核心技术人员	通过合肥集鑫拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 840,007 股, 通过合肥集鑫叁拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 37,104 股, 通过合肥集鑫陆拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 4,125,033 股, 通过合肥集鑫玖拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 301,596 股	5,303,740	0.0088%

注: 朱一明通过兆易创新间接持有发行人的股份数量, 以公开查询的截至 2026 年 5 月 25 日变动后朱一明持有兆易创新的股份数量以及兆易创新的总股本为基础计算。

截至本招股说明书签署日, 公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司的股份不存在质押或冻结以及诉讼纠纷的情况。

(五) 董事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日, 公司董事、高级管理人员及核心技术人员在发行人及其子公司以外的其他单位的主要兼职情况如下:

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的其他关系
1	朱一明	董事长	兆易创新	董事长	公司直接股东
			芯技佳易微电子(香港)科技有限公司	执行董事	公司直接股东兆易创新控制的其他企业
			GigaDevice Semiconductor Singapore PTE.LTD	执行董事	公司直接股东兆易创新控制的其他企业

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的其他关系
			深圳市外滩科技开发有限公司	执行董事	公司直接股东兆易创新控制的其他企业
			清辉管理咨询有限公司	监事	无
			清辉景瑄（杭州）企业管理有限公司	监事	无
			清辉景恒（北京）管理咨询有限公司	监事	无
			TSINGHALO LIMITED	董事	无
			TSINGHALO PTE. LTD.	董事	无
2	曹堪宇	董事、总裁、核心技术人员	北京清辉鑫电企业管理有限公司	董事	公司间接股东
3	赵纶	总经理	北京创安徽芯科技有限责任公司	董事、总经理	无
			北京通美晶体技术股份有限公司	独立董事	无
			合肥集鑫硕驰企业管理有限公司	监事	公司间接股东
			香港集鑫有限公司	董事	公司间接股东
4	冯鹏熙	高级副总裁、战略投资负责人	上海芯展科技有限公司	董事	无
			中水信通科技（武汉）有限公司	董事	无
5	袁园	副总裁、董事会秘书	北京超容科技有限公司	监事	无
6	郑锐	董事	安徽皖投资产管理有限公司	执行董事、总经理	公司直接股东安徽省投控制的其他企业
			安徽安凯汽车股份有限公司	董事	无
			城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司	董事	无
			国元农业保险股份有限公司	董事	无
			安徽省小额再贷款股份有限公司	董事	公司直接股东安徽省投控制的其他企业
			数字安徽有限责任公司	董事	无
			安徽九华山旅游发展股份有限公司	董事	无
			长盛基金管理有限公司	董事	无
7	方炜	董事	合肥市产业投资控股（集团）有限公司	总经济师	公司间接股东
			长虹美菱股份有限公司	董事	无
			合肥市创业投资引导基金有限公司	董事长	无

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的其他关系
			马钢（合肥）钢铁有限责任公司	董事	无
			合肥市生命健康产业发展有限公司	董事长	无
			合肥科技农村商业银行股份有限公司	董事	无
			安徽安利材料科技股份有限公司	董事	无
			合光光掩模科技（安徽）有限公司	董事长	无
8	韦俊	董事	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	副总裁	无
			国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	副总裁	公司直接股东
			国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司	副总裁	无
			长江存储控股股份有限公司	董事	无
			长江存储科技有限责任公司	董事	无
			上海华力集成电路制造有限公司	董事	无
			武汉芯飞科技投资有限公司	董事	无
			武汉芯腾科技投资有限公司	董事	无
			华虹半导体（无锡）有限公司	董事	无
9	侯华伟	董事	华芯投资管理有限责任公司	董事、副总裁	无
			中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	副董事长	无
			中芯京城集成电路制造（北京）有限公司	董事	无
			江苏长电科技股份有限公司	董事	无
			紫光展锐（上海）科技股份有限公司	董事	无
10	陈武朝	独立董事	清华大学	副教授	无
			中信信托有限责任公司	独立董事	无
			中国石油集团资本股份有限公司	独立董事	无
			清华大学资产管理有限公司	董事	无
11	李华	独立董事	北京德恒律师事务所	全球合伙人律师	无
			太极计算机股份有限公司	独立董事	无
			北京宇信科技集团股份有限公司	独立董事	无
12	蔡一茂	独立董事	北京大学	教授、院长	无
			北京华卓精科科技股份有限公司	独立董事	无
			方正科技集团股份有限公司	独立董事	无

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的其他关系
13	郭薇	独立董事	中欧国际工商学院	副教授	无
			环旭电子股份有限公司	独立董事	无

（六）董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况如下：

单位：万元

姓名	与本公司关系	对外投资情况	注册资本	持股比例
朱一明	董事长	兆易创新	70,110.25	5.13%

注：朱一明持有兆易创新的股份比例，以公开查询的截至 2026 年 5 月 25 日变动后朱一明持有兆易创新的股份数量以及兆易创新的总股本为基础计算。

发行人董事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突。

（七）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。公司董事方炜、郑锐、韦俊、侯华伟及原监事许允金、李珺未在公司领取薪酬。公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资及奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的内部程序。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额分别为 3,621.95 万元、2,932.85 万元及 8,936.47 万元。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期利润总额的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	8,936.47	2,932.85	3,621.95
利润总额	770,111.78	-904,865.71	-1,922,309.93
占利润总额比例	1.16%	-	-

注：上表中薪酬总额计算包括工资薪金、福利费、五险一金、奖金等，未包含股份支付金额。

2025 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额较 2024 年度同比增长，主要原因系：（1）2025 年度公司业绩大幅提升，各项经营目标均超额完成，故 2025 年度薪酬总额中计提了年终奖等浮动收入；（2）公司自 2024 年 10 月起新增了高管人数，导致薪酬总额有所增加。

3、最近一年从发行人及关联企业领薪情况

公司董事方炜、郑锐、韦俊、侯华伟及原监事许允金、李珺未在公司领取薪酬。

公司独立董事仅在公司领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司及其子公司领取薪酬，2025 年度从发行人及子公司处领取薪酬（包括工资薪金、福利费、奖金等）合计为 8,936.47 万元。

除上述薪酬待遇外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

十二、发行人的股权激励和其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，发行人的直接员工持股平台为合肥集鑫，其直接持有发行人 8.37% 的股份。发行人不存在首发申报前制定、上市后实施的员工期权计划。

（一）第一期员工持股计划

1、员工持股计划的形成及实施的程序

2020 年 12 月 4 日，公司召开股东会，审议并同意合肥集鑫认购公司 476,045,602.16 元注册资本，合肥集鑫通过上述增资取得的公司股份即为公司第一期员工持股计划的激励股份来源。2021 年 2 月 3 日，公司召开董事会，审议通过了第一期员工持股计划的相关议案；2021 年 11 月 27 日，公司召开董事会，审议通过了关于修订第一期员工持股计划的相关议案。

2、员工持股平台的基本情况及其人员构成

公司第一期员工持股计划的激励对象主要包括对公司中长期发展战略具有使命感、责任感和认同感的管理人才、业务骨干及核心员工，以及其他对公司有突出贡献的员工。

公司自 2021 年 9 月起开始实施第一期员工持股计划的首次授予，授予价格为 1.05 元/注册资本。截至本招股说明书签署日，公司合计完成了 9 次第一期员工持股计划的授予工作，累计授予 3,596 人次。其中，涉及授予给公司现任董事、高级管理人员的情况如下：

2021 年 9 月，公司合计授予激励对象约 94,414,751 股激励股份，其中公司现任董事、高级管理人员合计获授约 6,520,053 股激励股份；2022 年 6 月，公司合计授予激励对象约 340,116,592 股激励股份，其中公司现任董事、高级管理人员合计获授约 8,631,620 股激励股份；2023 年 4 月，公司合计授予激励对象约 58,816,973 股激励股份，其中公司现任董事、高级管理人员合计获授约 4,258,240 股激励股份；2024 年 9 月，公司合计授予激励对象约 2,987,946 股激励股份，其中公司现任董事、高级管理人员合计获授约 1,296,201 股激励股份。

截至本招股说明书签署日，公司第一期员工持股计划的历次授予情况具体如下：

序号	授予日	本次授予的人数（人）	本次授予的总股份（股）	获授的现任董事、高级管理人员	获授予股数（股）	占本次发行前公司总股本的比例
1	2021 年 9 月 30 日	808	94,414,751	曹堪宇	2,200,018	0.0037%
				赵纶	1,200,010	0.0020%
				谢树民	230,002	0.0004%
				黄丹阳	1,600,013	0.0027%
				袁园	290,002	0.0005%
				李红文	1,000,008	0.0017%
2	2021 年 12 月 31 日	571	61,167,758	-	-	-
3	2022 年 6 月 30 日	1,700	340,116,592	曹堪宇	2,135,017	0.0035%
				赵纶	1,187,260	0.0020%
				谢树民	368,003	0.0006%
				黄丹阳	1,431,762	0.0024%
				袁园	714,006	0.0012%
				李红文	915,557	0.0015%

序号	授予日	本次授予的人数（人）	本次授予的总股份（股）	获授的现任董事、高级管理人员	获授予股数（股）	占本次发行前公司总股本的比例
				朱文菊	1,880,015	0.0031%
4	2022 年 12 月 31 日	60	9,194,690	-	-	-
5	2023 年 4 月 30 日	398	58,816,973	曹堪宇	1,517,262	0.0025%
				黄丹阳	1,061,122	0.0018%
				袁园	351,403	0.0006%
				李红文	670,448	0.0011%
				朱文菊	658,005	0.0011%
6	2024 年 9 月 30 日	19	2,987,946	袁园	190,142	0.0003%
				张羽	598,146	0.0010%
				冯鹏熙	507,913	0.0008%
7	2025 年 3 月 31 日	5	509,978	-	-	-
8	2025 年 9 月 30 日	28	1,165,522	-	-	-
9	2026 年 3 月 31 日	7	2,897,652	-	-	-

注：上述董事、高级管理人员获授第一期员工持股计划激励股份的价格均为 1.05 元/注册资本。

2020 年 7 月，公司设立合肥集鑫作为直接员工持股平台。由于激励人数较多，公司设立了合肥集鑫零号企业管理合伙企业（有限合伙）和香港集鑫有限公司作为合肥集鑫的有限合伙人用于实施第一期员工持股计划，并进一步在合肥集鑫零号企业管理合伙企业（有限合伙）上层设立了 39 个合伙企业作为间接员工持股平台，在香港集鑫有限公司上层设立了 Jixin I L.P.和 Jixin II L.P.两个间接员工持股平台（Jixin I L.P.和 Jixin II L.P.通过 Jixin Management Limited 持有香港集鑫有限公司的股份），激励对象通过持有上述 41 个间接员工持股平台份额的方式间接持有公司的股份。上述员工持股平台的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“十、员工持股平台”。

3、激励股份的转让及锁定期安排

根据员工持股计划管理办法，激励对象和持股平台承诺自公司上市后法律法规规定的限售期届满为止锁定其激励股份，非经员工持股计划管理委员会同意，不得以任何方式出售、转让、质押、抵押、设置其他担保或权益负担、偿还债务、赠与或以其他方式处置其持有的激励股份或退出第一期员工持股计划。公司上市前及上市后的股份限售期

内，激励对象所持激励股份拟转让退出的，只能根据员工持股计划管理办法的规定向第一期员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

员工持股平台合肥集鑫就本次发行前所持公司股份的锁定事宜签署了承诺函，承诺自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。员工持股平台合肥集鑫就所持发行人股份锁定期及减持事项承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“1、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

4、员工离职后的股份处理

如激励对象在第一期员工持股计划的实施过程中因出现或存在员工持股计划管理办法所规定的“红线行为”而离职并退出持股计划的，则激励对象应以退伙、份额转让等方式退出第一期员工持股计划。除“红线行为”以外，因离职退出时，管理委员会允许激励对象继续持有第一期员工持股计划的激励股份。

（二）第二期员工持股计划

1、员工持股计划的形成及实施的程序

2023 年 3 月 2 日，公司全体股东以书面一致决议的方式一致同意用公司部分资本公积转增注册资本，其中，大基金二期获得转增注册资本 495,575,337.05 元，合肥集鑫获得本次资本公积转增形成的其余注册资本 4,561,277,525.81 元，其他股东未参与转增。合肥集鑫在本次转增中新获得的公司注册资本即为第二期员工持股计划的总额度。2023 年 6 月 9 日，公司召开董事会，审议通过了第二期员工持股计划的相关议案。

2、员工持股平台的基本情况及其人员构成

第二期员工持股计划激励对象主要包括：高级管理人员；优秀中层管理人员和核心技术人员、技术与业务骨干人员；对集团公司文化和发展战略有强烈认同感的高潜质技术人员等。

公司自 2023 年 6 月起开始实施第二期员工持股计划的首次授予，授予价格为 0.108 元/注册资本。截至本招股说明书签署日，公司合计完成了 7 次第二期员工持股计划的

授予工作，累计授予 3,164 人次。其中，涉及授予给公司现任董事、高级管理人员的情况如下：

2023 年 6 月，公司合计授予激励对象约 3,025,472,558 股股份，公司现任董事、高级管理人员合计获授约 346,315,335 股激励股份，其中曹堪宇获授 209,813,756 股激励股份；2024 年上半年，面对复杂的外部环境，公司正处于加快建设与经营发展的关键期，结合朱一明作为公司创始人对公司发展做出的重要历史贡献以及其对公司长远发展不可或缺的关键作用，公司于 2024 年 5 月召开董事会，审议决定将 1,535,841,835 股激励股份授予给朱一明，经履行内外部相关程序，公司于 2025 年 7 月与朱一明签署了《股权激励授予协议》；2024 年 9 月，公司合计授予激励对象约 217,849,578 股激励股份，其中公司现任董事、高级管理人员合计获授 59,417,831 股激励股份。

截至本招股说明书签署日，公司第二期员工持股计划的历次授予情况具体如下：

序号	授予日	本次授予的人数（人）	本次授予的总股份（股）	获授的现任董事、高级管理人员	获授予股数（股）	占本次发行前公司总股本的比例
1	2023 年 6 月 30 日	1,986	3,025,472,558	曹堪宇	209,813,756	0.3486%
				赵纶	10,000,081	0.0166%
				谢树民	3,210,026	0.0053%
				黄丹阳	32,190,736	0.0535%
				袁园	14,500,117	0.0241%
				李红文	25,800,209	0.0429%
				朱文菊	50,800,411	0.0844%
2	2024 年 3 月 31 日	38	25,078,845	-	-	-
3	2024 年 9 月 30 日	537	217,849,578	袁园	4,503,831	0.0075%
				张羽	50,000,000	0.0831%
				冯鹏熙	4,914,000	0.0082%
4	2025 年 3 月 31 日	332	122,731,408	-	-	-
5	2025 年 7 月 31 日	1	1,535,841,835	朱一明	1,535,841,835	2.5515%
6	2025 年 9 月 30 日	262	91,743,622	-	-	-
7	2026 年 3 月 31 日	8	27,000,000	-	-	-

注：上述董事、高级管理人员获授第二期员工持股计划激励股份的价格均为 0.108 元/注册资本。

公司设立了合肥集鑫肆拾号企业管理合伙企业（有限合伙）作为合肥集鑫的有限合伙人用于实施第二期员工持股计划，由于激励人数较多，公司在合肥集鑫肆拾号企业管理合伙企业（有限合伙）上层设立了合肥集鑫捌拾陆号企业管理合伙企业（有限合伙）和其他 45 个合伙企业作为间接员工持股平台，并进一步在合肥集鑫捌拾陆号企业管理合伙企业（有限合伙）上层设立了 25 个合伙企业作为间接员工持股平台，激励对象通过持有上述 70 个间接员工持股平台份额的方式间接持有公司的股份。上述员工持股平台的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“十、员工持股平台”。

3、激励股份的转让及锁定期安排

（1）一般锁定期安排

激励对象根据第二期员工持股计划及员工持股计划管理办法授予的激励股份自授予协议文件确定的股权授予日起 60 个月锁定，每满 12 个月（“解锁周期”）按照激励对象的绩效考核结果及其他表现情况进行解锁，每个解锁周期内各激励对象最多解锁其持有的激励股份总规模的 20%。

根据员工持股计划管理办法，激励对象和持股平台承诺自公司上市后三十六个月届满之日为止锁定其激励股份，非经员工持股计划管理委员会同意，不得以任何方式出售、转让、质押、抵押、设置其他担保或权益负担、偿还债务、赠与或以其他方式处置其持有的激励股份或退出第二期员工持股计划。公司上市前及上市后的股份限售期内，激励对象所持激励股份拟转让退出的，只能根据员工持股计划管理办法规定向第二期员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。

员工持股平台合肥集鑫就本次发行前所持公司股份的锁定事宜签署了承诺函，承诺自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。员工持股平台合肥集鑫就所持发行人股份锁定期及减持事项承诺详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“1、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

（2）其他锁定和减持安排

公司董事长朱一明针对其获授予的第二期员工持股计划下的激励股份自愿做出承

诺，自愿承诺将所持合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙企业份额中的 50%（对应公司当前股本的 767,920,918 股股份，以下简称“目标激励股份”）在长鑫科技首次公开发行并上市满 36 个月后 10 个自然年度内分配给长鑫科技及其并表子企业的在职员工（不含朱一明本人），用于员工激励。上述承诺内容具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“1、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

此外，根据公司员工持股计划减持事项管理细则的约定，满足一定岗位、职级、汇报层级及持股数量等要求的激励对象将被认定为“第一梯队激励对象”或“第二梯队激励对象”（以下简称“特定激励对象”）。发行人董事长和其他特定激励对象就其持有的第二期员工持股计划的激励股份作出如下承诺：

发行人董事长朱一明承诺：除自愿承诺未来用于员工激励的目标激励股份另有约定外，自发行人股票在证券交易所上市之日起 120 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。自限售期届满后的首个减持周期起，本人每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%，限售期满十年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持任何发行人股份。

第一梯队激励对象承诺：自限售期届满后的首个减持周期起，在职期间（含离职当年）每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%，限售期满十年后，可以一次性减持剩余激励股份，法律法规、证监会及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外；上述激励对象自公司离职后 6 个月内，不得减持任何激励股份；

第二梯队激励对象承诺：自限售期届满后的首个减持周期起，在职期间（含离职当年）每年可减持的激励股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 30%，限售期满八年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证监会及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。

发行人董事长朱一明及其他特定激励对象就所持发行人第二期员工持股计划下的

激励股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺的具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“1、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

4、员工离职后的股份处理

员工离职触发退出情形时，若不涉及员工持股计划管理办法所规定的“红线行为”的，则相关激励对象所持有的未解锁的持股份额原则上应根据员工持股计划管理委员会的决定进行收回；若涉及员工持股计划管理办法所规定的“红线行为”而离职退出的，则由管理委员会决定，将激励对象已解锁及未解锁的持股份额全部收回。

（三）对公司经营状况、财务状况、控制权等方面的影响

通过实施上述员工持股计划，公司建立健全激励约束长效机制，充分调动了公司研发和核心管理等人员的积极性，有利于兼顾员工与公司长远利益，为公司良性发展夯实基础，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极的影响。公司股权激励涉及股份支付会计处理，相关会计处理符合企业会计准则等要求，各期股份支付费用计提充分、准确、完整。

1、权益工具的公允价值及确认方法

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。公司授予职工的权益工具在授予日公允价值的确定方法为参考授予日6个月内投资者入股单价确定或者以收益法评估确定。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

截至本招股说明书签署日，公司第一期员工持股计划共完成了9次授予工作，授予日每股股份支付的公允价值分别为1.17元、1.17元、1.30元、1.30元、1.56元、1.56元、1.58元、1.58元和3.09元；公司第二期员工持股计划共完成了7次授予工作，授予日每股股份支付的公允价值分别为2.50元、2.50元、2.50元、2.52元、2.52元、2.52元和4.03元。

2、权益工具的数量及确定依据

公司结合激励对象的职级、岗位职责、司龄、考核绩效、对公司发展的贡献和对公司未来战略及业务的影响等因素确定授予给各激励对象的具体激励份额。对于可行权权益工具数量，公司按各考核日的绩效条件及各解锁期的离职率估计确定。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

因实施员工持股计划，公司于报告期各期确认的股份支付金额分别为 208,250.33 万元、232,251.62 万元和 599,439.02 万元，其中，第一期员工持股计划确认金额分别为 52,656.45 万元、433.91 万元和 258.21 万元，第二期员工持股计划确认金额分别为 155,593.88 万元、231,817.71 万元和 599,180.81 万元，股份支付费用未对公司财务状况造成不利影响。实施上述员工持股计划前后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，因此上述员工持股计划不会影响公司控制权的稳定性。

十三、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

报告期各期末，公司（含下属子公司）的在职员工人数分别为 9,605 人、13,858 人和 19,298 人。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工专业结构情况如下：

专业分工	人数（人）	占总人数的比例
生产人员	11,766	60.97%
研发人员	6,259	32.43%
管理人员	1,099	5.69%
销售人员	174	0.90%
合计	19,298	100.00%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工学历结构情况如下：

学历	人数（人）	占总人数的比例
硕士及以上	7,586	39.31%
本科	7,001	36.28%

学历	人数（人）	占总人数的比例
大专及以下	4,711	24.41%
合计	19,298	100.00%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工年龄结构情况如下：

年龄	人数（人）	占总人数的比例
30 岁及以下	12,156	62.99%
31-40 岁	5,945	30.81%
41-50 岁	1,045	5.42%
51 岁以上	152	0.79%
合计	19,298	100.00%

（二）公司执行社会保障制度、住房制度、医疗制度的情况

报告期各期末，公司（含下属子公司）社会保险和住房公积金缴纳人员情况如下：

单位：人

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
在册员工人数	19,298	13,858	9,605
社保缴纳人数	19,335	13,901	9,608
公积金缴纳人数	18,881	13,510	9,202

公司及其聘用员工的境内子公司在报告期各期期末缴纳社会保险及住房公积金人数与员工人数存在一定差异主要系：（1）因退休返聘员工的社会保险和住房公积金未由发行人缴纳；（2）新员工入职时间晚于当月缴纳截止日或已由前任职单位为其缴纳当月社会保险和住房公积金、已缴纳员工当月离职；（3）员工中存在中国台湾籍居民、外籍人士等情形所致。

除上述情况之外，公司及各子公司已按照有关社会保险的法律、行政法规、规章及规范性文件的规定为员工缴付了养老、医疗、工伤、失业及生育保险金。报告期内，公司不存在因违反社会保险方面的法律法规而被相关主管部门处以重大行政处罚的情形。公司亦取得了在劳动保障领域无违法违规信息的企业公共信用信息报告。

公司及各子公司已在住房公积金主管部门开设了住房公积金缴存账户，并已为符合条件的职工缴纳住房公积金。报告期内，公司不存在因违反住房公积金方面的法律法规被住房公积金主管部门处以重大行政处罚的情形。公司亦取得了在劳动保障领域无违法违规信息的企业公共信用信息报告。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及服务情况

（一）公司主营业务及主营产品情况

1、公司主营业务情况

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。自 2016 年成立以来，公司始终专注于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售。公司采取“跳代研发”的策略，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 等产品覆盖和迭代升级，目前公司核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。根据 Omdia 的数据，按出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。

DRAM 是现代信息技术和数字信息产业发展的重要基石，广泛应用于数据中心、移动设备及终端、通信、智能制造等领域。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。同时，公司积极把握行业发展趋势，持续进行产品迭代，现已形成 DDR 系列、LPDDR 系列等多元化产品布局，并可提供 DRAM 晶圆、DRAM 芯片、DRAM 模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。

我国是全球最大的 DRAM 需求市场之一，而全球前三家 DRAM 厂商三星电子、SK 海力士和美光科技长期占全球 90% 以上的市场份额。公司致力于持续扩充产能，不断提升全球市场份额，并为我国 DRAM 市场提供稳定的供应。公司在合肥、北京两地共拥有 3 座 12 英寸 DRAM 晶圆厂，产能规模位居中国第一、全球第四。

公司高度重视技术创新与先进工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了经验丰富的研发团队，承担多项国家重大专项课题。通过持续不断的研发投入与技术创新，公司已形成多项科研成果，并在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了全面、完善的核心技术体系，主要核心技术已达到国际先进水平。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。根据世界知识产权组织的统计数据，公司 2023 年国际专利申请公开数量排名全球第 22 位；根据美国权威专利服务机构 IFI 公布的数据，公司 2024

年美国专利授权排名全球第 42 位，在所有上榜的中国企业中排名第四。

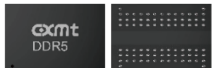
作为 DRAM 产业龙头企业，经过长期发展，公司已与上下游合作伙伴共同构建了相互依存、共同发展的产业生态。公司在服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等各大领域积累了广泛的优质客户资源，建立了良好的品牌效应。公司与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作，持续赢得客户的肯定和赞誉。此外，公司积极与半导体存储设计企业、EDA 厂商、材料厂商、设备及零部件厂商、存储模组厂商等紧密合作，共同推动我国 DRAM 市场发展和产业生态的完善。随着公司现有产能逐步释放以及规划建设产能逐步完成，公司将持续提升市场份额，以存储科技赋能信息社会，成为技术领先与商业成功的半导体存储企业。

2、公司的主要产品及服务

公司产品覆盖 DDR、LPDDR 两大主流系列，并且各系列均能提供当前市场主流的第四代、第五代产品，包括 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X 等，产品广泛应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场领域。公司可结合不同产品的应用特点和不同客户的需求，提供 DRAM 晶圆、DRAM 芯片、DRAM 模组等多元化的产品方案，其中 DRAM 芯片是报告期内公司出货及销售的主要产品类型。凭借丰富的产品布局和卓越的产品性能，公司能够为客户提供全面的 DRAM 存储解决方案。公司主要产品及服务的具体情况如下：

(1) DRAM 芯片

公司 DRAM 芯片主要包括 DDR 系列与 LPDDR 系列，具体情况如下：

产品系列	产品类型	产品介绍	产品图示	主要应用领域
DDR	DDR4	提供 8Gb 或 16Gb 的容量选择，速率可达 3200Mbps，并可提供 4bit/8bit/16bit 不同位宽选择；可用于制造 8GB/16GB/32GB/64GB 等多种容量规格的 DDR4 模组		服务器、台式电脑、笔记本电脑、其他消费类产品
	DDR5	具备 16Gb、24Gb、32Gb 的容量，速率可达 8000Mbps，并可提供 4bit/8bit/16bit 等不同位宽选择；可用于制造 8GB/16GB/32GB/64GB/96GB/128GB 等多种容量规格的 DDR5 模组		

产品系列	产品类型	产品介绍	产品图示	主要应用领域
LPDDR	LPDDR4X	采用 LVSTL 的低功耗接口及多项降低功耗的设计，具备低功耗的特点。可提供 8GB 以下、8GB、12GB、16GB 等不同容量规格的产品，速率可达 4266Mbps，广泛用于移动设备等领域		手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备及其他消费类产品
	LPDDR5/5X	具备 6GB、8GB、12GB、16GB 等多种容量规格，速率可达 10667Mbps。通过内置纠错码等技术，能够有效减少系统故障，增强稳定性，广泛应用于中高端移动设备市场	 	

1) DDR 系列

① DDR4

公司凭借长期的技术积累与创新，推出了自主设计、研发、生产的 DDR4 芯片，公司的 DDR4 芯片具备多领域的应用支持能力，可以满足多产品组合使用需求，为数据存储和高速传输提供高可靠性保障。目前，公司结合下游应用市场发展趋势，通过技术迭代推出了 DDR5 等新一代产品。2024 年底以来，长鑫科技自有 DDR4 产品已停止生产。

② DDR5

随着新一代信息技术的发展，各类终端电子设备对数据处理的性能和系统功耗的要求持续提升，下游市场对高性能内存的需求快速增长。DDR5 作为新一代 DDR 内存芯片，凭借更高的带宽和更低的功耗，正在快速取代 DDR4，应用于中高端市场。基于目前 DRAM 产品的迭代趋势，公司推出了 DDR5 产品并完成量产，产品性能达到国际先进水平，广泛应用于服务器、个人电脑等领域，实现了更加全面的下游市场覆盖。

2) LPDDR

① LPDDR4X

LPDDR 芯片通过减小存储器与 CPU 之间的导线电阻和通道宽度实现低功率的运行，主要应用于智能手机、平板电脑等便携式设备。相较于 LPDDR4 芯片，LPDDR4X 芯片在封装方式、引脚设计、接口设计等方面进行了优化，在相同性能与速率的情况下能够实现更低的功耗与更好的稳定性。公司的 LPDDR4X 芯片兼具大容量、高速率、高带宽和低功耗的特点，能够提供稳定流畅的使用体验，目前已进入小米、OPPO、vivo、传

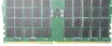
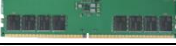
音、联想等主流厂商供应链，在智能手机等终端产品中实现广泛应用，并通过相关终端渠道走向海外市场。

② LPDDR5/5X

公司自主设计研发生产的 LPDDR5/5X 芯片具备大容量、高速率、超低功耗与高安全性等特性，相较于上一代 LPDDR4X 芯片，公司的 LPDDR5/5X 芯片单一颗粒的容量和速率均大幅提升，同时功耗进一步降低。此外，公司 LPDDR5/5X 芯片加入了强大的 RAS 功能，通过内置纠错码（On-die ECC）等技术，能够实现实时纠错，有效减少系统故障，确保数据安全，增强系统稳定性。公司 LPDDR5/5X 内存芯片能够有效满足中高端智能手机、笔记本电脑、AIoT 等市场需求，相关产品目前已进入小米、传音等品牌供应链。

（2）DRAM 模组

公司基于自身原厂 DRAM 芯片生产制造的 DRAM 模组包括 DDR4、DDR5 系列，涵盖 RDIMM、MRDIMM、UDIMM/CUDIMM、SODIMM/CSODIMM、LPCAMM 等不同类型产品。其中 RDIMM 和 MRDIMM 主要应用于服务器领域，UDIMM/CUDIMM 主要应用于计算机工作站、台式电脑，SODIMM/CSODIMM 主要应用于笔记本电脑、一体机主机中，LPCAMM 主要应用于高性能笔记本电脑、移动工作站等。公司 DDR4 模组包含 8GB/16GB/32GB/64GB 等多种容量规格，速率可达 3200Mbps。DDR5 模组包含 8GB/16GB/32GB/64GB/96GB/128GB 等多种容量规格，速率可达 8000Mbps 及以上。公司 DRAM 模组产品具体如下：

产品系列	产品类型	产品图示	主要应用领域
RDIMM	DDR4		服务器等
	DDR5		
MRDIMM	DDR5		
UDIMM	DDR4		计算机工作站、台式电脑等
	DDR5		
CUDIMM	DDR5		
SODIMM	DDR4		笔记本电脑、一体机主机等
	DDR5		
CSODIMM	DDR5		
LPCAMM	LPDDR5X		高性能笔记本电脑、移动工作站等

（3）DRAM 晶圆

报告期内，公司存在少量 DRAM 晶圆销售，DRAM 晶圆即公司完成技术研发、产品设计及生产制造流程后，尚未切割及封装测试的产品，相关客户主要包括下游模组厂商等。

（4）其他产品及服务

公司其他产品及服务主要包括提供技术及研发服务、晶圆代工服务及配套光罩产品销售等。

3、主营业务收入的构成情况

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	1,953,128.56	31.87%	317,397.33	13.26%	182,716.69	20.16%
LPDDR 系列	4,070,354.50	66.43%	1,979,825.86	82.74%	675,607.25	74.54%
其他产品及服务	104,054.15	1.70%	95,651.94	4.00%	47,990.43	5.30%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

（二）发行人的主要经营模式

1、研发模式

公司技术和产品的研发流程分为概念、计划、开发、验证等阶段，具体情况如下：

（1）概念阶段：该阶段启动后，公司开始组建团队，定义平台和产品需求，分析平台及产品开发可行性、可制造性。项目概念阶段总体风险经整体评估通过后，开发团队制定项目里程碑计划并提交评审，通过后进入计划阶段。

（2）计划阶段：该阶段主要为根据客户需求优化项目质量目标与计划、产品开发计划、财务评估与财务计划。经技术评审委员会对产品开发范围、规格和时间表、开发计划以及测试要求等风险评估通过后，开发团队将项目计划提交决策评审，通过后进入开发阶段。

（3）开发阶段：该阶段项目研发团队根据研发计划及产品规格设计产品架构，进行一系列版图、电路、封装等设计，并通过模拟仿真验证确认产品功能，在设计规则检

查及设计评审后发布设计数据，并发起流片，成功后进入验证阶段。

(4) 验证阶段：验证阶段主要分为两部分，分别为工程验证和客户验证。

1) 工程验证会完成内部检测与外部平台国际标准 JEDEC 检测，验证可靠性及系统兼容性。在此阶段中，相关部门开始监控产品验证活动，监控并管理配置及更改，修复工程验证过程中的程序漏洞，提升产品良率。工程样品达标后进入客户验证阶段。

2) 客户验证阶段会执行客户送样计划，通过客户产品认证，并提升质量水平。在此阶段中，公司研发团队修复客户验证过程中的程序漏洞，并提升产品良率，及时对项目执行情况进行跟踪，分析技术风险。公司结合市场及客户发展状况判定是否进行大规模生产，提交评审通过后项目进入量产阶段。

2、采购模式

报告期内，公司采购内容主要包括设备采购、原材料采购、后道采购、工程采购及通用采购。针对不同类型的采购，公司制定了相应的采购管理制度，并在供应商的选择、考核、质量管控等流程中严格执行相关规定，以提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制。

(1) 采购管理

公司建立了完善的采购管理制度，对采购申请到收货付款进行端到端的管理。公司主要采购流程如下：

1) 采购申请：请购部门按照需求、预算金额以及公司的请购限额核准权限提交对应的运营及投资支出审核委员会，待审核委员会决议通过后，由请购部门开出采购申请。

2) 采购合同/订单：采购部门根据签核完成的采购申请，使用公开招标、邀请招标、直接委托、单一来源采购、询价式采购等采购方式进行供应商选择、比价、议价，并通过技术和商务评审确定中标/选供应商。此后与中标/选供应商商谈并完成采购合同签署，创建采购订单，跟踪订单审批，订单审批通过后，采购员将已批准的采购订单发送给供应商，实施采买。

3) 收货与付款：请购部门或仓库对采购的产品和服务进行验收和收货，财务部门依据付款申请和合同或订单约定完成付款。

(2) 供应商管理

1) 新供应商准入

公司建立了完善的供应商准入机制，规范新供应商从采购需求申请、寻源、资质评审等导入全过程评估。由采购部门根据对未来采购需求和现有供应商资源池的评估，进行新供应商的寻源开发。新供应商需要经多部门的资质评审，评审合格后适用的供应商还需完成现场审核和样品验证，全部合格后方能进入合格供应商名单。

2) 供应商绩效评价

公司定期从质量、交付、成本、技术、服务、安全等方面对主要合作供应商进行考核，对于评估结果未达标的项目，供应商必须提供改善计划，并在规定期限内完成改善。如未完成整改或连续不达标的供应商，对其采取减少交易、冻结、淘汰等措施。

3) 供应商管理与退出

公司建立了完善的供应商冻结、淘汰、黑名单机制和流程，动态维护合格供应商名录，优化升级供应链，并依据定期的审核计划对供应商进行稽核。

3、生产模式

半导体产业链主要包含芯片设计、晶圆制造和封装测试等主要环节。由于半导体实际生产过程中的产业链较长、涉及生产工序较多，公司结合自身制造工艺情况、产能利用情况、生产效率及成本效益等因素综合考虑，在芯片封装环节、部分成品测试与模组加工及测试环节选择了外协加工的方式。在半导体行业，部分半导体企业会在自身拥有制造资源的同时进行部分环节的委外生产，公司采用外协生产的方式符合行业惯例。

DRAM 产品生产制造过程中晶圆制造、芯片封装及成品测试和模组加工及测试环节的主要流程如下：

(1) 晶圆制造环节

公司生产过程可分为制定生产计划、编制作业计划、作业准备确认及生产执行、过程监控与控制、晶圆产出入库等环节。

公司计划部门综合考虑生产因素，并结合相关部门提供的产品销售需求计划、产能计划和相关生产参数等，通过组织相关部门参加参数评审会议达成共识，形成定期的晶圆投入产出计划。制造部门根据生产计划，结合实际生产线各项指标，排定产品排序与生产线生产顺序，并根据作业计划确认各部门相关准备工作是否到位。在生产准备充分

后，制造部门根据作业计划执行生产任务。制造部门依据生产指标监控产线状况，并与工程部门、质量部门对生产过程质量和产品质量进行量测、监控。

(2) 芯片封装及成品测试环节

对于封装业务，公司在技术自主研发的基础上，采用委外生产模式，即将封装环节委托给封测厂商外协生产。计划部门负责根据公司相关标准制定委外生产计划；生产部门根据生产计划提出产量需求并下达给外协工厂、跟进交期；外包管理部主要负责新外包商或新项目评估导入、及日常质量交付等业务管理；后道采购部负责签订合同、商务谈判及核对账单等。

对于测试业务，公司在技术自主研发的基础上，采用自主测试为主，委外测试为辅的生产模式，一部分测试业务由全资子公司长鑫产品合肥完成，一部分测试委托封测厂商外协生产。计划部门负责根据公司相关标准制定综合生产计划，分配给公司的自主测试厂以及各委外测试厂；生产部门根据生产计划安排子公司和外协厂生产；外包管理商务部主要负责新外包商或新项目评估导入、及日常质量交付等业务管理；后道采购部负责签订合同、商务谈判、跟进订单交期及核对账单等。

(3) 模组加工及测试环节

公司模组加工及测试，在技术自主研发的基础上，采用自主加工测试和委外加工测试相结合的生产模式，模组加工及测试业务一部分由全资子公司长鑫产品合肥完成，一部分委托模组厂商外协完成。公司计划部门负责根据公司相关标准制定综合生产计划，分配给公司的自主模组厂以及各外协厂商；生产部门根据生产计划安排子公司和外协厂生产；外包管理商务部主要负责新外包商或新项目评估导入、及日常质量交付等业务管理；后道采购部负责签订合同、商务谈判、跟进订单交期及核对账单等。

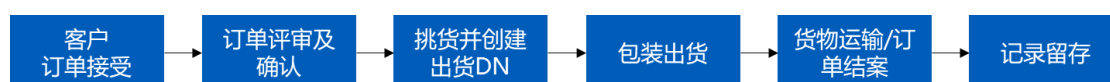
4、销售模式

报告期内，公司采取经销和直销相结合的销售模式，公司经销模式为买断式销售，经销模式是公司主要的销售模式之一。经销商可以帮助公司快速地建立销售渠道、扩大市场份额，实现产品和资金的快速周转，提升公司的运作效率和响应速度。

(1) 销售流程管理

公司建立了完善的销售管理制度，对销售进行全流程、系统化的跟踪管理。公司销

售流程主要如下：



（2）经销商管理

经销商管理方面，公司建立了完善的经销商管理体系，对经销商引入、管理及考核等方面进行严格的控制：

1）经销商引入：公司综合评估经销商的信誉、资金实力、公司规模、行业地位、人力资源和服务水平等方面，同时结合终端客户的合作意愿择优引入。

2）经销商考核：公司通常会与通过考核的合格经销商按年度签订框架合作协议，对经销合作模式、付款方式、内控规范等内容进行约定。公司相关部门会从业务、交付、技术支持、市场调查等维度对经销商进行定期的考核评估，对于打分不合格的经销商终止签订合作协议或不续签次年的合作协议。

（三）成立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

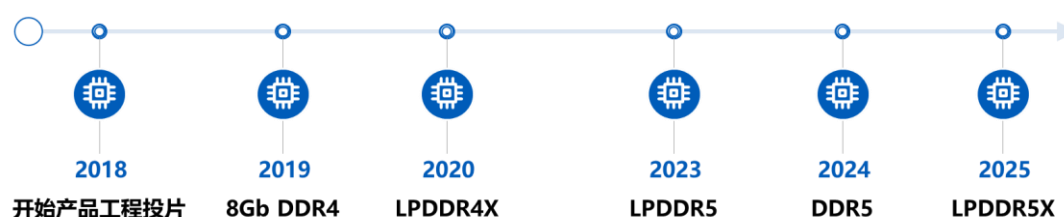
1、主营业务及主要经营模式

公司采用 IDM 模式开展经营，在此模式下，企业能够在研发、生产等环节实现长期且深厚的经验积累，这对于技术与工艺的沉淀以及产品矩阵的健全完善具有显著推动作用。此外，IDM 企业具有资源的内部整合优势，从芯片设计到完成制造的周期通常较短，有效保障了产品快速迭代，同时也可以高效响应客户需求。但 IDM 模式对企业的研发能力、资金实力、技术水平和运营管理能力都有很高的要求。

自设立以来，公司一直致力于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，公司主营业务、主要经营模式均未发生重大变化。

2、主要产品的演变情况

公司持续根据市场需求与技术发展方向，加快技术和服务的迭代更新，不断推出多样化且具有市场竞争力的 DRAM 产品组合。自成立以来，公司已经迅速推出了 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X 系列产品。未来几年内，公司将积极把握行业发展趋势，加快现有产品的丰富和升级，推出更多更大容量、更高速率和更低功耗的产品，同时积极布局推出更新代际的产品。公司主要产品的演变情况具体如下：



（四）业务经营情况和核心技术产业化情况

公司组建了经验丰富的研发团队，通过持续高效的研发创新机制，形成了现有核心技术体系，在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节掌握了一系列关键核心技术，并已大量应用于公司产品的批量生产中。

公司始终坚持以市场为导向，持续进行技术开拓创新和产品研发升级，并积累了一系列先进、创新的科技成果。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。公司凭借 DRAM 设计与制造领域的深厚技术积累，积极推进工艺技术和产品技术的开发与产业化，实现了科技成果与产业的深度融合。

报告期内，公司核心技术产品广泛应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场，并与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业核心客户开展了深度合作，实现了核心技术的产业落地。公司核心技术形成的收入及其占营业收入的比例情况详见本节之“八、发行人的核心技术与研发情况”之“（一）公司的核心技术情况”之“2、核心技术对主营业务的贡献情况”。

（五）工艺流程图

公司主要产品的工艺流程图如下：



（六）公司代表性的业务指标情况

报告期内，公司具有代表性的业务指标主要包括产能、产量、销量、产能利用率及产销率等，相关业务数据的具体变动情况及原因详见本节之“四、发行人销售情况和主要客户”。其他代表性业务指标参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”。

（七）发行人符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司主要从事 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，所属行业为半导体和集成电路行业，属于《战略性新兴产业分类（2018）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等列示的受国家政策鼓励的产业范围，受到国家产业政策的有力支持，产品发展高度契合未来经济发展方向，符合行业政策和国家经济发展战略。具体情况详见本节之“二、发行人所处行业基本情况和竞争情况”之“（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响”相关内容。

二、发行人所处行业基本情况和竞争情况

（一）公司所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事 DRAM 产品研发、设计、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为“制造业”（C）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（39）。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1

新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”，是国家重点发展的战略性新兴产业之一。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024 年 4 月修订），公司属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

发行人所属行业的主管部门包括国家发展和改革委员会和中华人民共和国工业和信息化部，其主要负责制定行业的产业政策、产业规划，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业发展方向进行宏观调控。

中国集成电路行业的自律组织为中国半导体行业协会，该协会的主要职责包括贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议等。

2、行业主要法律法规及产业政策

近年来，为进一步鼓励国内集成电路行业的整体发展，增强科技竞争力，国家相关部委出台了一系列支持和引导行业发展的政策法规。其中，自 2020 年以来行业主要法律法规及产业政策如下：

序号	发布时间	发布机关	法律法规/产业政策	主要内容
1	2026 年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。健全需求导向的攻关任务凝练机制，开展技术经济安全评估。强化跨领域跨学科协同，健全重大任务人才特殊调配机制，完善“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，探索以奖代补、后补助等资金支持方式。强化以用促攻、攻用结合，一体推进技术研发、成果转化、标准研制、产业培育，加快攻关成果应用和产品迭代升级。
2	2024 年	国家发展改革委、国家数据局、教育部、财政部、金融监管总局、中国证监会	《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》（发改数据〔2024〕1836 号）	支持企业加大创新投入，培育一批面向数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用的技术创新型企业，重点支持原创性引领性数据科技创新发展。加强新型存储技术研发，支撑规模化、

序号	发布时间	发布机关	法律法规/产业政策	主要内容
				实时性跨域数据存储和流动，提高智能存储使用占比。 打造全国一体化算力体系。发展通算、智算、超算等多元化算力资源，支持企业参与算力全产业链生态建设，构建一体化高质量算力供给体系。加强大带宽、低时延、高可靠的数据传输技术应用，加快算网融合、并网调度、储能散热等关键技术创新。
3	2024 年	市场监管总局、国家发展改革委、科技部、农业农村部、商务部	《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》（国市监质发〔2024〕6 号）	围绕《质量强国建设纲要》目标，聚焦新能源汽车、集成电路、人工智能、量子信息等战略性新兴产业及未来产业，统筹纺织服装、家用电器、工程机械等传统优势产业，深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动，充分释放质量基础设施效能，实现上中下游各环节质量联动发展，点线面各层级质量协同共进。
4	2023 年	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	将“集成电路：集成电路设计，集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产”纳入鼓励类产业。
5	2023 年	工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委	《算力基础设施高质量发展行动计划》（工信部联通信〔2023〕180 号）	持续提升存储产业能力。鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平，打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应用相互促进、协同发展的产业生态。 推动存算网协同发展。加快存储网络技术研发应用，推动计算与存储融合设计，促进存储与网络 and 计算协同发展，引导合理配置存算比例，实现数据在算力中心内部和算力中心之间的高效流动。
6	2022 年	国家发展改革委	《“十四五”扩大内需战略实施方案》	实现科技高水平自立自强。以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合，加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。 壮大战略性新兴产业。围绕新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、绿色环保、海洋装备等关键领域，5G、集成电路、人工智能等产业链核心环节，推进国家战略性新兴产业集群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育一批集群标杆，探索在集群中试点建设一批创新和公共服务综合体。
7	2021 年	国务院	国务院关于印发“十	增强关键技术创新能力。瞄准传感器、

序号	发布时间	发布机关	法律法规/产业政策	主要内容
			“十四五”数字经济发展规划的通知（国发〔2021〕29号）	量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。 完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
8	2020 年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发〔2020〕8号）	在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。
9	2020 年	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409 号）	加快新一代信息技术产业提质增效。加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。

3、报告期初以来新制定或修订、预期近期出台的法律法规、行业政策对发行人经营发展的影响

在国家数字经济大战略下，数据作为核心生产要素，已成为数字经济时代的基础性和战略性资源。在海量数据实时处理需求攀升的背景下，DRAM 芯片作为信息基础设施中数据高速存取的关键枢纽，在国家信息技术和高科技领域的基础地位日益凸显，已成为数字经济发展的战略要地。

公司主要产品是数字经济时代新型信息基础设施的核心组成部分，也是集成电路产业链的重点攻关领域。公司业务符合产业政策和国家发展战略，上述各项政策、决定、规划、方案等，重点鼓励公司所处半导体存储领域经营发展，并从财政、税收、人才和技术等多方面提供支持，为公司提供了良好的经营环境。

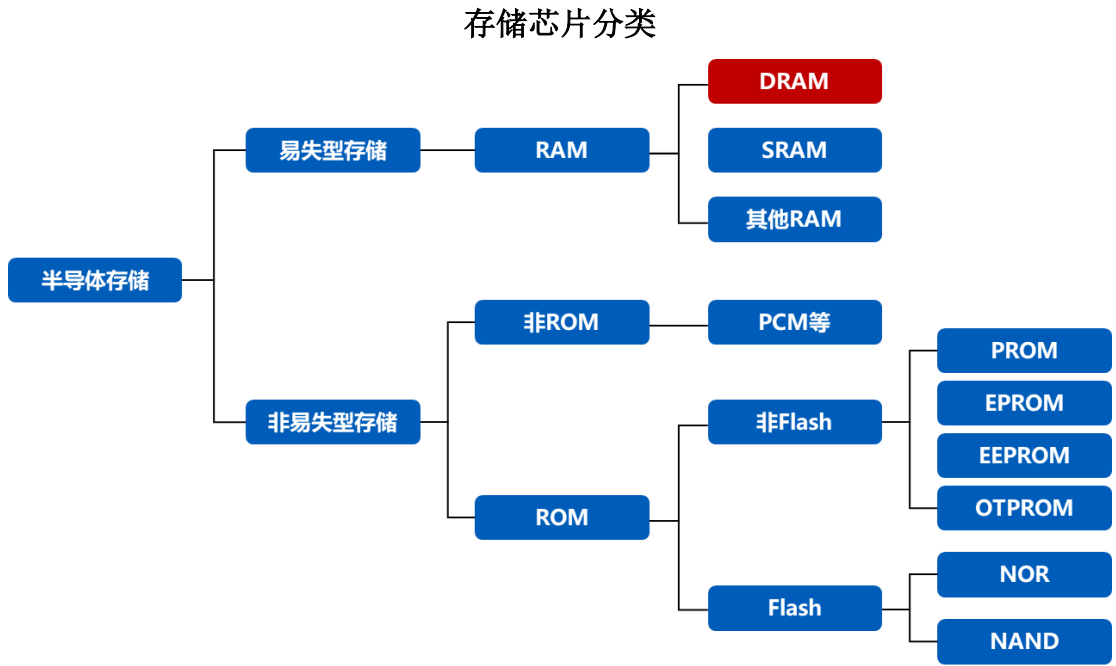
（三）所属行业发展情况

1、DRAM 行业概况

半导体产业作为现代信息技术和数字经济的基石，在全球科技进步和经济发展中扮演着至关重要的角色。从功能角度划分，半导体主要涵盖集成电路、光电器件、分立器件和传感器四大类。

其中，存储芯片作为集成电路的关键分支，是实现数据存取与读写功能的电子器件。近年来，全球数据总量呈现爆发式增长。存储芯片作为数字时代信息能够及时、完整和可靠传输的重要保障，不仅是电子设备的核心部件，也是新一代信息技术得以实现和发展的核心支撑。

根据断电后数据是否丢失，存储芯片分为易失型存储和非易失型存储两类。易失型存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电以临时保存数据供主系统 CPU 读写和处理，而非易失型存储主要包括只读存储器（ROM），无需持续通电亦能长久保存数据的存储器。



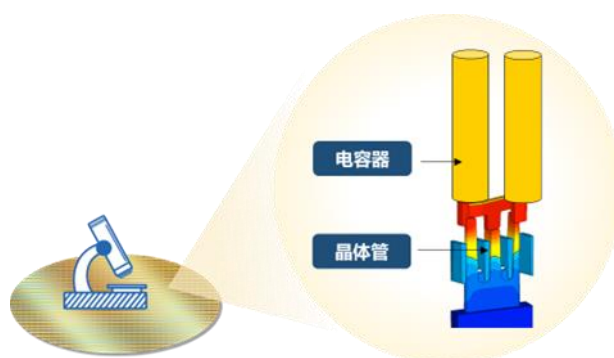
（1）数字经济蓬勃发展下，DRAM 作为数据读写与传输的核心硬件载体，是全球半导体市场占比最高且增速最高的单一品类之一

DRAM 是主流的易失型半导体存储器，主要用于数据和程序的临时存储。作为处理器与外存进行数据交互的关键桥梁，DRAM 通常也被称为内存芯片，并广泛应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等各类电子设备及系统。

DRAM 的每个存储单元仅由一个晶体管和一个电容器（1T1C）构成，通过电容的充放电状态表示数据位（0 或 1），且由于电容存在自然漏电特性，需要通过周期性电荷刷新维持数据完整性，因此称之为“动态存储器”。相较 SRAM 等其他易失型存储器而言，DRAM 单元结构简单，能够在有限的芯片面积上集成大量存储单元，具有高存储

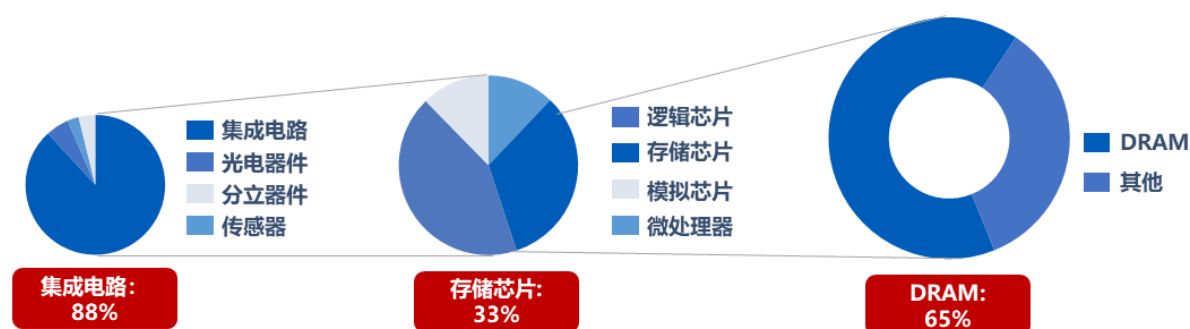
容量和成本效率优势，因而具有广泛的应用场景。

1T1C 结构示意图



作为数字经济时代新型信息基础设施的核心组成部分，DRAM 在现代信息社会中扮演着战略性基础设施的重要角色，是全球半导体市场占比最高的单一品类之一。根据世界半导体贸易统计协会 WSTS 统计，2025 年全球集成电路市场规模为 7,009 亿美元，占半导体产业整体规模的比例约为 88%，其中，全球存储芯片市场规模为 2,300 亿美元，占集成电路市场规模的比例约为 33%。根据 Omdia 和 WSTS 数据，DRAM 是市场规模最大的存储芯片，2025 年全球 DRAM 市场规模为 1,505 亿美元，占存储芯片市场规模的比例约为 65%。

2025 年全球半导体、集成电路和存储芯片市场份额

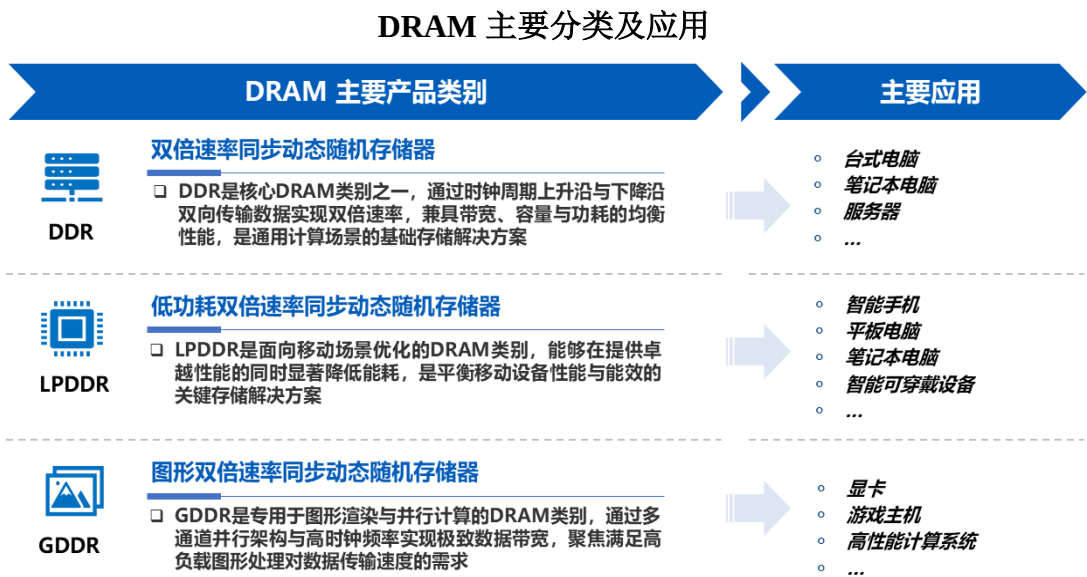


数据来源：WSTS, Omdia

（2）DRAM 芯片分类

在 DRAM 发展过程中，DRAM 产品类型主要分为 DDR（双倍速率同步动态随机存储器）、LPDDR（低功耗双倍速率同步动态随机存储器）、GDDR（图形双倍速率同步动态随机存储器）和其他新型高端存储器等。其中，DDR 及 LPDDR 产品面向广泛的下游终端应用领域，是 DRAM 市场的重要组成部分。JEDEC 定义并构建了上述标准化的内存技术规格体系，使得各厂商设计的产品满足目标应用的功率、性能和规格要求，

具备互换性和兼容性。

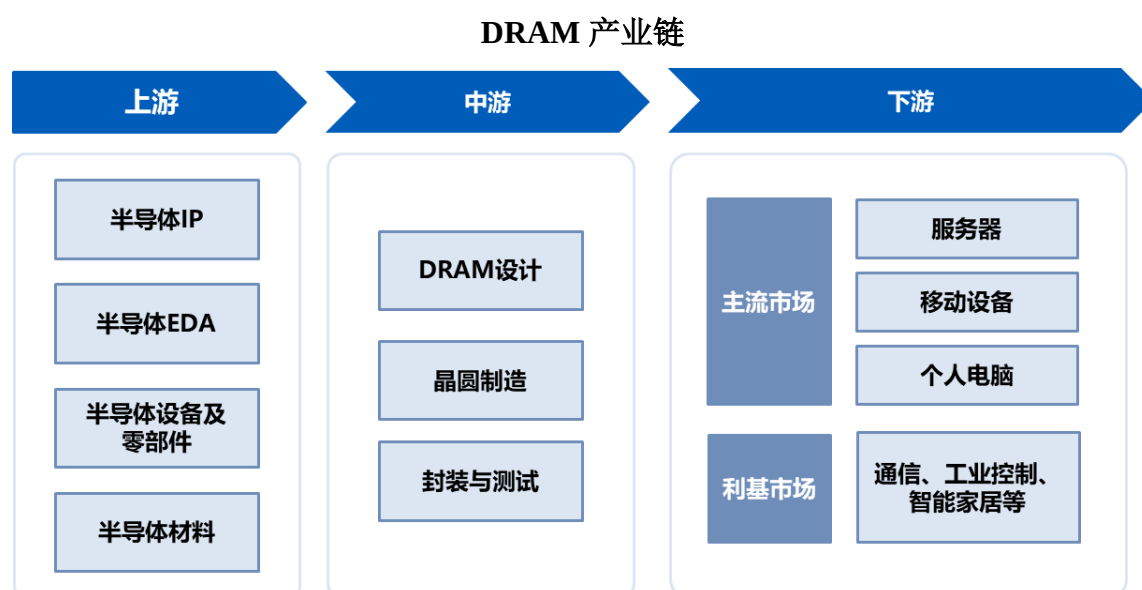


在技术突破、性能迭代与市场应用需求的多维驱动下，各类型 DRAM 产品呈现代际升级趋势，每代际新产品通常较前代际享有更高的速率和容量，以及更低的电压和功耗。2023 年至 2025 年，市场主要 DDR 及 LPDDR 产品分别处于 DDR4 向 DDR5、LPDDR4 向 LPDDR5 迭代升级阶段。其中，DDR 产品方面，DDR4 市场占有率由 2023 年的 64% 降至 2025 年的 27%，同期 DDR5 市场占有率由 32% 提升至 71%；LPDDR 产品方面，LPDDR4 市场占有率由 2023 年的 47% 降至 2025 年的 27%，同期 LPDDR5 市场占有率由 52% 提升至 72%。

除上述分类外，根据市场惯例，DRAM 产品通常也可分为主流 DRAM 和利基 DRAM。主流 DRAM 以容量大、传输速率高为特点，主要应用于服务器、移动设备、个人电脑等市场领域，下游市场具有市场规模大、技术要求高的特点。利基 DRAM 则指密度容量相对较低或从主流 DRAM 规格退役的产品，主要应用于主流市场之外的其他应用场景，例如通信、工业控制、智能家居等市场领域。

(3) DRAM 产业链分析

从产业链来看，DRAM 产业链上游包括 IP、EDA、半导体设备及零部件、材料等。产业链中游则包括 DRAM 设计、晶圆制造及封装测试环节，是产业链中的核心环节。产业链下游则主要包括服务器、移动设备、个人电脑、通信、工业控制、智能家居等应用领域。



多年来随着分工的持续细化，产业链中游芯片厂商已形成 IDM 与垂直分工两种主要的经营模式。IDM 模式下，企业通常自主完成芯片设计、晶圆制造、封装测试等全流程环节，要求企业具备较强的技术储备与资金实力；垂直分工模式下，各环节由不同企业专业化分工进行，其中 Fabless 企业专注于产品研发设计，晶圆制造环节通常委托给晶圆代工厂，封装与测试环节则交由封测厂完成。

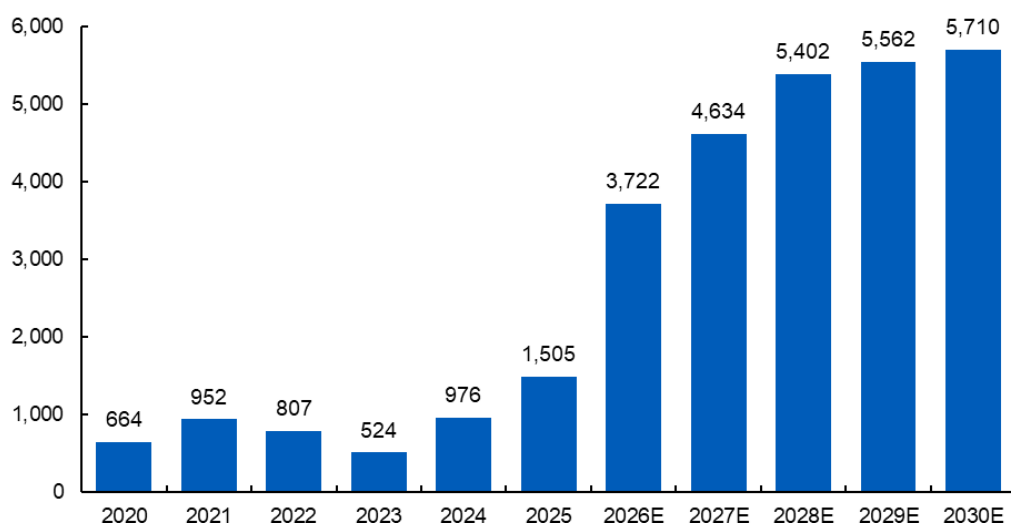
采用 IDM 模式经营的厂商在 DRAM 产业链中游环节占据绝对主导地位。由于 DRAM 布图设计与晶圆制造技术结合紧密度高，采用 IDM 模式经营的厂商能够更快地推进技术升级与产品迭代，响应市场快速变化的需求。此外，在 DRAM 产品大规模标准化生产特性下，IDM 厂商通过集中调配资源，易形成规模效应，经济效益更加显著。全球 DRAM 主要厂商三星电子、SK 海力士、美光科技、长鑫科技和南亚科技等均采用 IDM 模式经营。

(4) 海量数据处理需求驱动全球千亿美元 DRAM 市场规模快速增长，中国市场规模占比超过四分之一

近年来，新兴技术场景持续涌现，数据总量呈现爆发式增长，广泛的数据读写与传输需求驱动全球 DRAM 市场规模快速扩大。长期来看，全球 DRAM 市场仍有广阔的增长空间。根据 Omdia 数据，全球 DRAM 市场规模有望从 2025 年的 1,505 亿美元增长至 2030 年的 5,710 亿美元，年均复合增长率为 30.56%。

2020-2030 年全球 DRAM 市场规模

单位：亿美元



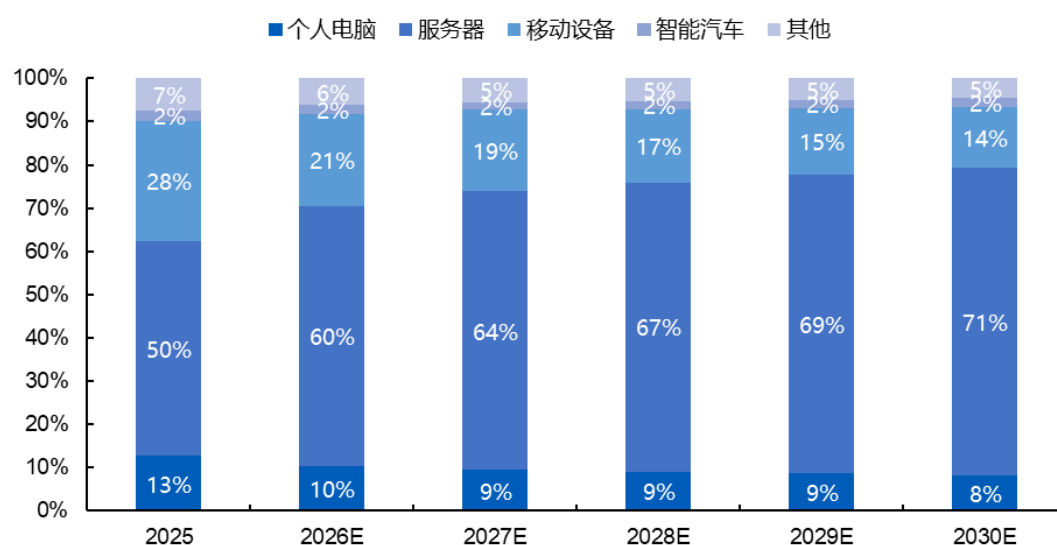
数据来源：Omdia

中国 DRAM 市场覆盖国内消费电子市场与电子信息制造业的广泛需求，在全球 DRAM 市场中占有重要份额。根据 Yole 数据，2024 年中国 DRAM 市场规模约为 250 亿美元，占全球 DRAM 市场规模的比重超过四分之一。作为全球主要的 DRAM 需求市场，中国在该领域长期高度依赖进口，DRAM 本土厂商仍有广阔的市场空间。

(5) 服务器、移动设备、个人电脑和智能汽车构成 DRAM 主要应用领域，数字经济时代下多元应用场景的发展，有望拉动 DRAM 需求持续增长

根据 Omdia 统计，2025 年全球 DRAM 下游应用领域中，服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车市场需求占比分别约为 50%、28%、13%和 2%，前述四大应用市场合计占全球 DRAM 下游应用需求市场的比例超过 90%。数字经济时代下，服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车以及其他多元应用场景的持续发展，有望拉动 DRAM 市场需求进一步增长。

2025-2030 年 DRAM 下游应用市场需求占比

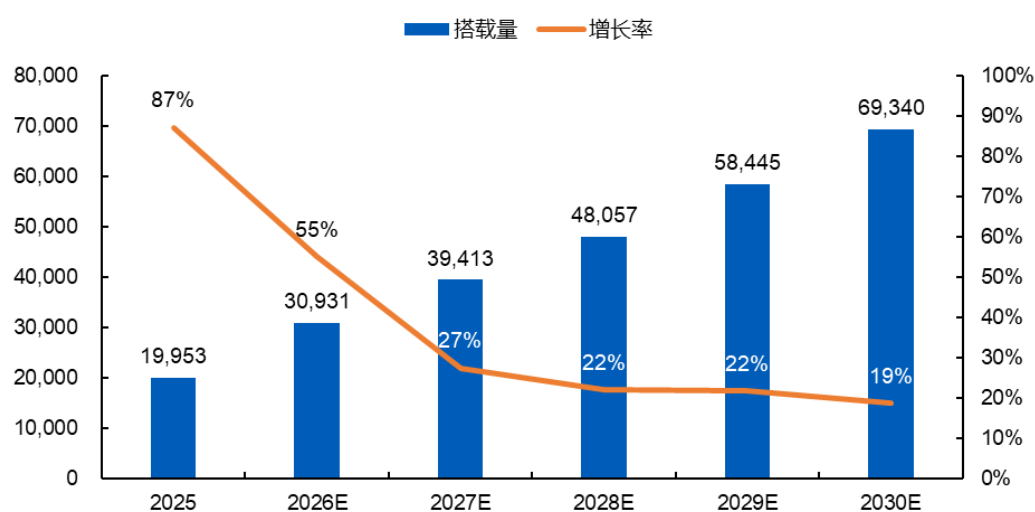


数据来源：Omdia

1) 服务器

服务器 DRAM 有望成为 DRAM 各应用领域中增长最快的市场之一。根据 Omdia 数据，2025 年全球服务器 DRAM 市场占比约为 50%，到 2030 年服务器 DRAM 市场占比预计将增长至约 71%。数据中心扩张、云计算发展对于数据处理基础设施建设的需求持续快速增长，成为服务器 DRAM 市场规模扩大的核心驱动力之一。根据 Omdia 预测，全球服务器搭载的 DRAM 总量预计将由 2025 年的约 19,953MGB 增长至 2030 年的约 69,340MGB，2025-2030 年年复合增长率约为 28.29%。

2025-2030 年全球服务器 DRAM 搭载量 (MGB)

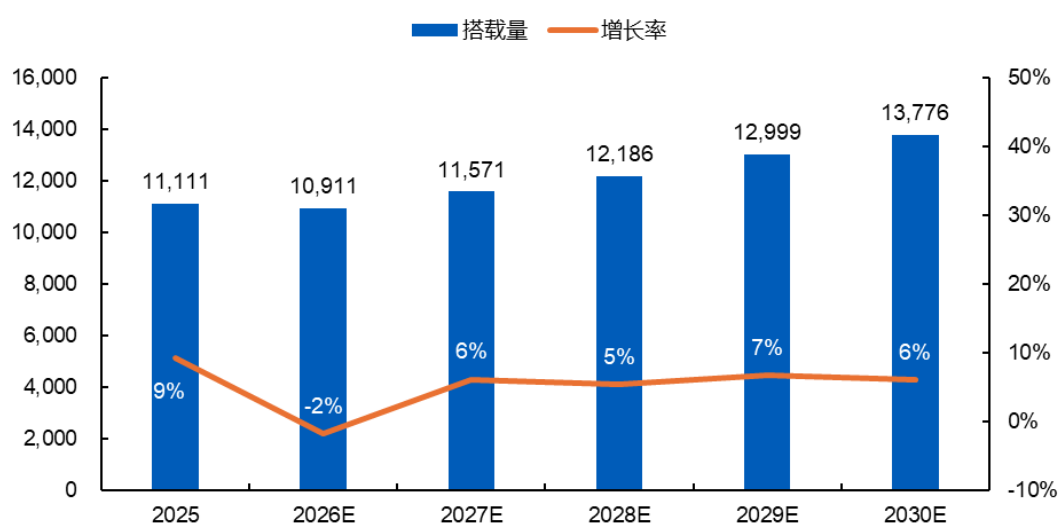


数据来源：Omdia

2) 移动设备

移动设备 DRAM 是 DRAM 核心下游应用市场之一，其中智能手机应用在移动设备 DRAM 市场中占有主要份额，其余细分应用包括平板电脑等。移动设备性能提升及功能升级驱动单机内存容量增长，为移动设备 DRAM 需求提供有力支撑，推动其市场规模稳健增长。根据 Omdia 预测，全球移动设备搭载的 DRAM 总量预计将由 2025 年的约 11,111MGB 增长至 2030 年的约 13,776MGB，2025-2030 年年复合增长率约为 4.39%。

2025-2030 年全球移动设备 DRAM 搭载量 (MGB)

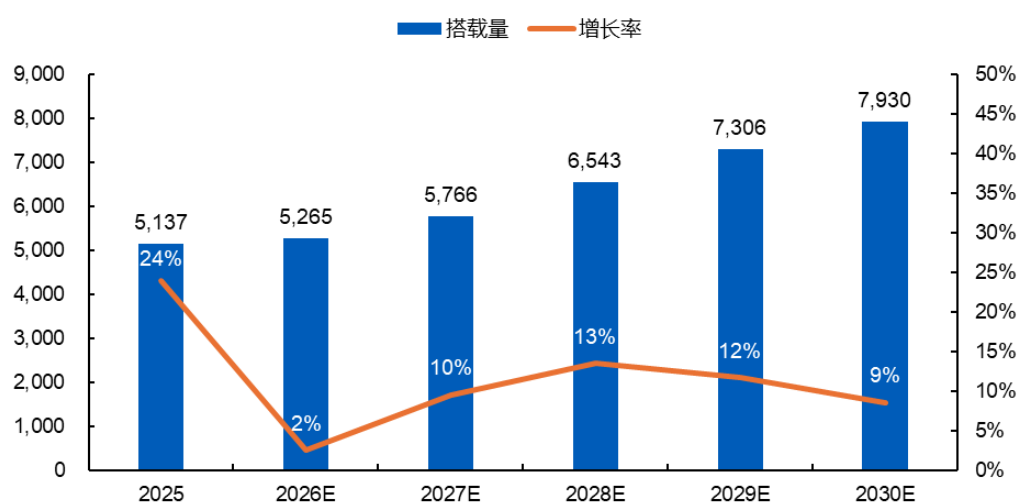


数据来源：Omdia

3) 个人电脑

个人电脑 DRAM 是 DRAM 第三大应用市场，主要应用包含台式机和笔记本电脑等。个人电脑的换机升级以及端侧场景的持续拓展，成为驱动个人电脑 DRAM 市场增长的重要因素。根据 Omdia 预测，全球个人电脑搭载的 DRAM 总量预计将由 2025 年的约 5,137MGB 增长至 2030 年的约 7,930MGB，2025-2030 年年复合增长率约为 9.07%。

2025-2030 年全球个人电脑 DRAM 搭载量 (MGB)

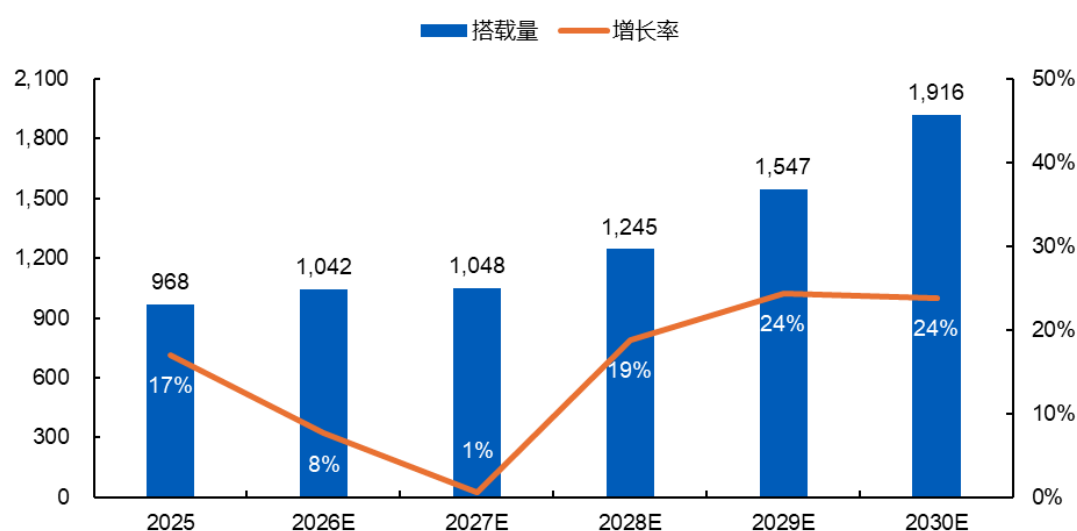


数据来源: Omdia

4) 智能汽车

智能汽车 DRAM 正在成为 DRAM 市场最具潜力的新兴赛道之一。尽管当前智能汽车 DRAM 占总体市场比例相对有限,但随着汽车智能化、网联化进程加速,自动驾驶和智能座舱的升级需求有望共同驱动汽车 DRAM 市场进入高速增长阶段。根据 Omdia 预测,全球智能汽车搭载的 DRAM 总量预计将由 2025 年的约 968MGB 增长至 2030 年的约 1,916MGB, 2025-2030 年年复合增长率约为 14.63%。

2025-2030 年全球智能汽车 DRAM 搭载量 (MGB)

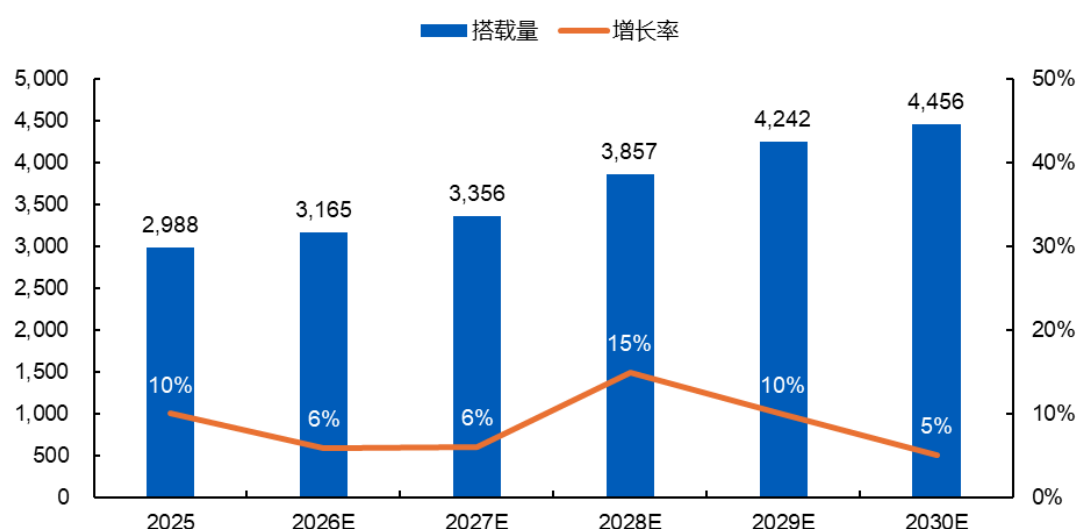


数据来源: Omdia

5) 其他

在全球数字化浪潮驱动下，工业控制、可穿戴设备、智能家居等众多应用领域的发展驱动数据存储与处理需求蓬勃增长。根据 Omdia 预测，全球其他多应用领域搭载的 DRAM 总量预计将由 2025 年的约 2,988MGB 增长至 2030 年的约 4,456MGB，2025-2030 年年复合增长率约为 8.32%。

2025-2030 年全球其他类 DRAM 搭载量（MGB）



数据来源：Omdia

（6）全球 DRAM 市场集中度较高，国际前三家厂商合计占 90% 以上市场份额，国内厂商长鑫科技正逐步进入主要厂商阵营

DRAM 行业具有极高的技术与资金门槛，已形成一定规模的领先企业可通过规模效应降低成本，巩固已有优势。受此行业特性的影响，DRAM 行业自 20 世纪 80 年代发展初期的数十家企业，发展到目前全球主要生产厂商包括三星电子、SK 海力士、美光科技及长鑫科技等。

根据 Omdia 的数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96%、34.48% 和 23.41%，上述三家企业合计占全球 DRAM 市场 90% 以上的市场份额。

近年来，国产 DRAM 厂商里长鑫科技正逐步进入主要厂商阵营。基于 Omdia 数据测算，按 2025 年第四季度 DRAM 销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至 7.67%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。

除前述厂商外，其他占有一定市场份额的厂商主要集中在中国台湾，包括南亚科技、

华邦电子、力积电等。中国大陆亦有其他半导体企业布局 DRAM 业务，但多专注于芯片设计。

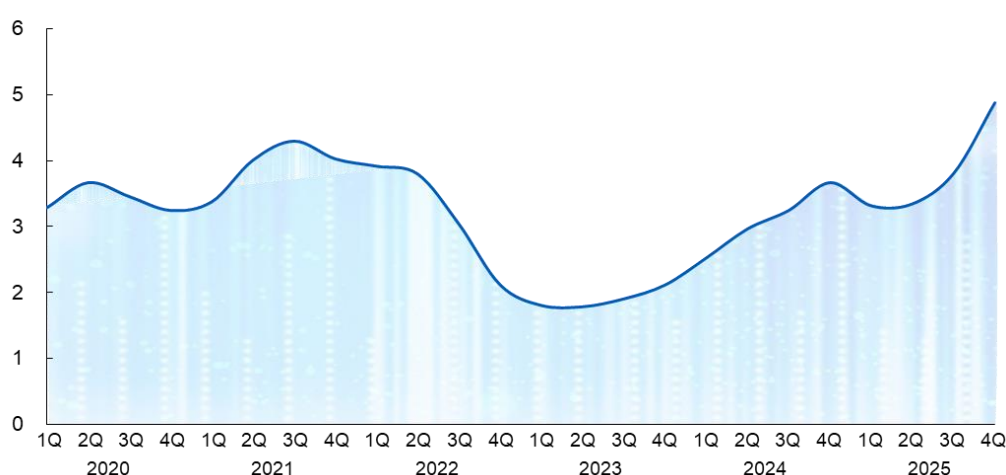
2、行业的周期性特征

DRAM 行业受市场供需波动影响较大，具有显著的周期性特征。厂商基于下游需求变化做出产能调控策略，但新建产线的产能爬坡通常需要多个季度，新建晶圆厂从资本开支到产能释放更是需要长达数年，导致市场供给与需求存在错配。同时，由于 DRAM 市场供给端高度集中，头部厂商占有绝大部分市场份额，各家资本开支较为集中，新增或缩减产能决策往往同步释放，使得 DRAM 行业较其他半导体产品行业呈现更加显著的强周期性特征。

DRAM 产品市场需求量大且产品标准化程度高，不同 DRAM 厂商的产品规格、性能相近，使得其具备大宗商品属性，供需错配时市场价格竞争尤为激烈。同时，从历史上看，技术迭代速度、宏观经济波动、贸易政策等多重不确定性因素也会进一步加剧 DRAM 价格起伏，使得 DRAM 市场价格呈现显著的波动性。

2025 年下半年以来，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，价格呈现大幅上涨趋势。

2020-2025 年 DRAM 价格变化图（美元/GB）



数据来源：Omdia

3、所属细分行业技术水平及特点

（1）DRAM 产品以标准技术规范为基础，定制化延伸特定应用场景

为了构建 DRAM 产业互联生态，JEDEC 制定了国际通用的 DRAM 技术标准，通

过统一规范内存芯片及模组的接口协议、时序参数等关键技术指标，从底层解决兼容性问题，确保不同厂商的 DRAM 产品在实际应用端均可实现适配。例如，DDR5 标准通过统一数据速率（如 6400MT/s）、双通道设计等规范，使得不同厂商的内存条能与主板即插即用。各厂商可通过自主进行内部架构设计、制造工艺开发等，满足上述标准化技术规范，推出标准化 DRAM 产品。

除了面向通用场景的标准化产品，针对特定应用需求，市场也存在定制化需求。这类定制化 DRAM 产品需要由厂商开展差异化设计，匹配终端设备在功耗、尺寸、性能等方面的特殊要求，从而实现从通用场景到特定场景的技术延伸，补充通用标准难以覆盖的细分需求。

（2）产品持续向传输速度更快、容量更大、功耗更低的新代际演进

随着场景数字化的持续渗透推动全球数据量规模化扩张，海量实时数据处理需求对于大容量、高速、低延迟内存的需求持续攀升，市场对更高性能的 DRAM 产品有着强烈需求。在半导体技术与工艺持续突破的基础上，DDR 及 LPDDR 产品持续向传输速度更快、容量更大、功耗更低的新代际演进，DDR5 及 LPDDR5 等新一代际产品在服务器、移动设备、个人电脑等市场的占有率持续攀升。

同时，持续发展的新一代信息技术对数据吞吐量有了更高的要求，各大厂商持续探索 DRAM 的新型架构及制造封装工艺，推动 DRAM 产品向传输速度更快、容量更大、功耗更低的方向演进。

（3）经济效益驱动 DRAM 工艺水平持续迭代与创新

长期以来，工艺制程的演进是 DRAM 厂商实现成本降低、产品性能提升的重要手段。在更先进的工艺制程下，DRAM 单元尺寸缩小，单位面积内得以集成更多的存储单元，每个比特的存储成本显著降低。同时，晶体管间距的缩小使得电子移动路径有效缩短，对于电压的需求也同步下降，从而实现功耗下降。在数据量高速增长及技术创新迭代等多重因素的驱动下，用户对存储容量、传输速度及功耗的要求不断提高。各大厂商通过工艺制程的不断微缩，使得单位内存芯片拥有更高的容量，并具备更快的传输速度以及更低的功耗，在能够显著降低单位成本的同时有效提升产品性能，获取经济效益。

由于漏电流、成本等物理及商业化层面的挑战，DRAM 平面架构演进逼近极限，

工艺制程的微缩速度正在放缓。4F²（即 4F Square，是一种单元结构技术）等新型架构通过将晶体管和电容器垂直堆叠，进一步减小了单元面积，是 DRAM 进一步发展的重要技术路径。

4、进入本行业主要壁垒

（1）技术壁垒

DRAM 具有极高的技术门槛，设计与制造工艺复杂，涉及专业领域广。在电路设计环节，DRAM 设计需要在高密度阵列中精确平衡高密度、高传输速度、低功耗及高可靠性等多重严苛目标，设计验证过程复杂且周期较长。而在制造环节，则需要持续迭代更先进的制程工艺以保持竞争力。这一过程涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、扩散及离子注入、化学清洗、化学机械抛光等数百道复杂而精密的工序，每一环节都对最终产品性能具有重要影响。必须通过严格的质量控制，才能确保最终芯片产品具备良好的性能及稳定的运行表现。

同时，受下游快速更新的需求驱动，DRAM 行业呈现出技术迭代较快的特点。这要求行业内的企业具备强大的技术储备和研发响应能力，能够根据下游应用市场的变化情况，持续迭代更高存储密度、更低功耗及更快读写速度的产品。在此过程中，伴随制程节点的持续微缩，电路设计复杂度攀升，光刻精度、蚀刻深宽比及薄膜沉积等核心工艺环节难度呈几何级数增长。较高的技术门槛迫使行业内的新进入者需要完成长时间的积累，才能具备快速响应市场的设计及制造水平，技术壁垒明显。

（2）资金和产能壁垒

行业内主要 DRAM 企业通常采取 IDM 模式经营，需要同时在技术迭代、产品开发和产线建设上持续投入大量资金以支撑企业发展。一方面，新建 DRAM 晶圆制造产线所需资本支出极高，单座工厂的投资规模已超过百亿美元。且随着制程工艺向更先进节点演进，相应的研发成本、厂房建设及设备投入也将进一步攀升，对企业资金实力提出严苛挑战。另一方面，下游应用对 DRAM 产品性能的要求持续提升，主流市场竞争高度依赖技术先进性。企业必须持续投入大量资金用于技术研发以持续在 DRAM 领域立足。能否紧跟或引领技术工艺，是企业在 DRAM 领域维持市场竞争力的关键因素之一。

在极高的资本开支需求下，DRAM 厂商必须将产能提升至足够大的量级，才能通过规模效应实现成本的摊薄，获取经济效益。随着产能规模持续扩大，单位成本呈现显

著下降趋势，企业将具备更充足的盈利空间。领先企业可以凭借规模优势，持续扩大其市场份额，巩固现有市场地位。前述资金和产能壁垒显著限制了 DRAM 行业潜在竞争者的进入，并促使行业集中度不断提升。

（3）人才壁垒

DRAM 行业是典型的人才密集型行业，对核心人才的知识储备、研发能力、实践经验均有极高要求。目前行业主要 DRAM 厂商均采用 IDM 模式经营，涵盖半导体设计、制造、封装测试等多个环节，对人才队伍的广度和宽度提出了更高的要求。我国集成电路行业正处于高速发展阶段，对于有技术和经验的高端人才的需求较大，人才的聚集和储备成为市场新进入企业的重要壁垒。

（4）运营管理壁垒

DRAM 产业链管理复杂，企业运营管理具备高度的专业性与复杂性：

首先，DRAM 生产制造从晶圆投片到封装测试涉及几百道工序，每道工序都需要精准控制。这要求运营管理部门必须具备高度专业的知识、丰富的运营经验和精细的调度能力，以确保整个生产流程的顺畅进行。

其次，DRAM 生产制造环节涉及工艺步骤非常多，生产工艺高度复杂，这就给质量监控、问题追溯和良率控制提出了极高的要求，往往需要研发、工艺、产品、测试等多个部门共同参与。同时，还需要有一套严格、全面、有效的测试程序来保障产品品质。

同时，DRAM 生产制造环节中所需设备和原材料品类较多，依赖大量高度专业化的设备和原材料供应商，这些供应商不仅需要满足极高的技术要求，还需保证供应的稳定性，同时下游客户对准时交付和长期稳定供应提出较高的要求，因此企业需具备卓越的全产业链生态协同能力，实现从材料采购、生产制造到产品交付各环节的高效运作。

另外，DRAM 行业属于资本密集型领域，高资本开支下需要通过高效的管理提升运营效率，实现精细化成本控制。在此背景下，DRAM 企业需在长期生产经营中积累规模化生产运营管理能力。

综上所述，构建高效的运营管理体系需要高度专业的知识和深厚的经验积淀，对于计划进入该行业的新企业而言，这种知识和管理经验上的差距构成了重要的进入壁垒，难以在短期内逾越。

5、面临的机遇与风险

（1）面临的机遇

1) 数字经济浪潮蓬勃发展，带来 DRAM 市场新一轮增长机遇

数字经济浪潮下，数据处理量指数级增长。近年来，随着新一代信息技术的成熟和普及，各行业正在加速迈向全面数字化，数字化转型已经成为提升效率、降低成本及拓展市场的重要手段。在此背景下，全球数据总量呈现爆发式增长。根据 IDC 预测，2025 年全球将产生 213.56ZB 数据，到 2029 年将增长一倍以上达到 527.47ZB。

海量数据的实时读写与高效处理，离不开 DRAM 芯片的核心支撑。作为各类电子设备中负责临时数据存储的关键器件，DRAM 不仅对数据处理的速度与效率具有重要影响，更是满足数字经济时代高吞吐、低延迟数据需求的基础硬件。而海量数据的存取与读写需求，进一步催生了 DRAM 芯片广阔的市场空间，为公司产品带来了历史性的发展机遇。

2) 国际竞争环境下，本土产业链生态建设推动国产 DRAM 厂商迎来战略机遇期

国产移动设备、个人电脑、智能汽车等终端品牌厂商基于中国市场庞大的需求，持续进行产品创新迭代，提升产品竞争力，在全球市场中占有日益重要的份额。同时，随着近年来国际贸易摩擦进一步加剧，众多产业链下游国产客户愈发关注供应链的安全性与稳定性，国产终端品牌积极推进本地化供应链体系搭建。本土终端厂商的崛起及其对于产业链生态建设的需求，为国产 DRAM 厂商带来了巨大机遇。

3) 摩尔定律放缓，新技术需求赋予国产 DRAM 厂商追赶窗口

目前国际领先 DRAM 企业已进入制程节点微缩瓶颈，新产品开发中面临的成本巨幅增长与物理极限的逼近问题导致工艺难度大幅提升，DRAM 厂商积极尝试新的技术方案。但技术路线的商业化验证仍具有不确定性，部分技术方案虽在试验阶段展现出了潜力，但在大规模量产的良率控制、成本适配、与现有产业链兼容性等方面仍需长期验证，技术落地存在不确定性。

在新技术领域的研发上，国内厂商与国际前三家厂商均处于探索阶段。国内厂商有望抓住产业革新机会迎来快速发展机遇，克服在追赶国际领先水平上面临的竞争挑战，聚焦于技术攻坚，通过产品与技术的革新逐步缩小与国际领先水平的差距，甚至实现部

分技术与产品的弯道超车。

(2) 面临的风险

1) 行业周期性波动带来的厂商经营风险

DRAM 行业具有强周期属性，价格波动较大。作为典型的资金密集型产业，DRAM 从规划到满产通常需要数年的时间，当市场需求因技术迭代或新兴应用爆发时，厂商难以快速增加产能，导致短期产品供不应求，迅速推升产品价格上涨；但随后头部厂商的集中扩产往往导致供给过剩，行业进入下行周期。同时，宏观经济波动、高集中度市场格局下主要厂商的产能调控策略等因素也进一步加剧周期波动。

在行业强周期性特征下，难以预测的价格波动可能导致 DRAM 产品销售价格短期内大幅上涨或下跌，增加了行业内厂商在生产规划、存货管理及资本开支决策等方面的经营难度，并对其经营业绩带来一定压力。前述不确定性使得行业内厂商面临行业强周期性特征下带来的经营挑战。

2) 国际地缘政治持续升温带来的产业链不稳定风险

国际地缘政治持续升温，给全球化布局的 DRAM 产业链带来了潜在的不稳定风险。DRAM 产业链的关键环节涉及多个国家和地区，若地缘政治紧张导致部分区域贸易政策调整、技术出口管制加强等，可能对产业链各环节的协同效率产生影响。

我国半导体与集成电路产业由于发展时间尚短，产业成熟度相对较低。近年来，国际政治环境日趋复杂，部分国家采用包括但不限于提高关税、限制进出口等多种方式实行贸易保护主义，限制我国以半导体集成电路行业为代表的高科技产业的发展，给我国相关产业的发展带来产业链不稳定风险。

3) 我国 DRAM 产业起步较晚，在短期市场竞争中面临一定挑战

我国 DRAM 企业的发展起步相对滞后于国际领先企业，在技术积累的深度与广度上仍有提升空间。国际头部厂商历经数十年的技术迭代，已在材料应用、专利布局等方面形成了深厚积淀；而我国相关产业的自主化探索时间较短，在先进工艺研发、关键技术突破等环节，还需要更多时间进行经验积累与体系构建，部分核心技术环节的配套能力也有待进一步夯实。

从产能规模来看，国际前三家厂商凭借长期的产能扩张与整合，已形成较大的规模

效应，在全球市场中占主导地位。相比之下，我国 DRAM 行业仍处于发展阶段，市场份额仍在持续开拓过程中。

6、发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

作为研发设计制造一体化企业，公司位于 DRAM 产业链核心的中游环节。DRAM 产业链分析具体请参见本节之“（三）所属行业发展情况”之“1、DRAM 行业概况”之“（3）DRAM 产业链分析”。

公司凭借持续的产能建设及技术突破，对 DRAM 产业链上下游形成关键带动与协同效应。向上游，公司规模化生产需求为设备、材料等上游企业提供了重要的技术验证和商业化应用机会，推动上游供应链构建更加成熟的市场供给能力；向下游，公司为服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等下游终端客户提供稳定供给，帮助下游企业更加灵活地响应市场需求，进而助力下游产业集群持续发展升级。作为 DRAM 产业链核心环节企业，公司为 DRAM 产业链生态的进一步完善提供了重要助力。

三、发行人的行业地位及竞争优势

（一）同行业主要企业情况

公司是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。行业内主要 DRAM 企业情况如下：

1、三星电子（005930.KS）

三星电子成立于 1969 年，总部位于韩国，于 1975 年在韩国证券交易所上市，是一家国际领先的电子产品的生产和销售企业。三星电子下设设备体验（DX）部门、设备解决方案（DS）部门、三星显示（SDC）等，其中 DS 部门主要提供半导体相关的产品或服务，主要包含 DRAM、NAND、移动应用处理器等半导体产品与晶圆代工服务等。2025 财年，三星电子实现营业总收入 3,336,059.38 亿韩元，净利润 452,068.05 亿韩元。

2、SK 海力士（000660.KS）

SK 海力士成立于 1983 年，总部位于韩国，于 1996 年在韩国证券交易所上市，是一家主要从事半导体存储器的研发设计、生产和销售企业，主要产品包括 DRAM、NAND Flash 等存储芯片。2025 财年，SK 海力士实现营业总收入 971,466.75 亿韩元，净利润 429,479.02 亿韩元。

3、美光科技（MU.O）

美光科技成立于 1978 年，总部位于美国，于 1984 年在美国纳斯达克证券交易所上市，是一家从事半导体存储的生产和销售企业，提供 DRAM、NAND Flash、NOR Flash 及其他存储产品。2025 财年，美光科技实现营业总收入 373.78 亿美元，净利润 85.39 亿美元。

4、南亚科技（2408.TW）

南亚科技成立于 1995 年，总部位于中国台湾，于 2000 年在台湾证券交易所上市，专注于 DRAM 的研发、设计、制造与销售。2025 财年，南亚科技实现营业总收入 665.87 亿新台币，净利润 66.13 亿新台币。

（二）可比上市公司的选择依据

在产品及业务方面，DRAM 行业内主要企业为境外企业，因此选取前述全球 DRAM 主要厂商三星电子、SK 海力士、美光科技、南亚科技作为可比公司。

公司是 DRAM 研发设计制造一体化企业，目前 A 股尚无与公司在产品和业务可比的上市公司。基于技术特点、市场地位及业务模式等核心要素考虑，进一步选取台积电、中芯国际及华润微作为可比公司，具体情况如下：

1、台积电（2330.TW）

台积电成立于 1987 年，总部位于中国台湾，于 1994 年在台湾证券交易所上市，主营业务包括集成电路及其他半导体芯片的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工服务。根据 TrendForce 统计，台积电是全球营收排名第一的晶圆代工企业。2025 财年，台积电实现营业总收入 38,090.54 亿新台币，净利润 17,153.97 亿新台币。

2、中芯国际（688981.SH）

中芯国际成立于 2000 年，总部位于中国上海，于 2020 年在上海证券交易所科创板上市，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者。2025 财年，中芯国际实现营业总收入 673.23 亿元人民币，净利润 72.09 亿元人民币。

3、华润微（688396.SH）

华润微成立于 2003 年，总部位于中国江苏省无锡市，于 2020 年在上海证券交易所

科创板上市，是拥有芯片设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制等领域。2025 财年，华润微实现营业总收入 110.54 亿元人民币，净利润 5.55 亿元人民币。

（三）与同行业可比公司的对比分析

1、市场地位

长鑫科技是全球主流 DRAM 市场的重要竞争者，也是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。基于 Omdia 全球厂商 2025 年第四季度 DRAM 销售额统计，凭借不断优化的产品结构、持续迭代的工艺水平、日臻成熟的运营能力以及广泛的市场认可，长鑫科技的全球市场份额已增至 7.67%，位列全球第四位，中国第一位。

2、技术实力

（1）产品线对比

经由前道制造、后道封装测试完成后，DRAM 芯片可直接或进一步制成模组，应用于服务器、移动设备、个人电脑及其他消费电子等下游应用领域。对于下游终端客户而言，容量是其在进行产品选择时的核心考量因素，直接影响着终端的存储承载能力及实际场景的运行表现。区分下游应用领域，截至 2025 年 12 月 31 日，公司与同行业企业产品对比情况如下：

1) 服务器领域

公司简称	DDR4		DDR5		
	32GB 及以下	32GB 以上	64GB 以下	64GB	64GB 以上
三星电子	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
SK 海力士	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
美光科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
南亚科技	已量产	已量产	已量产	开发中	开发中
长鑫科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产

注 1：数据来源为各公司官网、定期报告、第三方咨询机构等公开信息。

注 2：2024 年底以来，长鑫科技自有 DDR4 产品已停止生产。

2) 移动设备及其他消费电子领域

公司简称	LPDDR4X			LPDDR5/5X		
	8GB 以下	8GB	8GB 以上	16GB 以下	16GB	16GB 以上
三星电子	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
SK 海力士	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
美光科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
南亚科技	已量产	/	/	开发中	/	/
长鑫科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产

注：数据来源为各公司官网、定期报告、第三方咨询机构等公开信息。

3) 个人电脑领域

公司简称	DDR4		DDR5		
	8GB 及以下	8GB 以上	16GB 以下	16GB	16GB 以上
三星电子	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
SK 海力士	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
美光科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
南亚科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产
长鑫科技	已量产	已量产	已量产	已量产	已量产

注 1：数据来源为各公司官网、定期报告、第三方咨询机构等公开信息。

注 2：2024 年底以来，长鑫科技自有 DDR4 产品已停止生产。

(2) 参数指标对比

在具体的参数指标上,由于各厂商均参照 JEDEC 标准设计并制造标准 DRAM 产品,不同厂商的同代际产品在速率、带宽、电压等关键指标上严格遵循行业规范,在核心性能参数、接口协议及基础功能上具有高度一致性。

(四) 竞争优势与劣势

1、公司竞争优势

(1) 持续的研发创新和技术快速迭代能力

由于计算和处理芯片性能持续提升,对 DRAM 不断提出更高要求,需要 DRAM 产品不断向更大的存储密度、更快的传输速率、更低的功耗进行迭代升级。因此,产品和制程工艺的持续迭代并保持行业头部技术水平是能够在 DRAM 行业生存并维持产品竞争力的关键。公司始终坚持自主研发道路,并通过跳代研发加速技术创新,快速完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产,以及 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 的产品覆盖和迭代,目前核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。此外,

采用 IDM 模式运营的企业，需要同时在水产品设计、工艺技术、封装测试、模组设计与制造等经营环节投入大量研发资源，只有各经营环节技术和创新能力“齐头并进”，才能有效保持综合竞争力。经过多年发展，公司已在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了完善的核心技术体系，同时形成了全面的自主知识产权，并在技术快速迭代和产业化方面积累了丰富的经验。

(2) 产能规模持续提升，规模效应日益增强

DRAM 是半导体行业高度标准化的产品，其产能建设需要巨大的资本投入，规模效应带来的成本优势成为企业核心竞争力之一。公司产能规模位居中国第一、全球第四。随着公司目前规划产能建设投入逐步完成及产能快速爬坡，业务规模效应逐步显现，叠加 IDM 模式下各业务环节的有效协同和高效的成本管控，公司产品成本优势和价格竞争力将持续增强，助力公司未来进一步加速市场渗透。

(3) 丰富的产品组合不断迭代升级，具备全面的 DRAM 产品方案能力

不同应用场景下对 DRAM 的接口、容量、速率、带宽以及产品封装形态存在较大差异，只有建立起足够丰富的产品矩阵，才能更好与 DRAM 国际领先厂商竞争。公司紧跟行业领先技术和下游应用市场发展趋势，通过不断加强研发投入和不懈的技术攻关，完成了 DDR 系列和 LPDDR 系列的产品布局，产品速率、功耗等性能达到国际先进水平。其中，公司 DDR 系列产品覆盖 DDR4、DDR5 两大主流产品代际，能够提供 8GB、16GB、32GB、64GB、96GB、128GB 等多个容量规格的 DRAM 模组产品，有效满足服务器、个人电脑等应用市场需求。LPDDR 系列产品方面，公司目前已推出 LPDDR4X 和 LPDDR5/5X 产品，并提供 8GB 以下、8GB、12GB、16GB 等多个容量选择，广泛应用于手机、平板等移动设备和其他对功耗要求相对严格的小型电子设备以及智能汽车领域。此外，公司也在积极进行现有产品的丰富和升级，推出更高速率、更大容量的升级产品，同时布局更新代际产品以更好满足市场需求。凭借不断丰富的产品组合，公司能够为客户提供多元化的产品解决方案，成为全球 DRAM 市场的主要竞争者。

(4) 出色的统筹协调和规模化生产运营管理能力

DRAM 行业具有产品复杂度高且迭代速度快、原材料品种多、生产工序复杂、制造难度大等特点，且下游客户对 DRAM 产品质量、稳定性以及准时交付和稳定供给的要求较高，出色的统筹协调和规模化生产运营管理能力是 DRAM 企业核心竞争力的重

要体现。经过多年发展，公司构建了高效的研发创新机制，确保技术研发与产品量产的高效衔接，有效提升了技术产业化效率；另一方面，公司具备强大的供应链整合和管理能力，能够有效保障各类设备、原材料的供应与公司生产动态匹配；此外，公司通过引入自动化、信息化和智能化生产系统及流程优化，有效提升了生产效率并降低单位成本，同时保障了公司各地工厂的技术工艺精密性和一致性。出色的运营管理能力是公司快速发展并保持长期稳定供给的重要基础。

（5）与产业上下游紧密合作，构建了强大的产业生态

作为中国 DRAM 产业链的链主企业，基于自身强大的产业影响力，公司已与上游供应商和下游客户建立了紧密的战略合作关系，积极整合产业生态资源，共同构建了相互依存的产业生态，为公司业务持续发展并积极参与全球竞争奠定了坚实的基础。一方面，经过长期发展，公司与上游 EDA 厂商、材料厂商、设备及零部件厂商等供应商建立了稳固的合作关系，并通过深化产业链合作，积极推进供应链的多元化、本土化，增强供应链的安全保障能力，为公司产能持续扩充和技术工艺升级提供了有力保障。另一方面，公司与业内领先的移动端厂商、服务器厂商、存储模组厂商等下游客户建立了紧密的合作关系，并取得了众多客户的高度认可，树立了良好的市场品牌，为公司加强市场渗透，提升全球市场份额奠定了坚实的基础。

（6）专业务实、经验丰富的技术和管理团队

公司组建了具备丰富行业经验的专业务实、锐意进取的核心研发和运营管理团队。公司管理层团队的核心领导者拥有 25 年以上半导体行业经验，具备深刻的行业洞察力和卓越的战略定力，共同引领公司成长与战略落地。公司积极营造创业创新文化，鼓励技术创新，并吸纳了来自全球知名半导体企业的人才。公司技术与研发团队由海内外具备丰富半导体行业经验的专家团队组成，在 DRAM 产品设计、工艺开发、生产制造、质量管控等方面具备深厚的技术背景和丰富的管理经验。公司亦高度重视人才培养和团队梯次配置与持续发展，截至 2025 年末，公司研发人员占比超过 30%，强大的人才与团队储备是公司保持长久竞争力的重要基础。

2、公司竞争劣势

（1）发展起步相对较晚，较国际头部企业仍存在一定差距

DRAM 行业长期由三星电子、SK 海力士、美光科技等头部厂商主导，公司发展起

步较晚，与上述同行业企业相比，在收入规模、研发和资本投入规模、产能规模、产品组合等方面仍存在一定差距。上述企业已历经了数十年的发展，在 DRAM 产品设计、制造等方面已形成深厚的技术积累，具有技术先发优势和一定成本优势，相较上述厂商，公司目前尚处发展前期阶段，面临的竞争压力相对更大。

（2）部分国际供应链资源受限

近年来，受国际地缘政治因素影响，全球半导体产业分工合作日益受限。在当前充满挑战的产业发展环境下，公司在获取部分国际供应链资源、开展国际化产业合作等方面面临一定限制。

（3）融资渠道受限

DRAM 行业属于典型的重资本投入行业，产能的建设和运营需要大量资金投入，持续的产品、技术和工艺迭代也需要持续高额的研发投入支撑。三星电子、SK 海力士和美光科技等国际 DRAM 厂商均为上市公司，能够便捷开展资本运作以支撑其业务发展，相较于上述企业，公司在融资渠道上仍相对受限。近年来，公司持续加强产能建设与扩充、产品与技术升级以及市场渗透，随着公司业务快速发展，融资渠道受限带来的资金不足问题已经成为制约公司发展的主要瓶颈之一，公司业务进一步成长迫切需要资金支持。

四、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品的产能、产量和销量

产能方面，报告期内，公司产能均来自 12 英寸晶圆制造生产线，整体产能和产量快速增长，产能利用率稳步提升，各期产能利用率分别为 87.06%、92.46%和 95.73%。

产销量方面，公司主要 DRAM 产品包括 DDR 系列及 LPDDR 系列产品，报告期内，公司主要 DRAM 产品的产量和销量实现快速增长，按容量口径统计的产销率分别为 99.45%、97.94%和 90.67%。

（二）主营业务收入分业务构成

报告期内，公司主营业务收入分别为 906,314.37 万元、2,392,875.14 万元及 6,127,537.21 万元，主营业务收入具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	1,953,128.56	31.87%	317,397.33	13.26%	182,716.69	20.16%
LPDDR 系列	4,070,354.50	66.43%	1,979,825.86	82.74%	675,607.25	74.54%
其他产品及服务	104,054.15	1.70%	95,651.94	4.00%	47,990.43	5.30%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

（三）各销售模式的规模及占比情况

报告期内，公司产品销售采用经销和直销相结合的方式。公司主营业务收入按销售模式的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	5,231,648.90	85.38%	2,055,615.46	85.91%	767,564.89	84.69%
直销模式	895,888.31	14.62%	337,259.68	14.09%	138,749.48	15.31%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

（四）报告期内前五大客户情况

报告期内，公司向主营业务的前五大客户合计销售金额分别为 671,753.53 万元、1,610,353.51 万元及 4,171,676.44 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 74.12%、67.30% 及 68.08%。

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入 50%或严重依赖少数客户的情况。报告期内，公司主营业务的新增前五大客户包括客户 D、客户 E、客户 H 和客户 J，其中，客户 H 和客户 E 系 2024 年新增前五大客户，当期销售金额占主营业务收入比例分别为 7.55%和 7.42%；客户 J 和客户 D 系 2025 年新增前五大客户，当期销售金额占主营业务收入比例分别为 9.98%和 6.75%。

截至本招股说明书签署日，兆易创新集团为公司董事长朱一明控制并担任董事长的企业，除此之外，上述主要客户与公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

五、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要采购情况

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司生产经营使用的主要原材料包括化学品、备件、光阻剂、硅片、气体和靶材，具体采购情况如下：

种类	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
化学品	金额（万元）	427,785.53	346,161.80	228,029.24
	占原材料采购总额的比例	37.29%	30.43%	27.06%
光阻剂	金额（万元）	139,532.09	107,542.07	82,056.88
	占原材料采购总额的比例	12.16%	9.45%	9.74%
硅片	金额（万元）	98,124.73	85,313.60	70,202.49
	占原材料采购总额的比例	8.55%	7.50%	8.33%
气体	金额（万元）	58,554.39	48,217.93	39,412.29
	占原材料采购总额的比例	5.10%	4.24%	4.68%
靶材	金额（万元）	25,324.41	16,800.19	12,018.15
	占原材料采购总额的比例	2.21%	1.48%	1.43%
备件及其他	金额（万元）	397,985.65	533,710.98	410,977.47
	占原材料采购总额的比例	34.69%	46.91%	48.77%

注：以上原材料中，硅片仅包括生产芯片，气体不含大宗气体耗用，备件及其他中，其他种类主要为电子元器件。

2、报告期内主要原材料采购价格变动情况

报告期内，公司主要原材料采购单价呈现下降趋势，假设 2023 年采购价格指数为 100.00，后续各期采购价格指数以 2023 年采购价格指数为基数进行计算的主要原材料采购价格指数如下：

种类	2025 年度	2024 年度	2023 年度
化学品	73.72	91.13	100.00
备件	53.33	105.58	100.00
光阻剂	85.65	91.05	100.00
硅片	69.99	76.30	100.00
气体	82.46	92.59	100.00
靶材	78.13	84.58	100.00

注：以上原材料中，硅片仅包括生产芯片，气体不含大宗气体耗用。

（二）主要能源供应情况

报告期内，公司生产经营使用的能源主要为水和电，具体采购情况如下：

能源	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
水	采购数量（万吨）	3,354.77	2,420.19	1,532.14
	采购单价（元/吨）	4.42	4.44	4.16
	采购金额（万元）	14,831.88	10,735.31	6,372.10
电	采购数量（万度）	464,986.01	327,524.18	201,547.13
	采购单价（元/度）	0.60	0.61	0.63
	采购金额（万元）	280,987.97	201,045.06	126,482.85

报告期内，公司水和电的采购规模随着公司生产规模扩大而不断增加，各期采购水和电的平均单价基本保持稳定，能源供应稳定、充足。

（三）报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为 25.65%、31.39%和 21.81%，具体情况如下：

单位：万元

期间	排名	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占原材料采购总额的比例
2025 年度	1	供应商 A	化学品	84,323.56	6.67%
	2	供应商 B	化学品、光阻剂	67,913.03	5.37%
	3	供应商 T	气体	45,271.19	3.58%
	4	供应商 C	备件	40,206.76	3.18%
	5	供应商 I	硅片	38,228.75	3.02%
	合计			275,943.29	21.81%
2024 年度	1	供应商 F	备件	101,128.83	8.29%
	2	供应商 A	化学品	89,825.92	7.37%
	3	供应商 G	备件、靶材	81,789.22	6.71%
	4	供应商 B	化学品、光阻剂	58,745.48	4.82%
	5	供应商 C	备件、化学品	51,315.37	4.21%
	合计			382,804.83	31.39%
2023 年度	1	供应商 C	备件、化学品	64,152.95	7.08%
	2	供应商 B	化学品、光阻剂、气体、备件	49,332.28	5.44%
	3	供应商 A	备件、化学品	47,095.08	5.20%

期间	排名	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占原材料采购总额的比例
	4	供应商 H	备件	39,694.08	4.38%
	5	供应商 I	硅片	32,212.85	3.55%
	合计			232,487.24	25.65%

注：同一控制下的主体，采购金额已合并披露。

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额 50%或严重依赖于少数供应商的情形。截至本招股说明书签署日，上述主要供应商与公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

六、发行人主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备等，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	1,538,021.40	251,698.00	-	1,286,323.40	83.63%
机器设备	22,570,892.03	5,520,496.70	121,737.19	16,928,658.15	75.00%
运输设备	1,944.97	930.31	-	1,014.66	52.17%
办公及其他设备	202,278.55	115,832.60	43.36	86,402.59	42.71%
合计	24,313,136.94	5,888,957.61	121,780.54	18,302,398.79	75.28%

1、自有房屋所有权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司与生产经营相关的自有房屋所有权的情况如下：

序号	不动产权证编号	权利人	房屋座落	用途	房屋建筑面积（m²）	他项权利
1	皖（2025）合肥市不动产权第 1173251 号	长鑫科技	经开区天柱山大道 388 号“长鑫 12 吋存储器晶圆制造基地项目”配套研发中心及倒班宿舍楼项目长鑫存储研发中心配套项目	工业用地/工业	13,102.40	无
2	皖（2025）合肥市不动产权第 1172952 号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 101 号建筑芯片生产厂房 1	工业用地/工业	329,121.51	抵押
3	皖（2025）合肥市不动产权第 1172953 号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 102 号建筑动力厂房 1	工业用地/工业	52,291.80	抵押

序号	不动产权证 编号	权利人	房屋座落	用途	房屋建筑面 积 (m²)	他项 权利
4	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172955号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 106 号建筑柴油发电机及柴油泵房 1	工业用地/工业	7,267.40	抵押
5	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172956号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 107 号建筑硅烷站 1	工业用地/工业	317.50	抵押
6	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172957号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 108 号建筑废水处理站 1	工业用地/工业	10,978.55	抵押
7	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172958号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 109 号 建 筑 综 合 楼 -101/101/102/201/202/301 等	工业用地/机动车 库, 其它	11,719.83	抵押
8	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172960号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 111B 号建筑门卫 B	工业用地/其它	39.82	抵押
9	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172962号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 116A 号建筑甲类库房 1 (特气站)	工业用地/仓储	348.04	抵押
10	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172963号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 116B 号建筑甲类库房 2 (化学品库)	工业用地/仓储	1,444.48	抵押
11	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172964号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 116C 号建筑乙类库房	工业用地/仓储	5,639.35	抵押
12	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172965号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 116D 号建筑丙类废品库 2 (危废品)	工业用地/仓储	720.00	抵押
13	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172966号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 116E 号建筑甲类废品库 1 (废品库)	工业用地/仓储	720.00	抵押
14	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172967号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 118 号建筑厨房	工业用地/其它	632.20	抵押
15	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172968号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 121 号建筑大宗特气站	工业用地/工业	872.20	抵押
16	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172954号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 103 号建筑水池及水泵房 1	工业用地/工业	1,195.56	抵押
17	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172959号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 111A 号建筑门卫 A	工业用地/其它	45.54	抵押
18	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172961号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 111C 号建筑门卫 C	工业用地/其它	61.34	抵押
19	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172969号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号配套生产厂房 及厂务设施项目 116G 幢甲类库房	工业用地/工业	1,388.96	抵押

序号	不动产权证 编号	权利人	房屋座落	用途	房屋建筑面 积 (m²)	他项 权利
20	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172970号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号配套生产厂房 及厂务设施项目 116H 幢硅烷库	工业用地/工业	218.75	抵押
21	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172971号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号配套生产厂房 及厂务设施项目 116J 幢禁水甲库	工业用地/工业	256.25	抵押
22	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172972号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号配套生产厂房 及厂务设施项目 116K 幢丙类库房	工业用地/工业	13,014.46	抵押
23	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172973号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 111D 号建筑门卫 D	工业用地/其它	20.16	抵押
24	皖(2025)合肥市 不动产权第 1172974号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 117A-F 号建筑宿舍楼-101 等	工业用地/机动车 库, 集体宿舍	50,095.74	抵押
25	皖(2025)合肥市 不动产权第 1173252号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号 108A 号建筑 (废水处理站 1A)	工业用地/工业	2,560.96	无
26	皖(2025)合肥市 不动产权第 1173253号	长鑫存储	经开区天柱山大道 388 号长鑫工业厂房 项目废水处理站 1B	工业用地/工业	12,363.00	无
27	京(2023)开不动 产权第 0028801 号	长鑫集电	北京经济技术开发区经海三路 51 号院 9 号 1 层 107 等 7 套	工业用地/门卫, 危险品库, 化学品 库, 生产调度及研 发楼, 硅烷站	61,745.92	抵押
28	京(2024)开不动 产权第 0001983 号	长鑫集电	北京经济技术开发区科创八街 23 号院 13 号 1 层 101 等 8 套	工业用地/危废仓 库, 乙类仓库, 甲 类仓库, 一般仓库	21,940.06	抵押
29	京(2024)开不动 产权第 0016875 号	长鑫集电	北京经济技术开发区经海三路 28 号院 1 号楼-1 至 3 层 101 等 4 套	工业用地/门卫, 综合办公室(含中 控室), 供氢站, 动力站	8,097.55	抵押
30	京(2025)开不动 产权第 0000948 号	长鑫集电	北京经济技术开发区经海三路 51 号院 4 号楼-1-2 层 101 等 3 套	工业用地/柴发及 锅炉房, 集成电路 生产厂房, 动力厂 房	132,862.94	抵押
31	京(2025)开不动 产权第 0010897 号	长鑫集电	北京经济技术开发区科创八街 23 号院 4 号楼-1 至 3 层 101 等[6]套	工业用地/废水处 理站, 大宗特气站, 化学品供应厂房, 硅烷站, 动力厂房, 油泵房	119,668.67	抵押

2、租赁房屋

截至 2025 年 12 月 31 日, 发行人及其子公司与生产经营相关的租赁房产的情况如下:

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (m²)	租赁期间
1	陈燕	长鑫科技	深圳市南山区马家龙金龙创业园 64 栋西 6 楼 619 室	165.00	2022 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日
2	陈燕	长鑫科技	深圳市南山区马家龙金龙创业园 64 栋西 6 楼 620 室	180.00	2023 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日
3	聚光科技（杭州）股份有限公司	长鑫科技	杭州市滨江区滨安路 760 号 C 座一楼	租赁建筑面积 125 m²，其中套内建筑面积 94 m²	2024 年 9 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日
4	山东丽山细胞医学发展有限公司	长鑫科技	济南市历下区经十路 4577 号明湖国际细胞医学产业园 D 栋 504 室西半侧	建筑面积暂定 200 m²，以后期分割后实际测绘面积为准	2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日
5	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	长鑫科技	上海市闵行区合川路 2380 号 33 幢 3 层 302A 室	429.41	2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日
6	合肥市创新科技风险投资有限公司	长鑫科技	合肥市金寨路与习友路口琥珀五环城和颂阁 1 栋 7 层 701、702、707、708	700.26	2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
7	福岡スタンダード石油株式会社	长鑫日本	日本福岡县福岡市中央区今泉一丁目 20 番 2 号 8 层 801 区画、802 区画、803 区画	7,093.09	2021 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日（合同自动无限续期）
8	合同会社 Brayan	长鑫日本	日本神奈川县横浜市港北区新横浜 2 丁目 8 番 12 号五楼 01 区画	242.15	2021 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日（合同自动无限续期）
9	深圳湾科技发展有限公司	长鑫深芯	深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 25 层 06A 号	381.96	2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 31 日
10	深圳湾科技发展有限公司	长鑫深芯	深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 35 层 04 号	544.88	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
11	裕廊腾飞科技企业孵化器（西安）有限公司	长鑫西安	陕西省西安市高新区天谷七路 88 号新加坡腾飞科汇城东楼 23 层 2301 室	1,720.20	2023 年 10 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
12	合肥海恒创新投资管理有限公司	启航鑫睿	合肥市经开区清华路科技园 30 号楼	1,261.46	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
13	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	长鑫闵科	上海市闵行区漕宝路 1355 号 26 幢	9,426.92	2023 年 2 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日
14	肥西工投战新产业园管理有限公司	长鑫产品合肥	肥西经开区创新大道以西，紫蓬山路以北，大柏店路以东，清水河路以南	约为 160,000.00 m²，以肥西县规委会审批的总平面图规划方案为准	2024 年 7 月 4 日至 2044 年 7 月 3 日
15	北京火炬创新科技发展有限公司	长鑫芯瑞	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼科技大厦 D 座 5 层	1,511.91	2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）主要无形资产

1、境内土地使用权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司与生产经营相关的自有土地使用权的

情况如下：

序号	不动产权证 编号	使用 权人	土地座落	用途	使用权类型 及年限	宗地面积（㎡）	他项权利
1	皖（2021）合肥 市不动产权第 11015109号	长鑫 科技	经开区启德路西、 光福路北	工业 用地	国有建设用地使用权 /2020年10月10日至 2070年10月9日	16,057.73	无
2	皖（2021）合肥 市不动产权第 11015116号	长鑫 科技	经开区启德路西、 光福路北	工业 用地	国有建设用地使用权 /2020年10月10日至 2070年10月9日	18,143.92	无
3	皖（2025）合肥 市不动产权第 1172272号	长鑫 新桥	经开区启德路以 西、光福路以北	工业 用地	国有建设用地使用权 /2021年8月13日至 2071年08月12日	393,458.33	无
4	京（2023）开不 动产产权第 0024490号	长鑫 集电	亦庄新城 0302 街 区 B9M1 地块	工业 用地	国有建设用地使用权 /2021年10月19日至 2071年10月18日	82,052.60	抵押
5	京（2024）开不 动产产权第 0002181号	长鑫 集电	北京经济技术开发 区路东区 B14M1 地块	工业 用地	国有建设用地使用权 /2021年6月17日至 2071年6月16日	73,857.40	抵押
6	京（2024）开不 动产产权第 0002188号	长鑫 集电	北京经济技术开发 区路东区 B13M1 地块	工业 用地	国有建设用地使用权 /2021年6月17日至 2071年6月16日	71,796.60	抵押

2、专利

截至 2025 年 12 月 31 日，登记在公司及其子公司名下的专利共计 6,972 件，其中境内专利 3,929 件，包括发明专利 3,165 件；境外专利 3,043 件。发行人与生产经营相关的主要专利的具体情况参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“九、公司无形资产情况”之“（一）主要专利情况”。

3、商标

截至 2025 年 12 月 31 日，登记在公司及其子公司名下的商标共计 720 项，其中境内商标 292 项，境外商标 428 项。发行人与生产经营相关的主要商标的具体情况参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“九、公司无形资产情况”之“（二）主要商标情况”。

4、计算机软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，登记在公司及其子公司名下的主要计算机软件著作权共计 19 项，具体情况如下：

序号	著作权名称	著作权人	登记号	登记日期
1	Direct Materials/Indirect Materials 预算管控系统[简称：DM IDM 系统]V1.0	长鑫科技	2024SR0702055	2024-05-23
2	业务分析支撑系统[简称：BASS 系统]V1.0	长鑫科技	2024SR0638643	2024-05-13

序号	著作权名称	著作权人	登记号	登记日期
3	New College Graduates 系统[简称：NCG 系统]V1.0	长鑫科技	2024SR0702056	2024-05-23
4	长鑫宝软件[简称：长鑫宝]V1.0	长鑫科技	2024SR0638646	2024-05-13
5	Dorm Reserve Manage System 内部客房系统 [简称：DRMS]V1.0	长鑫科技	2024SR0611685	2024-05-08
6	Socket File Auto Generator 系统 V1.0	长鑫科技	2024SR0638648	2024-05-13
7	客户质量管理体系[简称：CQMS]V1.0	长鑫科技	2024SR0596899	2024-05-06
8	全球供应商战略预警系统[简称：GSSAS]V1.0	长鑫科技	2024SR0611686	2024-05-08
9	应用中心管理系统[简称：APPC]V1.0	长鑫科技	2024SR0611687	2024-05-08
10	预算管理系统[简称：BUCS]V1.0	长鑫科技	2024SR0611688	2024-05-08
11	危险废弃物数据治理系统[简称：危废数据治理系统]V1.0	长鑫科技	2024SR0611689	2024-05-08
12	高效会议管理系统软件[简称：HEMS]V1.0	长鑫科技	2024SR0638650	2024-05-13
13	最佳化公司班车调度系统[简称：班车调度系统]V1.0	长鑫科技	2024SR0611690	2024-05-08
14	面向 DRAM 设计的 Sign-off 管理系统[简称：WeSign]V2.0	长鑫科技	2024SR0597066	2024-05-06
15	DRAM 地址解析工具软件[简称：Acoder]V1.8	长鑫科技	2024SR0597099	2024-05-06
16	人事劳动合同签署系统[简称：Hrcontract]V1.0	长鑫科技	2024SR0597100	2024-05-06
17	员工预入职系统[简称：hrm]V1.0	长鑫科技	2024SR0597101	2024-05-06
18	意向订单征集平台[简称：Inorder]V1.0	长鑫科技	2024SR0597102	2024-05-06
19	企业人力资源分析软件	长鑫科技	2024SR0597103	2024-05-06

注：根据《计算机软件保护条例》等法律法规的规定，上述计算机软件著作权的保护期为五十年，截止于软件首次发表后第五十年的 12 月 31 日。

5、集成电路布图设计专有权

截至 2025 年 12 月 31 日，登记在公司及其子公司名下的集成电路布图设计专有权共计 4 项，具体情况如下：

序号	名称	登记号	申请人	首次商用时间	终止日
1	dbpla layout 布局	BS.255506422	长鑫存储	2023-10-10	2033-10-09
2	dbjoa layout 布局	BS.255506430	长鑫存储	2024-04-03	2034-04-02
3	dqpoa layout 布局	BS.255506384	长鑫存储	2024-12-05	2034-12-04
4	dbpma layout 布局	BS.255506406	长鑫存储	2023-04-01	2033-03-31

七、发行人特许经营及取得的相关资质

截至本招股说明书签署日，发行人业务不涉及特许经营内容，无特许经营权。

八、发行人的核心技术与研发情况

（一）公司的核心技术情况

1、核心技术情况

公司采用 IDM 模式运营，核心技术能力主要体现在工艺技术和产品技术两大方面，领先的产品技术是公司快速响应市场，持续进行产品优化升级、不断推陈出新的重要基础，工艺技术是公司产品技术得以有效实现商业化应用的重要支撑，也是公司产品质量、性能和成本持续改善的重要保障，工艺技术和产品技术相辅相成，共同构筑了公司的核心技术竞争力。

公司深耕 DRAM 存储芯片的设计与制造，通过持续的研发投入与技术探索，已掌握了多项达到国际先进水平的工艺和产品核心技术，覆盖 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。公司核心技术主要为自主研发形成，公司研发团队通过研发与创新形成了现有核心技术平台，并已大量应用于公司产品的大批量生产中。公司核心技术情况具体如下：

（1）DRAM 工艺技术

序号	核心技术名称	工艺技术特征及先进性表征	技术来源	技术先进程度	所处阶段
1	第一代工艺技术平台	应用低漏电、高性能、高密度的存储阵列结构设计及制造技术，引入埋入式字线、马鞍状鳍形有源区、位线、连接插塞、连接垫以及蜂巢排布电容结构等，提升存储阵列的性能。	自主研发	国内领先	已完成迭代并停止投片
2	第三代工艺技术平台	1、应用多重自对准曝光等光刻工艺技术，实现更精细化的图案转移，缩小产品体积； 2、应用精细化化学机械抛光工艺，持续提升 DRAM 生产工艺中各步骤界面均一性，提升研磨精度，减少刮伤、颗粒物等缺陷，进而提升产品良率。	自主研发	国内领先	量产
3	第四代工艺技术平台	1、采用低漏电、高性能的控制晶体管器件设计及制造技术，以实现高性能、高可靠性的外围控制能力； 2、应用多种精细化薄膜沉积工艺，满足 DRAM 制程中不同属性薄膜对高平整度、高均一性的要求，提升芯片整体性能； 3、通过改进清洗工艺程序，有效降低颗粒物残留及避免小尺寸结构因表面张力而导致的粘附，满足由于工艺技术演进对清洗步骤数大量增长和清洗能力的要求	自主研发	国际先进	量产

序号	核心技术名称	工艺技术特征及先进性表征	技术来源	技术先进程度	所处阶段
		提高的需求，提升产品良率； 4、采用过程控制和先进量测技术，满足先进 DRAM 制造对于控制关键尺寸、材料特性、产品缺陷、制造效率等的严苛要求。			

(2) DRAM 产品技术

序号	核心技术名称	产品技术特征及先进性表征	技术来源	技术先进程度	所处阶段
1	DDR4 设计技术	1、可实现数据独立读写提升数据吞吐量的两组 Bank Group 技术； 2、可降低芯片功耗的温度控制刷新、温度补偿自刷新等技术。	自主研发	国际先进	已成功量产，2024 年底以来自有产品已停止生产
2	DDR5 设计技术	1、信道反馈均衡技术，提升高速内存接口的数据接收裕量； 2、更优化的算法及保护电路，提升数据的安全性，降低 Row Hammer 的风险； 3、先进的封装工艺如 RDL 和后段金属，提高电源完整性；在内存条上，引入了专门的电源管理芯片以进一步保证电源的性能； 4、引入了纠错功能（ECC），提升了系统的可靠性； 5、四组 Bank Group 设计，进一步提高了内存的并行性和访问效率及带宽。	自主研发	国际先进	量产
3	LPDDR4X 设计技术	1、16 倍数据预取技术，提升内存的整体效率和带宽； 2、片上纠错功能（ECC），从而提升系统的可靠性； 3、开发 DDP、QDP、6DP、8DP 等多种封装形式，满足客户不同应用场景需求； 4、温度补偿刷新技术，在不同温度使用不同刷新频率，从而降低刷新功耗； 5、低功耗电源管理系统，在芯片不同工作模式下提供不同的电源能力，从而降低待机模式下的功耗。	自主研发	国际先进	量产
4	LPDDR5/5X 设计技术	1、信道反馈均衡技术，提升高速内存接口的数据接收裕量； 2、电源电压随频率动态调整（DVFS）的技术，以进一步降低功耗； 3、更优化的算法及保护电路，提升系统的可靠性，降低 Row Hammer 的风险； 4、先进的封装工艺如 RDL 和后段金属，提高电源完整性； 5、Bank Group 设计，提升了数据访问的效率及带宽。	自主研发	国际先进	量产
5	DRAM 产品封装技术	1、多层芯片堆叠 PoP 封装技术； 2、实现内存芯片和闪存芯片容量灵活搭配的 uPoP 封装技术； 3、Flip Chip 半导体晶片倒装封装技术。	自主研发	国际先进	量产

序号	核心技术名称	产品技术特征及先进性表征	技术来源	技术先进程度	所处阶段
6	DRAM 模组设计技术	1、RDIMM/UDIMM/SODIMM 内存模组产品技术，广泛应用于服务器，台式机和笔记本电脑，为整个系统提供内存存储； 2、LPCAMM（低电压压接式内存模组）新型内存模组产品技术，应用于工作站和游戏类高性能笔记本电脑； 3、MRDIMM（多重存取内存模组）新型内存模组产品技术，实现双倍的数据传输速率。	自主研发	国际先进	量产

2、核心技术对主营业务的贡献情况

发行人自主研发并持续积累形成的核心技术广泛应用于公司各类主营业务产品及服务，发行人应用核心技术产生的收入及其占营业收入比重情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	6,127,537.21	2,392,875.14	906,314.37
营业收入	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
占营业收入的比例	99.15%	98.97%	99.74%

3、核心技术的保护情况

（1）知识产权保护

公司高度重视对核心技术的保护，为上述核心技术构建了较为完备的专利布局，建立了科学完善的知识产权管理体系，制定了知识产权全生命周期管理制度。依据相关制度及流程，公司由知识产权部统筹管理向国家知识产权局申请专利、集成电路布图设计等知识产权，并依据《知识产权奖励管理办法》之规定向专利发明人发放奖金，确保研发成果获得及时、有效的法律保护；如研发成果不适宜公开，经审议通过后可将其列为商业秘密保护。通过有效运行公司知识产权管理体系、贯彻落实知识产权相关制度规则，明晰了公司的知识产权权属，有力保护了公司的核心技术。

（2）保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属明确清晰，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，公司与其技术人员在劳动合同、保密协议等相关协议中约定相应职务发明和作品权属、保密及竞业条款，约定其对工作中的技术秘密、商业信息负有保密责任。对于核心技术人员的离职情况将约定相应的提前通知期和竞业限制期限，离职人

员在竞业限制期内不得设立、经营、参与任何与发行人竞争的实体，不得在该等实体工作或提供服务、咨询等工作。

（二）科研实力和成果情况

1、承担的重大科研项目

作为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业，公司在相关业务领域具有强大的科研实力和技术创新能力，并长期承担及参与各类重大科研项目。报告期内，公司参与了多项重大科研项目。

2、公司所获荣誉奖项情况

截至本招股说明书签署日，公司获得的重要荣誉情况如下：

序号	荣誉名称	级别	获得时间
1	第二十五届中国专利优秀奖	国家级	2025 年
2	第二十三届中国专利优秀奖	国家级	2022 年
3	国家知识产权优势企业	国家级	2022 年
4	动态随机存储器安徽省技术创新中心	省级	2020 年
5	安徽省计算存储器产业创新中心	省级	2020 年
6	2021 年安徽省智能工厂	省级	2021 年
7	第九届安徽省专利金奖	省级	2022 年
8	2023 年安徽省科技领军企业	省级	2024 年
9	2023 年皖美品牌示范企业	省级	2024 年
10	第十一届安徽省专利金奖	省级	2024 年
11	安徽省商标品牌示范企业	省级	2021 年、2024 年

（三）项目研发及进展情况

截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目及其进展情况如下：

序号	研发项目名称	研发目标	项目进展情况	技术来源	参与研发人员
1	第四代工艺技术平台及相关产品研发项目	基于第四代技术平台，开发容量更大、性能更高的 LPDDR4X 产品、DDR5 产品和 LPDDR5X 产品，以满足服务器、手机、个人电脑等市场需求	工艺改进研发和更大容量、更高性能的产品研发	自主研发	发行人研发团队
2	第五代工艺技术平台及相关产品研发项目	采用进一步优化的多重曝光技术，进一步提升存储密度和阵列性能	研发阶段	自主研发	发行人研发团队

序号	研发项目名称	研发目标	项目进展情况	技术来源	参与研发人员
3	预研项目及其他	建立未来的 DRAM 技术平台并开发面向未来市场应用的相关产品及技术，能够基于技术平台设计满足行业 JEDEC 标准的更高密度 LPDDR5X、LPDDR6、DDR5 等产品，实现更高密度、更高容量、更高速度、更低功耗，满足服务器、移动设备和个人电脑等市场内存需求	研发阶段	自主研发	发行人研发团队

（四）合作研发情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在正在从事的对生产经营具有重要影响的合作研发项目。

（五）研发投入情况

公司始终鼓励创新，高度重视技术的持续研发。报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	959,325.46	634,129.13	467,047.07
营业收入	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
占营业收入的比例	15.52%	26.23%	51.40%

（六）核心技术人员及研发人员情况

1、研发部门组织架构

公司负责产品与技术研究的部门主要包括产品设计中心（PDC）、技术研究和开发中心（TD）。PDC 主要负责公司的产品研发工作，包括产品技术研发、产品设计、产品开发与应用。TD 负责公司的技术研发工作，主要职责是针对各代技术进行制程技术开发整合，开展前沿技术研究，形成技术实施初步方案等。

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员的简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员基本情况”，公司核心技术人员取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项情况、对公司研发的具体贡献如下：

（1）曹堪宇

曹堪宇先生，毕业于清华大学应用物理系，获美国加州大学伯克利分校博士学位，拥有 20 余年半导体行业经验，是中国 DRAM 产业的重要推动者。2017 年加入长鑫科技以来，曹堪宇先生主导制定了公司研发战略和技术路线图，带领团队成功开发第三代和第四代自主工艺技术平台，实现 DDR4/LPDDR4X、DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 存储芯片从设计到量产的完整突破，填补了国内相关产品和技术的空白。作为公司技术带头人，曹堪宇先生推动器件模型、电路设计、产品测试等全流程研发工作，完成 DRAM 产品技术开发及量产应用。曹堪宇先生拥有多项授权发明专利，发表多篇学术论文，是国家科技部、工信部专家库成员，2023 年获评首届“国家卓越工程师”称号。在曹堪宇先生的领导下，公司构建了完整的技术创新体系，为中国存储芯片产业实现技术自主化和市场国际化做出重要贡献，更标志着中国企业在全球 DRAM 芯片领域实现了从技术跟随到自主创新的关键跨越。

（2）李红文

李红文先生，毕业于北京航空航天大学自动控制专业。李红文先生在公司组建了本土设计团队，搭建了公司整体设计流程，配合测试部门建立了 DRAM 的 DFT 设计雏形。李红文先生和制程研发团队合作，创建了公司全自主的制程开发套件，推动第一颗测试芯片在公司第一代工艺技术平台流片与量产。2020 年以来，李红文先生带领产品开发团队和工艺开发部门紧密合作，实现测试芯片在第三代工艺技术平台的流片、产品工程送样、量产等工作。随后，李红文先生持续带领产品开发团队研发大容量高速率 DDR4、DDR5、LPDDR4X 及 LPDDR5/5X 产品。在公司工作期间，李红文先生作为发明人参与公司大量已授权发明专利的技术研发工作，并作为项目负责人主导多个省部级重大科研项目。

（3）TAN TECK HONG（陈德鸿）

TAN TECK HONG（陈德鸿）先生，毕业于新加坡国立大学机械工程系，拥有南洋理工大学工商管理硕士学位。TAN TECK HONG（陈德鸿）先生在担任公司晶圆厂厂长和公司运营副总裁期间，带领量产团队完成第一代和第三代工艺技术平台产品的量产工作。在第四代工艺技术平台，与产品研发团队合作进行 DDR5 和 LPDDR4X 产品的工艺改进，攻克工艺技术平台升级的技术难点，实现量产良率的提升和产能的快速爬坡。

此外，TAN TECK HONG（陈德鸿）先生推动完成新厂产能建设及智能工厂雏形建设，搭建了公司工厂自主可持续运营流程与标准化体系。

（4）王丹

王丹女士，毕业于上海交通大学，拥有微电子学博士学位。王丹女士在公司组建了本土的首个 DRAM 核心器件研发团队，带领团队参与并完成了第三代/第四代工艺技术平台的开发，实现了中国大陆 DRAM 从无到有的突破，并以项目总负责人的身份参与第五代工艺技术平台研发。王丹女士作为发明人参与公司多项已授权发明专利的技术研发工作，发表多篇半导体器件及工艺研发相关论文，并参与多项国家及省部级重点科研项目。

（5）唐衍哲

唐衍哲女士，毕业于浙江大学信息与电子工程学系，拥有微电子学与固体电子学博士学位。唐衍哲女士参与了公司第三代、第四代、第五代工艺技术平台及相关产品研发项目，是 DDR 系列产品的设计负责人，同时也是前沿研究项目的设计负责人。唐衍哲女士作为发明人参与公司多项已授权专利的技术研发工作，作为项目负责人参与国家级重大科研项目，并发表多篇技术论文。唐衍哲女士曾获得全国发明专利金奖、上海市科技进步二等奖等荣誉。

3、研发人员情况

报告期各期末，公司研发人员数量及占公司员工总数的比例情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
员工总数（人）	19,298	13,858	9,605
研发人员人数（人）	6,259	4,143	2,891
研发人员占总员工人数比例	32.43%	29.90%	30.10%

4、公司对核心技术人员及研发人员实施的约束激励措施

公司高度重视对研发人才、核心技术人才的长期激励，通过目标管理和考核机制、市场化的薪酬机制及股权长期激励机制等，促进研发与技术团队骨干成员的稳定，并激励其不断进取、持续创新。相关约束激励措施主要包含如下几方面内容：

（1）目标管理和考核机制

公司建立了完善的绩效管理体系，依据公司年度战略规划制订年度目标计划并将组织业绩目标层层落实至个人，确立员工绩效标准与个人发展计划，定期推进研发人员的业绩评价管理与沟通，从而将研发人员及技术人员绩效考核结果与业绩激励紧密挂钩，促进公司组织业绩目标的达成。

（2）市场化薪酬机制

公司对标行业建立了全面合规的薪酬福利体系，为研发人员特别是核心技术人员提供良好的薪酬与福利、全面完善的职业发展及晋升机会，不断促进核心技术人才的吸引与保留。

（3）研发骨干的培养和高速发展

公司定期对研发和技术团队员工进行人才盘点，重点关注和培养关键岗位的优秀员工，并给予更多的发展机会，促进其长期稳定在公司发挥关键作用。

（4）研发项目管理和激励机制

公司针对研发人才专门设立了研发创新项目、技术发展项目及专利相关的奖励机制，给予技术研发人员目标奖励等，鼓励各类技术与管理创新。

（5）股权长期激励机制

公司通过开展员工股权激励的方式，对核心技术人员和关键岗位人员等进行了股权激励，促进员工与公司共同成长，增强了核心技术人员的稳定性及其与公司发展目标的一致性，帮助企业实现稳定发展的长期目标。

（6）其他约束与竞业措施

公司已与核心技术人员签订《劳动合同》《保密协议》和《竞业禁止协议》，约定了竞业禁止和保守技术秘密的义务，对涉及技术等影响公司重大利益的事项设置了相应的保密措施进行管理，有效防范技术泄密及人才流失风险。

（七）技术创新机制、技术储备及技术创新的安排

1、技术创新机制及安排

公司致力于增强 DRAM 领域的综合竞争实力，高度重视技术创新工作，通过吸纳半导体产业科研人才、建立长效激励机制，从整体上提升自身技术实力。公司实施的技

术创新机制及安排包括以下方面：

（1）科研团队建设及选拔机制

公司高度重视人才选拔体系的建设，顺应公司发展需求，制定相应研发人才战略，利用各种招聘渠道吸引人才竞聘，并采用灵活市场化招聘方式引进高端人才。此外，公司通过培训机制、带教辅导、行业交流等一系列的培养机制吸引并留住高素质研发人才，以核心技术人才带动培养一批创新研发团队。

（2）持续加大研发投入力度

公司在技术研发上多头并进，充分整合和共享研发资源，提升技术研发和产品开发的效率，为技术创新注入源源不断的动力；同时战略性布局前瞻技术，持续推进新一代制程工艺提升及多元化产品开发，加速对国际领先技术的追赶。

（3）建立公平、有效的激励机制

公司针对核心技术人员订立了明确的年度绩效指标及年度考核，依据考核结果进行调薪及奖金发放。同时，公司通过设置多种荣誉奖项、股权激励等方式吸引、留住各类研发与技术人才，充分激发技术团队的创新能力。

2、技术储备

为了进一步提高产品性能、降低成本和丰富产品线，公司在 DRAM 工艺技术（如新架构、新材料、新工艺、特色工艺等），以及新型产品应用（如存内计算、近存计算、CXL 等）方向积极开展技术探索和布局，致力于增强公司整体技术实力，提高产品竞争力与市场占有率。

九、发行人安全生产及环境保护情况

公司重视环境保护工作，严格遵守国家、地区、行业的各项法律法规，在安全、应急、卫生、环保、消防等方面严格执行各类合法合规要求。公司生产经营符合国家和地方环保要求，正在运营的项目均已履行环评手续并取得了环评批复，环保设施运行正常，经处理后的污染物排放能够达到环保要求。

发行人不属于重污染行业企业，发行人生产过程中涉及的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声等，上述污染物经过分类处理后达标排放或规范转移，具体情况如下：

污染物分类	主要污染物	处理情况
废水	一般酸碱废水、含氟废水及含氨废水等废水	生产废水分流汇集到公司污水站集中进行处理，达到市政污水处理厂接管处理标准后与生活污水一起排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。
废气	酸性废气、碱性废气、有机废气等废气	(1)酸性废气处理系统采用碱液喷淋方式对酸性废气进行处理，或通过通风橱管道收集并通过二级活性炭处理； (2)碱性废气处理系统采用酸液喷淋方式对碱性废气进行处理； (3)有机废气处理系统采用沸石浓缩转轮焚烧系统对有机废气进行处理，或通过通风橱管道收集并通过二级活性炭处理； (4)工艺尾气处理系统采用“干式吸附”源头处理装置和“燃烧+水洗”式源头处理装置对工艺尾气进行处理； (5)锅炉烟气采用低氮燃烧器进行处理。
固体废物	危险废物（如污泥、废酸、废碱等）、一般固废（如一般废包装材料、金属边角料等）	(1)对于危险废物，公司设置专门的危废仓库收集存放，并按照规范的申报审批流程委托第三方有资质的单位进行转移处置； (2)对于一般固废，公司分类整理后外售综合利用或交由有资质单位进行外售综合利用或转移处置。
噪声	厂界噪声	采用减振台、厂房隔声等措施。

发行人主要废水处理设施包括含氨废水处理系统、含氟废水处理系统及有机废水处理系统等；主要废气处理设施包括酸性废气处理系统、碱性废气处理系统及有机废气处理系统等。报告期内，发行人环保设施运行良好，不存在因违反环境保护相关法律法规而被相关主管部门处以重大行政处罚的情形。公司生产经营符合国家和地方环保要求。

十、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有境外子公司，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况”。

境外销售情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“4、按地区分布划分的主营业务收入”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据及有关说明反映了发行人报告期内经审计财务报表及附注的主要内容。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自德勤出具的标准无保留意见的《审计报告》（德师报（审）字（26）第 S00141 号），或根据其中相关数据计算得出，并按合并口径披露。

公司提醒投资者，除阅读本章节内容外，需阅读财务报告、审计报告全文以获取完整财务信息。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	51,990,220,162.31	42,698,683,658.53	31,373,547,153.52
交易性金融资产	20,638,349,907.95	-	-
衍生金融资产	707,905,137.60	834,762.49	-
应收账款	1,523,740,591.27	1,845,888,030.46	398,716,292.54
预付款项	93,086,203.11	109,977,944.68	161,816,978.57
其他应收款	170,527,966.70	144,174,207.36	786,769,498.24
存货	28,567,686,719.81	18,549,529,584.42	10,736,177,312.42
其他流动资产	7,294,364,913.46	4,665,021,279.29	3,992,744,875.31
流动资产合计	110,985,881,602.21	68,014,109,467.23	47,449,772,110.60
非流动资产：			
长期股权投资	1,519,540,603.53	299,855,528.29	-
其他权益工具投资	466,412,500.00	276,077,695.95	136,000,000.00
其他非流动金融资产	2,398,313,215.65	1,079,231,374.49	202,721,114.38
固定资产	183,023,987,914.04	153,132,015,998.90	84,452,072,919.36
在建工程	31,789,621,728.55	41,208,688,675.40	51,502,550,126.59
使用权资产	123,356,368.09	120,544,761.06	151,747,533.71
无形资产	4,277,557,353.98	5,153,411,865.98	4,453,181,548.81
开发支出	-	-	150,000,004.23
长期待摊费用	1,005,695,586.29	873,132,421.51	320,234,098.30

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他非流动资产	1,194,555,343.84	1,441,763,237.71	3,938,053,334.54
非流动资产合计	225,799,040,613.97	203,584,721,559.29	145,306,560,679.92
资产总计	336,784,922,216.18	271,598,831,026.52	192,756,332,790.52
流动负债：			
短期借款	9,675,900,538.61	1,796,482,216.39	1,999,224,812.50
衍生金融负债	11,635,378.55	4,487,629.16	-
应付票据	2,014,972,432.80	1,616,667,821.01	667,493,744.77
应付账款	6,686,718,640.72	4,658,275,618.19	3,659,329,614.09
合同负债	447,177,358.00	141,228,750.32	116,555,583.06
应付职工薪酬	3,319,728,768.80	1,087,502,933.15	940,541,690.28
应交税费	783,143,006.15	97,844,653.00	73,035,551.70
其他应付款	11,935,379,864.21	16,489,607,089.47	14,879,586,121.49
一年内到期的非流动负债	17,967,700,611.68	31,298,700,879.53	9,317,029,174.61
流动负债合计	52,842,356,599.52	57,190,797,590.22	31,652,796,292.50
非流动负债：			
长期借款	118,825,342,726.71	95,993,810,675.95	89,823,176,319.76
租赁负债	63,634,453.02	70,458,030.61	102,050,615.07
长期应付款	975,254,166.66	1,525,642,598.95	1,820,855,825.21
递延收益	4,570,809,243.75	3,598,022,008.14	2,553,827,818.55
递延所得税负债	68,040,850.99	-	-
其他非流动负债	5,339,544,753.45	8,963,222,650.07	1,690,243,106.77
非流动负债合计	129,842,626,194.58	110,151,155,963.72	95,990,153,685.36
负债合计	182,684,982,794.10	167,341,953,553.94	127,642,949,977.86
所有者权益：			
股本/实收资本	60,192,797,469.00	57,770,942,240.00	53,633,000,000.00
资本公积	33,103,760,929.71	22,165,863,111.09	13,339,328,051.21
其他综合收益（损失）	107,566,919.94	4,857,254.80	135,675.24
累计亏损	-36,650,421,094.02	-38,522,001,027.93	-31,377,113,779.05
归属于母公司所有者权益合计	56,753,704,224.63	41,419,661,577.96	35,595,349,947.40
少数股东权益	97,346,235,197.45	62,837,215,894.62	29,518,032,865.26
所有者权益合计	154,099,939,422.08	104,256,877,472.58	65,113,382,812.66
负债和所有者权益总计	336,784,922,216.18	271,598,831,026.52	192,756,332,790.52

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	61,799,321,546.81	24,178,248,674.03	9,087,147,184.13
减：营业成本	36,465,406,329.12	22,829,536,568.89	9,262,565,994.86
税金及附加	350,588,987.17	182,762,378.24	106,594,760.86
销售费用	337,127,224.35	223,974,021.91	171,096,520.18
管理费用	6,630,922,259.23	2,358,314,546.15	2,274,677,309.15
研发费用	9,593,254,617.13	4,607,283,459.75	4,520,470,733.55
财务费用	2,953,752,257.00	2,204,283,035.62	1,934,447,982.46
其中：利息费用	2,989,197,168.22	2,669,163,046.07	2,340,681,058.31
利息收入	571,112,006.00	806,691,032.08	663,283,633.19
加：其他收益	2,690,659,755.13	1,800,301,838.28	1,642,025,997.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,122,701.90	104,943,374.82	-17,882,097.25
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	371,531,398.20	-177,617,694.63	-343,729.81
信用减值利得（损失）（损失以“-”号填列）	886,271.19	-8,673,598.99	-2,841,558.29
资产减值利得（损失）（损失以“-”号填列）	-754,660,087.34	-2,464,124,303.95	-11,779,279,013.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,144,796.36	4,319,115.37	26,249.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,720,709,304.45	-8,968,756,605.63	-19,341,000,268.85
加：营业外收入	13,206,029.53	15,838,646.49	130,361,061.88
减：营业外支出	32,797,552.76	95,739,169.18	12,460,088.75
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	7,701,117,781.22	-9,048,657,128.32	-19,223,099,295.72
减：所得税费用	556,880,633.23	2,343,308.87	1,787,036.03
四、净利润（亏损以“-”号填列）	7,144,237,147.99	-9,051,000,437.19	-19,224,886,331.75
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	7,144,237,147.99	-9,051,000,437.19	-19,224,886,331.75
2.终止经营净利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,874,859,379.01	-7,144,887,248.88	-16,339,777,193.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,269,377,768.98	-1,906,113,188.31	-2,885,109,138.39

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
五、其他综合收益的税后净额	102,709,665.14	4,721,579.56	114,030.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,709,665.14	4,721,579.56	114,030.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	104,231,679.05	4,077,695.95	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	104,231,679.05	4,077,695.95	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,522,013.91	643,883.61	114,030.22
1. 外币财务报表折算差额	-1,522,013.91	643,883.61	114,030.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	7,246,946,813.13	-9,046,278,857.63	-19,224,772,301.53
归属于母公司股东的综合收益总额	1,977,569,044.15	-7,140,165,669.32	-16,339,663,163.14
归属于少数股东的综合收益总额	5,269,377,768.98	-1,906,113,188.31	-2,885,109,138.39
七、每股收益			
基本每股收益	0.03	-0.13	-0.30
稀释每股收益	0.03	-0.13	-0.30

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	65,606,061,705.44	23,710,372,721.65	8,995,888,453.53
收到的税费返还	4,286,411,188.71	4,761,786,437.22	3,556,014,068.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,164,050,697.92	5,627,837,653.42	2,850,264,925.45
经营活动现金流入小计	74,056,523,592.07	34,099,996,812.29	15,402,167,447.91
购买商品、接受劳务支付的现金	26,814,164,253.96	21,808,406,978.95	16,221,740,270.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,744,246,203.29	3,937,308,848.78	4,129,100,358.87
支付的各项税费	329,336,180.99	187,030,449.13	107,876,542.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,648,963,694.01	1,269,792,002.45	2,215,071,005.69
经营活动现金流出小计	37,536,710,332.25	27,202,538,279.31	22,673,788,177.22
经营活动产生的现金流量净额	36,519,813,259.82	6,897,458,532.98	-7,271,620,729.31

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	1,336,350.90	-	-
取得投资收益收到的现金	192,232,944.85	118,737,846.53	100,423,077.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,301,676.60	15,846,352.83	10,213,128.88
收到其他与投资活动有关的现金	101,213,708,147.04	-	90,480,879.69
投资活动现金流入小计	101,442,579,119.39	134,584,199.36	201,117,086.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,739,203,349.94	71,229,681,134.80	43,658,339,783.92
投资支付的现金	2,434,495,578.87	1,320,150,000.00	336,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	136,091,624,145.55	-	208,305,174.69
投资活动现金流出小计	188,265,323,074.36	72,549,831,134.80	44,202,644,958.61
投资活动产生的现金流量净额	-86,822,743,954.97	-72,415,246,935.44	-44,001,527,872.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	31,794,849,988.02	45,867,242,623.03	18,039,315,889.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,938,843,637.34	35,067,242,623.03	17,902,596,939.63
取得借款收到的现金	75,507,087,394.42	38,061,791,818.31	39,989,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,656,408,354.71	7,092,004,455.23	3,702,995,544.77
筹资活动现金流入小计	109,958,345,737.15	91,021,038,896.57	61,731,861,434.56
偿还债务支付的现金	60,229,889,311.49	10,301,645,351.81	8,113,203,078.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,076,928,796.85	3,203,515,309.48	2,706,270,252.80
支付其他与筹资活动有关的现金	530,851,400.24	301,696,180.46	105,538,189.07
筹资活动现金流出小计	63,837,669,508.58	13,806,856,841.75	10,925,011,520.08
筹资活动产生的现金流量净额	46,120,676,228.57	77,214,182,054.82	50,806,849,914.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528,153,326.85	-300,786,652.69	-202,454,077.83
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	-4,710,407,793.43	11,395,606,999.67	-668,752,765.26
加：期初/年初现金及现金等价物余额	42,508,218,629.66	31,112,611,629.99	31,781,364,395.25
六、期末/年末现金及现金等价物余额	37,797,810,836.23	42,508,218,629.66	31,112,611,629.99

二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项

（一）审计意见

德勤审计了发行人的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度、2024 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

德勤认为,发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了发行人 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度、2024 年度及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

（二）关键审计事项

1、收入确认

（1）事项描述

发行人的营业收入主要来自于 DRAM 产品的销售,主要 DRAM 产品包括 DDR 系列和 LPDDR 系列。于 2025 年度、2024 年度及 2023 年度,发行人主要 DRAM 产品销售收入分别为 6,023,483.06 万元、2,297,223.19 万元及 858,323.94 万元。由于报告期内发行人销售收入增长迅速,营业收入系其关键业绩指标之一,因此德勤将 DRAM 产品销售收入发生作为关键审计事项。

（2）审计应对

针对上述 DRAM 产品销售收入,德勤执行的主要审计程序包括:

1) 了解发行人与收入确认相关的关键内部控制,评价相关关键内部控制的设计和

2) 查阅重大的销售合同的条款,评价发行人的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

3) 对报告期内的产品销售收入以及毛利情况实施分析程序,对报告期内销售收入以及毛利的波动情况,询问管理层了解变动原因并评估合理性;

4) 按发行人的客户选取样本来对其销售额、对应的合同负债及应收账款余额实施函证程序;

5) 从报告期内记录的销售收入交易中选取样本, 查看销售订单、发票、出库单、签收单以及报关单(如适用)等支持文件以测试销售收入的真实性;

6) 对发行人的主要客户进行背景调查、实地走访或视频电话访谈。

2、研发支出资本化

(1) 事项描述

于 2025 年度、2024 年度及 2023 年度, 发行人在合并财务报表中满足资本化条件的研发支出分别为人民币 0 万元、173,400.78 万元及 15,000.00 万元。由于报告期内研发支出金额重大, 确定研发支出是否满足资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计, 因此德勤将研发支出资本化确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对上述研发支出资本化, 德勤执行的主要审计程序包括:

1) 了解发行人与研发支出相关的关键内部控制, 评价相关关键内部控制的设计及执行;

2) 检查管理层批准的项目开发预算, 通过收集市场相关信息, 评估管理层的开发项目预期经济利益分析的合理性;

3) 综合发行人的资金及技术储备, 了解管理层对于开发项目及后续生产提供的资金及技术资源的支持计划;

4) 检查研发项目的立项文件、技术可行性论证文件、相关产品初步研制完成测试报告及管理层评审记录等文件, 检查资本化项目是否已经进入开发阶段;

5) 抽样检查研发支出的相关支持性文件, 核对发生的研发支出的成本费用归集范围是否恰当, 研发支出的计量是否真实、准确, 是否与相关研发活动切实相关。

3、存货跌价准备

(1) 事项描述

当存在客观证据表明存货存在减值时, 发行人管理层根据存货的可变现净值低于成

本的差额计提存货跌价准备。于 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表中列报的除房地产开发产品/成本外的存货账面余额分别为人民币 2,924,797.55 万元、2,062,355.75 万元及 1,361,385.74 万元，存货跌价准备分别为人民币 78,630.76 万元、257,386.40 万元及 344,429.77 万元。由于存货金额重大，且确定存货的可变现净值涉及管理层的重大会计估计，因此德勤将除房地产开发产品/成本外存货跌价准备认定为关键审计事项。

（2）审计应对

德勤针对存货跌价准备的主要审计程序包括：

1) 了解发行人除房地产开发产品/成本外存货跌价准备相关的关键内部控制，评价相关关键内部控制的设计及执行；

2) 获取发行人除房地产开发产品/成本外的存货跌价准备计算表并检查其计算过程，复核管理层计提存货跌价准备的方法，评估其进行测试时所使用相关估计的合理性，包括存货预计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金等；将发行人管理层估计的售价与近期的实际售价、市场信息等进行比较，将管理层估计的成本、销售费用以及相关税费与期后或历史实际数据进行比较；

3) 结合存货监盘结果，检查发行人期末存货中是否存在库龄较长、产品呆滞或毁损等情形，分析存货跌价准备计提是否充分合理；

4) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

项目	重要性标准
重要的在建工程	报告期内任意期末单个项目余额占公司期末总资产 5%以上
重要的非全资子公司	报告期内任意期末非全资子公司总资产占公司期末总资产 5%以上
账龄超过一年的重要应付账款	占应付账款账面价值比例 10%且金额人民币 5 亿元以上
账龄超过一年的重要其他应付款	占其他应付账款账面价值比例 10%且金额人民币 5 亿元以上
重要的联营/合营公司	单个投资账面价值占本集团期末总资产 0.5%以上

四、财务报表编制基础和财务报表合并范围

（一）财务报表编制基础

公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）。此外，公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

（二）财务报表的合并范围及变化情况

1、合并财务报表范围

报告期内，除公司 A、公司 B 和公司 C 以外，公司纳入合并范围的子公司如下：

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			取得方式
		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
1	长鑫存储	是	是	是	同一控制下企业合并
2	长鑫香港	是	是	是	同一控制下企业合并
3	长鑫科服	是	是	是	设立
4	久芯科技	是	是	是	设立
5	公司 G	是	是	是	同一控制下企业合并
6	长鑫新桥	是	是	是	设立
7	长鑫西安	是	是	是	设立
8	长鑫日本	是	是	是	非同一控制下企业合并
9	长鑫集电	是	是	是	非同一控制下企业合并
10	长鑫集电半导体	是	是	是	设立
11	长鑫集电科技	是	是	是	设立
12	长鑫芯聚	是	是	是	设立
13	启航鑫睿	是	是	是	设立
14	长鑫芯元	是	是	是	设立
15	长鑫科技合肥	是	是	是	设立
16	长鑫产品合肥	是	是	是	设立
17	长鑫闵科	是	是	是	设立
18	安徽新一代	是	是	是	设立
19	启航创芯	是	是	是	设立

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			取得方式
		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
20	长鑫芯达	是	是	是	设立
21	长鑫芯安	是	是	是	设立
22	长鑫深芯	是	是	是	设立
23	长鑫芯瑞	是	是	否	设立
24	公司 E	是	是	否	设立
25	长鑫汇芯	是	否	否	设立
26	长鑫汇芯北京	是	否	否	设立
27	公司 I	是	否	否	设立
28	公司 J	是	否	否	设立
29	公司 K	是	否	否	设立
30	公司 L	是	否	否	设立

2、报告期内合并报表范围的变化情况

(1) 2023 年

长鑫闵科于 2023 年 1 月成立，安徽新一代于 2023 年 4 月成立，启航创芯于 2023 年 7 月成立，长鑫芯达于 2023 年 9 月成立，长鑫芯安于 2023 年 9 月成立，长鑫深芯于 2023 年 11 月成立，公司自 2023 年度起将上述公司纳入合并范围。

(2) 2024 年

长鑫芯瑞于 2024 年 3 月成立，公司 E 于 2024 年 5 月成立，公司 A 和公司 B 于 2024 年成立，公司自 2024 年度起将上述公司纳入合并范围。

(3) 2025 年

长鑫汇芯于 2025 年 2 月成立，长鑫汇芯北京于 2025 年 3 月成立，公司 I 于 2025 年 8 月成立，公司 J 于 2025 年 9 月成立，公司 K 于 2025 年 10 月成立，公司 L 于 2025 年 11 月成立，公司自 2025 年度起将上述公司纳入合并范围，公司 C 自 2025 年度起纳入公司合并范围。

五、重要会计政策和会计估计

公司报告期内采用的具体各项会计政策和会计估计参见德勤出具的审计报告后附

的财务报表附注之“（三）重要会计政策及会计估计”，本招股说明书只列示公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计。

（一）收入

1、收入确认的一般原则

公司的收入来源于如下业务类型：DRAM 产品及其他产品销售和技术服务，按照销售模式划分包括直销及经销。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

2、收入确认的具体方法

公司 DRAM 产品及其他产品销售和技术服务均属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入，具体会计政策如下：

（1）DRAM 产品及其他产品销售

对于向客户销售 DRAM 产品及其他产品，控制权的转移时点依据约定的交货方式而定，公司根据合同或订单约定的交货条件采用将商品发至客户指定交货地点的方式时，以客户或其委托第三方签收时作为收入确认时点；采用以客户自提方式时，公司以客户或其委托的承运人提货签收时作为收入确认时点。

（2）技术服务收入

对于向客户提供的技术服务收入，根据合同约定公司在相关技术服务成果被客户确认验收时交付，即客户取得了相关服务的控制权，因此公司于该时点确认技术服务收入。

交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。单独售价，是指公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

（二）合同成本

1、取得合同的成本

公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2、履行合同的成本

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- （2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值损失

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三）存货

1、存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）存货类别

公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品及房地产开发产品/成本等。存货按成本进行初始计量，除在建房地产开发产品外，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。在建房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

（3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（四）固定资产

1、确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

项目	折旧方法	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5	2.71-9.50
机器设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

报告期内，公司固定资产折旧年限与可比公司基本一致，具体如下：

公司简称	固定资产类别	折旧年限（年）
三星电子	房屋及建筑物	15, 30
	机械设备	5
	其他	5
SK 海力士	建筑物	10-50
	构筑物	10-20
	机械设备	5-15
	车辆	5-10
	其他	5-10
美光科技	房屋及建筑物	10-30
	生产设备	7
	其他设备	不超过 7 年
	软件	3-5
南亚科技	房屋及建筑	25

公司简称	固定资产类别	折旧年限（年）
	机器设备	5-16
	其他设备	3-15
台积电	土地改良	20
	建筑物	10-20
	机器设备	5
	办公设备	5
中芯国际	房屋及建筑物	25
	机器设备	5-10
	办公设备	3-5
华润微	房屋建筑物	25
	机器设备	8
	运输工具	5
	电子设备	3-5
	信息系统	8
	办公设备及家具	5
发行人	房屋及建筑物	10-35
	机器设备	5-8
	运输设备	5
	办公及其他设备	3

注：资料来源为可比上市公司定期报告。

3、其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（五）在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。各类在建工程结转为固定资产

的标准和时点如下：

项目	结转为固定资产的标准及时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态
需要调试的机器设备	达到设计要求并完成安装调试或完成试生产
其他设备	设备经过资产管理人员或使用人员验收

（六）无形资产

1、使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产包括土地使用权、软件、专利权和非专利技术。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的预计净残值为零，摊销方法和使用寿命如下：

项目	摊销方法	使用寿命确认依据	使用寿命（年）
土地使用权	直线法	土地使用权期限	50
软件	直线法	软件使用权期限与预计使用期限孰短	2-10
专利权	直线法	专利权期限与预计使用期限孰短	5
非专利技术	直线法	预计使用期限	5

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见本节之“五、重要会计政策和会计估计”之“（七）长期资产减值”。

2、研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出的归集范围包括研发职工薪酬、研发材料费、测试服务费、折旧及摊销、股份支付及其他费用等。

产品初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；产品初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

(七) 长期资产减值

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产及其他非流动资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产和符合资本化条件的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(八) 股份支付

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。公司授予职工的权益工具在授予日公允价值的确定方法为参考授予日6个月内投资者入股单价确定或者以收益法评估确定。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

公司可行权权益工具数量的确定依据为按各考核日的绩效条件及各解锁期的离职率估计确定。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（九）金融工具

公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1、金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款和其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

初始确认时，公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明公司持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售；相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2、金融工具减值

公司对以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额

计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- 4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；
- 5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 8) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30 天的，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

基于公司内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括公司在内的债权人（不考虑公司取得的任何担保），则公司认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过（含）90日，则公司推定该金融工具已发生违约。

（3）预期信用损失的确定

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 2) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金

融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

3、金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(1) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利（如果公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上公司承担的义务（如果公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利（如果公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上公司承担的义务（如果公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

4、金融负债和权益工具的分类

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

（1）金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明公司承担该金融负债的目的是交易性的：承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该指定能够消除或显著减少会计错配；根据公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

(2) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

5、衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- （1）嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
- （2）与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- （3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

6、金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（十）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按交易发生当月月初的市场汇率中间价计算确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

（十一）所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十二）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

2、初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）按权益法核算的长期股权投资

对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4、长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（十三）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方

取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的资本/股本溢价，资本/股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（十五）重大会计判断和估计说明

公司在运用会计政策中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与公司的估计存在差异。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

1、运用会计政策过程中所做的重要判断

对于开发支出，公司在运用会计政策过程中作出以下重要判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响：

发行人将研发项目分为研究阶段和开发阶段，判断是否进入开发阶段是基于对研发项目相关生产工艺的验证和评估结果。发行人在大规模生产前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足开发阶段资本化条件的，予以资本化。不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。是否满足开发阶段资本化条件判断依据包括：（1）生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准生产工艺开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产，以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

2、会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

（1）存货跌价准备

如本节“五、重要会计政策和会计估计”之“（三）存货”中所述，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于原材料及在产品，以对应产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为确定可变现净值的依据；对于产成品，以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额作为确定可变现净值的依据。公司需要对存货未来销售数量以及估计售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费作出估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

公司的存货跌价准备的具体情况详见本节“十、资产质量分析”之“（一）资产结构分析”之“2、流动资产分析”之“（7）存货”。

（2）固定资产预计可使用寿命和预计净残值

如本节“五、重要会计政策和会计估计”之“（四）固定资产”所述，公司至少于

每年年度终了对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。对使用寿命和预计净残值的估计是根据对类似性质和功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新的原因发生重大改变。当固定资产预计使用寿命和预计净残值与先前估计不同时，公司将作会计估计变更。申报期内，公司管理层未发现固定资产使用寿命缩短或延长及需要改变预计净残值的情况。

（3）长期资产减值

公司管理层定期检查长期资产是否存在减值迹象，并在长期资产账面价值低于其可收回金额时确认资产减值损失。公司考虑长期资产减值的迹象包括但不限于业务或生产业绩显著低于预期、明显的负面行业或经济趋势，以及资产使用的重大改变或重大改变计划等。长期资产主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、使用权资产及其他非流动资产等。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

预计未来现金流量现值时，管理层需估计该项资产或资产组的未来现金流量并确定其现值。如果重新估计的可收回金额低于当前估计，该差异将会影响该资产的账面价值。

（十六）重要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司无对财务报表有重大影响的会计政策变更，无重要会计估计变更。

六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）的相关规定，公司编制了最近三年的非经常性损益明细表，并由德勤出具《关于长鑫科技集团股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》（德师报（函）字（26）第Q00163号）。报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

非经常性损益明细	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,479.11	-8,799.81	-678.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	33,478.35	-5,965.20	-1,822.58
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-86,331.22	-	-49,301.82
其他一次性确认的股份支付费用	-387,370.03	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734.44	1,241.67	12,470.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,638.21	133,879.50	125,859.44
小计	-256,329.36	120,356.16	86,527.76
减：非经常性损益的所得税影响数	17,518.47	-	-
减：归属少数股东非经常性损益的影响数	70,254.86	47,841.65	45,305.09
归属于母公司股东的非经常性损益影响净额	-344,102.68	72,514.51	41,222.66
归属于母公司股东的净利润	187,485.94	-714,488.72	-1,633,977.72
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	531,588.62	-787,003.23	-1,675,200.38

报告期各期，公司归属于母公司股东的非经常性损益影响净额分别为 41,222.66 万元、72,514.51 万元及-344,102.68 万元，主要包括一次性确认的股份支付费用及公允价值变动损益和投资收益等。2025 年，公司非经常性损益较 2024 年变动较大，主要由当年对部分符合条件的第二期员工持股计划激励对象取消服务期安排产生的加速行权和授予董事长股权激励带来的一次性确认股份支付费用增加，以及应付纳入合并范围的结结构化主体的其他持有人的款项、衍生金融工具产生的公允价值变动所致。

七、主要税种、税率和税收优惠

（一）适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%（征收率）、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育附加	实际缴纳的增值税	2%
消费税（日本）	应纳税增值额（销售额乘以适用税率扣除采购额乘以适用税率的余额计算）	10%

税种	计税依据	税率
房产税	从租计征部分按照租金收入的 12%计缴；从价计征部分按照房产原值一次减除 10%至 30%后余值的 1.2%计缴	12%、1.2%
印花税	买卖合同、承揽合同、建设工程合同、技术合同、借款合同、财产租赁合同等各类印花税计税合同、营业账簿及应税产权转移书据	0.03%、0.005%、0.1%、0.025%、0.05%
土地使用税	土地面积	3、5 元/平方米
企业所得税	应纳税所得额	详见下表所示企业所得税情况

报告期内，除公司 A、公司 B 及公司 C 以外，公司及所属子公司执行的企业所得税税率如下：

纳税主体	主要注册地/ 经营地	企业所得税税率		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
长鑫科技	安徽省合肥市	15%	15%	15%
长鑫存储	安徽省合肥市	15%	15%	15%
长鑫香港	中国香港	8.25%及 16.5%	8.25%及 16.5%	8.25%及 16.5%
长鑫科服	安徽省合肥市	25%	25%	25%
久芯科技	北京市	20%	20%	25%
公司 G	上海市	15%	15%	15%
长鑫新桥	安徽省合肥市	15%	25%	25%
长鑫西安	陕西省西安市	15%	20%	20%
长鑫日本	日本神奈川县	23.20%	23.20%	23.20%
长鑫集电	北京市	15%	15%	15%
长鑫集电半导体	北京市	20%	20%	20%
长鑫集电科技	北京市	20%	20%	20%
长鑫芯聚	安徽省合肥市	25%	25%	25%
启航鑫睿	安徽省合肥市	25%	20%	20%
长鑫芯元	安徽省合肥市	20%	20%	20%
长鑫科技合肥	安徽省合肥市	25%	20%	20%
长鑫产品合肥	安徽省合肥市	15%	25%	25%
长鑫闵科	上海市	15%	25%	25%
安徽新一代	安徽省合肥市	不适用	不适用	不适用
启航创芯	安徽省合肥市	不适用	不适用	不适用
长鑫芯达	安徽省合肥市	20%	20%	20%
长鑫芯安	安徽省合肥市	不适用	不适用	不适用

纳税主体	主要注册地/ 经营地	企业所得税税率		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
长鑫深芯	广东省深圳市	20%	20%	20%
长鑫芯瑞	北京市	25%	20%	不适用
公司 E	上海市	25%	25%	不适用
长鑫汇芯	安徽省合肥市	25%	不适用	不适用
长鑫汇芯北京	北京市	25%	不适用	不适用
公司 I	江苏省苏州市	20%	不适用	不适用
公司 J	新加坡	17%	不适用	不适用
公司 K	安徽省合肥市	20%	不适用	不适用
公司 L	安徽省合肥市	不适用	不适用	不适用

注 1: 长鑫香港按照中国香港地区利得税率, 中国香港地区执行两级制利得税税率, 对于不超过(含)港币 2,000,000 元的税前利润适用 8.25% 的税率, 对于税前利润超过港币 2,000,000 元以上的部分适用 16.5% 的税率。

注 2: 长鑫日本按照日本的税收政策缴纳法人税, 适用法人税的标准税率, 按固定税率 23.2% 进行计征。

注 3: 安徽新一代、启航创芯、长鑫芯安和公司 L 为合伙企业, 不缴纳企业所得税。

(二) 税收优惠政策及依据

1、高新技术企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号), 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。企业获得高新技术企业资格后, 自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠。发行人在报告期内获得高新技术企业资格情况如下:

长鑫科技于 2023 年 11 月取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合批准的“高新技术企业证书”, 有效期三年, 2023 年至 2025 年适用 15% 的企业所得税税率。

长鑫存储分别于 2021 年 11 月和 2024 年 12 月取得由安徽省科学技术厅、安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合批准的“高新技术企业证书”, 有效期均为三年, 2021 年至 2026 年适用 15% 的企业所得税税率。

公司 G 取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准的“高新技术企业证书”, 报告期内适用 15% 的企业所得税税率。

长鑫集电于 2023 年 10 月取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的“高新技术企业证书”，有效期三年，2023 年至 2025 年适用 15%的企业所得税税率。

长鑫新桥于 2025 年 12 月取得由安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，有效期三年，2025 年至 2027 年适用 15%的企业所得税税率。

长鑫闵科于 2025 年 12 月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准的“高新技术企业证书”，有效期三年，2025 年至 2027 年适用 15%的企业所得税税率。

长鑫西安于 2025 年 12 月取得由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，有效期三年，2025 年至 2027 年适用 15%的企业所得税税率。

长鑫产品合肥于 2025 年 12 月取得由安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，有效期三年，2025 年至 2027 年适用 15%的企业所得税税率。

2、集成电路行业所得税优惠政策

按照《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，自获利年度起计算，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过 10 年。

报告期内，发行人以及子公司长鑫存储、长鑫集电及长鑫新桥属于小于 28 纳米集成电路生产企业，符合上述政策规定。发行人以及子公司长鑫存储及长鑫集电因报告期内处于累计亏损状态，报告期内尚未享受上述的所得税优惠政策；长鑫新桥于 2025 年度已实现累计税务盈利，由于相关国家部委尚未完成 2025 年度享受税收优惠政策的集成电路企业清单的审批，2025 年尚未享受上述的所得税优惠政策。

3、小型微利企业所得税税收优惠政策

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定,对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

报告期内,长鑫芯元、长鑫集电半导体、长鑫集电科技、长鑫芯达和长鑫深芯报告期内均为小型微利企业。久芯科技 2024 年和 2025 年符合小型微利企业标准。长鑫西安、启航鑫睿和长鑫科技合肥 2023 年和 2024 年符合小型微利企业标准,2025 年不符合小型微利企业标准。长鑫芯瑞 2024 年符合小型微利企业标准,2025 年不符合小型微利企业标准。公司 I、公司 K 及公司 A 在 2025 年符合小型微利企业标准。

4、增值税加计抵减税收优惠政策

根据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税〔2023〕17 号)规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

发行人及长鑫存储、公司 G、长鑫集电、长鑫闵科、长鑫新桥和长鑫西安等下属子公司为符合条件的集成电路企业。其中,长鑫存储、公司 G、长鑫集电自 2023 年 1 月 1 日起,按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。发行人及长鑫闵科自 2024 年 1 月 1 日起,按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。长鑫新桥、长鑫西安自 2025 年 1 月 1 日起,按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

5、集成电路行业进口关税优惠政策

按照《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的

通知》（国发〔2020〕8号）及相关细则文件，集成电路线宽小于65纳米（含，下同）的存储器生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用，下同）原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，免征进口关税。发行人、长鑫存储、长鑫集电及长鑫新桥属于小于65纳米存储器生产企业，在报告期内根据实际进口情况享受上述优惠政策。

（三）税收政策及税收优惠变化的影响

报告期内，公司税收政策不存在重大变化，相关税收政策的变化不会对公司经营成果产生重大影响。

八、发行人的主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2025年12月31日/ 2025年度	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度
流动比率（倍）	2.10	1.19	1.50
速动比率（倍）	1.56	0.86	1.16
资产负债率（合并）	54.24%	61.61%	66.22%
资产负债率（母公司）	21.82%	10.26%	8.69%
利息保障倍数（倍）	3.43	-1.79	-6.18
应收账款周转率（次/年）	36.49	21.44	34.63
存货周转率（次/年）	1.44	1.29	0.78
息税折旧摊销前利润（万元）	3,777,677.64	984,453.98	-476,216.89
归属于母公司股东的净利润（万元）	187,485.94	-714,488.72	-1,633,977.72
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	531,588.62	-787,003.23	-1,675,200.38
研发投入占营业收入的比例	15.52%	26.23%	51.40%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.63	0.12	-0.14
每股净现金流量（元）	-0.08	0.20	-0.01
归属于母公司股东的每股净资产（元）	0.94	0.72	0.66

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=速动资产 / 流动负债=（流动资产-存货） / 流动负债
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额

- 6、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额
 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
 8、研发投入占营业收入的比例=（研发费用+资本化研发支出） / 营业收入
 9、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 加权平均股份数量
 10、每股净现金流量=现金流量净额 / 加权平均股份数量
 11、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产 / 期末调整后股份数量

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司报告期内净资产收益率和每股收益如下：

单位：元/股

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	3.83	0.03	0.03
	2024 年度	-17.54	-0.13	-0.13
	2023 年度	-38.28	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2025 年度	10.86	0.09	0.09
	2024 年度	-19.32	-0.14	-0.14
	2023 年度	-39.34	-0.31	-0.31

九、经营成果分析

报告期各期，公司主要经营成果指标情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
营业成本	3,646,540.63	2,282,953.66	926,256.60
营业利润	772,070.93	-896,875.66	-1,934,100.03
利润总额	770,111.78	-904,865.71	-1,922,309.93
净利润	714,423.71	-905,100.04	-1,922,488.63
归属于母公司股东的净利润	187,485.94	-714,488.72	-1,633,977.72
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	531,588.62	-787,003.23	-1,675,200.38

报告期各期，发行人的营业收入分别为 908,714.72 万元、2,417,824.87 万元及 6,179,932.15 万元，净利润分别为-1,922,488.63 万元、-905,100.04 万元及 714,423.71 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-1,675,200.38 万元、

-787,003.23 万元及 531,588.62 万元。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动

报告期各期，公司营业收入构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	6,127,537.21	99.15%	2,392,875.14	98.97%	906,314.37	99.74%
其他业务收入	52,394.95	0.85%	24,949.73	1.03%	2,400.35	0.26%
合计	6,179,932.15	100.00%	2,417,824.87	100.00%	908,714.72	100.00%

报告期各期，公司主营业务突出，主营业务收入占当期营业收入的比例分别为 99.74%、98.97%和 99.15%，其中最主要来自 DDR 和 LPDDR 系列产品销售收入。公司其他业务收入主要包括废弃物处置收入、向员工销售房产收入、咨询服务及手续费和租金收入等，占营业收入的比例较小。

报告期各期，公司主营业务收入分别为 906,314.37 万元、2,392,875.14 万元和 6,127,537.21 万元，2023 年至 2025 年复合增长率为 160.02%，呈高速增长趋势，主要原因如下：

（1）公司产能建设以及工艺迭代等带来公司产出及销量迅速增加

报告期内，为实现产能及市场份额的快速提升，公司始终处于产能扩建及释放阶段，产能的迅速爬坡带来产出及销量的增长是公司报告期内收入提升的最主要因素。同时，公司通过长期的技术投入和自主创新，陆续搭建了第一代、第三代、第四代并持续迭代的工艺技术平台，由此带来单片晶圆产出持续增加。

产能规模、工艺水平的快速提升为公司产品销量增长提供了可靠保障。报告期内，公司产品销量迅速增长，2023 年至 2025 年主要 DRAM 产品销量的年均复合增长率高达 83.98%，实现快速增长，总体呈供不应求的市场状态。

（2）DRAM 产品应用领域广泛，随着新兴领域的快速发展叠加中国市场的广阔前景，公司产品市场需求旺盛

DRAM 产品是现代存储器的重要组成部分，一方面，下游服务器、手机、个人电

脑等主流终端市场以及智能汽车、智能可穿戴设备等新兴终端市场的快速发展显著提升了对于 DRAM 的需求。另一方面，中国是全球主要的 DRAM 需求大国之一，三星电子、SK 海力士和美光科技三家国际厂商占据绝大部分市场份额，国内厂商发展前景广阔。DRAM 行业在 2023 年上半年经历深度下行周期后，于 2023 年下半年起快速回暖，2024 年产品市场价格整体回升。2025 年度，得益于下半年以来全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，价格呈现大幅上涨趋势。报告期内，公司抓住独特的行业机遇，通过持续研发投入及技术突破，产品得到市场的广泛认可，已成为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业。

（3）公司顺应市场及产品需求，持续进行产品结构优化，提升行业头部客户粘性及销售增量

报告期内，公司持续拓展与下游客户的深度合作，与下游服务器、手机和个人电脑的各类型厂商建立了长期稳定的合作关系，成功进入阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo 等行业头部客户的供应链，客户基础不断扩大。同时，公司持续优化产品结构，加快进行更高代际产品的开发和市场拓展，以不断满足下游客户多样化应用的需求。报告期内，公司 LPDDR5、DDR5 和 LPDDR5X 产品分别于 2023 年、2024 年和 2025 年量产，在中高端市场的渗透率快速提高。更多品类、更高代际的产品确保了公司能够持续满足市场及客户需求，增加客户粘性并带来新的业务增量。

2、按业务类别划分的主营业务收入

报告期各期，公司主营业务收入按业务类别划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	1,953,128.56	31.87%	317,397.33	13.26%	182,716.69	20.16%
LPDDR 系列	4,070,354.50	66.43%	1,979,825.86	82.74%	675,607.25	74.54%
其他产品及服务	104,054.15	1.70%	95,651.94	4.00%	47,990.43	5.30%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

报告期各期，公司主营业务收入分别为 906,314.37 万元、2,392,875.14 万元和 6,127,537.21 万元。公司主要 DRAM 产品包括 DDR 系列、LPDDR 系列产品，各期主要 DRAM 产品收入占主营业务收入比例分别为 94.70%、96.00%和 98.30%，是公司收

入的主要来源。

报告期各期，公司其他产品及服务销售收入占主营业务收入比例分别为 5.30%、4.00% 和 1.70%，主要为提供技术及研发服务、晶圆代工及配套光罩销售收入等。

报告期内，公司 LPDDR 系列产品销售占比较高，主要原因为 LPDDR 系列产品主要应用于智能手机和平板电脑等领域，公司在报告期内迅速拓展了相关领域的下游终端客户，客户对公司产品认可度较高，需求旺盛且增长迅速。2024 年，LPDDR 系列产品收入占比提升，主要由于公司 LPDDR5 产品于 2023 年开始量产，2024 年收入迅速增长，带动 LPDDR 系列产品销售占比提升。2024 年底，公司 DDR5 产品量产，并于 2025 年开始迅速放量，带动 DDR 系列产品的收入占比提升。

报告期各期，公司主要 DRAM 产品收入按应用领域划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
移动设备	3,638,080.86	60.40%	1,763,520.18	76.77%	554,640.43	64.62%
服务器	1,596,992.64	26.51%	192,676.09	8.39%	39,451.87	4.60%
个人电脑	233,014.30	3.87%	36,513.27	1.59%	44,308.51	5.16%
智能汽车	28,937.12	0.48%	17,645.37	0.77%	55.74	0.01%
其他	526,458.13	8.74%	286,868.28	12.49%	219,867.39	25.62%
合计	6,023,483.06	100.00%	2,297,223.19	100.00%	858,323.94	100.00%

报告期内，公司 DRAM 产品主要应用于移动设备、服务器及个人电脑领域，受益于数据中心等基础设施建设需求持续快速增长，公司把握行业发展趋势于 2024 年底推出 DDR5 等更新代际产品并快速实现客户导入，应用于服务器领域的 DRAM 产品收入实现快速增长，年均复合增长率高达 536.24%。报告期内，公司应用于人工智能算力服务器的 DRAM 产品收入占比仍旧较低，随着人工智能下游需求的持续增长和公司服务器领域产品的持续放量，来自相关领域的产品收入及占比有望持续上升。

3、主要产品价格及销量变化情况分析

报告期各期，公司主要 DRAM 产品的单位价格及销量（按容量）变动幅度情况具体如下：

产品类别	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
DDR 系列产品	单位价格	61.00%	54.72%	-46.61%
	销量（按容量）	282.22%	12.28%	132.05%
	营业收入	515.36%	73.71%	23.89%
LPDDR 系列产品	单位价格	24.46%	54.63%	-42.74%
	销量（按容量）	65.18%	89.51%	83.87%
	营业收入	105.59%	193.04%	5.29%

销量方面，报告期内，公司产能处于持续建设状态，DRAM 产品销量快速增长，DDR 系列和 LPDDR 系列的销量复合增长率分别高达 107.16%和 76.93%，均呈现快速上升趋势。

单价方面，DRAM 行业在 2023 年上半年深度下行，随着行业逐步回暖及公司产品结构优化，2024 年公司产品均价整体回升。2025 年，随着公司单价较高的 DDR5 和 LPDDR5X 产品快速放量及收入占比迅速提升，同时得益于 2025 年下半年以来全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配导致的 DRAM 供给紧张，公司 DDR 系列和 LPDDR 系列产品单价进一步显著上升。

4、按地区分布划分的主营业务收入

报告期各期，公司主营业务收入按地区分布划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	2,622,183.00	42.79%	702,002.27	29.34%	181,677.22	20.05%
境外	3,505,354.21	57.21%	1,690,872.87	70.66%	724,637.15	79.95%
其中：中国香港	3,334,536.41	54.42%	1,630,747.39	68.15%	680,221.72	75.05%
其他地区	170,817.80	2.79%	60,125.48	2.51%	44,415.43	4.90%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

报告期内，公司境外收入占比分别为 79.95%、70.66%和 57.21%。报告期内，公司主营业务收入大部分来自中国香港，主要由于中国香港是半导体产品国际贸易集散地，在外汇结算方面存在诸多便利，公司大部分客户倾向于在中国香港以美元计价开展交易。2025 年，公司境内收入占比大幅提升，主要由于部分经销客户出于融资便利及安全性等因素考虑由境内主体使用人民币交易的规模大量增加，以及公司对境内直销客户的销

售规模大幅增加。

5、按销售模式划分的主营业务收入

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	5,231,648.90	85.38%	2,055,615.46	85.91%	767,564.89	84.69%
直销模式	895,888.31	14.62%	337,259.68	14.09%	138,749.48	15.31%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

公司产品销售采用经销和直销相结合的方式。报告期各期，公司经销模式收入占主营业务收入比例分别为 84.69%、85.91%和 85.38%，经销模式收入占比较高。

6、按季度划分的主营业务收入

报告期各期，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	614,438.98	10.03%	466,437.50	19.49%	108,227.07	11.94%
第二季度	907,937.02	14.82%	481,931.55	20.14%	151,612.76	16.73%
第三季度	1,650,062.03	26.93%	657,827.03	27.49%	249,296.90	27.51%
第四季度	2,955,099.18	48.23%	786,679.06	32.88%	397,177.64	43.82%
合计	6,127,537.21	100.00%	2,392,875.14	100.00%	906,314.37	100.00%

报告期内，公司不存在明显的收入季节性特征，各季度的收入及占比变动主要受公司产销量持续增加及行业周期引起价格波动等因素影响。随着公司产销量持续、快速增加及市场逐步回暖等，公司主营业务收入从一季度到四季度呈现逐季度增长趋势。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成及变动

报告期各期，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	3,614,251.30	99.11%	2,273,346.14	99.58%	926,175.87	99.99%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他业务成本	32,289.33	0.89%	9,607.51	0.42%	80.73	0.01%
合计	3,646,540.63	100.00%	2,282,953.66	100.00%	926,256.60	100.00%

报告期各期，公司主营业务成本分别为 926,175.87 万元、2,273,346.14 万元及 3,614,251.30 万元，主营业务成本占营业成本比例均在 99%以上，公司主营业务成本随产销规模扩大而增加。

2、按业务类别划分的主营业务成本

报告期各期，公司主营业务成本按业务类别划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	1,088,807.11	30.13%	327,822.11	14.42%	188,798.74	20.38%
LPDDR 系列	2,432,744.58	67.31%	1,874,166.61	82.44%	705,022.81	76.12%
其他产品及服务	92,699.62	2.56%	71,357.42	3.14%	32,354.32	3.49%
合计	3,614,251.30	100.00%	2,273,346.14	100.00%	926,175.87	100.00%

报告期各期，公司主营业务成本分别为 926,175.87 万元、2,273,346.14 万元及 3,614,251.30 万元，其中主要为 DDR 系列及 LPDDR 系列产品的销售成本，各期相关成本占主营业务成本比例分别为 96.51%、96.86%及 97.44%。

3、按成本性质划分的主营业务成本

报告期各期，公司主营业务成本按成本性质划分如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	84,596.45	2.34%	72,810.94	3.20%	58,900.52	6.36%
直接人工	118,251.49	3.27%	93,699.22	4.12%	64,751.36	6.99%
制造费用	3,608,228.51	99.83%	2,339,225.05	102.90%	1,809,208.98	195.34%
其他成本	-196,825.15	-5.45%	-232,389.07	-10.22%	-1,006,685.00	-108.69%
合计	3,614,251.30	100.00%	2,273,346.14	100.00%	926,175.87	100.00%

报告期各期，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用及其他成本构成，

其他成本均来自存货跌价准备转销。报告期内，受产能快速爬坡和技术持续迭代影响，公司制造费用中折旧及摊销规模较高，产品单位生产成本较高，公司针对存货的生产成本超出售价部分计提存货跌价准备，已计提存货跌价准备的存货销售后，存货跌价准备转销冲减主营业务成本。

2023 年，公司存货跌价准备转销金额较大，主要原因为公司销售数量随着产能建设持续上升，但当年受行业因素影响，公司产品价格经历周期性低点，导致存货跌价准备的计提及转销金额较大。2024 年及 2025 年，随着 DRAM 行业回暖及公司产品结构的优化，公司产品销售价格不断回升，同时随着规模效应和精益生产管理作用的不断显现，公司产品单位生产成本持续下降，存货跌价准备转销规模大幅减少。

若不考虑存货跌价准备转销对主营业务成本的影响，则公司主营业务成本结构如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	84,596.45	2.22%	72,810.94	2.91%	58,900.52	3.05%
直接人工	118,251.49	3.10%	93,699.22	3.74%	64,751.36	3.35%
制造费用	3,608,228.51	94.68%	2,339,225.05	93.35%	1,809,208.98	93.60%
合计	3,811,076.45	100.00%	2,505,735.21	100.00%	1,932,860.86	100.00%

剔除存货跌价准备转销因素影响后，报告期内，公司直接材料、直接人工及制造费用比例保持稳定，主营业务各项成本规模均随经营规模增长而上升。随着公司规模化效应逐渐显现以及精益生产管理，报告期内公司营业成本的增长速度大幅低于产品销量增速。

（三）毛利及毛利率分析

1、综合毛利及毛利率情况

报告期各期，公司毛利和毛利率的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
转销前综合毛利	2,336,432.61	-97,530.03	-1,024,226.88
综合毛利	2,533,391.52	134,871.21	-17,541.88
转销前综合毛利率	37.81%	-4.03%	-112.71%
综合毛利率	40.99%	5.58%	-1.93%

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
转销前主营业务毛利	2,316,460.76	-112,860.07	-1,026,546.49
主营业务毛利	2,513,285.91	119,528.99	-19,861.50
转销前主营业务毛利率	37.80%	-4.72%	-113.27%
主营业务毛利率	41.02%	5.00%	-2.19%

注：转销前数据为不考虑存货跌价准备转销影响的口径。

报告期各期，公司综合毛利分别为-17,541.88 万元、134,871.21 万元及 2,533,391.52 万元，公司综合毛利率分别为-1.93%、5.58%及 40.99%，剔除存货跌价准备转销因素影响后，公司综合毛利率分别为-112.71%、-4.03%及 37.81%，呈快速上升的趋势。

公司综合毛利主要由主营业务毛利构成，剔除存货跌价准备转销因素影响后，公司 2023 年及 2024 年主营业务毛利率为负，主要系公司处于产能快速建设及爬坡阶段，规模效应尚未完全释放，产品生产成本相对较高。2025 年上半年，随着公司规模效应的持续显现，公司转销前主营业务毛利率已实现转正，同时得益于下半年 DRAM 行业市场价格的快速上涨，公司全年毛利率实现大幅提升。

2、主营业务毛利构成

报告期各期，不考虑存货跌价准备转销因素，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
DDR 系列	818,197.19	35.32%	-85,270.32	75.55%	-198,719.47	19.36%
LPDDR 系列	1,516,192.65	65.45%	-24,355.09	21.58%	-820,008.17	79.88%
其他产品及服务	-17,929.08	-0.77%	-3,234.66	2.87%	-7,818.86	0.76%
合计	2,316,460.76	100.00%	-112,860.07	100.00%	-1,026,546.49	100.00%

报告期内，不考虑存货跌价准备转销因素，公司主营业务毛利于 2023 年及 2024 年为负，2025 年实现转正，整体呈快速上升趋势。2023 年，公司主营业务的负毛利规模较大，主要系当期 DRAM 行业经历深度下行周期，产品销售价格处于近年来的周期性低点。2024 年至 2025 年，随着行业下游需求回暖以及 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5X 等相对高毛利的新产品快速放量，公司主要的 DDR 系列及 LPDDR 系列产品毛利水平显著改善，同时得益于 2025 年下半年全球 DRAM 市场供不应求对产品价格的快速拉升，公司 2025 年毛利转正并实现大幅提升。

3、主营业务毛利率分析

报告期各期，不考虑存货跌价准备转销因素，公司主营业务毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
DDR 系列	41.89%	31.87%	-26.87%	13.26%	-108.76%	20.16%
LPDDR 系列	37.25%	66.43%	-1.23%	82.74%	-121.37%	74.54%
其他产品及服务	-17.23%	1.70%	-3.38%	4.00%	-16.29%	5.30%
合计	37.80%	100.00%	-4.72%	100.00%	-113.27%	100.00%

(1) 主要产品毛利率整体情况分析

报告期内，不考虑存货跌价准备转销因素，公司主要 DRAM 产品销售毛利率分别为-118.69%、-4.77%及 38.75%，呈现快速上升的趋势。

2023 年公司毛利率水平较低，主要由于 DRAM 行业 2023 年上半年处于深度下行周期，尽管下半年行业开始回暖，但当年公司产品价格整体较低并对毛利率产生较大冲击。2024 年以来公司毛利率持续上升，主要系公司产品单价随着 DRAM 行业逐步回暖及公司产品结构优化而提升，同时公司产品的单位成本随着公司规模效应逐步显现及精益生产管理等而下降。2025 年，在 DRAM 行业市场价格快速上涨的背景下，随着公司规模效应的持续显现，公司主要 DRAM 产品毛利率转正并实现大幅提升。

(2) 主要产品毛利率变动分析

报告期各期，不考虑存货跌价准备转销因素，公司主要 DRAM 产品的单位价格、单位成本的变化幅度及毛利率情况具体如下：

产品类别	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
DDR 系列	单位价格变动	61.00%	54.72%	-46.61%
	单位成本变动	-26.26%	-5.98%	-16.03%
	毛利率	41.89%	-26.87%	-108.76%
LPDDR 系列	单位价格变动	24.46%	54.63%	-42.74%
	单位成本变动	-22.85%	-29.29%	-8.49%
	毛利率	37.25%	-1.23%	-121.37%

注：以上单位成本、毛利率均为不考虑存货跌价准备转销影响的口径。

报告期内，公司 DDR 和 LPDDR 系列产品的毛利率均呈现快速上升趋势，最主要

由于相关产品的销售单价在下行周期后随 DRAM 行业回暖和供需格局的变化而持续上升。此外，单位成本方面，随着产能建设和经营规模持续扩大，公司规模效应逐步显现，同时公司通过精益生产管理提高产出，主要产品的单位成本逐年下降。

2024 年，公司 LPDDR 系列产品较 DDR 系列产品单位成本更低、毛利率更高，主要系 LPDDR 系列产品销售规模较大，先进工艺技术平台产品的收入占比更高，规模效应、生产工艺的提升以及精益生产管理对产品单位成本下降的效果更显著。2025 年，公司 DDR 系列产品较 LPDDR 系列产品单位价格及毛利率更高，主要系当期高价格、高毛利的 DDR5 产品快速放量、收入占比快速提升所致。

4、与可比公司毛利率的对比分析

报告期内，公司与可比上市公司综合毛利率对比情况如下：

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
三星电子	39.38%	37.99%	30.33%
SK 海力士	60.41%	48.08%	-1.63%
美光科技	39.79%	22.35%	-9.11%
南亚科技	22.51%	-1.23%	-15.00%
台积电	59.89%	56.12%	54.36%
中芯国际	21.62%	18.59%	21.89%
华润微	26.38%	27.19%	32.22%
平均值	38.57%	29.87%	16.15%
发行人（转销前）	37.81%	-4.03%	-112.71%
发行人	40.99%	5.58%	-1.93%

注 1：资料来源为可比上市公司定期报告，美光科技财年与日历年不一致，按照财年口径计算。

注 2：转销前数据为不考虑存货跌价准备转销影响的口径。

报告期内，不考虑存货跌价准备转销因素，公司综合毛利率分别为-112.71%、-4.03%及 37.81%，2023 年和 2024 年低于可比公司平均水平，一方面是公司和中芯国际、台积电等代工企业的经营模式不同，同时与华润微的产品类型存在较大差异；另一方面主要由于公司尚处于产能快速爬坡期，与三星电子、SK 海力士、美光科技和南亚科技等 DRAM 领域的 IDM 公司所处发展阶段不同，公司折旧及摊销金额较大，产品生产成本较高，规模效应尚未完全显现。2025 年，随着公司规模效应持续显现及产品结构持续优化，同时得益于 2025 年 DRAM 产品价格大幅上涨，公司综合毛利率已转正并大幅提升，与三星电子综合毛利率基本相当，并显著高于南亚科技。

从毛利率的变动趋势看，受 DRAM 行业在下行周期后快速回暖和市场供需格局变化等因素的影响，公司毛利率呈现快速上升趋势，与美光科技、SK 海力士等 DRAM 领域的 IDM 公司基本一致。

（四）税金及附加

报告期各期，公司税金及附加构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
房产税	12,402.09	8,905.80	5,442.28
印花税	11,360.10	6,151.37	3,354.92
水利基金	8,279.80	1,906.09	690.37
土地使用税	621.11	576.56	573.30
城建税及教育费附加	2,047.53	188.89	144.23
其他	348.27	547.52	454.39
合计	35,058.90	18,276.24	10,659.48

报告期各期，公司税金及附加分别为 10,659.48 万元、18,276.24 万元和 35,058.90 万元，主要由房产税、印花税、水利基金、土地使用税、城建税及教育费附加等构成。

（五）期间费用分析

报告期各期，公司的期间费用金额及费用率情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	33,712.72	0.55%	22,397.40	0.93%	17,109.65	1.88%
管理费用	663,092.23	10.73%	235,831.45	9.75%	227,467.73	25.03%
研发费用	959,325.46	15.52%	460,728.35	19.06%	452,047.07	49.75%
财务费用	295,375.23	4.78%	220,428.30	9.12%	193,444.80	21.29%
合计	1,951,505.64	31.58%	939,385.51	38.85%	890,069.25	97.95%

报告期各期，公司期间费用分别为 890,069.25 万元、939,385.51 万元和 1,951,505.64 万元，其中，2025 年期间费用大幅增长主要由研发投入、员工股权激励形成的股份支付以及职工薪酬等增长所致。

报告期各期，公司期间费用率分别为 97.95%、38.85%和 31.58%。报告期内，公司

产销量持续快速增长，2024 年及 2025 年，随着行业逐步回暖及公司产品结构的持续优化，公司营业收入快速增长，期间费用率大幅下降。

1、销售费用

报告期各期，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	14,818.35	43.95%	6,515.79	29.09%	6,127.15	35.81%
股份支付	6,183.09	18.34%	7,936.45	35.43%	6,222.46	36.37%
平台认证费	6,457.50	19.15%	4,002.00	17.87%	2,431.44	14.21%
样品费	2,863.19	8.49%	1,476.65	6.59%	595.97	3.48%
差旅费	1,388.50	4.12%	904.68	4.04%	569.70	3.33%
折旧及摊销	585.25	1.74%	472.64	2.11%	253.73	1.48%
办公费	483.92	1.44%	468.27	2.09%	292.94	1.71%
业务招待费	592.07	1.76%	408.75	1.82%	289.06	1.69%
其他	340.85	1.01%	212.19	0.95%	327.20	1.91%
合计	33,712.72	100.00%	22,397.40	100.00%	17,109.65	100.00%

报告期各期，公司销售费用分别为 17,109.65 万元、22,397.40 万元和 33,712.72 万元，总体随着公司业务规模的扩大而增长。公司销售费用主要由职工薪酬、股份支付、平台认证费及样品费等构成。

2024 年，公司销售费用较 2023 年增加，主要系授予销售人员股权激励所带来的股份支付费用持续增加，以及公司产品与主控芯片平台进行适配而产生的平台认证费用随公司业务规模的显著增长及产品线丰富而增长等。2025 年，公司销售费用较 2024 年大幅增加，主要系公司业绩大幅增长，销售人员业绩奖金所带来的职工薪酬大幅增加，以及平台认证费、样品费持续增长。

报告期内，公司销售费用率与可比公司比较的具体情况如下：

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
南亚科技	1.25%	1.95%	1.97%
台积电	0.44%	0.45%	0.49%
中芯国际	0.45%	0.49%	0.56%

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
华润微	1.59%	1.56%	1.69%
平均值	0.93%	1.11%	1.18%
发行人	0.55%	0.93%	1.88%

注 1：资料来源为可比上市公司定期报告。
注 2：三星电子、SK 海力士和美光科技未分别披露销售费用及管理费用金额，此处未进行比较。

报告期各期，公司销售费用率分别为 1.88%、0.93%和 0.55%，整体高于台积电和中芯国际，低于南亚科技和华润微，处于可比公司的中间水平。

2、管理费用

报告期各期，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股份支付	521,590.26	78.66%	137,471.05	58.29%	123,856.18	54.45%
职工薪酬	79,595.03	12.00%	43,044.19	18.25%	60,264.11	26.49%
折旧及摊销	26,561.90	4.01%	21,108.55	8.95%	19,506.20	8.58%
专业服务费	14,970.26	2.26%	19,205.28	8.14%	10,261.38	4.51%
物业安保费	8,981.63	1.35%	5,794.11	2.46%	4,768.12	2.10%
办公及差旅费	5,383.81	0.81%	3,916.11	1.66%	4,312.82	1.90%
其他	6,009.33	0.91%	5,292.16	2.24%	4,498.92	1.98%
合计	663,092.23	100.00%	235,831.45	100.00%	227,467.73	100.00%

报告期各期，公司管理费用分别为 227,467.73 万元、235,831.45 万元和 663,092.23 万元，主要由股份支付、职工薪酬、折旧及摊销和专业服务费等构成，并随着公司业务规模的扩大而增长。

2024 年，公司管理费用较 2023 年略有增加，主要系股份支付金额及专业服务费中产线技术升级改造相关的拆机费等增加所致。2025 年，公司管理费用较 2024 年增加较多，主要系公司于 2025 年对部分符合条件的第二期员工持股计划激励对象取消服务期安排以及向董事长授予股权激励，使得股份支付金额增加。

报告期内，公司管理费用率与可比公司比较的具体情况如下：

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
南亚科技	2.81%	5.23%	6.06%

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
台积电	2.16%	2.89%	2.82%
中芯国际	5.10%	6.64%	6.97%
华润微	5.17%	5.17%	6.62%
平均值	3.81%	4.98%	5.62%
发行人	10.73%	9.75%	25.03%

注 1：资料来源为可比上市公司定期报告。
 注 2：三星电子、SK 海力士和美光科技未分别披露销售费用及管理费用金额，此处未进行比较。

报告期各期，公司管理费用率分别为 25.03%、9.75%和 10.73%，高于可比公司平均值，剔除股份支付后的管理费用率分别为 11.40%、4.07%和 2.29%。2024 年及 2025 年，随着行业回暖、收入快速增长，公司管理费用率较 2023 年有所下降。

3、研发费用

报告期各期，公司研发费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	413,086.15	43.06%	153,970.79	33.42%	164,079.56	36.30%
研发材料费	209,166.08	21.80%	118,997.31	25.83%	84,495.41	18.69%
股份支付	71,665.67	7.47%	86,844.12	18.85%	78,171.69	17.29%
折旧及摊销	163,440.62	17.04%	58,493.85	12.70%	85,020.08	18.81%
测试服务费	69,081.25	7.20%	28,067.54	6.09%	22,516.00	4.98%
其他	32,885.69	3.43%	14,354.73	3.12%	17,764.34	3.93%
合计	959,325.46	100.00%	460,728.35	100.00%	452,047.07	100.00%

报告期各期，公司研发费用分别为 452,047.07 万元、460,728.35 万元和 959,325.46 万元，主要由职工薪酬、研发材料费、股份支付、折旧及摊销和测试服务费等构成。报告期各期，公司研发投入水平保持在较高水平。

2024 年，公司研发费用较 2023 年略有增加，主要系研发材料费和测试服务费随公司先进工艺平台、新产品的持续研发投入而增加。职工薪酬和折旧及摊销较 2023 年有所下降，主要受 2024 年公司针对技术平台研发的相关研发支出进行了资本化的影响。2025 年，公司研发费用较 2024 年大幅增加，一方面是由于随着研发活动的持续开展，研发耗用的材料费以及研发流片增加进而分摊的折旧及摊销相应增加，另一方面，公司

为持续巩固和提升核心技术优势，扩充研发团队以及提升研发人员的薪酬激励导致职工薪酬增加。

报告期内，公司研发费用率与可比公司比较的具体情况如下：

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
三星电子	11.31%	11.63%	10.94%
SK 海力士	6.66%	6.70%	11.45%
美光科技	10.16%	13.66%	20.04%
南亚科技	10.57%	22.52%	25.34%
台积电	6.47%	7.05%	8.44%
中芯国际	8.20%	9.42%	11.03%
华润微	10.57%	11.53%	11.66%
平均值	9.13%	11.79%	14.13%
发行人	15.52%	19.06%	49.75%

注：资料来源为可比上市公司定期报告。

报告期各期，公司研发费用率分别为 49.75%、19.06%和 15.52%，高于可比公司平均水平，主要系公司始终高度重视研发投入，不断进行产品及工艺技术的研发迭代，以实现技术追赶并提升产品市场竞争力，研发投入增加且处于较高水平。

4、财务费用

报告期各期，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	316,629.20	324,389.78	267,734.81
减：已资本化的利息费用	17,709.48	57,473.47	33,666.70
减：利息收入	57,111.20	80,669.10	66,328.36
手续费	3,641.27	3,100.91	1,805.31
汇兑差额	49,083.65	30,626.65	23,514.31
其他	841.79	453.54	385.44
合计	295,375.23	220,428.30	193,444.80

报告期各期，公司财务费用分别为 193,444.80 万元、220,428.30 万元和 295,375.23 万元，主要由利息支出、手续费、汇兑差额和其他构成。报告期内公司财务费用逐年增长，主要系公司生产经营规模不断扩大导致资金需求不断提高，随之产生较大利息支出，

该等情形与公司生产经营阶段的特点相匹配。

（六）利润表其他主要项目分析

1、信用减值利得（损失）

报告期各期，公司信用减值利得（损失）明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款信用减值利得（损失）	137.88	-716.98	-137.68
其他应收款信用减值利得（损失）	-49.25	-150.38	-146.48
合计	88.63	-867.36	-284.16

报告期各期，信用减值利得（损失）为公司根据会计政策对应收账款和其他应收款相应计提的信用减值利得（损失），信用减值利得（损失）金额相对较小。

2、资产减值利得（损失）

报告期各期，公司的资产减值利得（损失）情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-47,314.97	-182,688.41	-1,150,021.06
固定资产减值损失	-26,141.41	-57,155.59	-27,906.84
长期待摊费用减值损失	-2,009.62	-6,568.43	-
合计	-75,466.01	-246,412.43	-1,177,927.90

报告期各期，公司资产减值利得（损失）金额分别为-1,177,927.90 万元、-246,412.43 万元和-75,466.01 万元，由存货跌价损失、固定资产减值损失、长期待摊费用减值损失构成。

2024 年以来，随着 DRAM 市场回暖与产品价格回升，对应存货可变现净值回升，同时公司产品单位成本持续下降，使得 2024 年度以及 2025 年度存货跌价损失大幅收窄。

3、投资收益（损失）

报告期各期，公司的投资收益（损失）情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
远期外汇合同结算收益（损失）	-13,064.85	11,796.57	-1,788.21

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
对联营企业的投资损失	-3,137.48	-1,379.45	-
交易性金融资产的投资处置收益	8,914.79	-	-
其他非流动金融资产对外投资的投资收益	475.27	77.22	-
合计	-6,812.27	10,494.34	-1,788.21

报告期各期，公司的投资收益（损失）金额分别为-1,788.21 万元、10,494.34 万元和-6,812.27 万元，占同期净利润（亏损）的 0.09%、-1.16%和-0.95%，主要源于公司为规避汇率风险开展的远期结售汇、外汇掉期业务及交易性金融资产的投资处置产生的投资收益或损失。

4、公允价值变动收益（损失）

报告期各期，公司的公允价值变动收益（损失）情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项的公允价值变动	-51,991.37	-18,097.51	1,275.24
衍生金融工具产生的公允价值变动收益（损失）	69,992.26	-365.29	-1,581.73
其他非流动金融资产公允价值变动	18,317.26	701.03	272.11
结构性存款公允价值变动	834.99	-	-
合计	37,153.14	-17,761.77	-34.37

报告期各期，公司公允价值变动收益（损失）金额分别为-34.37 万元、-17,761.77 万元和 37,153.14 万元，主要源于衍生金融工具产生的公允价值变动收益（损失）和应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项的公允价值变动。

5、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
保险赔偿款	0.90	80.60	12,058.10
质量赔偿金	-	-	456.50
违约金	844.12	706.16	115.23
其他	475.58	797.10	406.28

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	1,320.60	1,583.86	13,036.11

报告期内，公司营业外收入的金额分别为 13,036.11 万元、1,583.86 万元和 1,320.60 万元，金额较小，占营业收入比例较低。其中，2023 年的保险赔偿款为公司因意外停电而取得的保险公司赔付的赔偿款。

6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
资产报废损失	2,693.59	9,231.73	680.70
其他	586.16	342.19	565.31
合计	3,279.76	9,573.92	1,246.01

报告期内，公司的营业外支出的金额分别为 1,246.01 万元、9,573.92 万元和 3,279.76 万元，主要为资产报废损失。其中，2024 年的资产报废损失主要系公司因技术改造处置相关的机器设备。

（七）纳税情况

报告期内，公司主要税种的纳税情况如下：

单位：万元

税种	期间	期初未交数	本期应交数	本期缴纳数	期末未交数
企业所得税	2025 年度	75.08	52,542.30	162.32	52,455.06
	2024 年度	43.93	234.33	203.19	75.08
	2023 年度	1.07	178.70	135.84	43.93
增值税	2025 年度	48.20	11,193.25	3,985.07	7,256.38
	2024 年度	98.25	2,069.55	2,119.60	48.20
	2023 年度	128.51	1,780.98	1,811.24	98.25

报告期内，公司部分子公司存在盈利，计提并实缴所得税。报告期内，公司适用的税收政策稳定，未发生重大不利变化，亦不存在面临即将实施的重大税收政策调整的情况。

（八）存在累计未弥补亏损的情况

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-1,633,977.72 万元、-714,488.72

万元和 187,485.94 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 -1,675,200.38 万元、-787,003.23 万元及 531,588.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-3,665,042.11 万元。报告期内，公司亏损金额快速收窄并已于 2025 年度实现盈利，但截至报告期末仍存在累计未弥补亏损。

1、存在累计未弥补亏损的具体原因

报告期前两个年度公司处于亏损状态，截至报告期末公司存在累计未弥补亏损，具体原因如下：

(1)IDM 企业需要持续且密集的资金投入，报告期内公司处于产能快速爬坡阶段，规模效应尚未完全显现

DRAM 芯片的设计和制造环节具有很强的耦合性和技术复杂性，为提高产品生产效率，实现规模化生产从而降低单位成本，同时增强产业链自主权及行业影响力，重资产投入的 IDM 模式成为 DRAM 厂商参与国际竞争的必然选择。为尽快优化成本并扩大市场份额，报告期内公司迅速进行产能建设。然而，报告期内，公司仍处于产能快速爬坡阶段，规模效应尚未完全显现，固定资产规模不断扩大带来的折旧金额不断增加。报告期内，公司固定资产折旧金额分别为 1,055,525.26 万元、1,487,543.58 万元和 2,468,025.21 万元，对公司盈利能力有较大影响。

(2) DRAM 行业具备高研发投入的特征，公司技术工艺迭代和产品结构优化带来的研发支出持续增加，但毛利提升的整体效果尚待进一步显现

为持续响应及满足下游市场需求，确保产品竞争优势，DRAM 企业需要持续高额研发投入对产品技术及制造工艺进行迭代并不断优化产品结构。报告期内，公司完成了第三代、第四代技术平台的研发及产品量产，产品结构持续优化，核心工艺技术已达到国际先进水平，更先进工艺平台与更高代际产品的开发也在同步开展。报告期内，公司研发投入分别为 467,047.07 万元、634,129.13 万元和 959,325.46 万元，占营业收入比例较高，研发形成的无形资产摊销及期间费用金额较高。此外，报告期内虽然公司相对高价格高毛利的 LPDDR5、DDR5 和 LPDDR5X 等产品收入迅速提升，但由于量产时间较短，高毛利产品收入放量需要一定过程，工艺提升、产品优化带来毛利水平的提升尚待进一步显现。

(3) DRAM 行业存在强周期属性，下行周期内公司产品价格迅速下降，存货减值

损失大幅增加，经营业绩受到较大冲击

DRAM 产品标准化程度高、需求量大且具有强行业周期性，产品价格、市场规模受供求关系影响较大。2022 年下半年至 2023 年上半年，受全球通货膨胀、经济衰退和地缘冲突等宏观负面因素及下游市场周期性需求波动等行业因素影响，DRAM 行业经历了历史罕见的深度下行周期，产品市场价格低点较下行周期前跌幅达 50%，DRAM 国际三巨头也在 2023 年出现历史罕见的亏损及负毛利。2023 年度，公司通过坚定扩产策略保证了收入的增长及市场份额的扩大，但盈利能力受行业下行冲击较大，存货减值损失及亏损金额较大。2024 年以来随着 DRAM 行业回暖，公司产品量价齐升，叠加产品结构不断优化，公司亏损金额大幅收窄并于 2025 年度在 DRAM 市场价格快速上涨的带动下实现盈利。

2、存在累计未弥补亏损的影响

（1）对现金流方面的影响

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-727,162.07 万元、689,745.85 万元和 3,651,981.33 万元，2023 年度公司经营现金流为负，主要系公司处于快速发展阶段，对关键原材料实施战略采购策略，报告期内采购原材料现金支出金额较高，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较大。2024 年以来，公司经营性现金流已实现转正并于 2025 年度实现快速增长，截至 2025 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额为 5,199,022.02 万元，公司现金流充沛，存在累计未弥补亏损的情况未对公司整体资金运营和偿债能力构成重大不利影响。

（2）对业务拓展方面的影响

自成立以来，公司通过长期的技术投入和自主创新，搭建了第一代、第三代、第四代并持续迭代的工艺技术平台，在核心 DRAM 产品领域拥有自主研发的、完整的技术布局。依靠卓越的研发技术实力、稳定的产品性能及完善的配套服务体系，公司产品在服务器、手机及电脑等各大领域已实现规模化应用，积累了广泛的优质客户资源，逐步建立起了优质的品牌效应和良好的产业生态。随着公司现有产能逐步释放以及新产能建设逐步完成，公司产品竞争力及行业影响力不断增强，存在累计未弥补亏损的情况未对公司业务拓展产生重大不利影响。

（3）对人才吸引和团队稳定性方面的影响

公司高度重视人才选拔体系的建设，顺应发展需求，制定相应研发人才战略，利用各种招聘渠道吸引人才竞聘，并采用灵活市场化招聘方式引进高端人才。此外，公司通过培训机制、带教辅导、行业交流等一系列的培养机制吸引并留住高素质研发人才，以核心技术人才带动培养一批创新研发团队。报告期内，公司广泛吸纳 DRAM 领域技术人才，员工行业经验丰富，具备追赶国外先进水平的人员基础。公司主要高级管理人员均拥有多年从业经验，存在累计未弥补亏损的情况未对公司团队稳定性产生重大不利影响。

（4）对研发投入方面的影响

公司始终鼓励创新，高度重视技术的持续研发。报告期内，公司研发投入维持较大规模且持续上升，报告期各期金额分别为 467,047.07 万元、634,129.13 万元和 959,325.46 万元。在持续高额的研发及生产投入下，公司已建成中国技术最先进、规模最大的 DRAM 生产线，同时紧跟国际主流厂商发展脚步，积极布局推出 LPDDR5、DDR5 和 LPDDR5X 等更先进代际产品，存在累计未弥补亏损的情况未对公司研发投入的可持续性构成重大不利影响。

（5）对战略投入方面的影响

报告期内，公司战略性布局前瞻技术，持续推进新一代制程工艺提升及多元化产品开发，加速对国际先进技术的追赶。同时为进一步提高产品性能、降低成本和丰富产品线，公司在 DRAM 产品先进工艺以及新型产品应用等方向积极开展技术探索和布局，致力于增强公司整体技术实力，提高产品竞争力与市场占有率，实现我国存储芯片自主可控的发展目标。存在累计未弥补亏损的情况未对公司战略性投入构成重大不利影响。

综上所述，发行人发展状态良好，存在累计未弥补亏损的情况未在公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定、研发投入、战略投入、生产经营可持续性等方面产生负面影响，未对公司未来持续经营能力构成重大不利影响。

3、趋势分析

收入方面，基于全球及中国市场广阔且持续增长的 DRAM 需求，公司业务增长仍有较大的市场空间。公司稳步推进技术平台升级、产品多元化开发、加快产能建设及爬坡，为市场开拓提供了重要保障，预计出货量将持续增长。结合公司产品升级策略及新产品推出计划，公司同代际更大容量产品及 DDR5 等更先进新产品的快速放量，为总

体均价提供一定的客观基础。2025 年下半年以来，各类 DRAM 产品价格呈现显著上涨趋势，有利于公司营收提升和业绩改善。

成本及费用方面，公司更先进技术平台的量产将显著提升单位晶圆产出，叠加公司产能建设、产能利用率提升，公司规模效应持续显现。在此基础上，公司通过优化工艺路径、加大国产供应商导入力度等多方面运营管理手段，以促进降本增效，预测期单位成本预计将持续下降。同时，公司将持续加大研发投入力度，用于工艺提升及产品研发。随着公司业务规模快速增大，预计销售费用、管理费用及财务费用占营业收入的比重将有所下降。

在上述因素驱动下，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 187,485.94 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 531,588.62 万元，公司已实现扭亏为盈。同时，公司作为全球 DRAM 市场的重要竞争者之一，有望持续受益于全球算力需求增长浪潮，盈利能力预计将进一步改善，累计未弥补亏损将逐步得以弥补。

公司上述前瞻性信息是建立在推测性假设的数据基础上的预测，具有重大不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

4、风险因素

公司已就存在累计未弥补亏损的相关风险因素做出提示，具体参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、存在累计未弥补亏损的风险”“6、国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险”“7、产品及技术研发不达预期的风险”以及“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（三）人才短缺或流失的风险”“（六）主营业务毛利率存在波动的风险”的相关内容。

5、敏感性分析

基于对公司产能建设与产能爬坡、市场与客户开拓、产品与工艺研发等经营情况以及 DRAM 市场价格变动趋势的谨慎预测，原预计公司 2026 年实现盈利。公司能否在 2026 年盈利主要受到平均单价及月均出货量的综合影响。公司基于谨慎性原则，原假设 2026 年自身产品平均价格低于 2025 年 9 月实际价格。在前述谨慎假设基础上，公司综合考虑不同平均单价、不同月均出货量的变动情形，原对于盈利年度的敏感性分析如下：

平均单价 月均出货量	下降 30%	下降 20%	下降 10%	下降 5%	不变	上升 5%	上升 10%	上升 20%	上升 30%
下降 3 万片/月	2028 年	2027 年	2027 年	2027 年	2027 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年
下降 2 万片/月	2028 年	2027 年	2027 年	2027 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年
不变	2028 年	2027 年	2027 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年
增加 2 万片/月	2027 年	2027 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年	2026 年

注：敏感性分析根据公司归属于母公司股东的净利润测算。

2025 年下半年以来，在全球 DRAM 产品供不应求，价格呈现大幅上涨趋势的行业背景下，公司凭借不断优化的产品结构、持续迭代的工艺水平、日臻成熟的运营能力以及广泛的市场认可，实现了营业收入的持续增长和毛利率的大幅提升，尤其是第四季度内公司产品单价在月度之间仍持续、快速上涨，大幅带动了公司毛利提升，公司较前期预测提前于 2025 年度实现了扭亏为盈。作为全球 DRAM 市场的重要竞争者之一，公司有望持续受益于全球算力需求增长浪潮，盈利能力预计将进一步改善，累计未弥补亏损也将逐步得以弥补。

6、投资者保护措施及承诺

为增强公司盈利能力，充分保护投资者的合法权益，公司根据自身经营特点制定了相关措施：（1）大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力；（2）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；（3）加强管理，控制成本；（4）完善利润分配政策，强化投资者回报。

公司主要股东、高级管理人员、核心技术人员按照相关规定作出了关于股份锁定及减持股票的特殊安排或承诺，具体参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或累计未弥补亏损的情况及投资者保护措施”及“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”。

十、资产质量分析

（一）资产结构分析

1、资产的构成及变化

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	11,098,588.16	32.95%	6,801,410.95	25.04%	4,744,977.21	24.62%
非流动资产	22,579,904.06	67.05%	20,358,472.16	74.96%	14,530,656.07	75.38%
合计	33,678,492.22	100.00%	27,159,883.10	100.00%	19,275,633.28	100.00%

报告期内，随着公司持续扩产、业务规模的不断扩大，公司总资产呈现逐年增长趋势。公司采用 IDM 模式，资产结构以非流动资产为主。报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 75.38%、74.96%和 67.05%，总体呈现小幅下降趋势。

报告期各期末，公司资产总额分别为 19,275,633.28 万元、27,159,883.10 万元和 33,678,492.22 万元。报告期内，流动资产的增加主要是随着公司生产经营规模持续扩大，货币资金、存货等流动资产随之增长；非流动资产的增加主要系公司建设合肥一期生产线、合肥二期生产线及北京生产线，公司资本投入逐渐增多，固定资产、在建工程等非流动资产规模不断扩大。

2、流动资产分析

公司流动资产由货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收账款、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产组成。报告期各期末，公司流动资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	5,199,022.02	46.84%	4,269,868.37	62.78%	3,137,354.72	66.12%
交易性金融资产	2,063,834.99	18.60%	-	-	-	-
衍生金融资产	70,790.51	0.64%	83.48	0.001%	-	-
应收账款	152,374.06	1.37%	184,588.80	2.71%	39,871.63	0.84%
预付款项	9,308.62	0.08%	10,997.79	0.16%	16,181.70	0.34%
其他应收款	17,052.80	0.15%	14,417.42	0.21%	78,676.95	1.66%
存货	2,856,768.67	25.74%	1,854,952.96	27.27%	1,073,617.73	22.63%
其他流动资产	729,436.49	6.57%	466,502.13	6.86%	399,274.49	8.41%
合计	11,098,588.16	100.00%	6,801,410.95	100.00%	4,744,977.21	100.00%

报告期各期末，公司流动资产金额分别为 4,744,977.21 万元、6,801,410.95 万元及 11,098,588.16 万元。公司流动资产主要为货币资金和存货，报告期各期末两者合计占流

动资产的比例分别为 88.75%、90.05%及 72.58%。

公司流动资产各主要项目构成及变动情况如下：

(1) 货币资金

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	5,195,789.29	4,259,563.41	3,119,756.31
其他货币资金	3,232.72	10,304.95	17,598.41
合计	5,199,022.02	4,269,868.37	3,137,354.72

报告期各期末，公司货币资金分别为 3,137,354.72 万元、4,269,868.37 万元和 5,199,022.02 万元，主要为银行存款。报告期内，公司银行存款持续增加，主要原因系公司股权及债务融资、营收规模扩大收到的货币资金较大。

报告期各期末，公司其他货币资金为受限制货币资金，主要为长鑫科服房地产项目预售收取的专项监管资金等。

(2) 交易性金融资产

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
结构性存款	2,063,834.99	-	-
合计	2,063,834.99	-	-

报告期内，公司的交易性金融资产系未到期结构性存款，主要投资于与汇率或黄金挂钩的产品。

(3) 衍生金融资产

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
远期外汇合约	20,848.16	83.48	-
外汇掉期合约	49,942.36	-	-
合计	70,790.51	83.48	-

报告期各期末，发行人衍生金融资产分别为 0 万元、83.48 万元和 70,790.51 万元，由未到期的远期外汇合约、外汇掉期合约构成。

（4）应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	153,162.06	185,516.38	40,071.99
应收账款坏账准备	788.00	927.58	200.36
应收账款账面价值	152,374.06	184,588.80	39,871.63

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 39,871.63 万元、184,588.80 万元和 152,374.06 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.84%、2.71%和 1.37%，占比较低。

1) 应收账款变动分析

报告期内，公司应收账款余额及占营业收入比例的变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	153,162.06	185,516.38	40,071.99
营业收入	6,179,932.15	2,417,824.87	908,714.72
占比	2.48%	7.67%	4.41%

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 40,071.99 万元、185,516.38 万元和 153,162.06 万元，整体随公司销售规模扩大而扩大，占当期营业收入的比例分别为 4.41%、7.67%和 2.48%，公司客户回款情况良好，对于经销商主要采用先款后货的结算方式，应收账款余额占营业收入的比例总体较低。

2024 年，公司应收账款余额大幅增加，最主要是由于境外经销商亿安仓（香港）有限公司当年为尽快向公司锁定订单并完成采购，先行由其集团内注册于境内的关联公司向公司支付人民币作为合同保证金，该款项在后续亿安仓（香港）有限公司向公司支付美元后退还，截至 2025 年 6 月末，公司对亿安仓（香港）有限公司的应收账款已收回。

2) 应收账款前五名客户情况

报告期各期末，发行人前五大客户应收账款余额合计分别为 40,071.99 万元、177,290.65 万元和 152,768.13 万元，占发行人各期末应收账款余额的比例分别为 100.00%、95.57%和 99.74%。

3) 应收账款坏账计提方式情况

报告期各期末，公司应收账款余额按照坏账计提方式划分的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账计提	账面余额	坏账计提	账面余额	坏账计提
按单项计提	-	-	-	-	-	-
按组合计提	153,162.06	788.00	185,516.38	927.58	40,071.99	200.36
合计	153,162.06	788.00	185,516.38	927.58	40,071.99	200.36

4) 应收账款账龄情况及坏账计提分析

报告期各期末，公司的应收账款账龄结构以及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
六个月以内	148,923.71	744.62	0.50%
六个月至一年	4,213.35	42.13	1.00%
一年至两年	25.00	1.25	5.00%
合计	153,162.06	788.00	0.51%
账龄	2024 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
六个月以内	185,516.38	927.58	0.50%
合计	185,516.38	927.58	0.50%
账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
六个月以内	40,071.99	200.36	0.50%
合计	40,071.99	200.36	0.50%

报告期各期末，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，相对较短，应收账款管理情况良好，发生坏账损失的风险较小。公司已依照审慎原则，根据会计政策对不同账龄的应收账款合理计提了相应的坏账准备。

5) 坏账准备计提与可比公司对比分析

报告期各期末，公司应收账款坏账减值准备综合计提比例与可比公司对比情况如下：

公司简称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
三星电子	1.11%	0.96%	0.96%
SK 海力士	0.01%	0.01%	0.15%
台积电	0.18%	0.17%	0.26%
中芯国际	0.59%	0.25%	0.15%
华润微	0.06%	0.24%	0.40%
平均值	0.39%	0.33%	0.38%
发行人	0.51%	0.50%	0.50%

注：中国台湾及境外可比公司中，美光科技未单独披露应收账款坏账计提金额；台积电仅披露应收票据和应收账款等合并计提的坏账准备，未进一步区分，坏账准备计提比例计算的分子分母口径为应收票据和应收账款合并金额；南亚科技无因预期信用风险增加而须计提应收账款坏账准备的情形。

报告期各期末，公司计提的综合坏账准备比例为 0.50%、0.50%和 0.51%，2023 年末、2024 年末，公司综合坏账准备计提比例高于可比公司平均水平，2025 年末与可比公司基本相当，坏账准备计提充分。

（5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 16,181.70 万元、10,997.79 万元和 9,308.62 万元，账龄基本为 1 年以内，具体如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	7,169.38	77.02%	7,619.26	69.27%	14,053.31	86.85%
1 至 2 年	2,121.18	22.79%	1,871.32	17.02%	2,073.50	12.81%
2 至 3 年	18.06	0.19%	1,496.53	13.61%	54.89	0.34%
3 年以上	-	-	10.69	0.10%	-	-
合计	9,308.62	100.00%	10,997.79	100.00%	16,181.70	100.00%

报告期各期末，公司预付款项主要系与部分供应商签订采购合同所预付的采购款。

（6）其他应收款

报告期各期末，发行人其他应收款按款项性质分类列示情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金及保证金	3,599.37	6,531.57	70,319.02
员工社保	1,478.91	971.92	1,461.94

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
代垫款项	11,977.22	7,164.58	4,288.27
应收利息	-	-	2,744.40
其他	350.87	53.68	17.26
合计	17,406.37	14,721.74	78,830.89

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 78,830.89 万元、14,721.74 万元和 17,406.37 万元。公司其他应收款主要为押金及保证金和代收代付款项。2023 年末，公司其他应收款余额较高，主要系当年公司因进口设备向海关所支付的保证金期末余额较高，该类保证金可收回性较高、信用风险较低。2024 年末和 2025 年末，公司其他应收款余额较 2023 年末已大幅下降。

(7) 存货

1) 存货构成及变动分析

报告期各期末，公司存货余额构成情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	713,763.92	18,504.00	695,259.92	24.34%
在产品	1,751,567.09	41,934.06	1,709,633.03	59.84%
产成品	459,466.54	18,192.70	441,273.84	15.45%
房地产开发产品	14,191.97	3,590.08	10,601.89	0.37%
合计	2,938,989.52	82,220.84	2,856,768.67	100.00%
2024 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	812,810.01	77,419.65	735,390.36	39.64%
在产品	1,100,501.85	162,333.91	938,167.94	50.58%
产成品	149,043.89	17,632.84	131,411.05	7.08%
房地产开发产品	59,095.12	9,111.51	49,983.61	2.69%
合计	2,121,450.87	266,497.91	1,854,952.96	100.00%
2023 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	609,954.96	45,002.74	564,952.22	52.62%
在产品	607,884.86	242,787.44	365,097.41	34.01%

产成品	143,545.93	56,639.59	86,906.33	8.09%
房地产开发成本	56,661.76	-	56,661.76	5.28%
合计	1,418,047.50	344,429.77	1,073,617.73	100.00%

注：房地产开发成本/产品为公司基于员工住房需求而开发建设的地产项目，开发项目的认购对象仅限于公司员工。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 1,073,617.73 万元、1,854,952.96 万元和 2,856,768.67 万元，占流动资产比例分别为 22.63%、27.27%和 25.74%。公司存货包括原材料、在产品、产成品和房地产开发成本/产品，随着公司规模的扩大，公司存货金额及占比呈上升趋势。

剔除房地产开发成本/产品后，报告期各期末存货的构成及变动如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	695,259.92	24.43%	735,390.36	40.74%	564,952.22	55.55%
在产品	1,709,633.03	60.07%	938,167.94	51.98%	365,097.41	35.90%
产成品	441,273.84	15.50%	131,411.05	7.28%	86,906.33	8.55%
合计	2,846,166.78	100.00%	1,804,969.35	100.00%	1,016,955.97	100.00%

报告期各期末，公司存货账面价值持续上升，主要受到产能增加、产品生产周期、外部环境等综合影响，原材料、在产品和产成品规模相应增长，与其经营规模增长相匹配。

2) 存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货（剔除房地产开发成本/产品）计提的存货跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	18,504.00	2.59%	77,419.65	9.52%	45,002.74	7.38%
在产品	41,934.06	2.39%	162,333.91	14.75%	242,787.44	39.94%
产成品	18,192.70	3.96%	17,632.84	11.83%	56,639.59	39.46%
合计	78,630.76	2.69%	257,386.40	12.48%	344,429.77	25.30%

注：比例为各类存货跌价准备余额占该类存货账面余额的比例。

报告期各期末，公司存货（不含房地产开发成本/产品）跌价准备计提金额分别为

344,429.77 万元、257,386.40 万元和 78,630.76 万元，计提比例分别为 25.30%、12.48% 和 2.69%，呈逐步下降趋势。2024 年末、2025 年末，公司跌价准备计提金额和计提比例均大幅减少的原因系产品价格随着行业逐步回暖及公司产品结构优化而整体回升，同时规模效应逐渐显现、精益生产管理能力不断增强，单位成本下降，产品销售毛利率持续改善并在 2025 年转正及大幅提升。

报告期各期末，公司按照原材料、在产品和产成品分类对期末存货进行减值测试。公司存货跌价准备的计提方法参见本节之“五、重要会计政策和会计估计”之“（三）存货”。

3) 可比公司存货跌价准备计提比例情况

报告期各期末，公司与可比公司存货跌价准备计提比例情况如下：

公司简称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
三星电子	9.99%	8.78%	12.53%
SK 海力士	3.35%	7.99%	15.25%
美光科技	-	-	17.92%
台积电	0.74%	0.31%	1.37%
中芯国际	11.15%	11.12%	9.76%
华润微	11.82%	12.03%	10.83%
平均值	6.18%	6.71%	11.28%
发行人	2.69%	12.48%	25.30%

注 1：可比公司数据系以公告数据为基础计算，其中南亚科技未披露相关数据。

注 2：发行人数据已剔除房地产开发成本/产品影响。

经对比，2023 年末、2024 年末，公司存货跌价计提比例整体上高于可比公司。主要原因系公司设备等长期资产投入较大，单位产品承担较大的折旧摊销成本，使得可变现净值低于生产成本。2024 年以来，公司产品矩阵逐步缩小与可比公司的代际差异，产品毛利率回升，从而使得存货跌价计提比例差异减小。

(8) 其他流动资产

报告期各期末，公司的其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	705,998.17	460,078.35	394,028.74

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预缴税款	65.22	16.01	16.55
预付进项税款	14,927.11	2,756.47	1,440.73
待摊费用	7,707.64	3,517.34	3,563.84
其他	738.35	133.96	224.62
合计	729,436.49	466,502.13	399,274.49

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 399,274.49 万元、466,502.13 万元和 729,436.49 万元，占各期末流动资产的比例分别为 8.41%、6.86%和 6.57%，主要为公司固定资产购置金额较高产生的待抵扣进项税额。

3、非流动资产分析

公司非流动资产由长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用和其他非流动资产组成。报告期各期末，公司非流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	151,954.06	0.67%	29,985.55	0.15%	-	-
其他权益工具投资	46,641.25	0.21%	27,607.77	0.14%	13,600.00	0.09%
其他非流动金融资产	239,831.32	1.06%	107,923.14	0.53%	20,272.11	0.14%
固定资产	18,302,398.79	81.06%	15,313,201.60	75.22%	8,445,207.29	58.12%
在建工程	3,178,962.17	14.08%	4,120,868.87	20.24%	5,150,255.01	35.44%
使用权资产	12,335.64	0.05%	12,054.48	0.06%	15,174.75	0.10%
无形资产	427,755.74	1.89%	515,341.19	2.53%	445,318.15	3.06%
开发支出	-	-	-	-	15,000.00	0.10%
长期待摊费用	100,569.56	0.45%	87,313.24	0.43%	32,023.41	0.22%
其他非流动资产	119,455.53	0.53%	144,176.32	0.71%	393,805.33	2.71%
合计	22,579,904.06	100.00%	20,358,472.16	100.00%	14,530,656.07	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 14,530,656.07 万元、20,358,472.16 万元和 22,579,904.06 万元。其中，固定资产、在建工程 and 无形资产的占比较高，报告期各期末上述三项资产占非流动资产的比例合计为 96.63%、97.99%和 97.03%。公司非流动资产各主要项目构成及变动情况如下：

(1) 固定资产

1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	24,313,136.94	18,873,725.42	10,594,119.20
房屋及建筑物	1,538,021.40	1,287,585.91	924,693.05
机器设备	22,570,892.03	17,439,613.84	9,576,618.30
运输设备	1,944.97	1,310.87	879.62
办公及其他设备	202,278.55	145,214.80	91,928.23
二、累计折旧合计	5,888,957.61	3,461,557.85	2,091,697.75
房屋及建筑物	251,698.00	171,498.49	113,960.48
机器设备	5,520,496.70	3,211,685.06	1,926,179.48
运输设备	930.31	557.12	362.26
办公及其他设备	115,832.60	77,817.17	51,195.53
三、减值准备	121,780.54	98,965.97	57,214.16
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	121,737.19	98,965.97	57,214.16
运输设备	-	-	-
办公及其他设备	43.36	-	-
四、账面价值合计	18,302,398.79	15,313,201.60	8,445,207.29
房屋及建筑物	1,286,323.40	1,116,087.41	810,732.57
机器设备	16,928,658.15	14,128,962.81	7,593,224.65
运输设备	1,014.66	753.75	517.36
办公及其他设备	86,402.59	67,397.63	40,732.70

2) 固定资产变动分析

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 8,445,207.29 万元、15,313,201.60 万元和 18,302,398.79 万元，固定资产的增加主要系机器设备增加所致。报告期内公司产能、收入规模持续增长，为适应业务的快速增长，公司设备相应增加。

3) 固定资产减值分析

报告期各期末，公司固定资产减值准备累计余额分别为 57,214.16 万元、98,965.97

万元和 121,780.54 万元。公司定期对包含与 DRAM 制造相关的固定资产等长期资产按照资产组进行减值测试，或结合公司产线升级改造等对固定资产按照单项进行减值测试，报告期各期末，根据减值测试结果，公司对相关长期资产计提相应的减值准备。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合肥一期生产线	398,591.13	508,467.58	397,642.88
合肥二期生产线	555,985.54	2,017,504.72	3,053,416.00
北京生产线	1,199,628.56	1,541,066.32	1,662,776.71
其他	1,024,756.95	53,830.24	36,419.41
合计	3,178,962.17	4,120,868.87	5,150,255.01

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 5,150,255.01 万元、4,120,868.87 万元和 3,178,962.17 万元，主要由合肥一期生产线、合肥二期生产线、北京生产线等构成。报告期内，公司持续进行产能建设及产品升级迭代，DRAM 产品产销规模持续增长，为适应业务的快速增长，公司持续推进产线建设及改造。

报告期内，公司主要在建工程变动情况如下：

单位：万元

2025 年度					
项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	期末余额
合肥一期生产线	508,467.58	357,582.22	467,458.67	-	398,591.13
合肥二期生产线	2,017,504.72	1,233,480.36	2,694,999.55	-	555,985.54
北京生产线	1,541,066.32	1,697,604.16	2,039,041.92	-	1,199,628.56
2024 年度					
项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	期末余额
合肥一期生产线	397,642.88	752,793.18	641,968.49	-	508,467.58
合肥二期生产线	3,053,416.00	3,626,544.46	4,662,455.74	-	2,017,504.72
北京生产线	1,662,776.71	2,984,726.43	3,106,436.82	-	1,541,066.32
2023 年度					
项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期其他减少	期末余额
合肥一期生产线	1,051,117.77	527,713.71	1,181,188.60	-	397,642.88
合肥二期生产线	827,382.04	3,147,919.32	921,885.36	-	3,053,416.00

北京生产线	758,963.12	1,503,878.32	600,064.73	-	1,662,776.71

报告期各期末，发行人主要在建工程均处于正常建设中，不存在长期停工或项目延期较长的情形，不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	25,042.55	21,745.73	24,657.31
房屋建筑物	12,403.02	14,337.77	17,249.36
专有云设备	12,231.76	7,407.96	7,407.96
土地使用权	407.78	-	-
二、累计折旧合计	12,706.92	9,691.25	9,482.56
房屋建筑物	7,065.25	6,472.66	7,861.80
专有云设备	5,488.75	3,218.59	1,620.76
土地使用权	152.92	-	-
三、账面价值合计	12,335.64	12,054.48	15,174.75
房屋建筑物	5,337.77	7,865.11	9,387.55
专有云设备	6,743.00	4,189.37	5,787.20
土地使用权	254.86	-	-

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 15,174.75 万元、12,054.48 万元和 12,335.64 万元，占非流动资产的比例分别为 0.10%、0.06%和 0.05%，包括公司租赁的房屋建筑物、专有云设备和土地使用权。

(4) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	1,044,105.31	964,281.71	782,974.85
土地使用权	164,911.00	101,134.52	100,618.53
软件	131,799.32	115,540.68	124,172.90
专利权	5,447.49	5,447.49	5,357.93
非专利技术	741,947.50	742,159.01	552,825.48

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
二、累计摊销合计	616,349.57	448,940.52	337,656.69
土地使用权	9,892.23	6,724.96	4,620.08
软件	76,179.43	47,390.32	54,093.59
专利权	5,447.49	4,864.27	3,892.93
非专利技术	524,830.41	389,960.96	275,050.08
三、账面价值合计	427,755.74	515,341.19	445,318.15
土地使用权	155,018.76	94,409.56	95,998.45
软件	55,619.89	68,150.37	70,079.30
专利权	-	583.22	1,465.00
非专利技术	217,117.08	352,198.04	277,775.40

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 445,318.15 万元、515,341.19 万元和 427,755.74 万元，占非流动资产的比例分别为 3.06%、2.53%和 1.89%。公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权和非专利技术，其中非专利技术账面价值占比最高，主要为公司内部制程工艺研发项目资本化形成的专有技术。

2024 年末，公司无形资产账面价值较 2023 年末增加，主要系公司第四代工艺技术平台及相关产品研发项目完成开发，相关的开发支出 188,400.79 万元转入无形资产所致。2025 年末，公司无形资产账面价值较上年减少，主要系非专利技术摊销所致。

报告期各期末，公司无形资产状况良好，期末不存在减值迹象，故未计提减值准备。

（5）开发支出

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对符合资本化条件的研发项目进行了资本化处理。报告期各期，公司满足资本化条件的研发支出分别为 15,000.00 万元、173,400.78 万元和 0 万元，主要涉及第四代工艺技术平台及相关产品研发项目。

报告期各期末，公司开发支出账面金额为 15,000.00 万元、0 万元和 0 万元，主要由职工薪酬、研发材料费、测试服务费、折旧摊销费等内容构成。2024 年末账面金额为 0 万元，主要系涉及研发支出资本化的项目在当期末前已结项，对应的开发支出转入无形资产。2025 年末，发行人相关研发项目尚未符合资本化标准。

报告期内，发行人研发支出满足资本化相关条件的具体情况如下表所示：

资本化条件	发行人实际情况	是否符合

资本化条件	发行人实际情况	是否符合
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性	研究阶段流片验证及相关测试的完成标志着产品物理结构完备性及电性功能得以验证，工艺及产品设计已基本定型，并满足一定的良率要求。经技术可行性的评估，发行人第四代工艺技术平台及相关产品研发项目具有较高的技术可行性。	符合
具有完成该无形资产并使用或出售的意图	发行人致力于成为技术领先和商业成功的半导体芯片存储公司，报告期内主要从事第四代工艺技术平台以及更高工艺技术平台的研究开发，已实现 DRAM 产品的生产和销售，后续还会有其他迭代产品的研发、生产和销售，具有完成相关无形资产并使用的意图。	符合
无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性	发行人第四代工艺技术平台的研发有利于进一步提升发行人的市场竞争力，相关产品在研发时具备广阔的市场空间，发行人已完成相关工艺技术平台及产品的研发过程，经验证相关产品符合市场需求，未来可以产生经济利益。	符合
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产	根据发行人对于相关研发项目的财务预算、技术和人才储备及研究经验积累，发行人有足够的资源、能力完成上述项目开发。	符合
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	发行人建立了相关研发项目管理制度及财务核算制度，能够对开发阶段的支出进行有效控制、归集和计量。	符合

报告期内，集成电路行业中的中微公司、三安光电、海光信息等公司亦存在研发支出资本化情况，相关信息具体如下：

名称	研究阶段及开发阶段的划分标准
中微公司	试制样机初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，予以资本化。
三安光电	对开发活动实行项目管理，填写《实验申请单》申报、批准，确定项目预算，设置项目编号、项目负责人、项目费用供会计部门进行会计处理。并且以项目的立项申请批准为界限将研发项目分成研究与开发阶段，同时作为会计上核算计入研发费用或开发支出的划分点；本公司在开发阶段结束之后，会形成结案报告，将其转入无形资产中的专利或专有技术。
海光信息	在研发项目立项时，根据项目性质，在大类上进行判断分类，区分为“技术研究类”和“开发类”两大类，其中“技术研究类”项目对应关键技术研究，于相关支出发生时计入研发费用；对于开发类项目，组织评审专家组进行资本化评审，形成《资本化评审报告》。对于不能同时满足资本化五个条件的项目，即“技术或产品预研（技术的开发设计与仿真验证）”，进行费用化处理；对于满足资本化条件的开发类项目，即“芯片产品的设计与实现技术”，进行资本化处理。
发行人	根据公司工艺技术平台的开发路径，研发项目的开发周期区分为研究阶段和开发阶段。其中，研究阶段包括概念、计划、设计及流片阶段，开发阶段包括工程验证阶段和客户验证阶段。按照公司研发费用资本化核算制度，在完成项目研究进入开发阶段时，对满足资本化条件的费用进行资本化处理。发行人以取得实验产品的外部检测报告以及内部技术专家团队完成对技术平台技术可行性的综合评估作为研发项目开始资本化的时点。

信息来源：上市公司公告。

与集成电路行业中的中微公司、三安光电、海光信息等公司相比，公司研发支出资本化的会计处理不存在显著差异。报告期内，公司制定了相关内部控制及会计核算等制度文件，对研发各阶段内部控制做出明确规划和建设，公司针对研发活动在研发规划、研发立项、过程管理、费用归集、项目评审等方面建立了严格的内控制度。公司按照相关内控制度要求分研发项目进行研发费用核算，按照项目管理要求区分研究阶段和开发阶段，对是否符合资本化条件进行评审，对相关项目开发阶段符合资本化条件的研发费用进行资本化处理。研发支出资本化已按公司相关内控制度执行，并在报告期内保持一致。报告期各期末，公司开发支出形成的资产状况良好，未计提减值准备。

（6）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
探针卡及光罩掩模板	80,552.71	65,275.79	18,187.60
硅片承载盒	21,688.80	24,475.82	10,151.44
其他	4,162.64	4,130.06	3,684.37
减：减值准备	5,834.59	6,568.43	-
合计	100,569.56	87,313.24	32,023.41

报告期各期末，公司长期待摊费用期末余额分别为 32,023.41 万元、87,313.24 万元及 100,569.56 万元，主要系探针卡及光罩掩模板和硅片承载盒的待摊销费用。报告期各期末，探针卡及光罩掩模板的摊销费用大幅增长，主要系每款产品均有配套的光罩和探针卡，随公司经营规模扩大和产品品类的增加相关待摊销费用大幅增长。2024 年末及 2025 年末，公司针对长期待摊费用分别计提 6,568.43 万元、5,834.59 万元减值准备，主要为根据生产及经营计划需求，对不再使用的光罩及探针卡计提的减值准备。

（7）长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产

1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资主要为对启航恒鑫、上海芯展科技有限公司、公司 D、公司 F 的投资，公司对相关企业能够施加重大影响，按联营企业投资进行核算。报告期各期末，公司长期股权投资账面金额分别为 0 万元、29,985.55 万元和 151,954.06

万元。

2) 其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资为对公司 H、公司 Q 的投资，公司对其投资并非以交易为目的，将对其投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。报告期各期末，公司其他权益工具投资账面金额分别为 13,600.00 万元、27,607.77 万元和 46,641.25 万元。

3) 其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产主要为公司对股权投资基金进行的投资，公司均作为有限合伙人，不执行合伙事务，将相关投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。报告期各期末，公司其他非流动金融资产的账面金额分别为 20,272.11 万元、107,923.14 万元和 239,831.32 万元。

(8) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付设备工程类款项	119,455.53	144,076.32	393,805.33
其他	-	100.00	-
合计	119,455.53	144,176.32	393,805.33

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 393,805.33 万元、144,176.32 万元和 119,455.53 万元，主要为预付设备工程类款项。报告期内公司预付设备工程类款项整体呈现下降趋势，主要系新购买的设备逐渐到货，同时原有规划工厂产能逐渐趋于满产，从而减少了采购新设备的相关预付款项。

(二) 资产周转能力分析

1、应收账款周转能力

报告期各期，公司应收账款周转率与可比公司比较如下：

单位：次/年

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
三星电子	7.01	7.42	7.09

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
SK 海力士	6.22	6.74	5.55
美光科技	5.94	6.73	4.56
南亚科技	6.44	7.30	6.24
台积电	14.18	12.24	10.01
中芯国际	14.74	17.96	10.87
华润微	6.69	7.31	8.46
平均值	8.75	9.39	7.54
发行人	36.49	21.44	34.63

注：数据来源为上市公司定期报告。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 34.63、21.44 和 36.49，高于其他可比公司，主要系公司经销收入占比较高，相比直销客户而言，公司与经销商客户交易时主要以先款后货方式结算，使得公司期末应收账款规模相对较小，资金回笼速度较快。

2、存货周转能力

报告期各期，公司存货周转率与可比公司比较如下：

单位：次/年

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
三星电子	3.51	3.22	3.12
SK 海力士	2.63	2.26	2.02
美光科技	2.61	2.04	2.01
台积电	5.30	4.68	4.11
中芯国际	2.00	2.07	1.99
华润微	3.28	3.21	3.11
平均值	3.22	2.91	2.73
发行人（转销前）	1.52	1.42	1.64
发行人	1.44	1.29	0.78

注 1：可比公司数据系以公告数据为基础计算。

注 2：转销前存货周转率为按不考虑存货跌价准备转销影响口径计算。

公司存货周转率与国际贸易环境影响下增加原材料备货、下游消费电子需求景气度相关，并受存货跌价准备转销影响。报告期内，不考虑存货跌价准备转销的影响，公司存货周转率分别为 1.64、1.42 和 1.52。2024 年公司存货周转率相对较低，主要由于当年度均有新产线于年内投产，期末在产品余额大幅增长，从而导致存货周转率下降。

报告期内，公司存货周转率低于可比公司平均值，主要原因系报告期内，公司始终处于产能快速爬坡期，而非全年产能稳定且满产状态，生产规模持续增长，使得期末在产品余额大幅增长。

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债结构分析

1、负债的构成及变化

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	5,284,235.66	28.93%	5,719,079.76	34.18%	3,165,279.63	24.80%
非流动负债	12,984,262.62	71.07%	11,015,115.60	65.82%	9,599,015.37	75.20%
合计	18,268,498.28	100.00%	16,734,195.36	100.00%	12,764,295.00	100.00%

公司负债以非流动负债为主，报告期各期末非流动负债分别为 9,599,015.37 万元、11,015,115.60 万元和 12,984,262.62 万元，占总负债的比例分别为 75.20%、65.82%和 71.07%。随着公司业务规模的不断扩大，公司总负债逐年增长。

2、流动负债分析

公司流动负债由短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债组成。报告期各期末，公司流动负债的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	967,590.05	18.31%	179,648.22	3.14%	199,922.48	6.32%
衍生金融负债	1,163.54	0.02%	448.76	0.01%	-	-
应付票据	201,497.24	3.81%	161,666.78	2.83%	66,749.37	2.11%
应付账款	668,671.86	12.65%	465,827.56	8.15%	365,932.96	11.56%
合同负债	44,717.74	0.85%	14,122.88	0.25%	11,655.56	0.37%
应付职工薪酬	331,972.88	6.28%	108,750.29	1.90%	94,054.17	2.97%
应交税费	78,314.30	1.48%	9,784.47	0.17%	7,303.56	0.23%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应付款	1,193,537.99	22.59%	1,648,960.71	28.83%	1,487,958.61	47.01%
一年内到期的非流动负债	1,796,770.06	34.00%	3,129,870.09	54.73%	931,702.92	29.44%
合计	5,284,235.66	100.00%	5,719,079.76	100.00%	3,165,279.63	100.00%

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 3,165,279.63 万元、5,719,079.76 万元和 5,284,235.66 万元。公司流动负债主要为短期借款、应付账款、其他应付款及一年内到期的非流动负债等，报告期各期末上述四项占流动负债的比例合计分别为 94.32%、94.85% 和 87.55%。

公司流动负债各主要项目构成及变动情况如下：

（1）短期借款

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	967,590.05	179,648.22	199,922.48
合计	967,590.05	179,648.22	199,922.48

报告期各期末，公司短期借款分别为 199,922.48 万元、179,648.22 万元和 967,590.05 万元，占流动负债比例分别为 6.32%、3.14%和 18.31%，借款性质为信用借款。2025 年末，公司短期借款随着公司整体经营规模的持续扩大及运营资金需求的增加而增加。

（2）衍生金融负债

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
远期外汇合约	36.19	448.76	-
外汇掉期合约	1,127.35	-	-
合计	1,163.54	448.76	-

报告期各期末，公司衍生金融负债分别为 0 万元、448.76 万元和 1,163.54 万元，由远期外汇合约和外汇掉期合约构成。

（3）应付票据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	201,497.24	161,666.78	66,749.37

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合计	201,497.24	161,666.78	66,749.37

报告期各期末，公司应付票据分别为 66,749.37 万元、161,666.78 万元和 201,497.24 万元，均为一年内到期的银行承兑汇票。

(4) 应付账款

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付经营材料款项	306,999.48	259,187.67	183,795.90
应付封测费用	157,633.71	69,369.17	72,336.09
应付其他经营款项	204,038.68	137,270.72	109,800.98
合计	668,671.86	465,827.56	365,932.96

报告期各期末，公司应付账款分别为 365,932.96 万元、465,827.56 万元和 668,671.86 万元，占流动负债比例分别为 11.56%、8.15%和 12.65%。公司应付账款主要为应付经营材料款项。报告期各期末，随着公司经营规模的扩大，公司对供应商的应付账款规模逐步增长。

(5) 合同负债

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
销售产品预收款	44,636.85	13,893.02	5,635.41
销售房产预收款	-	229.86	6,020.15
预收其他	80.89	-	-
合计	44,717.74	14,122.88	11,655.56

报告期各期末，公司合同负债分别为 11,655.56 万元、14,122.88 万元和 44,717.74 万元，占流动负债比例分别为 0.37%、0.25%和 0.85%，包括销售产品及销售房产的预收款项等。

(6) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	330,014.14	107,547.34	93,277.23

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
离职后福利-设定提存计划	1,958.73	1,202.95	776.94
合计	331,972.88	108,750.29	94,054.17

报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为 94,054.17 万元、108,750.29 万元和 331,972.88 万元，占流动负债的比例分别为 2.97%、1.90%和 6.28%。报告期内，公司应付职工薪酬主要由短期薪酬构成，呈持续增长趋势。2025 年末，公司短期薪酬增加较大主要系随着经营规模和经营业绩的持续增长，公司员工人数和计提的年终奖有所增加。

（7）应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体构成情况如下：

单位：万元

税种	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
企业所得税	52,455.06	75.08	43.93
代扣代缴个人所得税	5,062.55	3,682.59	3,607.74
印花税	5,577.80	3,014.32	1,665.74
房产税	2,104.03	1,534.54	1,468.27
土地使用税	132.40	117.87	117.87
增值税	7,256.38	48.20	98.25
其他	5,726.07	1,311.87	301.76
合计	78,314.30	9,784.47	7,303.56

报告期各期末，公司应交税费金额分别为 7,303.56 万元、9,784.47 万元和 78,314.30 万元，占流动负债的比例分别为 0.23%、0.17%和 1.48%，主要包括企业所得税、代扣代缴个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、增值税等。

（8）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付设备、工程款	1,185,216.90	1,526,375.11	1,484,425.20
合同保证金	1,204.27	119,002.80	680.78
其他	7,116.82	3,582.80	2,852.64

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合计	1,193,537.99	1,648,960.71	1,487,958.61

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为 1,487,958.61 万元、1,648,960.71 万元和 1,193,537.99 万元，占流动负债比例分别为 47.01%、28.83%和 22.59%，主要为应付设备、工程采购款。

(9) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,539,878.48	3,094,717.52	911,254.58
一年内到期的长期应付款	250,189.77	30,055.55	15,568.71
一年内到期的租赁负债	6,701.81	5,097.02	4,879.62
合计	1,796,770.06	3,129,870.09	931,702.92

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 931,702.92 万元、3,129,870.09 万元和 1,796,770.06 万元，占流动负债的比例分别为 29.44%、54.73%和 34.00%，一年内到期的非流动负债主要由一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款、一年内到期的租赁负债构成。

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	11,882,534.27	91.51%	9,599,381.07	87.15%	8,982,317.63	93.58%
租赁负债	6,363.45	0.05%	7,045.80	0.06%	10,205.06	0.11%
长期应付款	97,525.42	0.75%	152,564.26	1.39%	182,085.58	1.90%
递延收益	457,080.92	3.52%	359,802.20	3.27%	255,382.78	2.66%
递延所得税负债	6,804.09	0.05%	-	-	-	-
其他非流动负债	533,954.48	4.11%	896,322.27	8.14%	169,024.31	1.76%
合计	12,984,262.62	100.00%	11,015,115.60	100.00%	9,599,015.37	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 9,599,015.37 万元、11,015,115.60 万元

和 12,984,262.62 万元。公司非流动负债主要由长期借款等组成，报告期各期末长期借款占非流动负债的比例分别为 93.58%、87.15%和 91.51%。

公司非流动负债各主要项目构成及变动情况如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	3,529,597.41	6,684,780.30	4,744,114.63
抵押借款	9,892,815.34	6,009,318.29	5,149,457.58
小计	13,422,412.75	12,694,098.59	9,893,572.21
减：一年内到期的长期借款	1,539,878.48	3,094,717.52	911,254.58
一年后到期的长期借款	11,882,534.27	9,599,381.07	8,982,317.63

报告期各期末，公司长期借款分别为 8,982,317.63 万元、9,599,381.07 万元和 11,882,534.27 万元，占非流动负债比例分别为 93.58%、87.15%和 91.51%。报告期内，公司信用借款及抵押借款规模快速增长，主要系随着业务及资产规模快速扩张，公司资金需求量较大，新增银团借款所致。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付租赁款	13,065.26	12,142.82	15,084.69
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债	6,701.81	5,097.02	4,879.62
合计	6,363.45	7,045.80	10,205.06

报告期各期末，公司租赁负债分别为 10,205.06 万元、7,045.80 万元和 6,363.45 万元。2023 年末，公司租赁负债较大主要系公司新设立子公司和业务规模扩张导致的房屋租赁增加。

（3）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付售后租回融资借款	347,715.19	182,619.81	197,654.30
减：一年内到期的应付售后租回融资借款	250,189.77	30,055.55	15,568.71
合计	97,525.42	152,564.26	182,085.58

报告期各期末，公司长期应付款分别为 182,085.58 万元、152,564.26 万元和 97,525.42 万元，占非流动负债的比例分别为 1.90%、1.39%和 0.75%，均为应付售后租回租赁款。

（4）其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债金额及具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项	533,954.48	416,322.27	169,024.31
长鑫集电预收投资人的投资款项	-	480,000.00	-
合计	533,954.48	896,322.27	169,024.31

报告期各期末，公司其他非流动负债分别为 169,024.31 万元、896,322.27 万元和 533,954.48 万元，公司应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项主要为安徽新一代其他投资人在安徽新一代中享有的权益及启航创芯其他投资人在启航创芯中享有的权益。

（二）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.10	1.19	1.50
速动比率（倍）	1.56	0.86	1.16
资产负债率（母公司）	21.82%	10.26%	8.69%
资产负债率（合并）	54.24%	61.61%	66.22%
财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	3,777,677.64	984,453.98	-476,216.89

利息保障倍数（倍）	3.43	-1.79	-6.18

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.50 倍、1.19 倍和 2.10 倍，速动比率分别为 1.16 倍、0.86 倍和 1.56 倍。2024 年末，公司流动比率和速动比率有所下降，主要系公司产能建设、经营规模快速增长带来的应付账款、其他应付款（应付设备、工程采购款等）以及一年内到期的非流动负债增长较快所致，2025 年末，公司流动负债随着一年内到期的长期借款的减少而显著下降，流动比率和速动比率有所回升。公司在保障流动性的前提下持续进行生产线投入，其流动比率和速动比率的变化趋势符合公司报告期内产能建设的实际情况。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 66.22%、61.61%和 54.24%，主要系公司经营规模持续快速扩张，不断扩大厂房建设及设备采购，公司采用债务融资等方式满足自身资金需求，导致资产负债率较高。

报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为-476,216.89 万元、984,453.98 万元和 3,777,677.64 万元。2024 年及 2025 年公司经营业绩显著回升，主要受益于 DRAM 市场整体回暖和公司产品结构持续优化，以及工艺迭代和精益生产管理等因素的积极影响。

2、与可比公司的对比分析

报告期内，公司与可比公司的流动比率、速动比率、资产负债率对比情况如下：

公司简称	流动比率		
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
三星电子	2.33	2.43	2.59
SK 海力士	1.86	1.69	1.45
美光科技	2.52	2.64	4.46
南亚科技	5.71	3.29	4.80
台积电	2.62	2.44	2.40
中芯国际	2.36	1.73	1.84
华润微	2.95	3.23	3.77
平均值	2.91	2.49	3.04
发行人	2.10	1.19	1.50
公司简称	速动比率		
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
三星电子	1.83	1.88	1.91

SK 海力士	1.48	1.16	0.81
美光科技	1.79	1.68	2.70
南亚科技	4.27	2.22	3.42
台积电	2.42	2.21	2.13
中芯国际	1.81	1.38	1.47
华润微	2.50	2.72	3.31
平均值	2.30	1.89	2.25
发行人	1.56	0.86	1.16
公司简称	资产负债率（合并）		
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
三星电子	23.04%	21.83%	20.23%
SK 海力士	31.48%	38.33%	46.67%
美光科技	34.58%	34.98%	31.34%
南亚科技	18.19%	20.15%	13.22%
台积电	31.16%	35.39%	37.04%
中芯国际	33.00%	35.17%	35.45%
华润微	18.71%	16.53%	19.12%
平均值	27.17%	28.91%	29.01%
发行人	54.24%	61.61%	66.22%

注：可比公司财务数据来自于定期报告。

报告期内，公司的流动比率和速动比率低于可比公司平均水平，与 SK 海力士、中芯国际相近，资产负债率高于可比公司平均水平，主要系：（1）公司属于技术和资金密集型行业且目前处于产能快速建设及爬坡阶段，需持续加大长期资产投资，而可比公司目前大多处于成熟期，产能建设较稳定；（2）公司尚未上市，主要通过借款等债务融资方式筹集资金，融资渠道相对有限，因而形成了较大金额的长期借款，资产负债率较高，而可比公司均为上市公司，融资渠道丰富，流动性相对较高，其资本结构及财务状况更加优化，符合实际现状。

3、影响偿债能力的其他因素分析

报告期内，公司整体资金较为充足，银行资信状况良好，无违约情况发生；公司经营正常，相应技术平台生产线将为公司带来稳定的大额经营性现金净流入；公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需要披露的或有负债，也不存在重大表外融资情况。综上，公司不存在偿债风险。

（三）报告期内股利分配的具体实施情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

（四）现金流量分析

报告期各期，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07
投资活动产生的现金流量净额	-8,682,274.40	-7,241,524.69	-4,400,152.79
筹资活动产生的现金流量净额	4,612,067.62	7,721,418.21	5,080,684.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,815.33	-30,078.67	-20,245.41
现金及现金等价物净增加额	-471,040.78	1,139,560.70	-66,875.28

1、经营活动现金流量分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	6,560,606.17	2,371,037.27	899,588.85
收到的税费返还	428,641.12	476,178.64	355,601.41
收到其他与经营活动有关的现金	416,405.07	562,783.77	285,026.49
经营活动现金流入小计	7,405,652.36	3,409,999.68	1,540,216.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,681,416.43	2,180,840.70	1,622,174.03
支付给职工以及为职工支付的现金	674,424.62	393,730.88	412,910.04
支付的各项税费	32,933.62	18,703.04	10,787.65
支付其他与经营活动有关的现金	364,896.37	126,979.20	221,507.10
经营活动现金流出小计	3,753,671.03	2,720,253.83	2,267,378.82
经营活动产生的现金流量净额	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-727,162.07 万元、689,745.85 万元和 3,651,981.33 万元。2023 年，公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司处于产能快速爬坡阶段，持续扩产使得购买商品、接受劳务支付的现金支出较大，而规模效益尚未显现。2024 年及 2025 年，随着 DRAM 市场逐步回暖、公司产品结构优化，以及公司产能、产销规模持续提升，公司收入快速增长，销售商品、提供劳务收到的现金显著增长，经营活动产生的现金流量已由负转正。

报告期各期，公司将净利润(亏损)调节为经营活动的现金流量的过程如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润（亏损）	714,423.71	-905,100.04	-1,922,488.63
加：资产减值损失	75,466.01	246,412.43	1,177,927.90
信用减值损失（利得）	-88.63	867.36	284.16
固定资产折旧	2,468,025.21	1,445,642.36	1,053,081.08
使用权资产折旧	7,408.17	5,103.02	5,525.80
无形资产摊销	167,542.57	134,689.41	133,120.19
长期待摊费用摊销	65,670.19	36,968.60	20,297.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-1,214.48	-431.91	-2.62
固定资产报废损失	2,693.59	9,231.73	680.70
财务费用	337,690.26	305,952.89	268,001.41
递延所得税负债的增加	3,193.77	-	-
公允价值变动损失	-37,153.14	17,761.77	34.37
投资损失	6,812.27	-10,494.34	1,788.21
以权益结算的股份支付费用	599,438.41	232,253.09	208,250.28
存货的增加	-1,086,254.88	-1,025,881.90	-1,531,965.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	-230,918.83	-142,309.66	-216,568.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	559,247.11	339,081.05	74,870.77
经营活动产生的现金流量净额	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润（亏损）的差异主要系：

（1）公司处于持续发展阶段，产能快速释放，公司应收账款等经营性应收项目和应付账款等经营性应付项目金额波动较大；（2）公司存货规模不断扩大，占用了部分经营性资金；（3）公司固定资产投入规模较大，相应折旧费用增加较多。

2、投资活动现金流量分析

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资所收到的现金	133.64	-	-
取得投资收益收到的现金	19,223.29	11,873.78	10,042.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,530.17	1,584.64	1,021.31

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收到其他与投资活动有关的现金	10,121,370.81	-	9,048.09
投资活动现金流入小计	10,144,257.91	13,458.42	20,111.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,973,920.33	7,122,968.11	4,365,833.98
投资支付的现金	243,449.56	132,015.00	33,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,609,162.41	-	20,830.52
投资活动现金流出小计	18,826,532.31	7,254,983.11	4,420,264.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,682,274.40	-7,241,524.69	-4,400,152.79

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,400,152.79 万元、-7,241,524.69 万元和-8,682,274.40 万元。公司投资活动现金流出较多，各期分别为4,420,264.50 万元、7,254,983.11 万元和 18,826,532.31 万元，主要系公司为扩大产能，持续进行长期资产投入，导致固定资产、无形资产和其他长期资产等方面的支出相应较高。

3、筹资活动现金流量分析

报告期各期，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	3,179,485.00	4,586,724.26	1,803,931.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,493,884.36	3,506,724.26	1,790,259.69
取得借款收到的现金	7,550,708.74	3,806,179.18	3,998,955.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,640.84	709,200.45	370,299.55
筹资活动现金流入小计	10,995,834.57	9,102,103.89	6,173,186.14
偿还债务支付的现金	6,022,988.93	1,030,164.54	811,320.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,692.88	320,351.53	270,627.03
支付其他与筹资活动有关的现金	53,085.14	30,169.62	10,553.82
筹资活动现金流出小计	6,383,766.95	1,380,685.68	1,092,501.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,612,067.62	7,721,418.21	5,080,684.99

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,080,684.99 万元、7,721,418.21 万元和 4,612,067.62 万元。公司筹资活动现金流入较多，各期分别为6,173,186.14 万元、9,102,103.89 万元和 10,995,834.57 万元，主要系通过吸收投资和取得借款等方式筹措资金，用于日常经营和建设厂房、购置机器设备等活动所致。公司筹

资活动现金流出各期分别为 1,092,501.15 万元、1,380,685.68 万元和 6,383,766.95 万元，其中 2025 年度筹资活动现金流出金额较大，主要系偿还债务支付的现金金额较高。

（五）资本性支出分析

1、报告期内资本性支出情况

报告期内，发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 4,365,833.98 万元、7,122,968.11 万元和 4,973,920.33 万元，主要用于建设厂房、购置生产设备等。公司重大资本性支出的详细情况参见本节之“十二、重大资本性支出、重大资产业务重组等事项”之“（一）重大投资或重大资本性支出”。

2、报告期末及未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（六）流动性风险分析

报告期各期末，公司流动性相关指标如下：

财务指标	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
流动比率（倍）	2.10	1.19	1.50
资产负债率（合并）	54.24%	61.61%	66.22%
流动负债占总负债比例	28.93%	34.18%	24.80%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	3,651,981.33	689,745.85	-727,162.07
货币资金（万元）	5,199,022.02	4,269,868.37	3,137,354.72

报告期内，公司流动资产以货币资金为主，公司通过股权及债权融资等方式积累了大量货币资金，2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于公司尚处于快速发展阶段，销售规模相对有限，同时，报告期内公司采购原材料等现金支出金额较高，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较大。2024 年至 2025 年，随着公司收入规模快速提升，产品结构持续优化及精益生产管理，公司经营活动产生的现金流量净额转正并实现快速增长。截至报告期末，公司尚有货币资金余额 5,199,022.02 万元，为公司资金流动性提供支持。

报告期内，公司负债结构以非流动负债为主，公司资产负债率持续下降，流动比率呈先下降后上升趋势。2024 年，公司流动比率下降，主要原因为公司业务快速发展，

流动资产增长幅度整体慢于流动负债，但整体而言公司短期偿债能力仍旧较好，发生短期流动性风险的概率较低；公司资信状况良好，不存在逾期债务未清偿的情况；公司不存在影响现金流量的重要事件或承诺事项，现金情况良好，不存在流动性已经或可能产生重大不利变化的情形或风险趋势。

由于公司处于业务快速发展期，业务规模持续增长，考虑到 DRAM 行业存在的研发投入高、市场周期性影响显著等特征，公司不断完善流动性风险管理制度，进一步加强对货币资金来源及用途的管理和对存货水平的有效管控，在保证公司业务稳步发展的同时，逐步改善现金流量水平；同时，公司将进一步加快新产品研发，优化产品结构，通过技术持续升级保障盈利能力，增强抗流动性风险的能力。

（七）持续经营能力分析

报告期内，发行人以 IDM 模式经营，自设立以来一直致力于 DRAM 产品的研发、设计、生产及销售，其主营业务未发生重大变化。公司现已成为国内 DRAM 行业规模最大、技术最先进的企业，已具备一定的规模效应并持续进行技术迭代和产能规模的快速发展。

报告期内，发行人无实际控制人，管理层和核心技术人员保持稳定；发行人资产完整，业务、人员、财务、机构独立，报告期内不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。截至本招股说明书签署日，发行人不存在重大权属纠纷、重大偿债风险和重大担保、诉讼、仲裁等事项。

报告期内，发行人归属于母公司股东的净利润分别为-1,633,977.72 万元、-714,488.72 万元和 187,485.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司存在累计未弥补亏损。公司存在累计未弥补亏损的具体情况详见本节之“九、经营成果分析”之“（八）存在累计未弥补亏损的情况”。

综上所述，公司管理层经对公司经营情况进行审慎评估后认为，在可预见的未来，公司能够保持良好的持续经营能力，不存在可能影响公司未来持续经营的重大不利变化。公司持续经营能力的相关风险具体参考本招股说明书“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”。

十二、重大资本性支出、重大资产业务重组等事项

（一）重大投资或重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4,365,833.98万元、7,122,968.11万元和4,973,920.33万元，主要用于建设厂房、购置生产设备等。截至报告期末，公司由已签订的长期资产购买合同或订单尚未履行部分产生的购建长期资产承诺为1,712,939.00万元。通过持续的资本性支出，公司的产能持续扩充，研发和技术水平持续提升，为公司经营业绩的快速增长奠定了坚实基础，公司市场竞争力得以持续巩固和强化。

（二）重大资产业务重组

报告期内，公司不存在重大资产业务重组。

十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）重要承诺事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的承诺事项及其他重要事项。

（三）或有事项及其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的或有事项及其他重要事项。

十四、盈利预测报告

公司未编制盈利预测报告。

十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

（一）审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况持续向好，经营模式未发生重大变化；公司与主要客户、供应商合作情况良好，未出现重大不利变化；董事、高级管理人员与核心技术人员未发生重大变化；公司所处行业及市场发展情况良好，

未出现重大不利变化；在研产品的研发工作有序进行，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2026 年 1-3 月财务数据审阅情况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。德勤对发行人 2026 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2026 年 1-3 月的合并及母公司利润表，2026 年 1-3 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了无保留意见的《审阅报告》（德师报（阅）字（26）第 R00024 号）。

公司 2026 年 1-3 月经审阅的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	38,816,614.87	33,678,492.22	15.26%
负债总额	19,656,122.68	18,268,498.28	7.60%
所有者权益	19,160,492.19	15,409,993.94	24.34%
归属于母公司所有者权益	8,172,440.89	5,675,370.42	44.00%
项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月	同比变动幅度
营业收入	5,080,014.55	620,169.05	719.13%
营业利润	3,543,298.24	-283,061.42	1,351.78%
利润总额	3,543,428.53	-282,466.50	1,354.46%
净利润	3,301,152.51	-282,524.37	1,268.45%
息税折旧摊销前利润	4,373,337.84	398,650.45	997.04%
归属于母公司所有者的净利润	2,476,203.15	-155,902.79	1,688.30%
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	2,634,078.41	-139,118.16	1,993.41%
经营活动产生的现金流量净额	4,256,599.29	19,951.16	21,235.10%

注 1：2026 年 1-3 月财务数据已经发行人会计师审阅。

注 2：对于利润类指标为负时的变动幅度，以正值表示亏损金额收窄或利润转正。

1、财务状况分析

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额较 2025 年末增长 15.26%，主要由于随着 DRAM 行业价格的持续快速上升，公司经营活动产生的现金流量净额快速增加，货币资金和交易性金融资产规模大幅增长。公司负债总额存在小幅上升，所有者权益随着资产总额的增长而较 2025 年末增长 24.34%。

2、经营成果分析

2026 年 1-3 月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求，价格自 2025 年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势，同时，随着公司产销规模的持续增长、产品结构的持续优化，公司营业收入迅速增长，较 2025 年 1-3 月同比大幅增长 719.13%。得益于 2026 年一季度 DRAM 产品价格的快速上涨，公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。

3、现金流分析

2026 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额较 2025 年 1-3 月同比增长 21,235.10%，主要由于受 2026 年一季度 DRAM 产品价格的快速上涨影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金随着公司收入快速增长而大幅增加。

4、非经常性损益分析

公司 2026 年 1-3 月非经常性损益明细表如下：

单位：万元

非经常性损益明细	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,305.16	42.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-176,459.17	-21,196.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524.91	595.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,546.60	4,459.53
减：所得税影响额	4,321.42	-
少数股东权益影响额	4,471.34	686.16
合计	-157,875.26	-16,784.63

公司 2026 年 1-3 月非经常性损益绝对值较上年同期有所上升，主要来源于应付纳入合并范围的结构化主体的其他持有人的款项的公允价值变动损益等。

（三）2026 年 1-6 月业绩预计情况

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计 2026 年 1-6 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动幅度

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动幅度
营业收入	11,000,000 至 12,000,000	1,543,792.46	612.53%至 677.31%
净利润	6,600,000 至 7,500,000	-408,751.86	1,714.67%至 1,934.85%
归属于母公司所有者的净利润	5,000,000 至 5,700,000	-233,205.82	2,244.03%至 2,544.19%
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	5,200,000 至 5,800,000	-238,653.84	2,278.89%至 2,530.30%

注 1：2026 年 1-6 月的业绩预计情况未经发行人会计师审计或审阅，2025 年 1-6 月经营业绩为经发行人会计师审计数据。

注 2：对于利润类指标为负时的变动幅度，以正值表示亏损金额收窄或利润转正。

2026 年 1-6 月，随着 DRAM 行业产品价格的持续快速上涨，以及公司产销规模的持续增长、产品结构的不断优化，公司预计营业收入、净利润、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期均实现大幅增加。

上述 2026 年 1-6 月业绩预计仅为公司管理层对经营业绩的合理估计，未经发行人会计师审计或审阅，不构成对公司的盈利预测或业绩承诺。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金计划及投资项目概况

公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体情况如下表所示：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目	75.00	75.00	发行人子公司
2	DRAM存储器技术升级项目	180.00	130.00	发行人子公司
3	动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目	90.00	90.00	发行人
合计		345.00	295.00	-

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额等内容进行适当调整。

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（二）募集资金投向科技创新领域的具体安排

公司本次募集资金投资项目是基于业务发展阶段特点和技术研发创新要求对现有业务进行的扩充和延伸，是公司进一步提高技术研发实力的必然要求，也是公司持续深化工艺技术开发与积累、不断开拓前沿技术、提升核心竞争力的重要举措。

公司本次募集资金投资项目均属于科技创新领域，具体请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“十一、募集资金运用具体情况”。

（三）募集资金使用管理制度

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市规则》等规范性文件制定了《募集资金管理办法》，并经公司股东会审议通过。公司《募集资金管理办法》对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定；明确了公司募集资金专项存储制度，募集资金将严格按照规定存放于经董事会批准设立的专项

账户进行集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到位后规定时间内及时与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，按照有关规定对募集资金使用进行管理。

（四）募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响

本次募集资金投资项目均紧密围绕发行人主营业务展开，旨在实现生产线的技术升级改造、加快 DRAM 产能建设、完善产业链布局、提升技术研发水平、保持技术先进性、增强抗风险能力。本次募集资金投资项目的实施不会对发行人的独立性产生不利影响，实施后不会产生同业竞争。

二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性

（一）募集资金投资项目的必要性

1、精准把握行业发展的动态与方向，持续进行产品技术水平提升及迭代，保障业务持续发展

DRAM 作为支撑现代信息技术和数字信息产业发展的核心元件，其应用已深入数据中心、移动设备及终端、通信、智能制造等多个关键领域，随着新一代信息技术的发展，数据需求呈指数级增长，DRAM 产品的重要性愈发凸显，成为支撑算力提升与大规模数据处理的关键载体。站在全球 DRAM 市场角度，根据 Omdia 数据，全球 DRAM 市场规模有望从 2025 年的 1,505 亿美元增长至 2030 年的 5,710 亿美元，年均复合增长率为 30.56%，具有广阔的增长空间；站在中国 DRAM 市场角度，随着新一代信息技术的发展、汽车产业向智能化加速转型、5G 和物联网互联互通，为公司产品发展带来了历史性契机。

在不断变化的行业趋势下，计算与处理芯片性能持续跃进，对 DRAM 的性能提出了日益严苛的要求，推动其向更大存储密度、更快传输速率及更低功耗方向不断升级。在此背景下，持续推动产品与制程工艺的创新迭代、始终保持行业领先的技术水平，已成为在高度竞争的 DRAM 领域中维持生存与提升产品竞争力的核心要素。

为提升 DRAM 生产能力及产品研发制造工艺水平，公司亟需优化现有生产线，并投入资金以提升公司在相关领域的自主创新能力、研发及技术水平，保持公司生产工艺领先地位，并进一步提高公司抗风险能力；亦需在推动技术迭代的同时加快产能建设与升级，通过扩大生产规模提升公司的核心竞争力。

2、充分发挥产业链链主引领作用，有利于提升我国 DRAM 产业核心竞争力，并推动供应链本土化、多元化

根据 Yole 数据，2024 年中国 DRAM 市场规模约为 250 亿美元，占全球 DRAM 市场比例超过四分之一，为全球主流的 DRAM 消费大国，但中国在该领域长期高度依赖进口，且国产 DRAM 企业在顶尖技术积累、产能规模方面与业界龙头企业存在一定差距，因此 DRAM 本土厂商仍有广阔的发展空间，需要持续投入、加大投入加速产业突破。

DRAM 器件结构复杂、高难度工艺环节众多，对供应链上游的设备先进性和技术更新需求高，带动产业链上下游协同发展的作用明显。DRAM 存储每升级一代工艺，一般同时伴随着一定比例的设备更新，对于上下游的发展有显著的拉动作用。实施 DRAM 技术升级改造及前瞻技术与开发相关项目不仅能够补足我国行业短板，同时将带动一批相关产业迅猛发展，形成具有特色的 DRAM 存储器产业集群，形成联动互补的集聚效应，为我国 DRAM 产业核心竞争力的提升提供有力支撑。

公司作为国内 DRAM 产业龙头，对于我国半导体产业的发展具有举足轻重的作用。通过募投项目的实施，将开展本土及新型设备、材料、零部件等验证开发，促进产业链、供应链本土化、多元化，增强公司抗风险能力。

3、公司亟需就前瞻性技术持续进行研发，保持公司技术领先性，进一步提高公司核心竞争力及抗风险能力

持续推动产品与制程工艺的迭代，并维持行业技术领先地位，是在 DRAM 领域保持竞争力与实现长远发展的核心前提。DRAM 技术门槛极高、涉及专业领域很广，覆盖产品设计、工艺技术、封装测试、模组设计与制造等多个环节，涉及光刻、刻蚀、薄膜沉积、扩散及离子注入、化学清洗、化学机械抛光等数百道工序，只有坚持不懈的持续研发，不断迭代工艺技术，使得每一代新产品持续迭代更大存储密度、更低功耗及更快读写速度，提升产品竞争力，以满足市场需求，增加公司的抗风险能力。

因此，公司亟需就前瞻性技术持续进行研发，保持公司技术领先性的同时，有利于公司更快的推出满足市场需求、性能更好、竞争力更强的产品，以增强公司的核心竞争力及抗风险能力。

（二）募集资金投资项目的可行性

1、公司充足的技术储备和量产经验、高质量的研发人才队伍，为项目顺利实施奠定坚实基础、提供有力支撑

公司始终坚持自主研发道路，并通过跳代研发加快技术创新，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产，以及从 DDR4、LPDDR4X 到 DDR5、LPDDR5/5X 的产品覆盖和代际演进，目前核心产品及工艺技术已达到国际先进水平。经过多年发展，公司已在 DRAM 产品设计、制造工艺、封装测试、模组设计与应用等各业务环节构建了完善的核心技术体系，同时形成了全面的自主知识产权积累，并在技术快速迭代和产业化方面积累了丰富的经验，同时也为 DRAM 存储行业培养了一大批专业技术人才。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利，拥有 6,259 名研发人员，占公司员工总数的比例超过 30%；报告期内，公司累计研发投入为 2,060,501.67 万元，占累计营业收入的 21.67%。

公司多年来所积累的技术创新成果、持续的技术创新能力以及所构建的人才队伍是本项目实施的重要保障。

2、持续增长及变化的下游应用需求，对公司产品技术升级提出需要

随着数字经济的发展和新兴技术场景持续涌现，大模型、深度学习、自动驾驶等不断迭代，数据总量呈现爆发式增长，广泛的数据读写与传输需求导致下游应用场景对高性能内存芯片的需求爆发，即对 DRAM 产品市场需求增量持续增长的同时，亦要求 DRAM 产品持续迭代更高存储密度、更低功耗及更快读写速度。根据 Omdia 统计，2025 年全球 DRAM 下游应用领域中，服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车市场需求占比分别约为 50%、28%、13%和 2%，前述四大应用市场合计占全球 DRAM 下游应用需求市场的比例超过 90%，服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等应用领域对 DRAM 需求持续增长。

因此，随着下游需求的持续增长及变化，对 DRAM 产品的需求愈加强烈，公司产品技术也需要保持不断升级，通过技术迭代提升产品竞争力，持续满足下游产品的需求。

3、积极的供应链多元化准备，为项目顺利实施提供了充分保障

作为中国 DRAM 产业链的链主企业，基于自身强大的产业影响力，公司已与上游供应商和下游客户建立了紧密的战略合作关系，积极整合国内产业生态资源，共同构建

了相互依存的产业生态，为公司的业务持续发展并积极参与全球竞争奠定了坚实的基础。

经过长期发展，公司与上游 EDA 厂商、材料厂商、设备及零部件厂商等供应商建立了稳固的合作关系，并通过深化产业链合作，积极推进供应链的多元化、本土化，增强了供应链的安全保障能力，为本次募投项目的顺利实施提供了充分保障，并为公司产能持续扩充和技术工艺升级提供了有力支撑。

（三）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目均围绕公司现有业务与核心技术展开，是公司实现生产线的技术改造升级、加快 DRAM 产能建设、完善产业链布局、提升技术工艺水平及研发实力的重要载体，与公司未来发展战略相匹配。

三、发行人未来发展规划

（一）公司战略规划

长鑫科技秉持“以存储科技赋能信息社会、改善人类生活”的使命，在业务布局上坚持立足国内市场，并逐步拓展海外市场；在市场布局上加速扩大在中高端应用市场的占有率；在发展模式上持续向产业生态协同发展；在技术研发上持续深化工艺技术开发与积累，不断开拓前沿技术，加速实现中国先进 DRAM 芯片产业持续性的技术突破。公司致力于成为技术领先与商业成功的半导体存储企业，并一直为之不懈努力和奋斗。

（二）发行人报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

为实现公司的总体发展战略和经营目标，公司在报告期内具体实施了以下举措：

1、坚持高水平技术研发，致力于创新驱动发展

公司高度重视技术创新与先进工艺研发，建立了完善的研发创新体系，打造了经验丰富的研发团队，承担多项国家重大专项课题，截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 6,259 名研发人员，占公司员工总数的比例超过 30%。报告期内，公司累计研发投入为 2,060,501.67 万元，占累计营业收入的 21.67%。技术平台方面，公司始终坚持自主研发道路，并通过跳代研发加快技术创新，完成了从第一代工艺技术平台到第四代工艺技术平台的量产。公司于 2019 年 9 月推出自主设计生产的 8Gb DDR4 产品，实现了中国大陆 DRAM 产业“从零到一”的突破。截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 LPDDR4X、DDR5 和 LPDDR5/5X 的开发与量产。通过持续不断的研发投入与技术创新，公司已形成多项

科研成果及核心技术，截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 3,929 项境内专利（其中发明专利 3,165 项）以及 3,043 项境外专利。

2、加快产能建设，丰富产品组合

报告期内，公司持续提升产能以满足下游市场需求。基于出货量和销售额统计，公司均是中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。未来，随着公司产线建设的稳步推进，公司整体产能将持续提升，预计将进一步提升在全球市场的竞争力。

在产品矩阵方面，公司积极拓展产品组合以满足各类下游市场需要，已形成 DDR 系列、LPDDR 系列等的多元化产品布局，并可提供内存 DRAM 晶圆、内存 DRAM 芯片、内存 DRAM 模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求，并正在积极布局并计划推出更新代际的产品，以持续满足未来新一代信息技术产业快速发展的需求。

3、推动供应链建设，带动上下游企业共同发展

报告期内，公司围绕供应链建设采取了一系列措施，充分整合利用龙头企业资源优势，推动科研院所、高校与产业上下游关键企业广泛参与，重点聚焦供应链的开发与验证，有效带动半导体设备、半导体材料等相关上下游产业链核心环节的协同发展。

4、吸引、培养和保留关键人才，强化约束与激励机制

人才是集成电路企业持续发展的根本，对于需持续追求先进工艺的 DRAM 行业而言，关键人才显得尤为重要。一方面，公司持续优化薪酬制度和激励体系，不断激发核心队伍的创新动力，将公司未来发展与关键人才深度绑定；另一方面，公司持续加大对关键人才培养的投入，为其搭建清晰的职业发展通道，并通过打造优质内部师资队伍、开发各类课程培训体系、与国内各大高校合作等多种方式，以实现人才成长和公司发展的双赢效果。

（三）发行人未来具体发展计划及采取的措施

未来，公司将继续坚持当前战略规划，坚持高水平技术研发，持续深化工艺技术开发与积累、不断开拓前沿技术，夯实核心技术根基；加速产能布局建设，拓展多元化产品组合，积极探索和布局中高端细分市场及海外市场；提升团队建设，强化运营能力，夯实人才密度，不断提升公司市场地位和竞争优势。同时，公司将积极拓展融资渠道，

进一步结合市场及自身情况进行资本开支，以更好支撑未来战略发展。

本次募集资金运用安排中，公司结合未来发展计划，拟将募集资金投入于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目。项目实施后，能够满足公司在 DRAM 行业进一步提高技术及研发实力和加快产能建设与升级的需要，是公司持续深化工艺技术开发与积累、不断开拓前沿技术、加速产能建设、提升核心竞争力的重要举措，有利于公司迈向技术领先和商业成功的半导体存储企业发展目标的实现。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自设立以来，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，制定了《公司章程》，逐步建立健全了股东会、董事会（包括独立董事）、董事会专门委员会、董事会秘书制度，并制定了公司治理相关的规章制度。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东会、董事会（包括独立董事）、董事会专门委员会、董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构不断健全和完善。报告期内，公司治理规范，不存在重大缺陷。

公司股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行的详细情况，可参见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况”部分，董事会专门委员会的设置情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明”部分。

二、内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司董事会于 2026 年 3 月 10 日出具了《长鑫科技集团股份有限公司关于 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的评价报告》，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日财务报告相关内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价：

报告期内，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与财务报告相关内部控制的重大缺陷或重要缺陷。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。根据缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，以及年度内部控制评价结果，公司未发现在报告期内存在重大缺陷或重要缺陷。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

德勤于 2026 年 3 月 10 日出具了《长鑫科技集团股份有限公司内部控制审计报告》（报告号：德师报（审）字（26）第 S00142 号），认为：长鑫科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、发行人报告期内违法违规行及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内，公司不存在重大违法违规及受到重大处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人主要股东及其控制的其他企业占用发行人资金及发行人为其提供担保情况

发行人无控股股东和实际控制人，报告期内，公司不存在资金被主要股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为主要股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

公司的《公司章程》和《对外担保管理制度》明确规定了对外担保的审批权限和审议程序，公司在实践中严格遵守相关规定。

五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系。

（一）资产完整

公司系由睿力集成整体变更设立的股份有限公司，承继了原有限公司所有的资产、负债及权益。公司拥有开展业务所需的完整的资质、资产和配套设施，合法拥有经营所需的土地、房产、设备、商标、专利等的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整，具备与经营有关的业务体系及相关资产，不存在资产、资金被主要股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司具有完全独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，公司建立了健全的法人治理结构，董事、审计委员会成员、高级管理人员严格按照《公司章程》等相关规章制度选举产生。公司不存在其高级管理人员在公司主要股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务并领取薪酬的情形，且不存在财务人员在公司主要股东及其控制的企业中兼职的情况。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系，制定了内部财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司拥有独立的银行账户，作为独立纳税人履行独立纳税义务。

（四）机构独立

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东会作为最高权力机构，董事会为决策机构，审计委员会为监督机构，具有完备的法人治理结构。公司建立了健全且适应自身发展需要的内部组织机构，建立了相应的内部管理制度，拥有独立的职能部门并独立行使经营管理职权，不存在各职能机构在经营场所、办公场所和管理制度等各方面与主要股东及其控制的企业机构混同的情形。

（五）业务独立

发行人无控股股东和实际控制人，与主要股东及其控制的其他企业间不存在非公平竞争或者显失公平的关联交易，不存在通过客户或供应商进行利益输送、相互或单方面让渡商业机会等情形。公司拥有完整、独立的研发、采购、生产和销售的运营管理体系，公司的业务独立于其主要股东及其控制的其他企业。

（六）主营业务、管理团队和核心技术人员稳定

公司作为国产 DRAM 行业实现自主研发设计且商业化量产规模最大的公司，具有国内 DRAM 领域领先的技术水平与产业化能力。公司主营业务稳定，最近 2 年内主营业务没有发生变化。

公司管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。

（七）不存在对独立持续经营有重大影响的事项

报告期内，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对公司独立持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争情况

（一）是否存在同业竞争情况的说明

发行人无控股股东和实际控制人，不存在实际控制人及其一致行动人控制的其他企业与公司构成同业竞争的情况。截至本招股说明书签署日，发行人与持有公司 5%以上股份的主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争和保持业务独立性的承诺

公司第一大股东清辉集电已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”之“（五）第一大股东清辉集电关于避免同业竞争的承诺”的相关内容。

七、关联方和关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市规则》等相关规定，截至报告期末，发行人主要关联方及关联关系情况如下：

（一）直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

序号	关联方名称	关联关系
1	清辉集电	直接持有发行人 5%以上股份的企业
2	长鑫集成	直接持有发行人 5%以上股份的企业
3	产投高成长	长鑫集成的一致行动人
4	大基金二期	直接持有发行人 5%以上股份的企业
5	安徽省投	直接持有发行人 5%以上股份的企业
6	合肥集鑫	直接持有发行人 5%以上股份的企业

上述直接持有发行人 5%以上股份的股东直接或间接控制的法人或其他组织亦为发行人的关联方，但发行人及其控股子公司除外，其中报告期内与发行人存在关联交易的主体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	安徽合力叉车销售有限公司	安徽省投的子公司

（二）间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	合肥产投	间接持有发行人 5%以上股份的企业
2	芯睿投资	间接持有发行人 5%以上股份的企业
3	合肥集鑫肆拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	间接持有发行人 5%以上股份的企业
4	海恒控股	间接持有发行人 5%以上股份的企业
5	合肥经济技术开发区海恒科创控股集团有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的企业
6	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	间接持有发行人 5%以上股份的组织
7	合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会	间接持有发行人 5%以上股份的组织
8	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	间接持有发行人 5%以上股份的组织

（三）发行人董事、监事及高级管理人员

截至报告期末，发行人董事、高级管理人员为关联自然人，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。截至报告期末，发行人已不再设立监事会。

与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母亦为发行人的关联方。

（四）由前述关联自然人直接或者间接控制的，或由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

截至报告期末，发行人董事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	主要关联关系
1	北京清辉鑫电企业管理有限公司	朱一明控制的企业
2	清辉景瑄（杭州）企业管理有限公司及其附属企业	朱一明控制的企业
3	清辉景恒（北京）管理咨询有限公司	朱一明控制的企业
4	清辉管理咨询有限公司及其附属企业	朱一明控制的企业
5	清辉长鑫	朱一明控制的企业

序号	关联方名称	主要关联关系
6	TSINGHALO LIMITED	朱一明控制的企业
7	TSINGHALO PTE. LTD.	朱一明控制的企业
8	兆易创新及其附属企业	朱一明控制的企业
9	北京创安微芯科技有限责任公司	赵纶控制并担任董事、总经理的企业
10	北京通美晶体技术股份有限公司	赵纶担任独立董事的企业
11	香港集鑫有限公司	赵纶担任董事的企业
12	安徽皖投资产管理有限公司	郑锐担任执行董事、总经理的企业
13	安徽安凯汽车股份有限公司	郑锐担任董事的企业
14	城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司	郑锐担任董事的企业
15	国元农业保险股份有限公司	郑锐担任董事的企业
16	安徽省小额再贷款股份有限公司	郑锐担任董事的企业
17	数字安徽有限责任公司	郑锐担任董事的企业
18	长虹美菱股份有限公司	方炜担任董事的企业
19	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	方炜担任董事的企业
20	合肥市生命健康产业发展有限公司	方炜担任董事长的企业
21	合肥科技农村商业银行股份有限公司	方炜担任董事的企业
22	安徽安利材料科技股份有限公司	方炜担任董事的企业
23	合肥市创业投资引导基金有限公司	方炜担任董事长的企业
24	合光光掩模科技（安徽）有限公司	方炜担任董事长的企业
25	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	韦俊担任副总裁的企业
26	大基金二期	韦俊担任副总裁的企业
27	国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司	韦俊担任副总裁的企业
28	长江存储控股股份有限公司	韦俊担任董事的企业
29	长江存储科技有限责任公司	韦俊担任董事的企业
30	上海华力集成电路制造有限公司	韦俊担任董事的企业
31	华虹半导体制造（无锡）有限公司	韦俊担任董事的企业
32	武汉芯飞科技投资有限公司	韦俊担任董事的企业
33	武汉芯腾科技投资有限公司	韦俊担任董事的企业
34	华虹半导体（无锡）有限公司	韦俊担任董事的企业
35	杭州富芯半导体有限公司	韦俊担任董事的企业
36	华芯投资管理有限责任公司	侯华伟担任董事、副总裁的企业
37	江苏长电科技股份有限公司	侯华伟担任董事的企业
38	中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	侯华伟担任董事的企业

序号	关联方名称	主要关联关系
39	中芯京城集成电路制造（北京）有限公司	侯华伟担任董事的企业
40	紫光展锐（上海）科技股份有限公司	侯华伟担任董事的企业
41	中水信通科技（武汉）有限公司	冯鹏熙担任董事的企业
42	上海芯展科技有限公司	冯鹏熙担任董事的企业
43	珠海市芯格善筑投资有限公司	冯鹏熙控制的企业

发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者由前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及子公司以外的法人或其他组织亦属于发行人关联方。

（五）发行人纳入合并报表范围内的子公司

公司的控股子公司均为公司的关联方，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况”。

（六）其他关联方

除上述已列示的关联方外，发行人的其他关联方主要包括报告期及报告期前 12 个月内曾经具有本节所列情形的主体、按照实质重于形式的原则应当认定为关联方的其他主体等。其中，报告期内与发行人存在关联关系且发生关联交易的主体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	合肥沛顿存储科技有限公司	报告期内发行人曾任董事李中亚担任董事
2	合肥鑫丰科技有限公司	报告期内发行人曾任董事李中亚担任董事
3	上海泽丰半导体科技有限公司	报告期内发行人曾任董事李中亚担任董事
4	上扬软件（上海）有限公司	报告期内发行人曾任董事汤树军曾经担任董事
5	北京华卓精科科技股份有限公司	报告期内发行人曾任独立董事朱煜控制
6	供应商 L	报告期内发行人曾任高级管理人员担任高级管理人员
7	客户 O	发行人高级管理人员曾担任理事、常务副院长
8	中电科数字技术股份有限公司	发行人董事韦俊曾担任独立董事
9	合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人子公司担任基金管理人的私募基金，实质重于形式认定为关联方
10	公司 H	发行人具有重大影响的参股公司
11	公司 D	发行人具有重大影响的参股公司
12	公司 F	发行人具有重大影响的参股公司

八、关联交易

（一）关联交易的总体情况及重大关联交易判断标准

根据发行人《关联交易管理制度》，重大关联交易的标准为与关联自然人发生的成交金额在人民币三十万元以上的交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值百分之零点一以上的交易，且超过人民币三百万元。

报告期内，发行人关联交易的总体情况如下：

类型	关联方名称	交易内容	是否属于重大关联交易
经常性关联交易	合肥沛顿	采购封测服务	是
	合肥鑫丰	采购封测服务	是
	长鑫集成	采购项目管理服务	否
	海恒控股	采购其他服务	否
	华卓精科	采购技术服务	否
	上扬软件	采购技术服务	否
	客户 O	采购技术服务	否
	中电科	采购装修服务	否
	供应商 L	采购固定资产等	是
	兆易创新集团	采购其他服务	否
	泽丰半导体	采购技术服务	否
	兆易创新集团	晶圆代工及 DRAM 销售	是
	客户 O	提供技术及其他服务	是
	公司 F	提供服务及其他收入	是
	公司 D	提供服务	否
	启航恒鑫	提供服务	否
	公司 H	销售材料及其他	否
	供应商 V	其他服务	否
偶发性关联交易	合肥产投	委托贷款	是
	合肥产投、长鑫集成	关联担保	是
	长鑫集成	采购固定资产	否
	华卓精科	采购固定资产	否
	合肥沛顿	采购固定资产	否
	中电科	采购固定资产	否

类型	关联方名称	交易内容	是否属于重大关联交易
	长虹美菱	采购固定资产	否
	安徽合力叉车	采购固定资产	否
	合肥集鑫	资金拆借	否

（二）重大经常性关联交易

报告期内，发行人重大经常性关联交易情况如下：

1、向关联方采购商品、接受劳务

报告期内，发行人向关联方采购商品、接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合肥沛顿	封测服务	-	-	24,449.65
合肥鑫丰	封测服务	-	-	10,999.47
合计		-	-	35,449.11
占营业成本比重		-	-	3.83%

注：发行人原董事李中亚曾担任合肥沛顿、合肥鑫丰董事，并于 2022 年 8 月卸任关联方职务后不再担任，顺延 12 个月至 2023 年 8 月发行人与合肥沛顿、合肥鑫丰的关联关系终止，基于历史合作情况，双方仍保持业务合作关系。此处仅列示 2023 年 1 月至 2023 年 8 月相关交易金额。

（1）合肥沛顿

发行人与合肥沛顿于 2021 年开始合作，因合肥沛顿具备地理优势、响应速度迅速等优势，在经历初期小规模验证后，随着发行人的产能建设、封测需求增大，双方交易金额快速增长。合肥沛顿通过发行人供应商选聘机制成为封测服务供应商之一，交易价格系参考市场价格协商确定，相关交易价格公允。

（2）合肥鑫丰

发行人与合肥鑫丰于 2020 年开始合作，因合肥鑫丰具备地理优势、响应速度迅速等优势。合肥鑫丰通过发行人供应商选聘机制成为封测服务供应商之一，交易价格系参考市场价格协商确定，相关交易价格公允。

2、向关联方销售产品、提供劳务

报告期内，发行人向关联方销售商品、提供劳务情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
兆易创新集团	晶圆代工等	90,097.59	50,962.72	14,362.44
	DRAM 销售	28,115.29	50,842.48	62,002.03
公司 F	服务及其他收入	34,128.57	1,635.05	-
客户 O	技术及其他服务	-	-	14,249.22
合计		152,341.45	103,440.25	90,613.69
占营业收入比重		2.47%	4.28%	9.97%

注：发行人高级管理人员曾担任客户 O 常务副院长、理事，并于 2022 年 8 月卸任关联方职务后不再担任，顺延 12 个月至 2023 年 8 月发行人与客户 O 的关联关系终止。此处仅列示 2023 年 1 月至 2023 年 8 月相关交易金额。

（1）兆易创新集团

报告期内，发行人向兆易创新集团销售的内容主要包括自有 DRAM 产品以及提供代工服务，具体情况如下：

1）提供代工服务

兆易创新集团为采用 Fabless 模式的半导体设计公司，公司为境内少数具备为 DRAM 产品代工能力的 IDM 中国厂商。为实现在 DRAM 利基市场的产品布局及销售，兆易创新集团陆续向公司采购 DRAM 产品的晶圆代工服务，随着代工产品的量产，报告期内公司向兆易创新集团的代工服务收入增加。

2）销售 DRAM 产品

报告期内，一方面，兆易创新集团基于自身产品开发及客户服务需求，向公司采购 DRAM 芯片或晶圆；另一方面，公司在市场拓展早期通过兆易创新集团经销 DRAM 产品，随着公司业务规模扩大、销售渠道完善，公司已于 2023 年下半年停止通过兆易创新集团经销 DRAM 产品。

报告期内，公司与兆易创新集团的合作均在市场价格的基础上协商定价，具有公允性，且随着公司收入规模的扩大，关联交易占比逐年降低，未对发行人的财务状况、经营成果和主营业务产生重大不利影响。

（2）公司 F

公司 F 系发行人参股公司。发行人主要向其提供技术服务、运营及人力咨询服务，双方交易依据市场价格协商确定，交易价格公允。

(3) 客户 O

报告期内，发行人主要为客户 O 提供流片、样品分析、测试等综合技术服务。客户 O 为民办非企业单位，主要开展与存储器相关的学术研究、学术交流、专业培训、成果转化、技术研发、技术咨询、技术推广与应用，发行人为我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM 研发设计制造一体化企业，双方在存储器方面具有天然合作基础，双方约定的价格为双方协商后确定，价格公允，未对发行人的财务状况、经营成果和主营业务产生重大不利影响。

3、向关联方采购固定资产

报告期内，发行人向关联方采购固定资产的具体情况如下表所示：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
供应商 L	采购固定资产等	177,249.82	-	-

报告期内，发行人主要向供应商 L 采购半导体制造相关设备及备件等，采购价格公允。

(三) 重大偶发性关联交易

1、关联方委托贷款

报告期内，发行人与其关联方委托贷款情况如下：

单位：万元

期间	关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
2023 年度	合肥产投	130,000.00	-	130,000.00	-

上述委托贷款利息明细情况如下：

单位：万元

科目	关联方名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	合肥产投	-	-	2,351.56

报告期内，由于主营业务经营资金需求等原因，发行人存在通过关联方委托贷款借入资金的情形，在业务上具有必要性和合理性。该笔委托贷款利率水平与同期银行贷款利率接近，具有公允性。除上述关联方委托贷款外，发行人与关联方不存在其他委托贷款的情形。截至报告期末，该笔委托贷款借款已全部结清，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送的情形，未对发行人的财务状况、经营成果和主营业务产生不利

影响。

2、关联担保

报告期内，发行人接受关联方提供担保情况如下：

（1）2019年9月6日，发行人关联方长鑫集成、合肥产投分别与国家开发银行安徽省分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“各贷款行”）签订《银团贷款保证合同》。根据合同约定，长鑫集成、合肥产投对于发行人向各贷款行在贷款主合同项下的贷款（贷款期限自2019年9月11日至2031年9月10日）及对应利息、罚息等被担保债务提供连带责任保证。2025年12月，公司已结清该关联方担保项下银行借款，截至2025年12月31日，上述担保协议项下无银行借款余额。

（2）2019年11月7日，发行人关联方长鑫集成、合肥产投分别与各贷款行签订《外汇银团贷款保证合同》。根据合同约定，长鑫集成、合肥产投对于发行人向各贷款行的贷款（贷款期限自2019年11月13日至2031年11月12日）及对应利息、罚息等被担保债务提供连带责任保证。截至2025年12月31日，上述担保协议项下，发行人对各贷款行的债务本金余额为41,720.00万美元。

报告期内，发行人因项目建设和购买设备，在向银行申请借款及进行设备融资租赁时，存在关联方提供保证担保的情形，该等情况具有合理性。

（四）一般经常性关联交易

1、向关联方采购商品、接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品、接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司 F	原材料与其他服务	2,119.46	-	-
公司 H	原材料	1,169.19	-	-
供应商 V	其他服务	282.50	-	-
华卓精科	技术服务	20.01	13.66	30.10
公司 D	其他服务	261.75	-	-
中电科	装修服务	-	4.88	-
泽丰半导体	技术服务	-	-	2.23

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上扬软件	技术服务	-	-	138.77
客户 O	技术服务	-	-	47.69
海恒控股	其他服务	65.17	390.17	377.79
合计		3,918.07	408.71	596.58
占营业成本比例		0.11%	0.02%	0.06%

上述一般性关联采购交易金额及占比较小，且均基于市场价格基础上协商确定，交易价格公允，未对发行人的财务状况、经营成果和主营业务产生重大不利影响。

2、向关联方销售产品、提供劳务

报告期内，公司向关联方销售商品、提供劳务情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司 D	服务收入	19,430.69	5,967.99	-
启航恒鑫	其他服务	1,216.65	527.49	-
公司 H	材料销售及其他	1,082.82	86.87	3.59
合计		21,730.16	6,582.35	3.59
占营业收入比例		0.35%	0.27%	0.00%

发行人主要向公司 D 提供技术服务、运营及人力咨询服务，双方交易依据市场价格协商确定，交易价格公允。

除以上交易外的一般性关联销售交易，金额及占比较小，且均基于市场价格基础上友好协商确定，交易价格公允，未对发行人的财务状况、经营成果和主营业务产生重大不利影响。

（五）一般偶发性关联交易

1、采购资产

报告期内，发行人向关联方采购固定资产的具体情况如下表所示：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长鑫集成	采购固定资产	5,880.22	7,556.26	11,472.51
华卓精科	采购固定资产	110.62	-	-
合肥沛顿	采购固定资产	-	-	1,127.24

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中电科	采购固定资产	-	-	75.00
长虹美菱	采购固定资产	74.63	32.79	-
安徽合力叉车	采购固定资产	-	-	1.15
合计		6,065.47	7,589.05	12,675.90

发行人与长鑫集成签署协议，发行人委托其代建“合肥长鑫二期项目 220kV 输变电工程”项目，双方约定的价格为双方根据共同确认的成本费用进行结算，价格公允，未对发行人的财务状况、经营成果和主营业务产生重大不利影响。

2、资金拆借

报告期内，发行人与其关联方的一般偶发性资金拆借情况如下：

单位：万元

期间	关联方	期初余额	本期借出	本期收回	期末余额
2023 年度	合肥集鑫	-	9,000.00	9,000.00	-

上述资金拆借利息明细情况如下：

单位：万元

科目	关联方名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息收入	合肥集鑫	-	-	48.09

报告期内，由于员工持股计划员工进入与退出所需过渡资金缺口，发行人存在与关联方合肥集鑫的资金拆借情形，拆借利率水平系按照同期 1 年期 LPR 确定，具有公允性。2023 年末，相关资金拆借款项已全部结清。公司不断完善内控制度，对于资金拆借情况进行严格管理。上述关联方资金拆借于报告期内已偿还完毕。

（六）向关键管理人员支付报酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付的报酬如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	7,485.72	2,450.58	3,615.98

注：以上金额包含已离职关键管理人员从发行人处所获报酬。

（七）期末关联方往来余额汇总

报告期各期末，发行人期末关联方往来余额情况如下：

单位：万元

科目	关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	兆易创新集团	17,119.89	11,323.69	7,377.82
	公司 F	12,636.55	1,733.15	-
	公司 D	2,494.02	821.33	-
	公司 H	79.62	6.77	-
	合计	32,330.08	13,884.94	7,377.82
其他应收款	海恒控股	-	105.54	105.54
	公司 D	299.30	3.52	-
	公司 H	142.42	32.17	-
	公司 F	3,724.64	-	-
	合计	4,166.36	141.22	105.54
应付账款	华卓精科	33.28	13.27	30.10
	公司 H	546.68	-	-
	公司 F	2,367.13	-	-
	供应商 V	299.45	-	-
	公司 D	285.30	-	-
	海恒控股	-	65.17	-
	中电科	-	4.88	-
	供应商 L	12,281.79		
	合计	15,813.64	83.32	30.10
其他应付款	公司 F	21.31	291.74	-
	长鑫集成	8,370.82	2,796.72	2,771.57
	中电科	-	1.34	42.37
	长虹美菱	17.18	-	-
	供应商 L	11,518.90	-	-
	合计	19,928.20	3,089.81	2,813.94

（八）规范关联交易的制度安排

公司已就规范关联交易建立了相应的制度保障。公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，选举了独立董事，制定了《独立董事工作制度》，以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善；为保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联

交易管理办法》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序做出了详细规定。

（九）规范和减少关联交易的措施

对于在日常生产经营过程中基于业务需要与关联方进行的交易，发行人将按照有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等规章制度，严格履行关联交易的基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等制度，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、审批程序的合规性，确保发行人其他股东利益不受损害。发行人持股 5%以上股东及一致行动人、董事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”之“（一）关于规范关联交易的承诺”的相关内容。

（十）关联交易决策程序的履行情况及独立董事的意见

发行人报告期内的关联交易已按照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定履行了相应的决策审批程序。发行人报告期内发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。发行人独立董事已根据《公司章程》《关联交易管理制度》审批要求就关联交易相关议案发表了同意的独立意见，认为关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。发行人对报告期内关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

2025年9月25日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》，公司本次发行上市前可根据股东会决议进行利润分配，留存的滚存未分配利润（累计未弥补亏损）全部由公司本次发行上市后的新老股东按上市后的持股比例共同享有（承担）。

二、发行人股利分配政策

（一）本次发行后的股利分配政策

2025年9月25日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》，对本次发行上市后的股利分配政策作出了相应规定，具体如下：

1、利润分配的原则

公司实施稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。在决策和论证过程中应当充分听取和考虑独立董事和中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配的形式

公司可以采用现金分红、股票股利、二者相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润，但公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

3、分红的条件及比例

在满足下列条件时，应当进行分红：

（1）在公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东

分配的利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司上市后适用的《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时依据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本款第 3）项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

4、现金分红的具体条件

公司进行现金分红，应同时具备以下条件：

1）公司在该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值，现金分红后公司现金流仍可以满足公司持续经营和长期发展的需要；

2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3）公司未来十二个月内无重大资金支出安排等特殊情况发生（本次发行上市的募

集资金投资项目除外)。

在公司不具备上述第3项现金分红条件时，但公司决定进行现金分红，应按照上述第3条第(3)款差异化的现金分红政策执行。

5、现金分红的期间间隔

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

6、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

7、利润分配的决策程序与机制

公司在进行利润分配时，公司董事会应当结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划先制定分配预案并进行审议。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。

审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。

股东会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

8、利润分配政策的变更

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，公司认为确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的，应当将修订后的利润分配政策提交股东会审议。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（2）因出现战争、自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

10、股东分红回报规划的制订周期和调整机制

（1）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划，公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临的各项因素，以及股东（特别是中小公众股东）、独立董事和审计委员会的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

（2）如遇到战争、自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化，或者现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制定股东回报规划。

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后股利分配政策的差异主要在于进一步完善了发行后的利润分配政策，对分配原则、分红的条件和比例、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的变更等进行了明确。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或累计未弥补亏损的情况及投资者保护措施

根据《公司章程（草案）》，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。《公司章程（草案）》未针对特定股东设置特别表决权股份，公司股东亦不存在协议控制的特殊安排情况。

截至报告期末，公司存在累计未弥补亏损。公司主要股东等相关主体就股份锁定及减持股票做出了承诺，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”的相关内容。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

（一）重大销售合同

报告期内，发行人及其子公司通常以框架协议的形式与客户建立业务合作关系。发行人重大销售合同的选取标准为发行人与报告期内累计前五大客户签订的正在履行或已履行完毕的销售框架协议。发行人重大销售合同具体如下：

序号	客户名称	销售内容	合同金额	签订日期/生效日期	截至报告期末履行情况
1	客户 F	内存产品	框架协议	2025.02.01	正在履行
2	客户 G	内存产品	框架协议	2024.02.01	履行完毕
3	客户 B	内存产品	框架协议	2025.02.01	正在履行
4	客户 H	内存产品	框架协议	2025.02.01	正在履行
5	客户 D	内存产品	框架协议	2020.11.23	正在履行

注：上述销售合同系披露截至报告期末，发行人与相关客户最近一次签署的框架协议。

（二）重大原材料采购合同

发行人重大原材料采购合同的选取标准为发行人及其子公司与报告期内累计前五大原材料供应商签订的正在履行或已履行完毕的采购框架协议或金额最大的一笔订单。截至报告期末，发行人的重大原材料采购合同具体如下：

序号	供应商名称	采购内容	合同金额	签订日期/生效日期	截至报告期末履行情况
1	供应商 A	产品	框架协议	2024.09.01	正在履行
2	供应商 F	产品	框架协议	2023.10.01	正在履行
3	供应商 B	产品	框架协议	2025.02.08	正在履行
4	供应商 G	产品	框架协议	2021.08.02	正在履行
		产品	框架协议之补充协议	2021.08.18	正在履行
5	供应商 C	产品	框架协议	2025.01.24	正在履行

注：上述采购合同或订单系披露发行人与供应商集团内单体交易额最大的主体报告期内最近一次签订的框架协议或订单。

（三）重大设备采购合同

发行人重大设备采购合同的选取标准为发行人及其子公司与报告期累计前五大设备供应商签订的正在履行或已履行完毕的采购框架协议或金额最大的一笔订单。截至报

告期末，发行人重大设备采购合同具体如下：

序号	供应商名称	采购内容	合同金额	签订日期/生效日期	截至报告期末履行情况
1	供应商 J	设备	框架协议	2024.10.01	正在履行
2	供应商 C	设备	框架协议	2022.10.11	正在履行
3	供应商 G	设备	1,676.92 万美元	2022.10.08	履行完毕
4	供应商 F	设备	框架协议	2017.10.18	正在履行
5	供应商 K	设备、部件、软件	框架协议	2024.09.27	正在履行

注：上述采购合同或订单系披露发行人与供应商集团内单体交易额最大的主体报告期内最近一次签订的框架协议或订单。

（四）重大借款合同

截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在履行的 500,000.00 万元及以上的重大借款合同情况如下：

序号	合同名称	借款人	贷款银行	借款期限	合同金额
1	固定资产银团贷款合同	长鑫集电	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行、国家开发银行北京市分行、北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行、中国进出口银行北京分行、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区分行、中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	2022 年 5 月 12 日至 2035 年 5 月 11 日止，其中 2025 年 5 月新增的 6 亿银团贷款额度期限从该笔贷款资金实际提款日至 2042 年 5 月 11 日止	2,940,000.00 万元
2	固定资产银团贷款合同	长鑫科技、长鑫存储	国家开发银行安徽省分行、中国农业银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行、广发银行股份有限公司合肥分行、华夏银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行	首笔贷款资金的提款日/生效日起至 2034 年 5 月 10 日	1,540,000.00 万元
3	固定资产银团贷款合同	长鑫新桥	中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	首笔贷款资金的提款日/生效日至 2044 年 4 月 15 日	1,470,000.00 万元

序号	合同名称	借款人	贷款银行	借款期限	合同金额
4	人民币资金银团贷款合同	长鑫存储、长鑫科技	国家开发银行安徽省分行、中国农业银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行	2019年9月11日起至2031年9月10日	850,000.00 万元
5	固定资产银团贷款合同	长鑫新桥	中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、中国进出口银行安徽省分行	首笔贷款资金的提款日/生效日至2044年5月15日	791,200.00 万元
6	固定资产银团贷款合同	长鑫存储	中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	首笔贷款资金的提款日/生效日至2038年7月30日	650,000.00 万元
7	外汇银团贷款合同	长鑫存储、长鑫科技	国家开发银行安徽省分行、中国农业银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行、交通银行股份有限公司安徽省分行	2019年11月13日起至2031年11月12日	107,200.00 万美元

二、对外担保

截至本招股说明书签署日，公司无对外担保。

三、重大诉讼或仲裁

（一）公司重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在重大未决诉讼与仲裁事项。

（二）控股股东、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的诉讼、仲裁事项

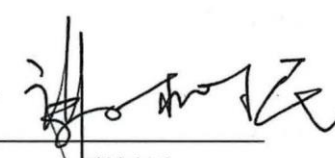
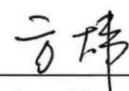
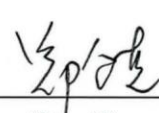
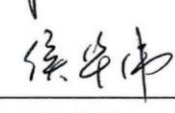
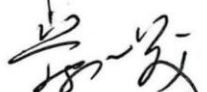
截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东，发行人控股子公司、董事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的可能对发行人产生重大不利影响的诉讼与仲裁。

第十一节 声明

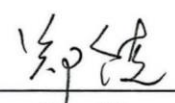
一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司全体董事签字：

 朱一明	 曹堪宇	 谢树民
 郑 炜	 郑 锐	 侯华伟
 韦 俊	 陈武朝	 郭 薇
 蔡一茂	 李 华	

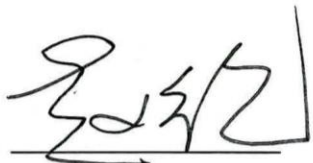
本公司全体审计委员会成员签字：

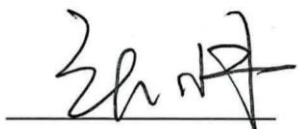
 陈武朝	 李 华	 郑 锐

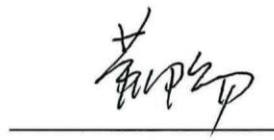


本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司除董事外全体高级管理人员签字：


赵 纶


张 羽


黄丹阳


冯鹏熙


袁 园


李红文


朱文菊



二、发行人第一大股东声明

本企业承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

执行事务合伙人委派代表签字：



曹堪宇

合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）

2026年5月27日



三、保荐人（主承销商）声明

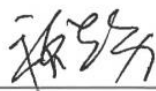
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：

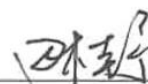


陈 亮

保荐代表人：



魏先勇



田桂宁

项目协办人：



吴 迪



中国国际金融股份有限公司

2026年5月27日

保荐人董事长声明

本人已认真阅读长鑫科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容,确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长:

陈 亮



保荐人总裁声明

本人已认真阅读长鑫科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总裁：



王曙光



三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

项目协办人签名: 汪鹏飞
汪鹏飞

保荐代表人签名: 董军峰
董军峰

廖小龙
廖小龙

法定代表人/董事长签名: 刘成
刘成

中信建投证券股份有限公司



声明

本人已认真阅读长鑫科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容,确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名:


金剑华

法定代表人/董事长签名:


刘 成

中信建投证券股份有限公司



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处，本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所

经办律师：


杨继伟

负责人：

沈国权

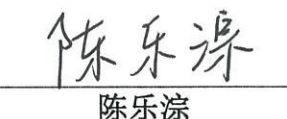
经办律师：


卢晴川

经办律师：


吴莎

经办律师：


陈乐淙

2026 年 5 月 27 日

Deloitte.**德勤**德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002**会计师事务所声明**

德师报(函)字(26)第 Q00948 号

本所及签字注册会计师已阅读长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)的招股说明书,确认招股说明书与本所出具的发行人 2025 年度、2024 年度及 2023 年度财务报表审计报告、关于原始财务报表与申报财务报表差异比较表的专项说明、关于非经常性损益明细表的专项说明、关于主要税种纳税情况的专项说明、于 2025 年 12 月 31 日的内部控制审计报告(以下统称“报告及说明”)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述报告及说明的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



执行事务合伙人:唐恋炯

Handwritten signature of Tang Lianjiong in black ink.

签字注册会计师:步 君

Handwritten signature of Bu Jun in black ink.



签字注册会计师:葛丞尧

Handwritten signature of Ge Chengyao in black ink.



2026年5月27日

Deloitte.**德勤**德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002**会计师事务所声明**

德师报(函)字(26)第 Q00947 号

本所及签字注册会计师已阅读长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)的招股说明书,确认招股说明书与本所出具的发行人截至 2023 年 6 月 26 日止注册资本及实收资本变更情况的验资报告(德师报(验)字(23)第 00178 号)(以下简称“验资报告”)无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



执行事务合伙人:唐恋炯

唐恋炯

签字注册会计师:步君

步君



签字注册会计师:葛丞尧

葛丞尧



2026 年 5 月 27 日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



经办资产评估师（签字）：

陈大海

许佳佳

评估机构负责人（签字）：

肖力

中水致远资产评估有限公司（盖章）



第十二节 附件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报表及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- (七) 与投资者保护相关的承诺；
- (八) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- (九) 内部控制审计报告；
- (十) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十一) 股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况；
- (十二) 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- (十三) 募集资金运用具体情况；
- (十四) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查地点及备查时间

查阅时间：工作日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

查阅地点：公司及保荐机构（主承销商）的住所。

除以上查阅地点外，投资者可以登录证监会和证券交易所指定网站，查阅《招股说明书》正文及相关附录。

三、申报前十二个月新增股东的基本情况

（一）广州信德

企业名称	广州信德鑫成科技投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	广州市天河区马场路 26 号（自编主楼）2601 房
主要生产经营地	广州市天河区马场路 26 号（自编主楼）2601 房
执行事务合伙人	广发信德投资管理有限公司
认缴出资额	43,760.10 万元
实缴出资额	43,760.10 万元
成立日期	2024 年 12 月 25 日
主营业务	从事投资业务
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关

截至本招股说明书签署日，广州信德合伙份额结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙）	20,487.50	46.82%
2	中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙）	5,910.00	13.51%
3	广发信德皖能（含山）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,350.00	12.23%
4	东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）	4,407.50	10.07%
5	广发信德（漳州芗城区）数字产业投资发展合伙企业	4,000.00	9.14%
6	珠海广发信德东盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000.00	4.57%
7	佛山市广发信德粤盈新产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,605.00	3.67%
8	广发信德投资管理有限公司	0.10	0.00%
合计		43,760.10	100.00%

（二）阿里云计算

企业名称	浙江阿里巴巴云计算有限公司
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 533 室
主要经营生产地	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 533 室
注册资本	7,002.9788 万元
实收资本	7,000.0000 万元
成立日期	2011 年 12 月 13 日
主营业务	从事计算机软件业务
与发行人主营业务关系	与发行人业务不相关

截至本招股说明书签署日，阿里云计算股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	阿里软件中国控股有限公司	7,002.9788	100.00
合计		7,002.9788	100.00

四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，建立了完善的投资者权益保护制度并严格执行，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，积极合理地实施利润分配政策，保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。

1、信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露管理制度》，明确了公司管理人员在信息披露中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，为投资者尤其是中小投资者提供了制度保障。

本次发行上市后，发行人将严格执行上述制度与办法，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

2、投资者沟通渠道建立情况

公司设置了董事会办公室负责具体信息披露和投资者关系管理工作，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，并配备专门工作人员，负责开展投资者关系管理工作，管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台。董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供信息披露资料等相关工作。

3、未来开展投资者关系管理的规划

为加强投资者关系管理，提高信息披露质量，促进投资者对公司的了解，发行人将依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护的相关工作，积极听取投资者的意见与建议，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策与选择管理者的相关权利，切实维护全体股东，尤其是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）股利分配决策程序

公司发行上市后的股利分配决策程序参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”。

（三）股东投票机制建立情况

公司《公司章程》《股东会议事规则》对股东投票机制作出了明确规定，包括累积投票制度选举董事、中小投资者单独计票机制、网络投票方式召开股东会进行审议表决、征集投票权机制的相关安排等，具体内容如下：

1、累积投票机制

《公司章程》规定，公司股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公布候选董事的简历和基本情况。

股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

2、中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、网络投票机制

公司召开股东会的地点为：公司住所地或日常办公地或股东会通知中载明的地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供通讯表决、网络投票等方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

4、征集投票权机制

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行

政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、与投资者保护相关的承诺

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

(1) 合计持股比例不低于发行前股份总数 51% 的股东的承诺

1) 清辉集电承诺

“1. 本企业将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。

2. 在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本企业可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，但应当遵守本承诺函其他规定。

3. 发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50% 以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50% 以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50% 以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。前述“届时所持股份”分别指本企业在发行人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。

4. 在发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价的，本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。

5.承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

6.在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

2) 长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫、安徽省投、产投高成长承诺

“1.本企业将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。

2.承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

3.在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

3) 产投壹号自愿承诺

“1.本企业将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。

2.承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

3.在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(2) 最近一年发行人新增股东/新增股份持有人阿里云计算、广州信德、星棋道和的承诺

1) 新增股东阿里云计算、广州信德承诺

“1.本企业将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。对于承诺人所持有的于发行人提交首次公开发行股票申请前 12 个月内所取得的发行人新增股份，自该等股份取得之日（取得之日指相关股份变动完成市场监督管理局变更登记之日，通过受让股份方式取得的新增股份部分，取得之日为发行人股东名册记载该等变动之日）起 36 个月内，承诺人不转让或委托他人管理，也不由发行人回购承诺人持有的该等股份。

2.承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

3.在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

2) 新增股份持有人星棋道和承诺

“1.本企业将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。对于承诺人所持有的于发行人提交首次公开发行股票申请前 6 个月内所取得的发行人新增股份，自该等股份取得之日（取得之日指相关股份变动完成市场监督管理局变更登记之日，通过受让股份方式取得的新增股份部分，取得之日为发行人股东名册记载该等变动之日）起 36 个月内，承诺人不转让或委托他人管理，也不由发行人回购承诺人持有的该等股份。

2.承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

3.在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券

监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(3) 持有发行人股份的董事、高级管理人员及核心技术人员朱一明、曹堪宇、谢树民、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文、TAN TECK HONG（陈德鸿）、王丹、唐衍哲的承诺

1) 董事长朱一明承诺

董事长朱一明关于股份锁定的承诺如下：

“1.本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，除自愿承诺未来用于员工激励的目标激励股份另有约定外，自发行人股票在证券交易所上市之日起 120 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2.在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的任何首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺。

3.本人在公司担任董事期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持任何发行人股份。

4.发行人上市后 120 个月或根据届时的 IPO 及上市公司监管规则要求设置的更长锁定期（孰晚，以下简称“限售期”）届满后，本人每年可减持的锁定股份（即本人在公司上市前通过发行人《第二期员工持股计划》获授予的持股份额，下同）不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%。限售期满十年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。

5.本人所持首发前股份在限售期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。

6.发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，本项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

7.若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整。

8.本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

9.在本人持股期间，若适用于发行人股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生更为严格的变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

董事长朱一明针对其获授予的第二期员工持股计划下的激励股份自愿承诺如下：

“本人自愿承诺将所持合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙企业份额中的 50%（对应公司当前股本的 767,920,918 股长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）股份，以下简称“目标激励股份”）在长鑫科技首次公开发行并上市满 36 个月后 10 个自然年度内分配给长鑫科技及其并表子企业（以下简称“公司”）的在职员工（不含本人），用于员工激励。具体安排如下：

1、自公司首次公开发行并上市满 36 个月后的 5 个自然年度内完成 50%目标激励股份的授予或减持收益分配。

2、自公司首次公开发行并上市满 36 个月后的 10 个自然年度内完成剩余目标激励股份的授予或减持收益分配。

3、该目标激励股份的实施过程不会新增发行公司股份及稀释上市后新老股东权益，具体分配安排视当期情况而定。未来激励对象（即员工）所支付行权价款在扣除本人认购目标激励股份的出资成本、税务成本及资金成本后将全部无偿交付给公司；目标激励股份未来减持收益在扣除本人出资成本、税务成本及资金成本后将专项用于公司员工激励。

4、除上述分配给员工的目标激励股份外，本人所持合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）的其他合伙企业份额（对应公司当前股本的 767,920,917 股长鑫科技股份）自愿锁定承诺安排不变。”

2）作为核心技术人员的董事、高级管理人员曹堪宇、李红文承诺

“1.本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，

自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2.在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的任何首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺。

3.本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持任何发行人股份。

4.本人作为发行人核心技术人员，本人所持首发前股份的限售期满之日起 4 年内，每年可转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人在离职后 6 个月内，不转让本人所持任何首发前股份。

5.发行人上市后 36 个月或根据届时的 IPO 及上市公司监管规则要求设置的更长锁定期（孰晚，以下简称“限售期”）届满后，本人在职期间（含离职当年）每年可减持的锁定股份（即本人在公司上市前通过发行人《第二期员工持股计划》获授予的持股份额，下同）不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%，限售期满十年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。自本人离职后 6 个月内，不转让任何锁定股份。自本人离职后满 6 个月起或自本人离职次年 1 月 1 日起（孰晚），本人每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。

6.尽管有前述承诺，如本人因任何原因在限售期届满前离职（包含主动离职与被动离职，但退休及基于公司安排在公司关联方任职（如有）除外（在该等情况下，本承诺函项下的其他承诺仍应适用）），则本人进一步承诺（i）在禁止减持期（如下文所定义）内不得转让或以其他方式处分本人所持有的任何锁定股份，且（ii）在禁止减持期届满后的次年 1 月 1 日起，每年减持锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。为本条之目的，禁止减持期

指限售期届满后的一段期间，该期间的长度与本人离职之日至限售期届满之日之间的期间长度相同。

7.本人所持首发前股份在限售期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价。

8.发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，本项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

9.若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整。

10.本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

11.在本人持股期间，若适用于发行人股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生更为严格的变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

3) 其他董事、高级管理人员谢树民、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园承诺

“1.本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2.在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的任何首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺。

3.本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持任何发行人股份。

4.发行人上市后 36 个月或根据届时的 IPO 及上市公司监管规则要求设置的更长锁定期（孰晚，以下简称“限售期”）届满后，本人在职期间（含离职当年）每年可减持

的锁定股份（即本人在公司上市前通过发行人《第二期员工持股计划》获授予的持股份额，下同）不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%，限售期满十年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。自本人离职后 6 个月内，不转让任何锁定股份。自本人离职后满 6 个月起或自本人离职次年 1 月 1 日起（孰晚），本人每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。

5. 尽管有前述承诺，如本人因任何原因在限售期届满前离职（包含主动离职与被动离职，但退休及基于公司安排在公司关联方任职（如有）除外（在该等情况下，本承诺函项下的其他承诺仍应适用）），则本人进一步承诺（i）在禁止减持期（如下文所定义）内不得转让或以其他方式处分本人所持有的任何锁定股份，且（ii）在禁止减持期届满后的次年 1 月 1 日起，每年减持锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。为本条之目的，禁止减持期指限售期届满后的一段期间，该期间的长度与本人离职之日起至限售期届满之日之间的期间长度相同。

6. 本人所持首发前股份在限售期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价。

7. 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，本项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

8. 若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整。

9. 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

10. 在本人持股期间，若适用于发行人股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生更为严格的变化，则本人将依据相关法律法规的要求适

用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

4) 核心技术人员 TAN TECK HONG (陈德鸿)、王丹、唐衍哲承诺

“1.本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2.在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的任何首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺。

3.本人作为发行人核心技术人员，本人所持首发前股份的限售期满之日起 4 年内，每年可转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人在离职后 6 个月内，不转让本人所持任何首发前股份。

4.发行人上市后 36 个月或根据届时的 IPO 及上市公司监管规则要求设置的更长锁定期（孰晚，以下简称“限售期”）届满后，本人在职期间（含离职当年）每年可减持的锁定股份（即本人在公司上市前通过发行人《第二期员工持股计划》获授予的持股份额，下同）不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%，限售期满十年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。自本人离职次年 1 月 1 日起，本人每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。

5.尽管有前述承诺，如本人因任何原因在限售期届满前离职（包含主动离职与被动离职，但退休及基于公司安排在公司关联方任职（如有）除外（在该等情况下，本承诺函项下的其他承诺仍应适用）），则本人进一步承诺（i）在禁止减持期（如下文所定义）内不得转让或以其他方式处分本人所持有的任何锁定股份，且（ii）在禁止减持期届满后的次年 1 月 1 日起，每年减持锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。为本条之目的，禁止减持期

指限售期届满后的一段期间，该期间的长度与本人离职之日至限售期届满之日之间的期间长度相同。

6. 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，本项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

7. 若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整。

8. 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

9. 在本人持股期间，若适用于发行人股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生更为严格的变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（4）发行人其他股东兆易创新、招银云亭、北京峰益、和谐健康、国调基金、阿里网络、鑫芯励润、宁波燕创、农银投资、芜湖星原、建信投资、国寿投资、宁波君和、中安招商基金、人保资本、鑫芯家园、嘉兴恒旭、美的投资、安徽担保资管、安元星亿达、安华创新、君挚璞创投、青岛朗格、Gamcier、建银国际、华芯科泰、广州科集、工融金投、深圳投控、Glades View、招证投资、前海方舟、云锋卓越、安徽交控、海通徽银、中银资产、交银金融、东方资管、阳光人寿、中邮人寿、建信领航、天津海河、中金共赢、湖北小米、北京君联、人保科创、和壮高新、中建材新材料基金、芯鑫集电、合肥建长的承诺

“1. 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或委托他人管理承诺人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人持有的上述股份。

2. 承诺人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

3. 在承诺人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(5) 除董事、高级管理人员、核心技术人员外的 22 名发行人第二期员工持股计划获授予对象的承诺

“1.本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2.在发行人实现盈利前，自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的任何首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份，本人在前述期间内离职的，将会继续遵守该承诺。

3.发行人上市后 36 个月或根据届时的 IPO 及上市公司监管规则要求设置的更长锁定期（孰晚，以下简称“限售期”）届满后，本人在职期间（含离职当年）每年可减持的锁定股份（即本人在公司上市前通过发行人《第二期员工持股计划》获授予的持股份额，下同）不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 20%，限售期满十年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。自本人离职后 6 个月内，不转让任何锁定股份。自本人离职后满 6 个月起或自本人离职次年 1 月 1 日起（孰晚），本人每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。

4.尽管有前述承诺，如本人因任何原因在限售期届满前离职（包含主动离职与被动离职，但退休及基于公司安排在公司关联方任职（如有）除外（在该等情况下，本承诺函项下的其他承诺仍应适用）），则本人进一步承诺（i）在禁止减持期（如下文所定义）内不得转让或以其他方式处分本人所持有的任何锁定股份，且（ii）在禁止减持期届满后的次年 1 月 1 日起，每年减持锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。为本条之目的，禁止减持期指限售期届满后的一段期间，该期间的长度与本人离职之日至限售期届满之日之间的期间长度相同。

5.发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月，本项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

6.若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整。

7.本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

8.在本人持股期间，若适用于发行人股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生更为严格的变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（6）发行人第二期员工持股计划获授予对象王远鹏等共计 412 名对象的承诺

“1.本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的股份锁定承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。

2.发行人上市后 36 个月或根据届时的 IPO 及上市公司监管规则要求设置的更长锁定期（孰晚，以下简称“限售期”）届满后，本人在职期间（含离职当年）每年可减持的锁定股份（即本人在公司上市前通过发行人《第二期员工持股计划》获授予的持股份额，下同）不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 30%，限售期满八年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。自本人离职次年 1 月 1 日起，本人每年可减持的锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份。

3.尽管有前述承诺，如本人因任何原因在限售期届满前离职（包含主动离职与被动离职，但退休及基于公司安排在公司关联方任职（如有）除外（在该等情况下，本承诺函项下的其他承诺仍应适用）），则本人进一步承诺（i）在禁止减持期（如下文所定义）内不得转让或以其他方式处分本人所持有的任何锁定股份，且（i）在禁止减持期届满后的次年 1 月 1 日起，每年减持锁定股份不得超过截至上一年末本人所持锁定股份

总数的 10%，限售期满十五年后，可以一次性减持剩余锁定股份，法律法规、证券监督管理机构及证券交易所另有更为严格的减持限制规定除外。为本条之目的，禁止减持期指限售期届满后的一段期间，该期间的长度与本人离职之日起至限售期届满之日之间的期间长度相同。

4.若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，上述股份价格、股份数量按照证券交易所的有关规定作相应调整

5.本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、公司上市的证券交易所业务规则中关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。

6.在本人持股期间，若适用于发行人股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生更为严格的变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

2、关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺

（1）发行人持股 5%以上股东及一致行动人的承诺

1) 清辉集电承诺

“1.承诺人将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人招股说明书中记载的和承诺人出具的承诺文件中载明的各项锁定期要求，在锁定期内承诺人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2.锁定期届满后的两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及承诺人作出的其他公开承诺前提下，承诺人存在适当减持发行人股份的可能。

3.在锁定期届满后，承诺人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

4.承诺人减持直接或者间接所持有的发行人股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人在发行人首次公开发行股票前直接或者间接所持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格按照证券交易所的有关规定作相应调整。

5.锁定期届满后，承诺人减持直接或者间接所持发行人股份时，将按照证券监督管

理机构及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务并配合发行人的信息披露工作，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的在减持前 15 个交易日前对相关减持计划予以公告，通过其他方式减持的在减持前 3 个交易日予以公告。

6.在承诺人持有发行人股份期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

2) 长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫、安徽省投、产投高成长承诺

“1.承诺人将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人招股说明书中记载的和承诺人出具的承诺文件中载明的各项锁定期要求，在锁定期内承诺人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2.锁定期届满后的两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及承诺人作出的其他公开承诺前提下，承诺人存在适当减持发行人股份的可能。

3.在锁定期届满后，承诺人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

4.承诺人减持直接或者间接所持有的发行人股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。

5.锁定期届满后，承诺人减持直接或者间接所持发行人股份时，将按照证券监督管理机构及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务并配合发行人的信息披露工作，按照届时适用的证券监管规则的要求提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人。

6.在承诺人持有发行人股份期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则承诺人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(2) 持有发行人股份的董事、高级管理人员及核心技术人员朱一明、曹堪宇、谢树民、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文、TAN TECK HONG (陈德鸿)、王丹、唐衍哲的承诺

1) 董事、高级管理人员朱一明、曹堪宇、谢树民、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文承诺

“1.本人将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人招股说明书中记载的和本人出具的承诺文件中载明的各项锁定期要求，在锁定期内本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2.在锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

3.本人减持所持有的发行人股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价。若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格按照证券交易所的有关规定作相应调整。

4.在本人持有发行人股份期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

2) 核心技术人员 TAN TECK HONG (陈德鸿)、王丹、唐衍哲承诺

“1.本人将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人招股说明书中记载的和本人出具的承诺文件中载明的各项锁定期要求，在锁定期内本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2.在锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

3.本人减持所持有的发行人股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的相应要求。

4.在本人持有发行人股份期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证

券监管机构的要求发生变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（二）稳定股价的措施和承诺

发行人及其董事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外，含董事长朱一明）、高级管理人员朱一明、曹堪宇、谢树民、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文就稳定股价作出如下承诺：

1、发行人的承诺

“公司将按照《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》（以下简称“稳定股价议案”）的相关规定，履行各项义务。

公司承诺并保证未来新聘任的董事和高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和公司稳定股价议案的相应要求。”

2、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员朱一明、曹堪宇、谢树民、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文承诺如下：

“本人将按照《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》（以下简称“稳定股价议案”）的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份方案的相关决议投赞成票（如有表决权）；并按照稳定股价议案中的相关规定，履行相关的各项义务。”

（三）填补被摊薄即期回报措施的承诺

1、发行人的承诺

“公司将按照《关于填补首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》的相关规定，履行各项义务。”

2、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员朱一明、曹堪宇、郑锐、方炜、韦俊、侯华伟、谢树民、陈武朝、李华、蔡一茂、郭薇、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文承诺如下：

“1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2.对职务消费行为进行约束。

3.不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4.在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5.如果公司未来拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。”

（四）股份回购和股份购回的承诺

发行人就稳定股价出具的股份回购和股份购回承诺如下：

“1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业承诺将依法回购本次公开发行的全部新股。本企业承诺将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后的5个工作日内启动股份回购程序，回购发行人本次公开发行的全部新股。

2、当《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，本企业承诺将按照《关于稳定股价的承诺函》履行回购公司股份的义务。”

（五）第一大股东清辉集电关于避免同业竞争的承诺

发行人第一大股东清辉集电承诺：

“1.截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人直接或间接控制的下属单位并未以任何方式直接或间接从事与发行人或其下属单位主营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（单位、企业）发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。

2.自本承诺函出具之日起，承诺人承诺将不会：（1）新增单独或与第三方，以直接或间接控制的形式从事与发行人或其下属单位主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；（2）如承诺人及承诺人直接或间接控制的下属单位获得以任何方式拥有与发行人及其下属单位主营业务竞争的单位的控制性股份、股权或权益的新商业机会，承诺人将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该新投资机会的书面答复，承诺人或承诺人直接或间接控制的下属单位（发行人及其下属单位除外）在合法框架下尽力促使该等新商业机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属单位。

3.本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）承诺人/及一致行动人（如有）不再是发行人第一大股东；（2）发行人的股票终止在上海证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

4.“下属单位”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他单位或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他单位或实体的下属单位。”

（六）发生欺诈发行情形的股份购回承诺

1、发行人的承诺

“1.公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

2.如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购本公司本次公开发行的全部新股。”

2、发行人第一大股东清辉集电的承诺

“1.承诺人保证发行人本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

2.如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次发行上市的全部新股。

3.如发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，承诺人自愿先行赔付投资者。”

（七）关于利润分配政策的承诺

发行人承诺如下：

“公司在本次发行上市后将严格依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》等规定执行利润分配政策，履行各项义务。”

（八）关于未能履行承诺事项约束措施的承诺

1、发行人及其持股 5%以上股东及一致行动人、董事、高级管理人员、核心技术人员承诺

“1.承诺人在发行人本次发行上市中作出的各项承诺（以下简称“承诺事项”）均为承诺人的真实意思表示，并对承诺人具有约束力，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。

2.如承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3.如承诺人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则承诺人承诺将采取以下各项措施予以约束：

（1）可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程（草案）》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；

（2）若证券监管部门或其他有权部门认定承诺人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。”

2、发行人第二期员工持股计划获授予对象朱一明、曹堪宇等共计 35 名对象的承诺

“1.承诺人在发行人本次发行上市中作出的各项承诺（以下简称“承诺事项”）均为承诺人的真实意思表示，并对承诺人具有约束力，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。承诺人将严格履行承诺事项中的各项义务和责任。

2.如承诺人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，承诺人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3.如承诺人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项，则承诺人承诺将采取以下各项措施予以约束：

（1）可以采取相应补救措施或提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程（草案）》、相关内控制度的规定履行相关审批和信息披露程序）；

（2）若因承诺人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。”

（九）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人及其第一大股东、董事、高级管理人员就依法承担赔偿责任作出如下承诺：

“1.公司本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

2.公司本次发行上市的《招股说明书》及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，承诺人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。”

2、发行人保荐机构（主承销商）的承诺

中金公司、中信建投承诺：“本公司为本次公开发行制作的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若因本公司未能勤勉尽责，为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

3、发行人律师的承诺

“上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的发行人律师，就为发行人本次公开发行制作、出具的文件，特此承诺如下：

若本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

4、发行人会计师、验资机构的承诺

“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）作为长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）首次公开发行股票并上市的审计机构及验资机构，出具了长鑫科技 2025 年度、2024 年度及 2023 年度财务报表的审计报告、关于原始财务报表与申报财务报表差异比较表的专项说明、关于非经常性损益明细表的专项说明、关于主要税种纳税情况的专项说明、长鑫科技于 2025 年 12 月 31 日的内部控制审计报告、长鑫科技截至 2023 年 6 月 26 日止注册资本及实收资本变更情况的验资报告（以下统称“报告及说明”）。若因本所出具的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

5、发行人评估机构的承诺

“本机构为长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人本次发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法承担相应责任，但本公司能够证明自己没有过错的情况除外。”

（十）忠实履行董事义务及避免利益冲突的承诺

1、发行人董事长就忠实履行董事义务及避免利益冲突作出如下承诺：

“本人未违反并继续遵守《公司法》（2023 年修订）规定的董事忠实义务，并承诺遵守《公司法》第一百八十三条规定的“不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列情形之一的除外：（一）向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过；（二）根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会。”的情形。

凡与长鑫科技主营业务（即符合公司业务布局 and 战略布局的主流 DRAM 产品）相

关的商业机会，本人均优先介绍给长鑫科技。”

六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）关于规范关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东及一致行动人、董事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：

1、发行人持股 5%以上股东及一致行动人清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫、安徽省投、产投高成长的承诺

“1.承诺人及承诺人控制的其他企业不利用承诺人作为发行人持股 5%以上股东的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及承诺人控制的其他企业将规范与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，签署相关协议，并按规定履行信息披露义务。

2.承诺人保证承诺人与承诺人控制的其他企业、提名的董事将按照法律法规、规范性文件 and 发行人公司章程的规定，在审议涉及与发行人的关联交易事项时，切实遵守发行人董事会、股东会进行关联交易表决时的回避程序。

3.承诺人保证承诺人、承诺人控制的其他企业、提名的董事严格遵守发行人关联交易的决策制度，确保不损害发行人和其他股东的合法利益；保证不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。”

2、发行人董事、高级管理人员的承诺

发行人董事、高级管理人员朱一明、曹堪宇、郑锐、方炜、韦俊、侯华伟、谢树民、陈武朝、李华、蔡一茂、郭薇、赵纶、张羽、朱文菊、黄丹阳、冯鹏熙、袁园、李红文承诺如下：

“1.本人及本人控制的其他企业不利用本人作为发行人董事/高级管理人员，占用发行人及其子公司的资金。本人及本人控制的其他企业将规范与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，签署关联交易协议，并按规定履行信息披露义务。

2.本人保证本人与本人控制的其他企业将按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程的规定，在审议涉及与发行人的关联交易事项时（如涉及），切实遵守发行人董事会、股东会进行关联交易表决时的回避程序。

3.本人保证本人、本人控制的其他企业严格遵守发行人关联交易的决策制度，确保不损害发行人和其他股东的合法利益；保证不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。”

（二）股东信息披露专项承诺

发行人就股东持股情况作出如下承诺：

“1.公司股东持有的发行人股份权属清晰，不存在股份代持等情况，不存在权属纠纷或潜在纠纷；

2.公司股东均具备持有公司股份的主体资格，不存在法律法规和中国证券监督管理委员会规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

3.除《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》已披露的股权关系外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；

4.公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形；

5.公司及公司股东已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”

（三）关于保证不影响和干扰审核的承诺函

发行人及其第一大股东、董事、高级管理人员作出如下承诺：

“（一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。

（二）不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所

上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益：

1. 以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利；
2. 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利；
3. 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
4. 直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动；
5. 其他输送不正当利益的情形。

（三）不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。

（四）遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

如违反上述承诺，承诺人自愿接受上海证券交易所依据其业务规则采取的终止审核、一定期限内不接受申请文件、公开认定不适合担任相关职务等措施。承诺人相关行为违反法律法规的，将承担相应法律责任。”

七、股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》，建立健全了股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书等制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构相互协调、相互制衡的运行机制。

为进一步健全法人治理结构，公司在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会，并制定了相应的工作制度，明确了各专门委员会的权责、决策程序及议事规则。自设立以来，公司股东会、董事会、监事会/审计委员会均按照《公司法》等相关法律法规独立有效运作，无违法、违规情况。

（一）股东会制度

公司制定了《股东会议事规则》。股份有限公司设立至本招股说明书签署日，公司共召开 11 次股东会。股东会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《股东会议事规则》等公司规章制度规范运作，股东通过现场、通讯或委托方式出席历次会议。股东会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

（二）董事会制度

公司制定了《董事会议事规则》。股份有限公司设立至本招股说明书签署日，公司共召开 32 次董事会会议。董事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度规范运作，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。此外，公司设立执行委员会，执行委员会是董事会领导下的公司经营管理决策机构，对董事会负责。

（三）审计委员会制度

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和其他规范性文件的要求，发行人设置审计委员会并制定了《董事会审计委员会工作细则》。发行人于 2025 年 6 月召开股东会，取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对审计委员会的职责权限、审计委员会的决策程序、审计委员会的议事规则等内容作出了详细明确的

规定，建立了较为完善的审计委员会制度。

审计委员会由3名成员组成，由董事会选举产生，其中独立董事2名，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任。

2025年6月取消监事会之前，发行人根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和其他规范性文件的要求，在《公司章程》中对监事会职权、监事会的通知、监事会的召开、监事会的表决和决议等内容作出了详细明确的规定，建立了较为完善的监事会制度。发行人监事会由3名监事组成。报告期内，发行人共召开了4次监事会会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司章程制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司章程制度行使职权的情形。

（四）独立董事制度

公司董事会设4名独立董事，达到董事会总人数的三分之一，其中1名为会计专业人士。独立董事自聘任以来，依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》等公司规章制度勤勉尽责地履行职权，准时出席了历次董事会会议，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事项进行了认真审议并发表了独立意见。独立董事对公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

（五）董事会秘书制度

公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘，主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定筹备董事会和股东会，勤勉地履行了其职责。

八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

发行人董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会等专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。发行人制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《关联交易委员会工作细则》。目前，各董事会专门

委员会的构成情况如下：

委员会名称	召集人	其他委员
审计委员会	陈武朝	李华、郑锐
战略委员会	朱一明	曹堪宇、侯华伟
提名委员会	郭薇	方炜、陈武朝
薪酬与考核委员会	蔡一茂	朱一明、李华
关联交易委员会	李华	侯华伟、陈武朝

发行人董事会各专门委员会自设立之日起，根据《公司法》《公司章程》及相关工作细则，积极履行职责，对公司审计工作、战略规划、董事与高级管理人员提名及薪酬与考核、关联交易等事项提出建议与改善措施，进一步规范和完善了公司的治理。

九、公司无形资产情况

（一）主要专利情况

报告期内，公司生产经营相关的主要专利 304 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
1	具有双倍间距的布局图形及其形成方法	201711467952.4	发明	2017-12-29	长鑫存储
2	柱状电容器阵列结构及制备方法	201810471970.8	发明	2018-05-17	长鑫存储
3	窗口型球栅阵列封装组件	201810487209.3	发明	2018-05-21	长鑫存储
4	半导体器件及其制作方法	201810538446.8	发明	2018-05-30	长鑫存储
5	用于形成图形的方法	201810902078.0	发明	2018-08-09	长鑫存储
6	沟槽的填充方法	201810987735.6	发明	2018-08-28	长鑫存储
7	半导体存储器及其形成方法	201811032485.7	发明	2018-09-05	长鑫存储
8	集成电路存储器的晶体管组合结构及其形成方法	201811033536.8	发明	2018-09-05	长鑫存储
9	空气隙形成方法	201811038068.3	发明	2018-09-06	长鑫存储
10	具有大马士革结构的半导体结构及其制备方法	201811041883.5	发明	2018-09-07	长鑫存储
11	半导体器件及其形成方法	201811043056.X	发明	2018-09-05	长鑫存储
12	半导体结构的形成方法及半导体结构	201811061292.4	发明	2018-09-04	长鑫存储
13	半导体存储器的形成方法	201811065120.4	发明	2018-09-11	长鑫存储
14	半导体结构中氧化层的形成方法	201811069648.9	发明	2018-09-13	长鑫存储
15	浅沟槽隔离结构及其制备方法	201811071286.7	发明	2018-09-14	长鑫存储
16	半导体器件及其制造方法	201811086052.X	发明	2018-09-18	长鑫存储
17	一种浅沟槽隔离结构及其制作方法	201811087794.4	发明	2018-09-18	长鑫存储
18	半导体器件形成方法	201811109931.X	发明	2018-09-21	长鑫存储
19	化学机械研磨混合液及研磨方法	201811118496.7	发明	2018-09-25	长鑫存储
20	一种硅化钴膜的制备方法	201811120092.1	发明	2018-09-25	长鑫存储
21	一种半导体结构及通孔的形成方法	201811122758.7	发明	2018-09-26	长鑫存储
22	一种半导体结构及其制作方法	201811123264.0	发明	2018-09-26	长鑫存储
23	半导体结构的形成方法	201811139884.3	发明	2018-09-28	长鑫存储
24	制备非晶硅薄膜的方法	201811140963.6	发明	2018-09-28	长鑫存储
25	晶体管及其形成方法、半导体器件	201811142032.X	发明	2018-09-28	长鑫存储
26	电容结构及其形成方法	201811146228.6	发明	2018-09-29	长鑫存储
27	半导体结构及制备方法	201811147153.3	发明	2018-09-29	长鑫存储
28	电容器阵列及其形成方法、半导体器件	201811149809.5	发明	2018-09-29	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
29	电容器阵列结构及其形成方法、半导体器件	201811151407.9	发明	2018-09-29	长鑫存储
30	集成电路修复方法及装置、存储介质、电子设备	201811155355.2	发明	2018-09-30	长鑫存储
31	一种半导体结构及其制作方法	201811160228.1	发明	2018-09-30	长鑫存储
32	掩膜板和电容器阵列、半导体器件及其制备方法	201811173407.9	发明	2018-10-09	长鑫存储
33	通孔阵列的形成方法及半导体器件的形成方法	201811174605.7	发明	2018-10-09	长鑫存储
34	微图案刻蚀方法	201811207063.9	发明	2018-10-17	长鑫存储
35	场效应管器件的制造方法	201811242745.3	发明	2018-10-24	长鑫存储
36	数据接口电路及存储装置	201811260394.9	发明	2018-10-26	长鑫存储
37	移位寄存器电路、动态随机存储器和电路控制方法	201811261641.7	发明	2018-10-26	长鑫存储
38	半导体器件及其制作方法	201811279155.8	发明	2018-10-30	长鑫存储
39	集成电路结构和存储器	201811290078.6	发明	2018-10-31	长鑫存储
40	半导体存储器	201811325774.6	发明	2018-11-08	长鑫存储
41	高频时钟占空比校准电路、校准方法和存储器	201811326927.9	发明	2018-11-08	长鑫存储
42	低频时钟占空比校准电路、校准方法和存储器	201811326930.0	发明	2018-11-08	长鑫存储
43	占空比校准电路、存储器及占空比校准电路的调整方法	201811326942.3	发明	2018-11-08	长鑫存储
44	半导体器件的形成方法	201811332614.4	发明	2018-11-09	长鑫存储
45	一种埋入式栅极结构及其制造方法	201811336185.8	发明	2018-11-09	长鑫存储
46	延时锁相环电路、同步时钟信号方法及半导体存储器	201811381841.6	发明	2018-11-20	长鑫存储
47	半导体器件的制作方法与半导体器件	201811393149.5	发明	2018-11-21	长鑫存储
48	晶圆清洗方法及半导体器件制作方法	201811419203.9	发明	2018-11-26	长鑫存储
49	数据读写方法及装置、动态随机存储器	201811446017.4	发明	2018-11-29	长鑫存储
50	导电插塞结构、半导体器件及其形成方法	201811460109.8	发明	2018-11-30	长鑫存储
51	一种半导体的涂布设备及涂布方法	201811476732.2	发明	2018-12-05	长鑫存储
52	互连结构及其制作方法、半导体器件	201910024057.8	发明	2019-01-10	长鑫存储
53	仿真结果的比较方法	201910040831.4	发明	2019-01-16	长鑫存储
54	半导体结构及其形成方法	201910183915.3	发明	2019-03-12	长鑫存储
55	半导体结构及其制备方法	201910276119.4	发明	2019-04-08	长鑫存储
56	存储器参考电压的确定电路、方法、存储器和电子设备	201910337990.0	发明	2019-04-25	长鑫存储
57	半导体结构及其形成方法	201910402381.9	发明	2019-05-15	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
58	对准图形、具有对准图形的半导体结构及其制造方法	201910419613.1	发明	2019-05-20	长鑫存储
59	半导体结构及其制造方法、存储器	201910433749.8	发明	2019-05-23	长鑫存储
60	半导体结构及其制造方法、存储器	201910434483.9	发明	2019-05-23	长鑫存储
61	沟槽阵列晶体管结构及其制备方法	201910438272.2	发明	2019-05-24	长鑫存储
62	沟槽阵列晶体管结构及其制备方法	201910438290.0	发明	2019-05-24	长鑫存储
63	半导体结构及其制作方法	201910456609.2	发明	2019-05-29	长鑫存储
64	半导体器件的制备方法	201910504944.5	发明	2019-06-12	长鑫存储
65	半导体器件及其制备方法	201910517520.2	发明	2019-06-14	长鑫存储
66	半导体结构及其形成方法	201910644881.3	发明	2019-07-17	长鑫存储
67	PIN 二极管及其形成方法、静电保护结构	201910661101.6	发明	2019-07-22	长鑫存储
68	导电互连结构及其制备方法	201910700587.X	发明	2019-07-31	长鑫存储
69	半导体结构及其制作方法	201910722668.X	发明	2019-08-06	长鑫存储
70	数据采样电路	201910741170.8	发明	2019-08-12	长鑫存储
71	半导体器件结构及其制作方法	201910750969.3	发明	2019-08-14	长鑫存储
72	半导体存储器的形成方法	201910814275.1	发明	2019-08-30	长鑫存储
73	电容阵列结构及其形成方法	201910898779.6	发明	2019-09-23	长鑫存储
74	DRAM 存储器	201910904496.8	发明	2019-09-24	长鑫存储
75	半导体结构的制作方法 & 半导体结构	201910906756.5	发明	2019-09-24	长鑫存储
76	图形转移方法	201910918577.3	发明	2019-09-26	长鑫存储
77	电源模块和存储器	201910922840.6	发明	2019-09-27	长鑫存储
78	阶梯型字线结构及其制备方法	201910981688.9	发明	2019-10-16	长鑫存储
79	输出驱动电路及存储器	201910981694.4	发明	2019-10-16	长鑫存储
80	半导体结构及其制备方法	201911080780.4	发明	2019-11-07	长鑫存储
81	浅沟槽隔离结构及其形成方法、掩膜结构	201911105656.9	发明	2019-11-13	长鑫存储
82	半导体结构及其形成方法	201911172409.0	发明	2019-11-26	长鑫存储
83	存储器、存储器的衬底结构及其制备方法	201911175485.7	发明	2019-11-26	长鑫存储
84	读写转换电路及其驱动方法、存储器	201911181058.X	发明	2019-11-27	长鑫存储
85	灵敏放大器及其控制方法	201911188084.5	发明	2019-11-28	长鑫存储
86	比较器	201911188793.3	发明	2019-11-28	长鑫存储
87	半导体器件及其制作方法	201911207283.6	发明	2019-11-29	长鑫存储
88	半导体结构及其制作方法	201911208941.3	发明	2019-11-30	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
89	半导体存储器及其形成方法	201911213052.6	发明	2019-12-02	长鑫存储
90	半导体结构及其形成方法	201911213609.6	发明	2019-12-02	长鑫存储
91	半导体结构及其制备方法	201911239722.1	发明	2019-12-06	长鑫存储
92	互连结构及其制备方法	201911244975.8	发明	2019-12-06	长鑫存储
93	半导体器件及其制备方法	202010052772.5	发明	2020-01-17	长鑫存储
94	封装结构及其形成方法	202010102446.0	发明	2020-02-19	长鑫存储
95	存储块以及存储器	202010237983.6	发明	2020-03-30	长鑫存储
96	半导体结构及其制作方法	202010267288.4	发明	2020-04-08	长鑫存储
97	半导体存储器件及其制备方法	202010267452.1	发明	2020-04-08	长鑫存储
98	掩膜版及掩膜版质量测试方法	202010279765.9	发明	2020-04-10	长鑫存储
99	半导体结构及其形成方法	202010361178.4	发明	2020-04-30	长鑫存储
100	半导体结构及其制备方法	202010537845.X	发明	2020-06-12	长鑫存储
101	半导体器件、电容装置及电容装置的制造方法	202010565258.1	发明	2020-06-19	长鑫存储
102	反熔丝存储单元状态检测电路及存储器	202010687680.4	发明	2020-07-16	长鑫存储
103	半导体结构的制作方法	202010758023.4	发明	2020-07-31	长鑫存储
104	驱动电路	202010787892.X	发明	2020-08-07	长鑫存储
105	半导体结构	202010804638.6	发明	2020-08-12	长鑫存储
106	集成电路存储器及其制备方法、半导体集成电路器件	202010842887.4	发明	2020-08-20	长鑫存储
107	半导体结构及半导体结构的制造方法	202010878114.1	发明	2020-08-27	长鑫存储
108	半导体器件的制备方法	202010887738.X	发明	2020-08-28	长鑫存储
109	振荡电路	202010943869.5	发明	2020-09-08	长鑫存储
110	半导体器件及其制备方法	202010962471.6	发明	2020-09-14	长鑫存储
111	半导体结构的形成方法及半导体结构	202010966605.1	发明	2020-09-15	长鑫存储
112	半导体结构的形成方法及半导体结构	202010966611.7	发明	2020-09-15	长鑫存储
113	埋入式字线晶体管的制作方法、晶体管及存储器	202010974520.8	发明	2020-09-16	长鑫存储
114	电容器阵列结构及其制造方法和动态随机存储器	202010976168.1	发明	2020-09-16	长鑫存储
115	半导体结构的制造方法及半导体结构	202010984302.2	发明	2020-09-18	长鑫存储
116	一种列选择信号单元电路、位线感测电路及存储器	202010986823.1	发明	2020-09-18	长鑫存储
117	半导体器件、半导体结构及其制造方法	202010993937.9	发明	2020-09-21	长鑫存储
118	数据通路接口电路、存储器和存储系统	202011006722.X	发明	2020-09-23	长鑫存储
119	均衡电路、数据采集方法及存储器	202011018885.X	发明	2020-09-24	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
120	半导体器件及其制备方法、存储装置	202011033098.2	发明	2020-09-27	长鑫存储
121	集成电路存储器及其形成方法	202011042960.6	发明	2020-09-28	长鑫存储
122	半导体结构以及半导体结构的形成方法	202011043756.6	发明	2020-09-28	长鑫存储
123	半导体结构及其形成方法	202011047212.7	发明	2020-09-29	长鑫存储
124	半导体器件及其制备方法	202011049179.1	发明	2020-09-29	长鑫存储
125	膜层的形成方法	202011051630.3	发明	2020-09-29	长鑫存储
126	半导体结构及其制作方法	202011149559.2	发明	2020-10-23	长鑫存储
127	半导体结构的形成方法	202011165219.9	发明	2020-10-27	长鑫存储
128	半导体结构的形成方法以及半导体结构	202011173598.6	发明	2020-10-28	长鑫存储
129	时钟产生电路、存储器以及时钟占空比校准方法	202011176592.4	发明	2020-10-28	长鑫存储
130	半导体结构制作方法及半导体结构	202011217685.7	发明	2020-11-04	长鑫存储
131	半导体结构及半导体结构制作方法	202011219025.2	发明	2020-11-04	长鑫存储
132	集成电路装置及其形成方法	202011221558.4	发明	2020-11-05	长鑫存储
133	存储器的电容连接线的制作方法和存储器	202011221664.2	发明	2020-11-05	长鑫存储
134	存储器的制造方法及存储器	202011233641.3	发明	2020-11-06	长鑫存储
135	具有埋入式位线的半导体装置及其制备方法	202011261602.4	发明	2020-11-12	长鑫存储
136	半导体结构及其形成方法	202011265548.0	发明	2020-11-13	长鑫存储
137	脉冲信号产生电路和产生方法、存储器	202011279041.0	发明	2020-11-16	长鑫存储
138	半导体结构的制造方法及半导体结构	202011305915.5	发明	2020-11-19	长鑫存储
139	半导体结构及半导体结构的制造方法	202011324586.9	发明	2020-11-23	长鑫存储
140	控制电路和延时电路	202011340785.9	发明	2020-11-25	长鑫存储
141	动态随机存取存储器电容器及其制备方法	202011349123.8	发明	2020-11-26	长鑫存储
142	存储器及其制作方法	202011622620.0	发明	2020-12-30	长鑫存储
143	半导体结构的制备方法及半导体结构	202011630018.1	发明	2020-12-30	长鑫存储
144	半导体器件的制备方法及半导体器件	202011631057.3	发明	2020-12-30	长鑫存储
145	封装后的内存修复方法及装置、存储介质、电子设备	202110033504.3	发明	2021-01-12	长鑫存储
146	芯片结构、封装结构及其制作方法	202110048328.0	发明	2021-01-14	长鑫存储
147	半导体结构及其制作方法	202110049125.3	发明	2021-01-14	长鑫存储
148	封装基板以及封装结构	202110082929.3	发明	2021-01-21	长鑫存储
149	半导体结构的制备方法及半导体结构	202110128710.2	发明	2021-01-29	长鑫存储
150	集成电路结构的形成方法	202110128716.X	发明	2021-01-29	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
151	封装基板及具有其的半导体结构	202110164409.7	发明	2021-02-05	长鑫存储
152	封装基板及具有其的半导体结构	202110164416.7	发明	2021-02-05	长鑫存储
153	半导体结构的熔断填充方法及半导体结构	202110177190.4	发明	2021-02-07	长鑫存储
154	半导体结构的制备方法	202110200823.9	发明	2021-02-23	长鑫存储
155	套刻标记的形成方法及半导体结构	202110209604.7	发明	2021-02-25	长鑫存储
156	存储器件及其制备方法	202110209896.4	发明	2021-02-25	长鑫存储
157	半导体结构及半导体结构的制备方法	202110212890.2	发明	2021-02-25	长鑫存储
158	半导体结构的制备方法及半导体结构	202110224667.X	发明	2021-03-01	长鑫存储
159	半导体结构及其制造方法	202110240323.8	发明	2021-03-04	长鑫存储
160	存储器及其制备方法	202110241856.8	发明	2021-03-04	长鑫存储
161	半导体结构及其形成方法	202110244158.3	发明	2021-03-05	长鑫存储
162	保护环结构、半导体结构及其制造方法	202110270706.X	发明	2021-03-12	长鑫存储
163	半导体结构及其形成方法	202110289168.9	发明	2021-03-18	长鑫存储
164	半导体结构及其制作方法	202110310445.X	发明	2021-03-23	长鑫存储
165	半导体结构的制备方法	202110313214.4	发明	2021-03-24	长鑫存储
166	灵敏放大器、存储器以及控制方法	202110313685.5	发明	2021-03-24	长鑫存储
167	半导体结构及其形成方法	202110313866.8	发明	2021-03-24	长鑫存储
168	半导体器件膜厚的测量方法	202110332821.5	发明	2021-03-29	长鑫存储
169	数据传输电路、方法及存储装置	202110333856.0	发明	2021-03-29	长鑫存储
170	半导体结构的制作方法	202110341446.0	发明	2021-03-30	长鑫存储
171	存储器的制作方法及存储器	202110343740.5	发明	2021-03-30	长鑫存储
172	半导体结构制作方法及半导体结构	202110348268.4	发明	2021-03-31	长鑫存储
173	对准量测标记结构及对准量测方法	202110360791.9	发明	2021-04-02	长鑫存储
174	半导体器件的制造方法及其半导体器件	202110406661.4	发明	2021-04-15	长鑫存储
175	存储器的制作方法及存储器	202110408047.1	发明	2021-04-15	长鑫存储
176	半导体结构及半导体结构的制备方法	202110432535.6	发明	2021-04-21	长鑫存储
177	半导体封装结构及其形成方法	202110440019.8	发明	2021-04-23	长鑫存储
178	半导体结构的制备方法	202110440942.1	发明	2021-04-23	长鑫存储
179	晶圆研磨方法及晶圆失效分析方法	202110465899.4	发明	2021-04-28	长鑫存储
180	半导体结构的制备方法和半导体结构	202110476539.4	发明	2021-04-29	长鑫存储
181	半导体结构的制备方法、测量方法及半导体结构	202110484441.3	发明	2021-04-30	长鑫存储
182	存储器	202110609025.1	发明	2021-06-01	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
183	半导体结构及半导体结构的制作方法	202110746013.3	发明	2021-07-01	长鑫存储
184	一种信号生成电路、方法及半导体存储器	202110750417.X	发明	2021-07-02	长鑫存储
185	半导体基底的制备方法及半导体器件	202110757022.2	发明	2021-07-05	长鑫存储
186	半导体结构及其形成方法	202110759799.2	发明	2021-07-05	长鑫存储
187	半导体结构的制造方法、半导体结构与存储器	202110778391.X	发明	2021-07-09	长鑫存储
188	一种半导体存储器及其上存储块的容量配置方法	202110783912.0	发明	2021-07-12	长鑫存储
189	一种比较器及判决反馈均衡电路	202110785565.5	发明	2021-07-12	长鑫存储
190	半导体结构及其形成方法	202110790428.0	发明	2021-07-13	长鑫存储
191	金属工件表面光泽度的控制方法及金属薄膜的制备方法	202110790618.2	发明	2021-07-13	长鑫存储
192	半导体结构及其制作方法	202110894824.8	发明	2021-08-05	长鑫存储
193	图案化方法及半导体结构	202110898137.3	发明	2021-08-05	长鑫存储
194	一种半导体薄膜形成方法、半导体结构及存储器	202110925579.2	发明	2021-08-12	长鑫存储
195	半导体结构的制备方法及半导体结构	202110926432.5	发明	2021-08-12	长鑫存储
196	半导体结构及半导体结构的制备方法	202110926800.6	发明	2021-08-12	长鑫存储
197	半导体结构的制作方法及半导体结构	202110961599.5	发明	2021-08-20	长鑫存储
198	半导体结构的形成方法及半导体结构	202111068450.0	发明	2021-09-13	长鑫存储
199	晶圆结构及其制造方法	202111100978.1	发明	2021-09-18	长鑫存储
200	一种电容器阵列结构、及其制造方法及半导体存储器件	202111120106.1	发明	2021-09-18	长鑫存储
201	一种半导体结构及半导体结构制作方法	202111195182.9	发明	2021-10-13	长鑫存储
202	确定 DRAM 自刷新次数的方法及装置	202111222328.4	发明	2021-10-20	长鑫存储
203	一种有源区结构的制备方法、半导体结构和半导体存储器	202111282772.5	发明	2021-11-01	长鑫存储
204	存储单元、存储器及其制作方法	202111516468.2	发明	2021-12-09	长鑫存储
205	一种半导体结构及半导体结构的制备方法	202111602336.1	发明	2021-12-24	长鑫存储
206	一种数据传输电路、数据传输方法和电子设备	202210011419.1	发明	2022-01-06	长鑫存储
207	一种驱动调整电路和电子设备	202210011424.2	发明	2022-01-06	长鑫存储
208	一种薄膜厚度的测量方法以及测量装置	202210013788.4	发明	2022-01-07	长鑫存储
209	半导体结构及其形成方法	202210013964.4	发明	2022-01-07	长鑫存储
210	存储器检测方法及其装置	202210030575.2	发明	2022-01-12	长鑫存储
211	地址译码电路、存储器及控制方法	202210039196.X	发明	2022-01-13	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
212	刷新电路和存储器	202210044510.3	发明	2022-01-14	长鑫存储
213	一种等离子体处理装置及其处理晶片的方法	202210052425.1	发明	2022-01-18	长鑫存储
214	一种存储结构和半导体存储器	202210060541.8	发明	2022-01-19	长鑫存储
215	半导体结构及其制备方法	202210060771.4	发明	2022-01-19	长鑫存储
216	套刻误差补偿方法、系统及装置、电子设备和存储介质	202210144575.5	发明	2022-02-17	长鑫存储
217	延迟电路单元的版图、延迟电路的版图和半导体存储器	202210171878.6	发明	2022-02-24	长鑫存储
218	存储电路、数据传输电路和存储器	202210174060.X	发明	2022-02-24	长鑫存储
219	半导体结构的制作方法及其半导体结构	202210208576.1	发明	2022-03-03	长鑫存储
220	一种刷新电路、存储器及刷新方法	202210210837.3	发明	2022-03-04	长鑫存储
221	一种信号采样电路以及半导体存储器	202210291688.8	发明	2022-03-23	长鑫存储
222	一种控制方法、半导体存储器和电子设备	202210501554.4	发明	2022-05-09	长鑫存储
223	计数器电路	202210562822.3	发明	2022-05-23	长鑫存储
224	平坦度控制方法、装置、设备及介质	202210706556.7	发明	2022-06-21	长鑫存储
225	薄膜沉积设备及方法	202210901025.3	发明	2022-07-28	长鑫存储
226	清洗剂及其应用	202210938428.5	发明	2022-08-05	长鑫存储
227	冗余金属填充方法、装置、设备及介质	202210952859.7	发明	2022-08-09	长鑫存储
228	一种延迟锁相环、时钟同步电路和存储器	202210959922.X	发明	2022-08-11	长鑫科技
229	一种偏移校准电路及存储器	202210959979.X	发明	2022-08-11	长鑫科技
230	腔室清洗方法	202210982669.X	发明	2022-08-16	长鑫存储
231	一种存储器	202210984495.0	发明	2022-08-17	长鑫科技
232	一种半导体结构及存储器	202211003680.3	发明	2022-08-22	长鑫科技
233	半导体结构及其制作方法	202211028523.8	发明	2022-08-25	长鑫存储
234	半导体结构及其制备方法	202211046968.9	发明	2022-08-30	长鑫存储
235	一种数据采样电路、数据接收电路及存储器	202211050917.3	发明	2022-08-31	长鑫科技
236	一种半导体结构的处理方法及装置	202211064639.7	发明	2022-09-01	长鑫科技
237	电路布局结构的验证方法、装置、存储介质及设备	202211071518.5	发明	2022-09-01	长鑫存储
238	版图的设计方法、设计设备以及计算机可读存储介质	202211123599.9	发明	2022-09-15	长鑫存储
239	存储器及存储器的操作方法	202211124337.4	发明	2022-09-15	长鑫存储
240	字线驱动器以及存储装置	202211138984.0	发明	2022-09-19	长鑫存储
241	一种数据采样电路、延时检测电路及存	202211152118.7	发明	2022-09-21	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
	储器				
242	半导体结构的制备方法及半导体结构	202211199827.0	发明	2022-09-29	长鑫存储
243	一种反熔丝单元及反熔丝阵列	202211250993.9	发明	2022-10-13	长鑫存储
244	一种感测放大器及其控制方法、存储器	202211275920.5	发明	2022-10-18	长鑫存储
245	半导体结构及其制作方法	202211277123.0	发明	2022-10-18	长鑫存储
246	一种半导体结构及其形成方法	202211277686.X	发明	2022-10-19	长鑫科技
247	一种数据转换电路、方法和存储器	202211294436.7	发明	2022-10-21	长鑫存储
248	灵敏放大器及控制方法	202211348875.1	发明	2022-10-31	长鑫存储
249	套刻误差的量测方法以及控制半导体制造过程的方法	202211352795.3	发明	2022-11-01	长鑫科技
250	一种供电电路、存储器和电子设备	202211389603.6	发明	2022-11-08	长鑫存储
251	半导体结构及其制作方法	202211409924.8	发明	2022-11-10	长鑫存储
252	半导体器件及其制作方法	202211485241.0	发明	2022-11-24	长鑫存储
253	一种修复电路及方法、存储器和电子设备	202310087550.0	发明	2023-02-09	长鑫存储
254	采样控制电路、方法和存储器	202310102047.8	发明	2023-02-13	长鑫科技
255	半导体结构的制备方法及半导体结构	202310114411.2	发明	2023-02-15	长鑫存储
256	电源电路及芯片	202310126665.6	发明	2023-02-07	长鑫存储
257	反熔丝结构及反熔丝结构的制备方法	202310153953.0	发明	2023-02-23	长鑫存储
258	半导体结构的制备方法	202310169055.4	发明	2023-02-22	长鑫存储
259	半导体结构及其制备方法	202310196712.4	发明	2023-03-03	长鑫存储
260	行锤攻击保护方法与存储器	202310223553.2	发明	2023-03-09	长鑫存储
261	失效地址处理方法、装置及电子设备	202310225514.6	发明	2023-03-10	长鑫存储
262	一种解码器及其解码方法	202310238658.5	发明	2023-03-14	长鑫存储
263	半导体结构及其制备方法	202310240331.1	发明	2023-03-14	长鑫存储
264	一种半导体结构及其形成方法	202310242292.9	发明	2023-03-14	长鑫存储
265	感测放大电路结构及存储器	202310251701.1	发明	2023-03-16	长鑫存储
266	一种半导体结构及其制作方法	202310252597.8	发明	2023-03-16	长鑫存储
267	半导体结构及其制备方法	202310293861.2	发明	2023-03-24	长鑫存储
268	一种半导体结构的制备方法及半导体结构	202310302159.8	发明	2023-03-27	长鑫存储
269	半导体结构及其制造方法	202310304369.0	发明	2023-03-27	长鑫存储
270	半导体结构及其制造方法	202310304370.3	发明	2023-03-27	长鑫存储
271	列控制电路以及存储装置	202310311823.5	发明	2023-03-28	长鑫存储
272	一种半导体结构的制备方法及其结构	202310311824.X	发明	2023-03-28	长鑫存储

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
273	半导体结构的制造方法	202310341971.1	发明	2023-03-30	长鑫存储
274	存储器	202310355882.2	发明	2023-04-06	长鑫存储
275	半导体结构及其制备方法	202310357527.9	发明	2023-04-06	长鑫存储
276	一种命令产生电路及存储器	202310381529.1	发明	2023-04-11	长鑫存储
277	掩模版数据生成方法、装置、设备及介质	202310391524.7	发明	2023-04-13	长鑫存储
278	数据写入电路和存储器	202310410904.0	发明	2023-04-12	长鑫存储
279	半导体结构及其制备方法	202310417511.2	发明	2023-04-13	长鑫存储
280	一种半导体产品的测试方法	202310427255.5	发明	2023-04-20	长鑫存储
281	半导体结构及其制备方法	202310437858.3	发明	2023-04-23	长鑫存储
282	半导体结构及其制备方法	202310443685.6	发明	2023-04-24	长鑫存储
283	封装叠层结构及其制备方法	202310449591.X	发明	2023-04-23	长鑫存储
284	半导体结构的制造方法及半导体结构	202310450453.3	发明	2023-04-23	长鑫存储
285	套刻误差量测方法、校准方法及半导体测试结构	202310463821.8	发明	2023-04-26	长鑫存储
286	半导体器件及其制备方法	202310492394.6	发明	2023-05-05	长鑫存储
287	半导体结构的清洗方法	202310554088.0	发明	2023-05-15	长鑫存储
288	均衡器版图及存储器版图	202310596337.2	发明	2023-05-22	长鑫存储
289	半导体结构及其制备方法	202310661104.6	发明	2023-06-06	长鑫存储
290	刷新电路及存储器	202310666924.4	发明	2023-06-06	长鑫存储
291	半导体结构及其制作方法	202310687713.9	发明	2023-06-09	长鑫存储
292	存储单元、存储阵列及存储阵列的形成方法	202310688260.1	发明	2023-06-09	长鑫存储
293	接收电路以及半导体装置	202310713134.7	发明	2023-06-14	长鑫存储
294	半导体结构及其形成方法	202310740610.4	发明	2023-06-21	长鑫存储
295	一种掩模版及半导体结构	202310747629.1	发明	2023-06-21	长鑫存储
296	驱动控制电路及存储器	202310832132.X	发明	2023-07-07	长鑫存储
297	半导体结构的制备方法以及半导体结构	202310870269.4	发明	2023-07-14	长鑫存储
298	封装后修复电路、封装后修复方法和存储器装置	202410016920.6	发明	2024-01-05	长鑫西安
299	半导体存储器	202410034319.X	发明	2024-01-10	长鑫西安
300	半导体存储器	202410051088.3	发明	2024-01-15	长鑫西安
301	一种冗余地址寄存器结构、冗余地址寄存器阵列及存储器	202410061720.2	发明	2024-01-16	长鑫西安
302	字线驱动电路及其控制方法、存储器	202410073636.2	发明	2024-01-18	长鑫西安
303	刷新控制结构、刷新控制方法及存储器	202410111236.6	发明	2024-01-26	长鑫西安

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	证载权利人
304	存储器结构、刷新方法及存储器	202410139681.3	发明	2024-02-01	长鑫西安

注：根据《中华人民共和国专利法》等法律法规的规定，上述发明专利权的期限为二十年，均自申请日起计算。

（二）主要商标情况

报告期内，公司生产经营相关的主要商标 62 项，具体情况如下：

序号	商标权	注册号	注册地	国际分类号	注册日期	有效期至	证载权利人
1		34455193	中国	9	2019-06-28	2029-06-27	长鑫科技
2		42715109	中国	9	2020-08-14	2030-08-13	长鑫科技
3		76770161	中国	9	2024-09-07	2034-09-06	长鑫科技
4		33909387	中国	9	2019-06-07	2029-06-06	长鑫科技
5		33909388	中国	9	2019-06-07	2029-06-06	长鑫科技
6		33909389	中国	9	2019-06-07	2029-06-06	长鑫科技
7		46519765	中国	9	2021-01-07	2031-01-06	长鑫科技
8		46521648	中国	9	2021-01-07	2031-01-06	长鑫科技
9		46537452	中国	9	2021-01-07	2031-01-06	长鑫科技
10		54425280	中国	42	2021-10-21	2031-10-20	长鑫科技
11		54440246A	中国	35	2022-03-07	2032-03-06	长鑫科技
12		59265887	中国	40	2022-03-14	2032-03-13	长鑫科技
13		59283868	中国	42	2022-03-14	2032-03-13	长鑫科技
14		59290535	中国	9	2022-03-14	2032-03-13	长鑫科技
15	 长鑫存储	62443672	中国	9	2023-08-14	2033-08-13	长鑫科技
16	 长鑫存储	62443672A	中国	9	2022-09-07	2032-09-06	长鑫科技
17	 长鑫存储	64812675	中国	9	2023-03-28	2033-03-27	长鑫科技
18	 长鑫	59335619	中国	42	2022-06-21	2032-06-20	长鑫科技

序号	商标权	注册号	注册地	国际分类号	注册日期	有效期至	证载权利人
19	长鑫	59335762	中国	9	2022-06-21	2032-06-20	长鑫科技
20	长鑫	59339503	中国	35	2024-12-14	2034-12-13	长鑫科技
21	长鑫	59372092	中国	40	2022-05-21	2032-05-20	长鑫科技
22	长鑫	67241034	中国	9	2023-06-28	2033-06-27	长鑫科技
23	长鑫	76744837A	中国	40	2024-08-28	2034-08-27	长鑫科技
24	长鑫存储	47398565	中国	9	2023-02-28	2033-02-27	长鑫科技
25	长鑫存储	58349188	中国	35	2023-07-07	2033-07-06	长鑫科技
26	长鑫存储	58349188A	中国	35	2022-03-21	2032-03-20	长鑫科技
27	长鑫科技	79291763A	中国	9	2024-12-28	2034-12-27	长鑫科技
28	长鑫科技	79293235A	中国	40	2024-12-28	2034-12-27	长鑫科技
29	cxmt	305443047	中国香港	9	2020-11-10	2030-11-09	长鑫科技
30	cxmt	306039955	中国香港	35	2022-08-18	2032-08-17	长鑫科技
31	cxmt	306039955	中国香港	40	2022-08-18	2032-08-17	长鑫科技
32	cxmt	306039955	中国香港	42	2022-08-18	2032-08-17	长鑫科技
33	长鑫	306493915	中国香港	35	2024-03-07	2034-03-06	长鑫科技
34	长鑫	306493915	中国香港	36	2024-03-07	2034-03-06	长鑫科技
35	长鑫	306493915	中国香港	38	2024-03-07	2034-03-06	长鑫科技
36	长鑫	306493915	中国香港	40	2024-03-07	2034-03-06	长鑫科技
37	长鑫	306493915	中国香港	41	2024-03-07	2034-03-06	长鑫科技
38	长鑫	306493915	中国香港	42	2024-03-07	2034-03-06	长鑫科技

序号	商标权	注册号	注册地	国际分类号	注册日期	有效期至	证载权利人
39	长鑫存储	305603742	中国香港	9	2021-04-23	2031-04-22	长鑫科技
40		109082284	中国台湾	9	2021-08-01	2031-07-31	长鑫科技
41		111061358	中国台湾	35	2023-03-01	2033-02-28	长鑫科技
42		111061359	中国台湾	40	2023-07-01	2033-06-30	长鑫科技
43	长鑫存储	110029041	中国台湾	9	2021-12-16	2031-12-15	长鑫科技
44		111061360	中国台湾	42	2023-07-16	2033-07-15	长鑫科技
45	长鑫	113017810	中国台湾	35	2024-11-16	2034-11-15	长鑫科技
46	长鑫	113017810	中国台湾	36	2024-11-16	2034-11-15	长鑫科技
47	长鑫	113017810	中国台湾	38	2024-11-16	2034-11-15	长鑫科技
48	长鑫	113017810	中国台湾	40	2024-11-16	2034-11-15	长鑫科技
49	长鑫	113017810	中国台湾	41	2024-11-16	2034-11-15	长鑫科技
50	长鑫	113017810	中国台湾	42	2024-11-16	2034-11-15	长鑫科技
51		N/175619	中国澳门	9	2021-04-12	2028-04-12	长鑫科技
52	长鑫存储	N/181890	中国澳门	9	2021-09-09	2028-09-09	长鑫科技
53	CXMT	IR1572136	新加坡	9	2020-11-11	2030-11-11	长鑫科技
54	CXMT	IR1697172	新加坡	35	2022-10-24	2032-10-24	长鑫科技
55	CXMT	IR1697172	新加坡	40	2022-10-24	2032-10-24	长鑫科技
56	CXMT	IR1697172	新加坡	42	2022-10-24	2032-10-24	长鑫科技
57	长鑫	40202253797B	新加坡	9	2022-08-22	2032-08-22	长鑫科技
58	长鑫科技	79272173A	中国	42	2025-01-14	2035-01-13	长鑫科技
59	长鑫	76744837	中国	40	2025-05-28	2035-05-27	长鑫科技
60	长鑫科技	79293235	中国	40	2025-05-28	2035-05-27	长鑫科技
61	长鑫存储	61115051	中国	35	2025-05-21	2035-05-20	长鑫科技

序号	商标权	注册号	注册地	国际分类号	注册日期	有效期至	证载权利人
62	长鑫	62445494	中国	35	2025-05-21	2035-05-20	长鑫科技

十、员工持股平台

截至 2026 年 3 月 31 日，公司员工持股平台的具体信息如下：

层级	持股平台名称	直接或间接持有发行人股份比例	激励对象人数
第一层持股平台	合肥集鑫	8.3687%	-
第二层持股平台 1	集鑫零号	0.6240%	-
第三层持股平台 1-1	合肥集鑫壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0417%	47
第三层持股平台 1-2	合肥集鑫贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0259%	41
第三层持股平台 1-3	合肥集鑫叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0139%	41
第三层持股平台 1-4	合肥集鑫肆号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0212%	49
第三层持股平台 1-5	合肥集鑫伍号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0191%	49
第三层持股平台 1-6	合肥集鑫陆号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0172%	48
第三层持股平台 1-7	合肥集鑫柒号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0121%	47
第三层持股平台 1-8	合肥集鑫捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0209%	48
第三层持股平台 1-9	合肥集鑫玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0192%	46
第三层持股平台 1-10	合肥集鑫拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0195%	43
第三层持股平台 1-11	合肥集鑫拾壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0219%	47
第三层持股平台 1-12	合肥集鑫拾贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0174%	48
第三层持股平台 1-13	合肥集鑫拾叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0166%	49
第三层持股平台 1-14	合肥集鑫拾肆号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0148%	48
第三层持股平台 1-15	合肥集鑫拾伍号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0231%	48
第三层持股平台 1-16	合肥集鑫拾陆号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0318%	48
第三层持股平台 1-17	合肥集鑫拾柒号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0125%	49
第三层持股平台 1-18	合肥集鑫拾捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0123%	44
第三层持股平台 1-19	合肥集鑫拾玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0248%	49
第三层持股平台 1-20	合肥集鑫贰拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	0.0139%	40

层级	持股平台名称	直接或间接持有发行人股份比例	激励对象人数
第三层持股平台 1-21	合肥集鑫贰拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0143%	46
第三层持股平台 1-22	合肥集鑫贰拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0150%	48
第三层持股平台 1-23	合肥集鑫贰拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0119%	49
第三层持股平台 1-24	合肥集鑫贰拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0141%	47
第三层持股平台 1-25	合肥集鑫贰拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0110%	47
第三层持股平台 1-26	合肥集鑫贰拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0139%	49
第三层持股平台 1-27	合肥集鑫贰拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0139%	48
第三层持股平台 1-28	合肥集鑫贰拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0118%	46
第三层持股平台 1-29	合肥集鑫贰拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0096%	44
第三层持股平台 1-30	合肥集鑫叁拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0128%	49
第三层持股平台 1-31	合肥集鑫叁拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0114%	49
第三层持股平台 1-32	合肥集鑫叁拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0100%	31
第三层持股平台 1-33	合肥集鑫叁拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0151%	30
第三层持股平台 1-34	合肥集鑫叁拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0227%	33
第三层持股平台 1-35	合肥集鑫叁拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0170%	33
第三层持股平台 1-36	合肥集鑫叁拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0044%	47
第三层持股平台 1-37	合肥集鑫叁拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0041%	45
第三层持股平台 1-38	合肥集鑫叁拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0045%	40
第三层持股平台 1-39	合肥集鑫叁拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0066%	47
第三层持股平台 1-40	合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司	0.0000%	-
第二层持股平台 2	香港集鑫	0.1669%	-
第三层持股平台 2-1	Jixin Management Limited	0.1669%	-
第四层持股平台 2-1-1	Jixin I L.P.	0.1312%	167
第四层持股平台 2-1-2	Jixin II L.P.	0.0357%	79
第二层持股平台 3	合肥集鑫肆拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	7.5778%	-

层级	持股平台名称	直接或间接持有发行人股份比例	激励对象人数
第三层持股平台 3-1	合肥集鑫肆拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	3.0725%	10
第三层持股平台 3-2	合肥集鑫肆拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0698%	47
第三层持股平台 3-3	合肥集鑫肆拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0693%	47
第三层持股平台 3-4	合肥集鑫肆拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0649%	44
第三层持股平台 3-5	合肥集鑫肆拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0488%	42
第三层持股平台 3-6	合肥集鑫肆拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0623%	42
第三层持股平台 3-7	合肥集鑫肆拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0562%	44
第三层持股平台 3-8	合肥集鑫肆拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1098%	47
第三层持股平台 3-9	合肥集鑫肆拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0822%	44
第三层持股平台 3-10	合肥集鑫伍拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0581%	41
第三层持股平台 3-11	合肥集鑫伍拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0786%	42
第三层持股平台 3-12	合肥集鑫伍拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0842%	45
第三层持股平台 3-13	合肥集鑫伍拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0930%	44
第三层持股平台 3-14	合肥集鑫伍拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0915%	47
第三层持股平台 3-15	合肥集鑫伍拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0768%	44
第三层持股平台 3-16	合肥集鑫伍拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0615%	41
第三层持股平台 3-17	合肥集鑫伍拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0873%	41
第三层持股平台 3-18	合肥集鑫伍拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0883%	45
第三层持股平台 3-19	合肥集鑫伍拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0751%	45
第三层持股平台 3-20	合肥集鑫陆拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1041%	47
第三层持股平台 3-21	合肥集鑫陆拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0909%	44
第三层持股平台 3-22	合肥集鑫陆拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1776%	44
第三层持股平台 3-23	合肥集鑫陆拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1001%	43
第三层持股平台 3-24	合肥集鑫陆拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1009%	42

层级	持股平台名称	直接或间接持有发行人股份比例	激励对象人数
第三层持股平台 3-25	合肥集鑫陆拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0630%	39
第三层持股平台 3-26	合肥集鑫陆拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0872%	40
第三层持股平台 3-27	合肥集鑫陆拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0734%	43
第三层持股平台 3-28	合肥集鑫陆拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1171%	43
第三层持股平台 3-29	合肥集鑫陆拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1021%	47
第三层持股平台 3-30	合肥集鑫柒拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1376%	47
第三层持股平台 3-31	合肥集鑫柒拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0829%	42
第三层持股平台 3-32	合肥集鑫柒拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0682%	46
第三层持股平台 3-33	合肥集鑫柒拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0451%	38
第三层持股平台 3-34	合肥集鑫柒拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0673%	45
第三层持股平台 3-35	合肥集鑫柒拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0695%	46
第三层持股平台 3-36	合肥集鑫柒拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0763%	38
第三层持股平台 3-37	合肥集鑫柒拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1033%	41
第三层持股平台 3-38	合肥集鑫柒拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0745%	23
第三层持股平台 3-39	合肥集鑫柒拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0684%	42
第三层持股平台 3-40	合肥集鑫捌拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0582%	35
第三层持股平台 3-41	合肥集鑫捌拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1970%	41
第三层持股平台 3-42	合肥集鑫捌拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1559%	41
第三层持股平台 3-43	合肥集鑫捌拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0863%	42
第三层持股平台 3-44	合肥集鑫捌拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0765%	40
第三层持股平台 3-45	合肥集鑫捌拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0846%	41
第三层持股平台 3-46	合肥集鑫捌拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.6440%	-
第四层持股平台 3-46-1	合肥集鑫捌拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0166%	43
第四层持股平台 3-46-2	合肥集鑫捌拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0225%	47

层级	持股平台名称	直接或间接持有发行人股份比例	激励对象人数
第四层持股平台 3-46-3	合肥集鑫捌拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0221%	47
第四层持股平台 3-46-4	合肥集鑫玖拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0136%	34
第四层持股平台 3-46-5	合肥集鑫玖拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0162%	42
第四层持股平台 3-46-6	合肥集鑫玖拾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0131%	44
第四层持股平台 3-46-7	合肥集鑫玖拾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0176%	46
第四层持股平台 3-46-8	合肥集鑫玖拾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0163%	34
第四层持股平台 3-46-9	合肥集鑫玖拾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.1043%	29
第四层持股平台 3-46-10	合肥集鑫玖拾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0134%	42
第四层持股平台 3-46-11	合肥集鑫玖拾柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0061%	24
第四层持股平台 3-46-12	合肥集鑫玖拾捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0205%	36
第四层持股平台 3-46-13	合肥集鑫玖拾玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0430%	12
第四层持股平台 3-46-14	合肥集鑫壹佰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0205%	45
第四层持股平台 3-46-15	合肥集鑫壹佰零壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0249%	47
第四层持股平台 3-46-16	合肥集鑫壹佰零贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0244%	45
第四层持股平台 3-46-17	合肥集鑫壹佰零叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0276%	46
第四层持股平台 3-46-18	合肥集鑫壹佰零肆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0254%	37
第四层持股平台 3-46-19	合肥集鑫壹佰零伍号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0235%	42
第四层持股平台 3-46-20	合肥集鑫壹佰零陆号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0406%	41
第四层持股平台 3-46-21	合肥集鑫壹佰零柒号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0308%	49
第四层持股平台 3-46-22	合肥集鑫壹佰零捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0202%	49
第四层持股平台 3-46-23	合肥集鑫壹佰零玖号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0193%	48
第四层持股平台 3-46-24	合肥集鑫壹佰壹拾号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0414%	49
第四层持股平台 3-46-25	合肥集鑫壹佰壹拾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0202%	49
第四层持股平台 3-46-26	合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司	0.0000%	-

层级	持股平台名称	直接或间接持有发行人股份比例	激励对象人数
第三层持股平台 3-47	合肥集鑫硕驰企业管理有限责任公司	0.0353%	-

注：上表“激励对象人数”不包含因离职等原因已退出员工持股计划但尚未办理完毕工商变更的人员。

十一、募集资金运用具体情况

（一）存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目

1、项目概况

本项目拟在发行人子公司上进行技术改造，逐步实现向中高端产品生产线工艺技术的切换，包括刻蚀、薄膜沉积、清洗等工艺步骤的技术改造升级，完成工艺产品线的改造升级。通过实施本项目，一方面可以实现 DRAM 生产线的技术改造升级，降低生产成本。另一方面也可以借本次技术升级改造，同步实施本土及新型设备、材料、零部件等的导入及合作，促进产业链、供应链本土化、多元化，增强公司抗风险能力。

2、项目投资概算情况

本项目投资总额为 75.00 亿元，具体投资概算情况如下：

序号	项目	投资金额（亿元）	占投资比例
1	建筑工程费	3.34	4.45%
2	设备购置及安装费	46.66	62.22%
3	无形资产	25.00	33.33%
	合计	75.00	100.00%

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设周期为 3 年，于 2025 年三季度前完成项目的初步设计、施工图设计，于 2027 年底前分批实施厂务改造、机台搬入、机台调试、机台投产等工作，于 2028 年上半年前完成竣工验收。

4、项目的选址情况

本项目拟在发行人子公司原有厂区建设实施，不涉及新购入土地。

5、项目备案及环评情况

本项目已取得相关主管单位出具的项目备案表和环评审批意见。

（二）DRAM 存储器技术升级项目

1、项目概况

本项目拟在 DRAM 存储器示范线项目上进行技术改造，包括刻蚀、薄膜沉积、清

洗等工艺步骤的技术改造升级，核心升级内容包括工艺提升、产品迭代等。通过实施本项目，将发行人子公司提升至更新一代工艺技术平台。

2、项目投资概算情况

本项目投资总额为 180.00 亿元，具体投资概算情况如下：

序号	项目	投资金额（亿元）	占投资比例
1	设备购置及安装费	174.00	96.67%
2	预备费	6.00	3.33%
	合计	180.00	100.00%

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设周期为 3 年，于 2025 年三季度前，完成项目前期工作，包括项目的初步设计、产能规划和设备需求规划，从 2025 年第四季度开始启动设备购买计划，计划于 2026 年到 2027 年底分前分批实施设备搬入、设备调试等工作，于 2028 年上半年前完成竣工验收。

4、项目的选址情况

本项目拟在发行人子公司原有厂区建设实施，不涉及新购入土地。

5、项目备案及环评情况

本项目已取得相关主管单位出具的项目备案证明和环评批复。

（三）动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目

1、项目概况

本项目聚焦适配于未来先进 DRAM 所需要的前瞻技术研究，公司将以市场和客户需求趋势为基础，基于 DRAM 未来前沿技术发展方向，对适配 DRAM 的前瞻技术开展研发工作。发行人拟投入募集资金中的 90 亿元开展前瞻技术研发工作，拓展公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，保持公司技术持续领先性。

2、项目投资概算情况

本项目投资总额为 90.00 亿元，主要包括研发人员费用、固定资产投资、材料与备件及其他费用、测试与服务等。

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设周期为3年，计划于2026年12月前，完成引入新机台的调试，实现适配DRAM的前瞻技术平台的工艺流程搭建工作；2027年12月前，完成前瞻技术平台工艺平台与工艺开发的结构搭建与验证，并进行技术平台工艺流程的优化工作；2028年12月前，完成前瞻技术平台工艺与架构的完善，验证并提取出器件的关键电学特性工作。

4、项目的选址情况

本项目拟在发行人现有办公区及厂区实施，不涉及新购入土地。

5、项目备案及环评情况

本项目已取得相关主管单位出具的项目备案表和环评审批意见。